

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

ESWIN

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

(陕西省西安市高新区西沱南路1888号1-3-029室)

首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书

(申报稿)

本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐人（主承销商）



(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座)

发行人声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

致投资者声明

公司报告期内始终专注于 12 英寸硅片的研发、生产和销售。基于 2024 年月均出货量和截至 2024 年末产能规模统计,公司均是中國大陸第一、全球第六的 12 英寸硅片厂商,前述月均出货量和产能规模全球同期占比约为 6%和 7%。同时,截至 2024 年末,公司是中國大陸 12 英寸硅片领域拥有已授权境内外发明专利最多的厂商。公司本次上市,募集资金全部保障第二工厂建设,进一步扩大产能,增强技术力,提升行业地位,为公司经营战略目标的实现奠定基础。

一、发行人上市的目的

(一) 服务国家战略,提升国内晶圆制造产业链竞争力

硅片是芯片制造的“地基”,硅片的性能和供应能力直接影响半导体产业链的竞争力。尤其是人工智能时代需要更强的数据算力、更快的数据传输、更大的数据存储和更灵敏的人机交互,实现前述功能技术和工艺制程最主流和最先进的逻辑和存储芯片(一般 90 纳米工艺制程以下)以及部分高端模拟和传感器芯片均采用 12 英寸晶圆制造工艺,从而 12 英寸硅片是目前业界最主流规格的硅片。根据 SEMI 统计,12 英寸硅片贡献了 2024 年全球所有规格硅片出货面积的 75%以上,12 英寸产能也是目前全球晶圆厂扩产的主流方向。随着人工智能应用不断普及,未来 12 英寸硅片全球出货面积占比将持续提升。截至 2024 年末,中国大陆已有 62 座(含外资晶圆厂)12 英寸晶圆厂量产运行,预计到 2026 年底中国大陆 12 英寸晶圆厂量产数量将超过 70 座,产能将超过 300 万片/月,约占届时全球 12 英寸晶圆厂产能的 1/3。12 英寸硅片全球前五大厂商均为海外老牌企业,寡头垄断格局持续多年,2024 年全球合计出货占比约 80%,国内自给缺口显著。特别是对于先进制程芯片所需的中高端 12 英寸硅片,自给矛盾更甚,影响国内晶圆厂发展。

作为国内 12 英寸硅片头部企业,公司实现了国内一线晶圆代工厂和存储 IDM 厂大多数主流量产工艺平台的正片供货,已成为国内主流存储 IDM 厂商全球 12 英寸硅片厂商中供货量第一或第二大的供应商,已成为国内一线逻辑晶圆代工厂中国大陆 12 英寸硅片供应商中供货量第一或第二大的供应商,已成为目前国内新建 12 英寸晶圆厂的首选硅片供应商之一。公司通过本次上市募集资金

保障 50 万片/月产能的第二工厂建设,可与第一工厂形成更优规模效应,加快技术迭代,提升产品丰富度,匹配国内晶圆厂发展,提升国内半导体产业链竞争力。

(二) 放眼全球市场, 增强技术实力, 提升产品竞争力

12 英寸硅片海外需求更大,公司立足国内需求,更放眼全球市场,服务国际客户。目前公司已向客户 D、联华电子、力积电、格罗方德、客户 P、客户 O 等全球一线晶圆厂批量供货,报告期各期外销收入占比稳定在 30%左右。公司 50 万片/月产能的第一工厂于 2023 年达产,本次发行上市募投项目的第二工厂已于 2024 年正式投产,计划 2026 年达产。截至 2024 年末,公司合并口径产能已超过 70 万片/月,全球 12 英寸硅片产能占比约 7%。根据 SEMI 预测,2026 年全球 12 英寸硅片需求将超过 1,000 万片/月,通过技术革新和效能提升,公司已将第一工厂 50 万片/月产能提升至 60 万片/月以上,公司届时第一和第二两个工厂合计可实现 120 万片/月产能,跻身全球 12 英寸硅片头部厂商。

技术方面,公司已与全球战略客户形成了紧密合作、协同创新的工作机制,以满足其技术和产品竞争力持续提升的需求,更好服务于全球市场。公司产品已量产用于 2YY 层 NAND Flash 存储芯片、先进际代 DRAM 存储芯片和先进制程逻辑芯片;更先进制程 NAND Flash 存储芯片、更先进际代 DRAM 存储芯片以及更先进制程逻辑芯片的 12 英寸硅片均已经在主流客户验证。人工智能高端芯片领域,除了公司正在验证适配先进制程的高性能专用逻辑芯片外,公司也在同步配合客户开发下一代高端存储芯片,相应产品可用于 AI 大模型训练和推理数据的实时处理,可用于 AI 大模型训练数据和模型参数的定制化存储需求。

公司通过本次上市募集资金建设的第二工厂,将进一步开拓海外客户,攻关先进际代 DRAM、先进制程 NAND Flash 和更先进制程逻辑芯片所需 12 英寸硅片,持续提升产品和技术端的核心竞争力。

(三) 作为链主提升国内电子级硅片产业链的竞争力

公司持续培育本土化 12 英寸硅片装备和材料的供应商,推动上游供应链多元化,是陕西省工业和信息化厅确定的“第一批陕西省重点产业链‘链主’企业”。目前无论从上游原材料(包括耗材),还是工艺设备,公司通过合作开发不断提升本土化供应商的量产供应的比例,特别是晶体生长、硅片抛、量测等部分核心

设备、超导磁场和热场等部分关键设备的核心零部件也已实现本土供应商配套。随着公司上市融资,第二工厂将进一步推动本土化设备和材料的突破全面提升国内电子级硅片产业链的竞争力。

(四) 提升价值创造力, 为股东创造长期价值

报告期内,随着公司产能达产、产品丰富和客户验证,收入高速增长,但由于初始投资规模大、固定成本和研发投入高、高端产品认证和放量周期长,目前尚未实现盈利。公司通过上市,有助于发挥自身已经形成的客户、技术、产品和组织管理优势,提升核心竞争力,优化规模效应,加速技术迭代,打造新质生产力,提升价值创造力,实现高质量发展,为股东创造长期价值。

二、发行人现代企业制度的建立健全情况

公司建立健全了完善的现代企业制度,已按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求建立了完善的法人治理结构,公司股东大会、董事会和监事会规范运作,各项规章制度有效执行。为了切实维护股东权益,保持股利分配政策的持续性和稳定性,提高股东对公司经营和分配的监督,稳定投资者预期,公司制定了明确、清晰的上市盈利后股东分红回报规划。

三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划

本次募集资金全部用于西安奕斯伟硅产业基地二期项目,有助于公司实现产能扩张,优化产品种类,增强技术实力,加快拓展海外市场,进一步服务全球客户,增加全球市场份额,为公司经营战略目标的实现奠定基础。

四、发行人持续经营能力及未来发展规划

(一) 公司具有持续经营能力

首先，12英寸硅片需求长期向好。随着以人工智能为代表的新兴应用对芯片算力和存力要求日趋增长，全球12英寸硅片需求稳步增长，尤其是中高端硅片呈现全球需求旺盛、国内结构性紧缺的局面。作为国内12英寸硅片头部企业，公司已逐步得到全球晶圆厂客户认可，全年出货量从2022年的**234.62**万片增至2024年的**625.46**万片，期间复合增长率约**63%**。

其次，公司所处行业上下游供求关系未发生重大不利变化。上游供应商方面，公司对关键物料已通过签订长期协议、提前备货、多元化采购以及合作培育国内供应商等方式保持供应链稳定和竞争力。报告期内，公司始终专注于12英寸硅片业务，不断提升竞争力，战略客户关系不断巩固，市场地位不断提升，发行人业务的稳定性和持续性无重大不利影响。

第三，截至本招股说明书签署日，公司不存在由于工艺过时、产品落后、技术更迭、研发失败等原因导致市场占有率持续下降、重要资产或主要生产线出现重大减值风险、主要业务停滞或萎缩的情形。报告期内，公司主要财务指标逐步向好。公司营业收入从2022年的**10.55**亿元增至2024年的**21.21**亿元，复合增长率达到**41.83%**。同时，公司经营活动产生的现金流量净额2022年开始持续为正，息税折旧摊销前利润逐年增长，2023年实现转正。报告期内，对公司业务经营或收入实现有重大影响的商标、专利、软件著作权等重要资产或技术不存在重大纠纷或诉讼。

(二) 公司未来发展规划

公司坚持“以客户为中心、以技术为基石、以品质为生命、以成果为导向、以奋斗者为本、以自省促卓越”的核心价值观，秉持“成为半导体硅材料领域受人尊敬的伟大企业”的企业愿景，始终将提升产品品质、提高技术能力、丰富产品结构和股东价值最大化作为推动企业发展的重要策略。

公司已制定2020至2035年的15年长期战略规划，通过“挑战者”“赶超者”等5个阶段的努力，到2035年打造2至3个核心制造基地，若干座现代化

的智能制造工厂，实现更优经济规模，聚焦技术力、品质力和管理力，成为半导体硅材料领域全球头部企业。截至本招股说明书签署日，公司 2020 至 2023 年第一阶段“挑战者”，即国内产销规模第一的目标已实现，正在努力实现 2024 至 2026 年第二阶段“赶超者”目标。



杨新元

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

2025 年 3 月 24 日

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	本次初始发行的股票数量为 53,780.00 万股，不涉及股东公开发售股份，约占初始发行后股份总数的 13.32%。本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权的发行股票数量不超过初始发行股票数量的 15.00%
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	人民币【】元
发行日期	【】年【】月【】日
拟上市证券交易所和板块	上海证券交易所科创板
发行后总股本	不超过 403,780.00 万股（不含超额配售选择权）
保荐人（主承销商）	中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期	【】年【】月【】日

目 录

发行人声明	1
致投资者声明	2
一、发行人上市的目的	2
二、发行人现代企业制度的建立健全情况	4
三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划	4
四、发行人持续经营能力及未来发展规划	5
本次发行概况	7
目 录	8
第一节 释义	12
一、一般释义	12
二、专业释义	19
第二节 概览	24
一、重大事项提示	24
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况	31
三、本次发行概况	32
四、发行人主营业务经营情况	34
五、公司符合科创板科技创新企业定位	39
六、发行人报告期主要财务数据和财务指标	40
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况	41
八、发行人选择的具体上市标准	41
九、发行人公司治理特殊安排	41
十、募集资金运用与未来发展规划	41
第三节 风险因素	43
一、与发行人相关的风险	43
二、与行业相关的风险	44
三、其他风险	46
第四节 发行人基本情况	47
一、发行人基本信息	47

二、公司的设立情况.....	47
三、报告期内公司股本和股东变化情况.....	58
四、公司成立以来重要事件.....	62
五、公司不存在其他证券市场的上市及挂牌情况.....	67
六、发行人的股权结构.....	67
七、发行人子公司、分公司及参股公司情况.....	69
八、持有发行人百分之五以上股份的主要股东和实际控制人情况.....	75
九、发行人不存在特别表决权股份或类似安排情况.....	83
十、发行人不存在协议控制架构情况.....	83
十一、控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为.....	83
十二、发行人股本情况.....	83
十三、股东特殊权利安排的终止.....	92
十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.....	94
十五、发行人本次申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.....	107
十六、发行人的员工情况.....	111
第五节 业务与技术.....	114
一、发行人主营业务、主要产品及变化情况.....	114
二、发行人所处行业基本情况.....	124
三、发行人主要产品销售情况和主要客户.....	148
四、发行人采购情况和主要供应商.....	150
五、发行人的主要固定资产及无形资产情况.....	154
六、截至本招股说明书签署日，发行人不存在特许经营情况.....	157
七、发行人核心技术及研发情况.....	157
八、安全生产及环境保护情况.....	166
九、发行人中国台湾及境外经营情况.....	167
第六节 财务会计信息与管理层分析.....	168
一、财务会计报表.....	168
二、审计意见、关键审计事项及与财务会计信息相关的重大事项的判断标准.....	172

三、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况.....	174
四、重要会计政策及会计估计	175
五、非经常性损益	183
六、税项.....	184
七、报告期内主要财务指标	186
八、经营成果分析	187
九、资产质量分析	211
十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析	231
十一、报告期重大投资或资本性支出等事项的基本情况	236
十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等 事项.....	236
第七节 募集资金运用与未来发展规划	237
一、募集资金运用基本情况	237
二、募集资金投资项目具体情况	239
三、未来发展规划	241
第八节 公司治理与独立性.....	244
一、公司治理制度的建立健全及运行情况说明	244
二、发行人内部控制制度情况	246
三、报告期内发行人的违法违规情况.....	246
四、报告期内资金占用及对外关联担保情况.....	247
五、发行人独立运行情况.....	247
六、同业竞争	248
七、关联方及关联交易	251
第九节 投资者保护	269
一、公司投资者权益保护的情况.....	269
二、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序	269
三、股利分配政策及长期回报规划	270
四、股东投票机制建立情况	274
五、承诺事项	275

第十节 其他重要事项	276
一、重大合同	276
二、发行人对外担保有关情况	280
三、对发行人产生重大影响的诉讼或仲裁事项	281
四、发行人控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项.....	281
第十一节 声明	282
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明	283
发行人控股股东声明.....	296
发行人实际控制人声明	297
保荐人（主承销商）声明.....	299
保荐人管理层声明	300
保荐人管理层声明	301
发行人律师声明	302
会计师事务所声明	303
资产评估机构声明	304
验资机构声明	306
第十二节 附件	307
一、备查文件	307
二、文件查阅时间	307
三、文件查阅地点	307
附件一：本次发行相关承诺	308
附件二：申报前十二个月新增股东基本信息	362
附件三：发行人及其子公司拥有或使用的房屋及建筑物清单	365
附件四：发行人及其子公司拥有或使用的商标清单	370
附件五：发行人及其子公司拥有的专利权清单	383
附件六：发行人及其子公司拥有的软件著作权清单	433
附件七：发行人及其子公司拥有的业务许可或资质清单	434

第一节 释义

本招股说明书中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下涵义：

一、一般释义

公司、发行人、奕斯伟材料	指	西安奕斯伟材料科技股份有限公司
本次发行	指	公司本次申请在境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票
本次发行上市	指	公司本次申请在境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所科创板上市
招股说明书	指	西安奕斯伟材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
北京奕斯伟科技	指	北京奕斯伟科技有限公司，2016年3月设立时曾用名“北京奕思众合科技有限公司”，2016年9月更名为“北京奕斯伟科技有限公司”，2019年9月至11月连续实施两次存续分立，最终存续主体更名为“北京奕斯伟材料技术有限公司”，2020年4月进一步更名为“西安奕斯伟材料科技有限公司”，即发行人有限公司前身“奕斯伟材料有限”。如无特殊说明，“北京奕斯伟科技”仅指2019年两次存续分立完成之前的法人主体
奕斯伟材料有限	指	西安奕斯伟材料科技有限公司，为发行人有限公司前身。如无特殊说明，“奕斯伟材料有限”仅指2020年4月更名为“西安奕斯伟材料科技有限公司”之后至2023年3月股份制改制之前的法人主体
奕斯伟材料技术	指	西安奕斯伟材料技术有限公司，报告期内曾为发行人控股子公司，2022年被“奕斯伟材料有限”吸收合并后注销
奕斯伟硅片、第一工厂	指	西安奕斯伟硅片技术有限公司，目前为发行人全资子公司，发行人第一工厂法人主体
欣芯材料、第二工厂	指	西安欣芯材料科技有限公司，发行人全资子公司，发行人第二工厂法人主体，本次发行募投项目实施主体
西安硅产业基金	指	西安奕斯伟硅产业投资基金（有限合伙），报告期内曾为奕斯伟硅片的少数股东
西安奕斯伟投资	指	西安奕斯伟投资合伙企业（有限合伙），发行人控制的合伙企业，报告期内曾为西安硅产业基金的有限合伙人之一
奕斯伟材料香港	指	奕斯伟材料科技（香港）有限公司，发行人全资子公司
奕斯伟材料韩国	指	奕斯伟材料科技韩国有限公司，奕斯伟材料香港全资子公司
奕斯伟材料日本	指	奕斯伟材料科技日本株式会社，奕斯伟材料香港全资子公司

芯晖装备	指	浙江芯晖装备技术有限公司，发行人参股子公司
奕斯伟设备	指	西安芯晖设备技术有限公司，曾用名“西安奕斯伟设备技术有限公司”，报告期内曾为发行人控股子公司，2023年发行人通过换股方式转让
北京分公司	指	西安奕斯伟材料科技股份有限公司北京分公司，发行人分公司
上海分公司	指	西安奕斯伟材料科技股份有限公司上海分公司，发行人分公司
奕斯伟集团	指	北京奕斯伟科技集团有限公司，2016年3月设立时曾用名“北京奕思致远科技有限公司”，2016年8月更名为“北京奕成科技有限公司”，2019年11月更名为“北京奕斯伟科技集团有限公司”，发行人控股股东
奕明科技	指	北京奕明科技合伙企业（有限合伙），发行人控股股东奕斯伟集团的控股股东
北京奕成科技	指	北京奕成科技有限公司，奕斯伟集团2016年8月至2019年11月期间的曾用名
北京芯动能基金	指	北京芯动能投资基金（有限合伙）
北京芯动能管理公司	指	北京芯动能投资管理有限公司，北京芯动能基金的基金管理人
奕斯伟计算	指	北京奕斯伟计算技术股份有限公司，曾用名“北京奕斯伟计算技术有限公司”，北京奕斯伟科技2019年9月存续分立的派生新设主体，承接当时北京奕斯伟科技的智能化系统级解决方案业务，目前为发行人关联方
奕斯伟封测技术	指	北京奕斯伟封测技术有限公司，北京奕斯伟科技2019年11月存续分立的派生新设主体，承接当时北京奕斯伟科技的显示驱动芯片封测业务，目前已注销
奕斯伟系统技术	指	北京奕斯伟系统技术有限公司，北京奕斯伟科技2019年11月存续分立的派生新设主体，承接当时北京奕斯伟科技的板级系统封测业务，目前已注销
重庆奕能科技	指	重庆奕能科技有限公司，奕斯伟集团控股企业之一
重庆奕欣科技	指	重庆奕欣科技有限公司，奕斯伟集团控股企业之一
珠海奕源科技	指	珠海奕源科技有限公司，奕斯伟集团控股企业之一
重庆原石装备	指	重庆原石智能装备有限公司，奕斯伟集团控股企业之一
重庆欣晖材料	指	重庆欣晖材料技术有限公司，奕斯伟集团联营企业之一
西安奕斯伟产业公司	指	西安奕斯伟科技产业发展有限公司，奕斯伟集团控股企业之一
新理益集团	指	新理益集团有限公司，发行人控股股东奕斯伟集团的历史股东

宁波奕芯	指	宁波奕芯股权投资合伙企业(有限合伙), 发行人控股股东奕斯伟集团的一致行动人, 发行人持股 5%以上股东
重庆奕芯	指	重庆两江奕芯私募股权投资基金合伙企业(有限合伙), 发行人控股股东奕斯伟集团的一致行动人 , 发行人股东
奕斯欣盛	指	西安奕斯欣盛科技合伙企业(有限合伙), 直接持股的发行人员工持股平台之一, 发行人控股股东奕斯伟集团的一致行动人
欣盛一号、欣盛二号	指	西安奕斯欣盛一号科技合伙企业(有限合伙)和西安奕斯欣盛二号科技合伙企业(有限合伙), 奕斯欣盛的有限合伙人
奕斯欣诚	指	西安奕斯欣诚科技合伙企业(有限合伙), 直接持股的发行人员工持股平台之一, 发行人控股股东奕斯伟集团的一致行动人
欣诚一号、欣诚二号	指	西安奕斯欣诚一号科技合伙企业(有限合伙)和西安奕斯欣诚二号科技合伙企业(有限合伙), 奕斯欣诚的有限合伙人
奕斯欣合	指	西安奕斯欣合科技合伙企业(有限合伙), 直接持股的发行人员工持股平台之一, 发行人控股股东奕斯伟集团的一致行动人
欣合一号、欣合二号、欣合三号、欣合四号、欣合五号	指	西安奕斯欣合一号科技合伙企业(有限合伙)、西安奕斯欣合二号科技合伙企业(有限合伙)、西安奕斯欣合二号科技合伙企业(有限合伙)、西安奕斯欣合三号科技合伙企业(有限合伙)、西安奕斯欣合四号科技合伙企业(有限合伙)、西安奕斯欣合五号科技合伙企业(有限合伙), 奕斯欣合的有限合伙人
陕西集成电路基金	指	陕西省集成电路产业投资基金(有限合伙), 发行人持股 5%以上股东
二期基金	指	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司, 发行人持股 5%以上股东
天津博思	指	天津博思纵横股权投资合伙企业(有限合伙), 发行人股东
三行资本	指	咸宁三行智赢资产管理中心(有限合伙), 发行人股东
博华资本	指	张家港博华创业投资合伙企业(有限合伙), 曾用名“宁波梅山保税区博华光证创业投资合伙企业(有限合伙)”和“宁波梅山保税区博华光诚创业投资合伙企业(有限合伙)”, 发行人历史股东
宁波庄宣	指	宁波庄宣投资合伙企业(有限合伙), 发行人股东
中建材新材料基金	指	中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙), 发行人股东
嘉兴隼望	指	嘉兴隼望股权投资合伙企业(有限合伙), 发行人股东
渝富芯材	指	重庆渝富芯材私募股权投资基金合伙企业(有限合伙), 发行人股东
中芯熙诚	指	扬州中芯熙诚兴奕创业投资合伙企业(有限合伙), 发行人股东

国寿惠泉	指	江苏惠泉成达股权投资中心(有限合伙), 曾用名“江苏国寿惠泉股权投资中心(有限合伙)”, 发行人股东
西安汇奕	指	西安汇奕股权投资基金合伙企业(有限合伙), 发行人股东
中证投资	指	中信证券投资有限公司, 发行人股东
中网投	指	中国互联网投资基金(有限合伙), 发行人股东
嘉兴顾嘉	指	嘉兴顾嘉股权投资合伙企业(有限合伙), 发行人股东
陕西民营基金	指	陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业(有限合伙), 发行人股东
创合材丰	指	创合材丰(厦门)投资合伙企业(有限合伙), 发行人股东
众励投资	指	珠海众励投资企业(有限合伙), 发行人股东
宏兆天实	指	宏兆天实(珠海)基金管理合伙企业(有限合伙), 发行人股东
长峡金石	指	长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙), 曾用名“三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)”, 发行人股东
烟台中冀	指	烟台中冀股权投资基金管理中心(有限合伙), 发行人股东
建投投资	指	建投投资有限责任公司, 发行人股东
北京硅新	指	北京硅新科技发展中心(有限合伙), 发行人股东
苏州芯动能	指	苏州芯动能硅片科技创业投资合伙企业(有限合伙), 发行人股东
泓生嘉启	指	天津泓生嘉启股权投资合伙企业(有限合伙), 发行人股东
睿势六期	指	无锡睿势六期创业投资合伙企业(有限合伙), 发行人股东
钛信九期	指	温州钛信九期股权投资合伙企业(有限合伙), 发行人股东
川投金石	指	四川川投金石康健股权投资基金合伙企业(有限合伙), 发行人股东
建银国际	指	建银国际资本管理(天津)有限公司, 发行人股东
广东星耀	指	广东星耀三号股权投资合伙企业(有限合伙), 发行人股东
源轩投资	指	无锡源轩股权投资合伙企业(有限合伙), 发行人股东
惠泉绿色基金	指	江苏惠泉绿色产业股权投资基金(有限合伙), 发行人股东
上海澜翎	指	上海澜翎科技中心(有限合伙), 发行人股东
普耀芯业	指	北京吉富普耀芯业科技中心(有限合伙), 曾用名为“北京普耀芯业科技中心(有限合伙)”, 发行人股东
国合新力	指	奕天(潍坊)产业投资合伙企业(有限合伙), 发行人股东
上海综改基金	指	上海国资国企综改试验私募基金合伙企业(有限合伙), 发行人股东

华泰紫金	指	南京华泰紫金新兴产业基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
长安汇通	指	陕西省汇创上市后备企业股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
江阴毅达	指	江阴毅达高新创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
越秀智创	指	广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
道禾源信	指	上海道禾源信一期私募基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
博达奕行	指	徐州博达奕行创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
中小企业基金	指	江苏中小企业发展基金（有限合伙），曾用名为“中小企业发展基金（江苏有限合伙）”，发行人股东
东方电气基金	指	东方电气（成都）氢能股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
嘉兴翊榛	指	嘉兴翊榛创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
烟台伯和	指	烟台伯和投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
天堂硅谷领新	指	绍兴柯桥天堂硅谷领新股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
天堂硅谷恒新	指	武汉天堂硅谷恒新创业投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
青岛远润	指	青岛远润奕达股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
宁波卓煌	指	宁波卓煌企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
国开科创	指	国开科技创业投资有限责任公司，发行人股东
佰仕德	指	武汉佰仕德新势能私募股权投资中心（有限合伙），发行人股东
光子强链	指	陕西光子强链创新创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
鑫华半导体	指	江苏鑫华半导体科技股份有限公司，发行人股东及电子级多晶硅原厂供应商
盛剑科技	指	上海盛剑科技股份有限公司（603324.SH），发行人股东
海南瑞麟	指	海南瑞麟贰号投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
上海道禾	指	上海临港新片区道禾一期产业资产配置股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人历史股东
毅达鑫业	指	上海毅达鑫业一号股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人历史股东
京东方	指	京东方科技集团股份有限公司（000725.SZ），全球半导体显示产业龙头企业
信越化学	指	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.，总部位于日本，证券代码 4063.T，全球产能和出货量排名第 1 的 12 英寸硅片厂商

SUMCO	指	SUMCO Corporation, 总部位于日本, 证券代码 3436.T, 全球产能和出货量排名第 2 的 12 英寸硅片厂商
环球晶圆	指	环球晶圆股份有限公司, 总部位于中国台湾, 证券代码 6488.TWO, 全球产能和出货量排名前 5 的 12 英寸硅片厂商
德国世创	指	Siltronic AG, 总部位于德国, 证券代码 WAF.DF, 全球产能和出货量排名前 5 的 12 英寸硅片厂商
SK Siltron	指	SK Siltron Co., Ltd., 总部位于韩国, 全球产能和出货量排名前 5 的 12 英寸硅片厂商
全球前五大厂商	指	信越化学、SUMCO、环球晶圆、德国世创、SK Siltron 的合称
沪硅产业	指	上海硅产业集团股份有限公司, 证券代码 688126.SH, 专注于电子级硅片, 发行人可比上市公司
上海新昇	指	上海新昇半导体科技有限公司, 沪硅产业全资子公司, 专注于 12 英寸硅片
TCL 中环	指	TCL 中环新能源科技股份有限公司, 证券代码 002129.SZ, 业务涵盖光伏级和电子级硅片, 以光伏级硅片为主
中环领先	指	中环领先半导体材料有限公司, TCL 中环下属专注于电子级硅片的控股子公司, 业务涵盖 8 英寸及以下和 12 英寸硅片
徐州鑫晶	指	曾用名“徐州鑫晶半导体科技有限公司”, 专注于 12 英寸硅片, 中环领先收购后更名为“中环领先(徐州)半导体材料有限公司”
立昂微	指	杭州立昂微电子股份有限公司, 证券代码 605358.SH, 业务涵盖功率器件和电子级硅片等, 旗下的浙江金瑞泓科技股份有限公司、金瑞泓科技(衢州)有限公司、金瑞泓微电子(衢州)有限公司等公司专注于不同规格的电子级硅片业务
金瑞泓微电子	指	金瑞泓微电子(衢州)有限公司, 立昂微下属专注于 12 英寸硅片的控股子公司
国晶半导体	指	曾用名“国晶(嘉兴)半导体有限公司”, 专注于 12 英寸硅片, 金瑞泓微电子收购后更名为“金瑞泓微电子(嘉兴)有限公司”
中欣晶圆	指	杭州中欣晶圆半导体股份有限公司, 国内电子级硅片企业, 业务涵盖 8 英寸及以下和 12 英寸硅片
有研硅	指	有研半导体硅材料股份公司, 证券代码 688432.SH, 国内电子级硅片企业, 业务涵盖 8 英寸及以下电子级硅片和刻蚀用硅材料
山东有研艾斯	指	山东有研艾斯半导体材料有限公司, 有研硅参股子公司, 专注于 12 英寸硅片
上海超硅	指	上海超硅半导体股份有限公司, 国内电子级硅片企业, 业务涵盖 8 英寸及以下和 12 英寸电子级硅片

长鑫存储	指	长鑫科技集团股份有限公司及其下属公司
长江存储	指	长江存储科技有限责任公司
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造有限公司（证券代码 688981.SH）及其下属公司
台积电	指	中国台湾积体电路制造股份有限公司（证券代码 2330.TW）及其下属公司，总部位于中国台湾
华虹集团	指	上海华虹（集团）有限公司及其下属公司
晶合集成	指	合肥晶合集成电路股份有限公司（证券代码 688249.SH）
联华电子	指	联华电子股份有限公司（证券代码 UMC.N）及其下属公司，总部位于中国台湾
格罗方德	指	GLOBAL FOUNDRIES Inc.（证券代码 GFS.O）及其下属公司，总部位于美国
力积电	指	力晶积成电子制造股份有限公司（证券代码 6770.TW）及其下属公司，总部位于中国台湾
三星电子	指	三星电子有限公司（证券代码 005930.KS），总部位于韩国，业务涉及半导体和半导体显示、消费电子和信息技术与移动通信三大领域
SK 海力士	指	SK Hynix Inc.（证券代码 000660.KS）及其下属公司，总部位于韩国，全球主要的 DRAM 和 NAND Flash 厂商
华立股份	指	华立企业股份有限公司，证券代码 3010.TW，总部位于中国台湾，半导体制造用材料及设备、资讯通讯用材料及设备等领域的专业贸易商
SVM	指	Silicon Valley Microelectronics, Inc.，总部位于美国，全球最大的硅片专业分销商之一
连云港众成	指	连云港众成磨料有限公司
赛米芯技术	指	赛米芯技术（北京）有限公司
《公司章程》	指	《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》及其历次修订版本
《公司章程（草案）》	指	《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程（草案）》，将于公司首次公开发行股票并在科创板上市后生效实施
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	西安奕斯伟材料科技股份有限公司股东大会
董事会	指	西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

监事会	指	西安奕斯伟材料科技股份有限公司监事会
保荐人	指	中信证券股份有限公司
竞天公诚	指	北京市竞天公诚律师事务所
毕马威会计师	指	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
天健兴业	指	北京天健兴业资产评估有限公司
报告期	指	2022年、2023年和2024年
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
财政部	指	中华人民共和国财政部
统计局	指	中华人民共和国国家统计局
税务总局	指	中华人民共和国国家税务总局
海关总署	指	中华人民共和国海关总署
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	除特别注明的币种外,指人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、专业释义

半导体器件	指	半导体器件是导电性介于导体与绝缘体之间,利用半导体材料特殊电特性来完成特定功能的电子器件,可用来产生、控制、接收、变换、放大信号和进行能量转换,常见的半导体材料有硅、锗或砷化镓。根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)定义,半导体器件按结构功能可分为集成电路、分立器件、光电子器件和传感器四大类,广泛应用于下游通信、计算机、消费电子、网络技术、汽车及航空航天等产业
半导体衬底材料	指	电阻率介于导体与绝缘体之间的材料,作为半导体器件制造的衬底。根据元素组分可分为元素半导体衬底材料和化合物半导体衬底材料,硅和锗是最常见的元素半导体衬底材料,化合物半导体材料是由两种或两种以上的元素化合而成的半导体衬底材料,如砷化镓、碳化硅等,硅片是目前主流的半导体衬底材料
集成电路/芯片	指	Integrated Circuit,简称IC,指通过一系列的加工工艺,将一个电路所需的晶体管、二极管等有源器件和电阻器、电容器等无源元件集成在半导体晶片上,成为具有所需电路功能的微型结构,执行特定功能的电路

		或系统, 集成电路是半导体器件产品家族主要的组成部分。根据 WSTS 定义可进一步细分为逻辑芯片、存储器、微处理器和模拟芯片四类
晶圆	指	在硅片上, 经过氧化/扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜生长、清洗与抛光、金属化等特定工艺加工后的半导体器件
逻辑芯片	指	以二进制为原理、实现数字信号逻辑运算和处理的芯片。根据 WSTS 定义, 功能原理一致的微处理器(包括电脑 CPU/GPU、手机 SOC、嵌入式 MCU 等)为逻辑芯片的并列芯片品类。为表述方便, 本招股说明书中逻辑芯片包括集成电路中逻辑芯片和微处理器两大品类
存储芯片	指	集成电路的主要品类, 用来存放程序和数据, 具体包括 DRAM、NAND Flash 和 Nor Flash 等不同产品
功率器件	指	用于电力设备的电能变换和控制电路的分立器件, 也称电力电子器件, 是半导体分立器件中的主要产品, 具体包括功率二极管、功率晶体管、功率晶闸管、MOSFET、IGBT 等不同品类
电子级硅片	指	用于除光电子器件外的半导体产品中的大多数集成电路、分立器件和传感器制造的衬底材料。根据硅片直径长度不同, 可分为 8 英寸以下、8 英寸和 12 英寸; 根据制造工艺不同, 可分为抛光片、外延片和 SOI 硅片等; 根据掺杂剂和掺杂浓度的区别, 可分为 P 型轻掺/重掺硅片和 N 型轻掺/重掺硅片
12 英寸硅片	指	12 英寸电子级硅片, 对应硅片直径为 300mm
正片	指	可用于晶圆量产制造的 12 英寸硅片, 本招股说明书中发行人的正片产品包括抛光片和外延片两大类
抛光片	指	以电子级多晶硅为原料, 通过直拉法拉晶制成单晶硅棒, 之后经过成型、抛光、清洗等工序形成的电子级硅片, 主要用于 DRAM、NAND Flash 等存储芯片制造
外延片	指	在抛光片所需工序基础上, 经过外延工序形成的电子级硅片, 主要用于 CPU\GPU\手机 SOC\嵌入式 MCU 为代表的逻辑芯片制造
测试片	指	用于晶圆厂对产线设备工艺环境的调试和检测的 12 英寸硅片, 并不直接用于晶圆制造。由于应用要求不同, 测试片具有不同的等级, 不同等级测试片之间产品技术参数和单价有明显差别
高端测试片	指	可应用于客户 28 纳米及以下工艺制程特定需求的测试片产品。该产品从单晶硅棒品质、硅片技术参数和销售价格等方面与抛光片正片接近
SOI 硅片	指	Silicon on Insulator, 绝缘底上硅, 电子级硅片的一种, 发行人尚未生产该产品
P 型/N 型硅片	指	硅片为半导体衬底材料, 具有双向导电性(电子/空穴), 通过掺杂不同元素对其载流子进行调控, 从而达到半导体器件需要的导电性能。根据掺杂元素的不同, 可分为 P 型/N 型硅片。P 型硅片掺入三价硼, 提供空

		穴，以空穴为多数载流子，电子为少数载流子。N型硅片主要掺入五价的磷或砷，提供自由电子，以电子为多数载流子，空穴为少数载流子
轻掺/重掺硅片	指	半导体衬底材料的导电性能通过掺杂剂进行调节，体现在电阻率上。通常情况下，掺杂浓度越低，电阻率越高，称之为轻掺硅片，适用于低功耗芯片。反之，重掺硅片掺杂浓度大，电阻率低，称之为重掺硅片，适用大功率的功率器件
多晶硅	指	由具有一定尺寸的硅晶粒组成的多晶体，各个硅晶粒的晶体取向不同，是生产单晶硅棒的直接原料
电子级多晶硅	指	12英寸硅片制作所需的电子级多晶硅为硅含量达到99.999999999%（11个9）的多晶硅颗粒或块状原料
单晶硅棒	指	多晶硅通过直拉法生长成的棒状硅单晶体，晶体形态为单晶，即各个硅晶粒的晶体取向相同
晶锭	指	拉晶工艺形成的单晶硅棒截断后的半成品形态
直拉法	指	切克劳斯基（Czochralski）方法，由波兰人切克劳斯基在1917年发明，采用单晶硅为籽晶，沿垂直方向从硅熔体中拉制单晶硅棒的方法，目前85%的单晶硅棒均用直拉法制备
拉晶设备	指	在惰性气体保护的低压环境下，实现晶体由加热、熔化、引晶、转肩、等径生长和收尾的晶体生长工艺设备
热场	指	拉晶设备内提供加热、热传导和保温的部件总称。热场为单晶硅棒生长各阶段提供所需的温度分布，是拉晶设备核心部件，主要材料为石墨
超导磁场	指	为拉晶设备提供稳定超导磁场的部件总称，超导磁场可更好控制晶体生长，提升单晶硅棒质量
退火	指	一种材料的热处理工艺，指的是将特定材料加热到一定温度，保持足够时间，然后以适宜速度冷却。目的是降低材料硬力和残余应力，调整组织，消除组织缺陷
化学气相沉积	指	Chemical Vapor Deposition，化学气相沉积技术，是指把含有构成薄膜元素的反应气体，在晶圆表面化学反应合成薄膜的方法，是半导体工业中应用最为广泛的薄膜沉积技术
制程	指	制程亦称为节点或特征线宽，用来衡量半导体芯片制造的工艺水准，线宽越低，则制程水平越高
DRAM	指	Dynamic Random Access Memory，动态随机存取存储器，是电脑和手机等系统中广泛使用的内存。DRAM断电后数据即消失，是一种易失性存储器
1X/1Y/1Z/1 α / 1 β /1 γ 际代	指	DRAM芯片工艺制程进入20纳米之后，由于制造工艺难度加大，厂商对工艺的定义已不是具体的线宽，而是将10-20纳米工艺范围分成至少

		6代产品,按工艺精密程度从低到高依次为1X际代、1Y际代、1Z际代、1α际代、1β际代和1γ际代
高带宽内存(HBM)	指	特定类型的DRAM产品,主要用于数据吞吐量大的高性能计算、AI大模型训练等应用场景。产品结构方面,HBM将多个DRAM芯片堆叠互联,再进一步与GPU内核封装集成为一个大芯片
NAND Flash	指	闪存,基于浮栅晶体管的NAND存储器,该类存储器的突出特点是数据存储状态不会因为断电而改变,因此是一种非易失存储器。常用作固态硬盘、物联网设备、存储卡、U盘等,目前主要采用3D堆叠结构,单个芯片的堆叠层数越高,则工艺难度和水平越高
Nor Flash	指	NOR型闪存,一种非易失性存储器,常用于嵌入式系统和存储设备中
MOSFET	指	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属-氧化物半导体场效应晶体管,功率器件的一种
IGBT	指	Insulate-Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极晶体管,功率器件的一种
CIS	指	CMOS Image Sensor,互补金属氧化物半导体图像传感器,一种基于半导体CMOS工艺的图像传感器,高端CIS芯片采用传感器晶圆和逻辑电路晶圆堆叠工艺制造,产品广泛使用于手机、汽车电子、安防等
IDM	指	Integrated Device Manufacture,垂直整合制造,指垂直整合制造商独立完成集成电路设计、晶圆制造、封装测试的全产业链环节
AMHS系统	指	Automated Material Handling Systems,物料自动化搬运系统,由OHT(天车)集群、移动机器人、交通控制系统、仓储系统等软硬件系统共同构成,主要应用于12英寸硅片厂和晶圆厂,通过空中轨道和移动机器人实现晶圆载具在不同工序的设备之间自动化传输
PLM系统	指	Product Lifecycle Management,产品生命周期管理系统
MES系统	指	Manufacturing Execution System,制造执行系统
EAP系统	指	Equipment Automation Programming,设备自动化程序,实现了对生产线上机台的实时监控
FGMS系统	指	Finished Goods Management System,成品仓库管理系统是一个用于管理成品库存、仓库操作和物流流程的软件系统
DDP	指	Delivered Duty Paid,国际贸易术语,完税后交货。即卖方在指定的目的地,将货物交给买方,即完成交货和风险转移,卖方负责进口清关
DAP	指	Delivered At Place,国际贸易术语,指定目的地交货。即卖方在指定的目的地,将货物交给买方,即完成交货和风险转移,与DDP不同,DAP由买方负责进口清关手续和费用
FCA	指	Free Carrier,国际贸易术语,货交承运人。即卖方将货物在指定的地点交给买方指定的承运人,即完成交货和风险转移,卖方负责出口清关

EXW	指	Ex-works , 国际贸易术语, 工厂交货。即卖方在其指定的地点(如卖方工厂或仓库等)将货物交给买方, 即完成交货和风险转移
CIP	指	Carriage and Insurance Paid to , 国际贸易术语, 运费、保险费付至指定目的地。即卖方将货物交给买方指定的承运人, 即完成交货和风险转移, 但卖方需承担后续货物运至指定目的地的运费和保险费
CIF	指	Cost, Insurance and Freight , 国际贸易术语, 成本、保险费和运费。卖方将货物装载至买方指定货运船并越过船弦, 即完成交货和风险转移, 但卖方需完成出口报关, 并承担后续航运费和保险费
Know-How	指	非标工业自动化行业技术诀窍, 是随着企业不断自主研发设计、生产优化而总结积累的关于设计路线、设备集成、操作要点、性能指标控制等方面的技术经验
毫米	指	毫米, 10^{-3} 米
微米	指	微米, 10^{-6} 米
纳米	指	纳米, 10^{-9} 米
SEMI	指	Semiconductor Equipment and Materials International , 国际半导体设备材料产业协会
WSTS	指	World Semiconductor Trade Statistics , 世界半导体贸易统计组织
TEHCET	指	TEHCET CA LLC , 是一家专注于电子材料技术和全球半导体等行业材料市场分析的咨询服务公司

特别说明: 本招股说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据招股说明书中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

本招股说明书所引用的有关行业的统计及其他信息, 均来自不同的公开刊物、研究报告及行业专业机构提供的信息, 但由于引用不同来源的统计信息可能其统计口径有一定的差异, 故统计信息并非完全具有可比性。

第二节 概览

本概览仅针对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、重大事项提示

(一) 特别风险因素

本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定，并特别关注其中的以下风险因素：

1、作为全球 12 英寸硅片的新进入“挑战者”，在波动的半导体周期中面临行业固有的投资强度大、技术门槛高、客户认证及正片放量周期长的挑战，报告期内公司扣除非经常性损益后尚未实现盈利，最近一期期末存在未弥补亏损

报告期各期，公司营业收入分别为 105,469.31 万元、147,376.14 万元和 **212,145.26 万元**，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为 -41,553.42 万元、-69,233.88 万元和 **-76,255.09 万元**，尚未实现盈利。截至 2024 年末，公司合并报表及母公司未分配利润分别为 **-192,750.64 万元**和 **-49,592.97 万元**，存在未弥补亏损。

公司报告期内尚未实现盈利，主要系：1) 12 英寸硅片在半导体产业链中单位产能投资强度仅次于晶圆厂。公司第一工厂总投资额高达 110 亿元，已经达产；第二工厂总投资额高达 125 亿元，2024 年已投产，目前主体厂房已整体转固，产线设备陆续转固，报告期内公司持续产能爬坡带来固定成本逐年增长。在波动的半导体周期中快速提升收入、释放规模效应、覆盖高额固定成本是公司实现盈利的最大挑战；2) 12 英寸硅片目前主要应用于制程更先进、技术迭代更快的逻辑和存储芯片，与下游晶圆制造相适应的硅片研发投入亦不断增加。随着芯片制程越先进，线宽越小，12 英寸硅片上极其微小的高度差和颗粒污染都会使芯片布线图发生变形、错位，影响晶圆制造良率。作为新进入“挑战者”，公司不仅需要快速设备调试、产能爬坡、实现达产，持续提升良率和优化成本；同时需契合下游客户技术路线迭代，持续对拉晶、成型、抛光、清洗和外延五大核心

工艺进行研发投入,持续根据客户需求进行产品丰富和升级。产能爬坡带来的阶段性产销量不足导致生产成本高以及针对核心技术和产品工艺的前期刚性研发投入影响公司短期盈利能力;3) 12英寸硅片下游行业集中度高,新进入者需要经历供应商准入、测试片认证、正片认证三个主要阶段方能获取正片量产订单,周期一般1-2年甚至更长,高单价正片收入方能开始逐步放量。而台积电、三星电子等全球战略级晶圆厂客户,是全球12英寸硅片采购主力,但认证条件更苛刻,产品要求更高端,叠加复杂的国际环境,公司对全球战略级客户提升收入规模,尤其是高端产品放量所需的周期更长,进一步增加盈利难度。

综上,参考国内外友商发展路径,新进入“挑战者”一般需经历4-6年的经营亏损期。报告期内,随着持续扩产,公司第一工厂和第二工厂计入营业成本的折旧摊销金额合计为3.20亿元、6.15亿元和9.31亿元,逐年攀升。随着第二工厂产线陆续转固直至2026年达产,可预见2025年和2026年公司计入营业成本的折旧摊销金额将持续增加,进一步增加盈利压力。如果公司持续亏损,短期无法对投资者分红,对公司发展产生不利影响。

2、公司服务全球客户,面对全球前五大厂商在12英寸硅片领域多年寡头垄断竞争格局的风险以及国内厂商同台竞争的风险

2024年,全球12英寸硅片约80%的出货量来自全球前五大厂商,寡头垄断格局已持续多年。作为新进入“挑战者”,与国际同业相比,公司在产能规模、产品品类、下游产品制程先进性和客户议价能力等方面存在一定差距。尤其是全球前五大厂商开展12英寸硅片业务大多早于公司15年以上,无论是下游台积电、三星电子等全球战略级晶圆厂客户,还是上游电子级多晶硅、石英制品和硅片工艺设备等核心设备和材料供应商,均已形成稳定合作(包括但不限于签订确保最低采购量的长期协议、优先参与客户更先进制程晶圆工艺的研发等),甚至是控股或参股的投资关系。同时,国际友商对硅晶体的基础理论研究、晶体生长和硅片加工具有深厚的技术底蕴,建立了森严的专利技术壁垒,具有技术先发优势。此外,相应厂商前期高额的设备投入部分已折旧完毕,固定成本压力小,生产工艺相对成熟,良率相对稳定,已实现规模效应,且正片及正片中的外延片出货和收入占比更高,具有较好的盈利能力。

此外,部分国内友商起步早于发行人,随着长期研发和产能投入,已形成一定市场规模,与发行人共同提升 12 英寸硅片国产化率。

面对全球和国内竞争,若公司不能有效开拓全球战略级客户、增强资本实力、持续提升产能和收入规模、提升正片和正片中外延片比例、夯实技术储备,将与全球前五大厂商的差距进一步拉大,将无法与国内友商进一步拉开竞争身位,可能导致公司市场竞争力下降,无法实现公司的经营战略和业绩目标。

3、公司研发不能紧跟半导体工艺制程演进和客户技术迭代的风险

目前全球最先进的 3 纳米逻辑芯片、1 β 际代 DRAM 和 2YY 层堆叠结构 NAND Flash 均实现量产。遵循“一代技术、一代工艺、一代材料”的规律,下游技术迭代对 12 英寸硅片的晶体缺陷控制水平、低翘曲度、超平坦度、超清洁度和外延膜层形貌与电学性能的要求愈发苛刻。对于同一代工艺制程、不同客户技术路线和指标各有差异,公司需紧跟行业技术路线和客户要求研发相匹配产品,并且持续优化工艺降本增效。此外,公司目前产品主要为 P 型硅片,随着越来越多功率器件由 8 英寸硅片转向 12 英寸硅片,公司对应的 N 型硅片也需进一步研发或客户导入。

截至本招股说明书签署日,公司产品尚未应用于全球最先进制程的芯片工艺。若公司研发不能及时满足客户工艺制程演进,不能紧跟客户产品的更新迭代,无法切入全球战略级晶圆厂客户的先进制程工艺,未来经营业绩将受到不利影响。

4、国际贸易摩擦的风险

报告期内,公司采购的部分原材料和生产设备主要来自日本、韩国、美国等国家厂商,同时公司产品已向中国台湾、日本、美国、新加坡等地客户批量供货,报告期各期,公司外销主营业务收入占比稳定在 30%左右。公司的进口采购和外销受前述国家或地区的政治经济环境影响较大,尤其是部分国家或地区对中国大陆原产的特定品类 12 英寸硅片限制进口或提高关税。若该等国家或地区继续提高关税、设置更严格的进口限制条件或其他贸易壁垒,将对公司经营产生不利影响。

目前,由于国际贸易摩擦等多种因素,发行人部分下游客户获取更先进制程

或特定规格的半导体用技术、软件、材料和设备等生产要素的能力受到影响，导致其产能扩张和工艺制程迭代放缓，可能对发行人销售产生不利影响。若国际贸易摩擦进一步升级，如限制公司产品进一步出海，或难以切入海外战略级晶圆厂客户的先进制程工艺，可能对公司经营和发展带来不利影响。

5、产品结构尚需优化的风险

公司作为新进入“挑战者”，产品需要遵循从测试片到正片逐步认证、依次放量的客观过程。随着正片认证陆续通过和客户正片采购需求波动，报告期各期，单价更高的正片主营业务收入占比分别为**53.83%**、**50.21%**和**56.10%**。公司正片收入占比对比国际同业仍需进一步提升，产品结构的优化能够提升公司综合销售单价和盈利水平。

正片中的外延片下游主要为晶圆代工厂。外延片在 12 英寸硅片中单价高、技术难度大、客户认证周期长，尤其是应用于先进制程逻辑芯片工艺的外延片产品。由于半导体行业和下游晶圆代工厂需求波动、以及全球前五大厂商与主要晶圆代工厂执行保有最低采购量的长期协议等因素，公司外延片产能利用率尚需提升，单位固定成本高。报告期各期，公司外延片毛利率分别为**-0.84%**、**-30.31%**和**5.47%**，虽 2024 年已实现毛利率转正，但仍相对较低。高端产品收入放量需要过程，外延片占比不足一定程度影响公司目前盈利水平。

如果公司因为自身技术研发、下游客户需求不足或客户认证周期过长，长期无法提升正片及正片中的外延片出货和收入占比，将对公司经营带来不利影响，可能无法实现最早于 2026 年公司合并报表盈利的目标。

6、存货跌价风险

报告期内，随着公司产能持续扩张，存货规模随之匹配，逐年大幅提升，各期末存货账面余额分别为**70,948.86**万元、**111,910.53**万元和**124,651.02**万元；2022年至2024年，公司存货周转率分别为**2.03**、**1.59**和**1.69**。鉴于产能持续爬坡，公司产品单位固定成本高，同时叠加行业波动，部分类别产品报告期内存在“负毛利”情况，报告期各期直接计入损益的存货跌价损失分别为**26,681.15**万元、**33,184.31**万元和**25,570.48**万元，金额整体略有下降。如果未来公司产品销售价格发生重大不利变化，或者受到第二工厂产能爬坡影响，可

能需要进一步计提对应的存货跌价准备,影响公司的盈利水平。

7、控制权稳定风险

本次发行前,控股股东奕斯伟集团直接持股比例为**12.73%**,与一致行动人宁波奕芯、重庆奕芯和奕斯欣盛、奕斯欣诚、奕斯欣合三个员工持股平台合计持股比例为**25.68%**,不足**30%**。本次发行后,控股股东直接持股比例与一致行动人合计表决权比例将被进一步稀释,可能对公司的控制权稳定产生不利影响。

此外,发行人控股股东奕斯伟集团控制的奕斯伟计算已实施多轮股权融资。根据奕斯伟集团与奕斯伟计算现有投资人签署的相关协议约定,特定情形下奕斯伟集团需承担回购投资人股权的义务。若前述特定情形实际发生,且奕斯伟集团没有足额自有或自筹资金,奕斯伟集团存在通过出售发行人股份筹措资金来履行前述回购义务的潜在风险。

(二)报告期内公司毛利率低于同行业可比公司平均水平,且在不考虑存货跌价准备转销等因素影响下,公司主营业务毛利率尚未转正

报告期内,公司主营业务毛利率为**9.85%、0.66%和5.49%**,低于同期可比公司平均水平。若剔除存货跌价准备转销等因素影响,公司主营业务毛利率分别为**-9.71%、-16.12%和-8.79%**,尚未转正,整体呈现“负毛利”收窄趋势。

公司第一工厂**50万片/月**产能已于**2023**年达产,公司第二工厂**2024**年已投产,目前主体厂房已整体转固,产线设备陆续转固。报告期内产能爬升持续带来的固定成本持续增长限制了公司毛利释放;此外,由于半导体行业波动,下游晶圆厂采购放缓,叠加全球前五大厂商在半导体景气周期与晶圆代工厂签订确保最低采购量的长期协议的“挤出”效应,公司高附加值产品放量被制约,产品结构尚需优化,导致报告期内产品综合销售单价低于同业,虽然销量增长,但收入规模释放受到影响。综上,由于发行人报告期内固定成本持续攀升,收入规模释放尚需时间,不考虑存货跌价转销等因素后的毛利率尚未转正具有合理性。

随着公司在主要客户中采购占比不断提升、高端产品持续验证放量、技术迭代和工艺优化稳定推进,**2024**年公司正片主营业务收入占比超过**55%**,单价最高的外延片主营业务收入占比已达到**16%**,相应比例同比**2023**年均不同程度

提升。报告期内，公司单位营业成本（不考虑存货跌价转销等因素影响）持续降低，2024年该指标已低于国内同业2023年水平。

未来公司将不断提升已有客户采购占比和采购规模，进一步拓展全球客户，不断优化产品销售结构；同时基于自身规划的技术和产品路线图，持续切入先进制程和特色工艺产品，提升产品竞争力；最后，通过生产和管理效率提升、工艺优化以及供应链多元化，持续改善产品成本和运营效率。前述措施的履行在报告期内已取得良好效果，公司毛利率持续改善具有切实可行的路径。

（三）公司报告期内尚未实现盈利的特别事项及前瞻性信息

可预见的未来，公司能够保持良好的持续经营能力。公司管理层根据已有的产能建设及投放、技术研发、客户验证和销售计划，预计公司最早可于2026年实现合并报表盈利。根据公司前瞻性信息预计，2026年月均出货量达到110万片/月，当年外延片销量占比达到15%是大致的盈亏平衡点。若2026年因外部环境原因业绩不达预期，在2027年各类产品单价与2026年一致的假设下，进一步考虑2027年的折旧摊销、期间费用等因素，当2027年月均出货量进一步提升至约120万片/月，外延片销量占比达到15%可实现当年合并报表盈利。

公司上述前瞻性信息是建立在推测性假设的数据基础上的预测，具有重大不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。

报告期内公司尚未实现盈利风险已在本节之“一、（一）特别风险因素”中提请投资者关注。公司尚未盈利的具体原因、影响分析，实现盈利的相关依据和假设基础以及持续经营能力分析详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“八、（七）报告期尚未盈利、最近一期期末存在未弥补亏损的分析”和“十、（六）持续经营能力分析”。

（四）本次发行相关主体作出的重要承诺和说明

本公司及相关责任主体按照中国证监会及上交所等监管机构的要求，出具了关于在特定情况和条件下的有关承诺，包括业绩下滑后延长股份锁定期的承诺、在审期间不进行现金分红的承诺、股份锁定、减持及持有意向的承诺、稳定股价的承诺、股份回购的承诺、欺诈发行上市的股份购回承诺、填补被摊薄即期回报

的承诺等。

公司实际控制人王东升、米鹏、杨新元和刘还平，间接控股股东奕明科技，直接控股股东奕斯伟集团及其一致行动人已出具针对业绩下滑情形下延长锁定期的相关承诺：“若公司上市当年较上市前一年净利润（口径为扣除非经常性损益后归母净利润，下同）下滑 50%以上的，延长承诺人届时所持直接或间接股份锁定期限 6 个月；若公司上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长承诺人届时所持直接或间接股份锁定期限 6 个月；公司上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长承诺人届时所持直接或间接股份锁定期限 6 个月。”

公司实际控制人王东升、米鹏、杨新元和刘还平，间接控股股东奕明科技，直接控股股东奕斯伟集团及其一致行动人已出具盈利前减持承诺：“自本公司股票上市之日起3个完整会计年度内，不得减持首发前股份；自公司股票上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内，每年减持首发前股份不得超过公司股份总数的2%（在计算减持比例时，本公司及一致行动人所持公司股份合并计算），并应当符合相关法律法规规定以及上述业绩下滑情形下延长锁定期的相关承诺。公司实现盈利后，可以自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份，但公司亦同时遵循其他限售安排和自愿锁定承诺及相关法律法规的规定。”

直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员已出具盈利前减持承诺：“在公司实现盈利前，本人自公司股票上市之日起3个完整会计年度内，不得减持首次公开发行股票前已发行股份；在前述期间内离职的，应当继续遵守本承诺。公司实现盈利后，本人可以自当年年度报告披露后次日起减持首次公开发行股票前已发行股份，但本人亦同时遵循其他限售安排和自愿锁定承诺及相关法律法规的规定。”

上述承诺事项详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件一：本次发行相关承诺”。

为推动奕斯伟集团永续经营，成为集成电路领域基业长青的公司，根据《北京奕斯伟科技集团有限公司核心骨干持股管理办法》，公司实际控制人王东升、米鹏、杨新元和刘还平以及其他直接或间接持有奕斯伟集团股权的核心骨干人员

(以下简称“持股人员”),承诺在所任职的奕斯伟集团下属控股主体上市后 10 年不主动离职。持股人员是否持有奕斯伟集团股份与其是否在奕斯伟集团及其控股子公司任职相挂钩,若持股人员从奕斯伟集团及其控股子公司离职,则其所持股权要转让给下一代核心创业骨干,不允许对外转让,实现事业传承,股权传承。转让对价原则为原始出资额加一定溢价,并与转让时对应奕斯伟集团实际可变现的股权市场估算价格对比,两者取其小。具体详见本招股说明书之“第四节、八、(一)控股股东情况”。

(五) 本次发行前滚存利润的分配安排、发行后现金分红的股利分配政策及长期回报规划

根据公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市前滚存利润分配和未弥补亏损承担方案的议案》:本次发行上市前的滚存利润由发行后新老股东按照本次发行后的股份比例共同享有,累计未弥补亏损由发行后的新老股东按照发行后的持股比例相应承担。

根据公司 2023 年第三次临时股东大会以及 2023 年年度股东大会审议通过的《上市后三年股东分红回报规划》:公司上市后三年,综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、重大资金支出安排以及预计上市时间等因素,公司在上市后三年仍将处于成长期且有重大资金支出安排,在上述期间进行利润分配时,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

公司发行上市后现金分红的股利分配政策具体内容详见“第九节 投资者保护”之“三、股利分配政策及长期回报规划”。

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

(一) 发行人基本情况

发行人名称	西安奕斯伟材料科技股份有限公司	成立日期	2016年03月16日
注册资本	350,000.00万元	法定代表人	杨新元

注册地址/主要生产 经营地	陕西省西安市高新区西沣南路1888号1-3-029室		
控股股东	北京奕斯伟科技集团有 限公司	实际控制人	王东升、米鹏、杨新元 和刘还平四人
行业分类	C39 计算机、通信和 其他电子设备制造业	在其他交易场所 (申请)挂牌或 上市情况	不适用

(二) 本次发行的有关中介机构

保荐人	中信证券股份有限公司	主承销商	中信证券股份有限公司
发行人律师	北京市竞天公诚律师事务所	其他承销机构	无
审计机构	毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)	评估机构	北京天健兴业资产评估 有限公司
<p>发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、 证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经 办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其 他利益关系</p>		<p>截至本招股说明书签署日,中证投资持有 股公司2.1964%的股份,长峡金石持有公 司1.3178%的股份,川投金石持有公司 0.7321%的股份。此外,中信证券持股的 中证投资是持有公司3.50%股份的中建材 新材料基金的有限合伙人(出资比例约 0.67%)。</p> <p>截至本招股说明书签署日,竞天公诚合 伙人李柳杰(非竞天公诚负责人,非本次发 行的项目经办律师)通过三行资本的有限 合伙人苏州众汇寄托创业投资合伙企业 (有限合伙)持有公司约0.0005%股份。 除上述情况外,发行人与本次发行有关的 证券服务机构及其负责人、高级管理人 员、经办人员之间不存在直接或间接股权 关系或其他权益关系。</p>	
股票登记机构	中国证券登记结算有 限责任公司上海分公 司	收款银行	【】

三、本次发行概况

(一) 本次发行的基本情况

股票种类	人民币普通股(A股)
------	------------

每股面值	人民币1.00元		
发行股数	不超过53,780.00万股（不含超额配售）	占发行后总股本比例	约占13.32%
其中：发行新股数量	不超过53,780.00万股（不含超额配售）	占发行后总股本比例	约占13.32%
股东公开发售股份数量	不适用	占发行后总股本比例	不适用
发行后总股本	不超过403,780.00万股（不含超额配售）		
每股发行价格	【】元		
发行市盈率	【】倍		
发行前每股净资产	【】元	发行前每股收益	【】元
发行后每股净资产	【】元	发行后每股收益	【】元
发行市净率	【】倍		
发行方式	本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，或中国证监会认可的其他方式		
发行对象	符合资格的战略投资者、网下投资者和上交所开户的境内自然人、法人等投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	【】万元		
募集资金净额	【】万元		
募集资金投资项目	西安奕斯伟硅产业基地二期项目		
发行费用概算	本次发行费用共计【】万元（不含增值税），其中承销及保荐费【】万元，审计及验资费【】万元，律师费【】万元，用于本次发行的信息披露费【】万元，用于本次发行的发行手续费及其他【】万元		
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	若公司决定实施高级管理人员及员工战略配售，则在本次公开发行股票注册后发行前，履行内部程序审议该事项的具体方案，并依法进行披露		
保荐机构相关子公司拟参与战略配售情况	保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件		

其他战略配售安排	若公司存在其他战略配售安排，则在本次公开发行股票注册后发行前，履行内部程序审议该事项的具体方案，并依法进行披露
----------	---

(二) 本次发行上市的重要日期

刊登发行公告日期	【】年【】月【】日
开始询价推介日期	【】年【】月【】日
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

四、发行人主营业务经营情况

(一) 主要业务情况

秉持“成为半导体硅材料领域受人尊敬的伟大企业”的长期愿景，报告期内公司始终专注于 12 英寸硅片的研发、生产和销售。基于 2024 年月均出货量和截至 2024 年末产能规模统计，公司均是中国大陆第一、全球第六的 12 英寸硅片厂商，前述月均出货量和产能规模全球同期占比约为 6%和 7%。同时，截至 2024 年末，公司是中国大陆 12 英寸硅片领域拥有已授权境内外发明专利最多的厂商。公司产品已用于 NAND Flash/DRAM/Nor Flash 等存储芯片、CPU/GPU/手机 SOC/嵌入式 MCU 等逻辑芯片、电源管理、显示驱动、CIS 等可实现数据计算、数据存储、数据传输、人机交互等核心功能的多品类芯片的量产制造，最终应用于智能手机、个人电脑、数据中心、物联网、智能汽车和机器人等人工智能时代下的各类智能终端。

硅片是芯片制造的“地基”，硅片的性能和供应能力直接影响半导体产业链的竞争力。尤其是人工智能时代需要更强的数据算力、更快的数据传输、更大的数据存储和更灵敏的人机交互，实现前述功能技术和工艺制程最主流和最先进的逻辑和存储芯片（一般 90 纳米工艺制程以下）以及部分高端模拟和传感器芯片均采用 12 寸晶圆制造工艺，从而 12 英寸硅片是目前业界最主流规格的硅片。根据 SEMI 统计，12 英寸硅片贡献了 2024 年全球所有规格硅片出货面积的 75% 以上，12 英寸产能也是目前全球晶圆厂扩产的主流方向。随着人工智能应用不

断普及,未来 12 英寸硅片全球出货面积占比将持续提升。12 英寸硅片全球寡头垄断格局已持续多年,2024 年全球前五大厂商供货占比约 80%,而我国 12 英寸晶圆厂产能全球占比预计 2026 年将超过 30%,这一自给结构矛盾对我国半导体产业链的发展形成制约。公司在进入该领域之初即制定了 2020 至 2035 年的 15 年战略规划,计划到 2035 年打造 2 至 3 个核心制造基地,建设若干座现代化的智能制造工厂,聚焦技术力、品质力和管理力,成为半导体硅材料领域头部企业,服务全球客户。

截至本招股说明书签署日,公司首个核心制造基地已落地西安,该项目第一工厂已于 2023 年达产,本次发行上市募投项目的第二工厂已于 2024 年正式投产,计划 2026 年达产。截至 2024 年末,公司合并口径产能已超过 70 万片/月,全球 12 英寸硅片同期产能占比已约 7%。根据 SEMI 统计,2026 年全球 12 英寸硅片需求将超过 1,000 万片/月,中国大陆地区需求将超过 300 万片/月。通过技术革新和效能提升,公司已将第一工厂 50 万片/月产能提升至 60 万片/月以上,2026 年第一和第二两个工厂合计可实现 120 万片/月产能,可满足届时中国大陆地区 40%的 12 英寸硅片需求,公司全球市场份额预计将超过 10%。

公司高度重视自主研发和知识产权保护,进入该领域之初即对全球前五大厂商近 30 年的半导体硅片专利全面检讨,制定差异化技术路线。目前,公司已形成拉晶、成型、抛光、清洗和外延五大工艺环节的核心技术体系,产品的晶体缺陷控制水平、低翘曲度、超平坦度、超清洁度和外延膜层形貌与电学性能等核心指标已与全球前五大厂商处于同一水平。公司产品已量产用于 2YY 层 NAND Flash 存储芯片、先进际代 DRAM 存储芯片和先进制程逻辑芯片;更先进制程 NAND Flash 存储芯片、更先进际代 DRAM 存储芯片以及更先进制程逻辑芯片的 12 英寸硅片均已经在主流客户验证。人工智能高端芯片领域,除了公司正在验证适配先进制程的高性能专用逻辑芯片外,公司也在同步配合客户开发下一代高端存储芯片,相应产品可用于 AI 大模型训练和推理数据的实时处理,可用于 AI 大模型训练数据和模型参数的定制化存储需求。截至 2024 年末,公司已申请境内外专利合计 1,635 项,80%以上为发明专利;已获得授权专利 746 项,70%以上为发明专利。公司相应专利均围绕 12 英寸硅片。截至 2024 年末,公司是中国大陆 12 英寸硅片领域拥有已授权境内外发明专利最多的厂商。

(二) 主要产品或服务及其用途

公司 12 英寸硅片根据用途可分为正片和测试片。其中，测试片用于晶圆厂对产线设备工艺环境的调试和检测，并不直接用于晶圆制造。一般情况下，新进入者需首先通过客户端测试片验证，方可进一步验证用于晶圆制造的正片。公司目前正片均为 P 型硅片（占目前全球 12 英寸硅片市场的 90%以上），正片又可进一步细分为抛光片和外延片。

抛光片主要用于 DRAM、NAND Flash 等存储芯片制造。公司抛光片的晶体缺陷控制水平、低翘曲和超平坦的硅片纳米形貌等品质要求已与全球前五大厂商处于同一水平。公司已成为国内主流存储 IDM 厂商全球 12 英寸硅片厂商中供货量第一或第二大的供应商，客户 O 和客户 P 等全球战略级客户先进制程存储芯片所用抛光片已批量供货，三星电子和 SK 海力士等全球战略级存储芯片客户正在验证导入。公司产品已量产用于国内最先进的 2YY 层 NAND Flash 和先进际代 DRAM 制造，更先进制程存储芯片所需抛光片正在客户端验证。

外延片即在抛光片上利用化学气相沉积方法镀膜而成，主要用于 CPU\GPU\手机 SOC\嵌入式 MCU 为代表的逻辑芯片制造。外延片核心的超清洁度、外延膜层形貌与电学性能随着芯片制程越先进，要求愈发苛刻，公司相应指标已与全球前五大厂商处于同一水平，但尚未应用于全球最先进工艺制程。目前，公司实现了对国内一线逻辑晶圆代工厂大多数主流量产工艺平台的外延片正片供货，已成为国内一线逻辑晶圆代工厂中国大陆 12 英寸硅片供应商中供货量第一或第二大的供应商，全球战略级晶圆代工厂客户也已陆续实现正片导入。公司产品已用于先进制程逻辑芯片量产，更先进制程逻辑芯片所需外延片产品正客户端验证。

测试片方面，公司已经为全球晶圆厂的主力供应商之一，量产供应国内几乎所有晶圆厂商，中国台湾及境外已实现主流一线晶圆厂客户的量产供货。公司自研的高端测试片品质和性能与抛光片正片相近，批量应用于部分全球战略级晶圆厂客户先进制程产线的特定需求。

报告期内，公司主营业务收入按产品分类构成情况如下：

单位：万元、%

类别	2024 年		2023 年		2022 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
抛光片	83,075.61	39.36	64,717.58	44.32	41,881.97	40.71
外延片	35,348.39	16.75	8,608.51	5.89	13,494.15	13.12
测试片	92,663.27	43.90	72,705.36	49.79	47,496.58	46.17
其中：高端测试片	44,683.83	21.17	30,854.60	21.13	2,550.82	2.48
合计	211,087.28	100.00	146,031.45	100.00	102,872.70	100.00
正片合计	118,424.00	56.11	73,326.09	50.21	55,376.12	53.83

(三) 所需主要原材料及重要供应商

公司所需原材料主要包括电子级多晶硅、化学试剂、包装材料、石英制品、切磨及抛光耗材等。公司已与境外行业内知名供应商建立了稳定的合作关系。对于采购占比最大的电子级多晶硅，全球技术成熟且具有一定产能规模的仅有 4-5 家企业，公司已与部分原厂供应商签订长期协议保证稳定供应，并已量产导入国内厂商。公司采购的主要设备包括拉晶、切片、研磨、抛光、清洗、量测和外延等近 120 余种，已与境外全球行业龙头设备厂商建立长期战略合作，部分设备的核心部件为公司自主设计或自行优化改良。

此外，公司持续培育本土化 12 英寸硅片装备和材料的供应商，推动上游供应链多元化，是陕西省工业和信息化厅确定的“第一批陕西省重点产业链‘链主’企业”。目前无论从上游原材料（包括耗材），还是工艺设备，公司通过合作开发不断提升本土化供应商的量产供应的比例，特别是晶体生长、硅片抛、量测等部分核心设备、超导磁场和热场等部分关键设备的核心零部件也已实现本土供应商配套。随着公司上市融资，第二工厂将进一步推动本土化设备和材料的突破全面提升国内电子级硅片产业链的竞争力。

(四) 主要生产模式、销售方式和渠道及重要客户

公司以电子级多晶硅为原料，通过直拉法拉制成单晶硅棒，截断形成晶锭，晶锭经成型、抛光、清洗三道工序形成 12 英寸抛光片和测试片，部分产品再进行外延工序后形成 12 英寸外延片。

公司采用以销定产模式,一般与主要客户在年末提前沟通次一年度主要产品采购需求和年度采购报价区间,并根据客户季度采购计划提前备产。鉴于客户认证数量不断增长,考虑新客户采购放量需求以及生产周期等诸多因素,公司会根据市场和客户判断提前备货生产。

销售方面,根据行业惯例,晶圆厂在引入新供应商时,会在审查通过供应商的技术实力、品控体系和产能规模等条件后,要求硅片供应商先行提供测试片进行认证,认证周期正常为 3-6 个月;测试片认证通过后,可以量产供货测试片。量产供货测试片后,根据晶圆厂内部评估,可进一步开展正片验证,验证周期正常为 9-12 个月;正片验证通过后,方实现正片量产供货。后续晶圆厂根据对供应商定期评价增减其供货比例。整体来看,新进入者测试片送样到正片量产至少需要 1-2 年周期,但同时由于认证周期较长并且认证成本较高,一旦认证通过,晶圆厂通常不会轻易更换硅片供应商,双方就此建立长期、稳固合作关系。

截至 2024 年末,公司已通过验证的客户累计 144 家,其中中国大陆客户 108 家,中国台湾及境外客户 36 家;已通过验证的测试片超过 390 款,量产正片超过 90 款,其中中国大陆客户正片已量产 80 余款,中国台湾及境外客户正片已量产近 10 款,2024 年量产正片已贡献公司主营业务收入的比例超过 55%。公司产品目前已全面导入国内外一线客户,具体详见本节之“四、(二)主要产品或服务及其用途”。

公司对大部分客户采用直销,少量特定客户根据中国台湾地区规定通过代理商销售。具体如下:

单位:万元、%

渠道	2024 年		2023 年		2022 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销模式	205,293.52	97.26	140,526.58	96.23	99,848.96	97.06
—终端客户	189,298.13	89.68	125,638.57	86.04	91,385.32	88.83
—卖断贸易商	15,995.39	7.58	14,888.02	10.20	8,463.64	8.23
代销模式	5,793.75	2.74	5,504.87	3.77	3,023.75	2.94
合计	211,087.28	100.00	146,031.45	100.00	102,872.70	100.00

(五) 行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

根据 TECHCET 报告及同行业公司公开数据统计, 假设全球前五大厂商 12 英寸硅片产能与 2023 年末一致, 截至 2024 年末全球 12 英寸硅片产能估计为 970 万片/月, 约 76% 被全球前五大厂商占据。截至 2024 年末, 公司两个工厂合计产能已超过 70 万片/月, 全球 12 英寸硅片产能占比已约 7%, 产能规模公司为中国大陆第一, 全球第六。

根据 SEMI 统计及同行业公司公开数据统计, 2024 年全球 12 英寸硅片月均出货量约 865 万片/月, 2024 年公司月均出货量为 52.12 万片/月, 同比 2023 年实现了 65% 的增长, 占 2024 年全球月均出货量比例约 6%, 持续保持中国大陆厂商第一, 全球第六的行业地位。

公司第二工厂(50 万片/月产能)已于 2024 年投产, 计划 2026 年达产。预计 2026 年, 全球 12 英寸硅片需求将超过 1,000 万片/月。通过技术革新和效能提升, 公司已将第一工厂 50 万片/月产能提升至 60 万片/月以上, 公司届时第一和第二两个工厂合计可实现 120 万片/月产能, 将满足全球 12 英寸硅片需求的 10% 以上, 有望进入全球 12 英寸硅片领域的第二梯队。

五、公司符合科创板科技创新企业定位

(一) 公司符合行业领域要求

公司所属行业领域	<input checked="" type="checkbox"/> 新一代信息技术	根据《产业结构调整指导目录(2024 年本)》, 公司所属行业领域属于“鼓励类”, 第二十八条第 4 款“集成电路”中包含“线宽小于 0.25 微米(含)的特色工艺集成电路生产(含掩模版、8 英寸及以上硅片生产)”
	<input type="checkbox"/> 高端装备	
	<input type="checkbox"/> 新材料	根据《国民经济行业分类》, 公司所属行业领域属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“电子元件及电子专用材料制造”(代码: C3985)
	<input type="checkbox"/> 新能源	
	<input type="checkbox"/> 节能环保	根据《战略性新兴产业分类(2018)》, 公司所属行业领域属于“3 新材料产业”之“3.4 先进无机非金属材料”之“3.4.3 人工晶体制造”之“3.4.3.1 半导体晶体制造”
	<input type="checkbox"/> 生物医药	
<input type="checkbox"/> 符合科创板定位的其他领域	根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引(2023 年 5 月)》, 公司所处行业为“C 制造业”之“CH 电气、电子及通讯”之“CH39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“CH398 电子元件及电子专用材料制造”	

(二) 公司符合科创属性相关指标要求

首先，2022年至2024年，公司累计研发投入为**57,623.25万元**，符合《科创属性评价指引（试行）》中“最近三年研发投入占营业收入比例5%以上，或最近三年研发投入金额累计在8,000万元以上”标准。

其次，公司营业收入从2022年的**10.55亿元**增至2024年的**21.21亿元**，复合增长率达到**41.83%**，符合《科创属性评价指引（试行）》中“最近三年营业收入复合增长率达到25%，或最近一年营业收入金额达到3亿元。”标准。

第三，公司研发活动分为技术研发、产品研发、工艺研发、设备及系统研发四大类。其中产品研发需要新产品导入量产，工艺研发需要针对产线已有工艺流程、方法和配方不断优化，鉴于发行人并无专用的研发产线，研发活动与生产活动存在共用设备情形，从而发行人存在非全时研发人员。截至**2024年末**，公司拥有研发人员**235人**，人数占比约**12%**，其中全时研发人员**115人**，非全时研发人员**120人**，符合《科创属性评价指引（试行）》中“研发人员占当年员工总数的比例不低于10%”标准。

第四，截至**2024年末**，公司已获授权发明专利合计**539**项。按照严格标准，剔除海内外同族专利、共有专利、无法对应公司五大工艺或未涉及已披露核心技术的专利以及尚未产生经济效益、业内尚未应用但公司提前储备的专利后公司应用于主营业务、形成核心技术且并能够产业化的发明专利共计**108**项，符合《科创属性评价指引（试行）》中“应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利7项以上”的标准，也高于《科创属性评价指引（试行）》中例外条款的第五条“形成核心技术和主营业务收入发明专利（含国防专利）合计**50**项以上”标准。

六、发行人报告期主要财务数据和财务指标

单位：万元，如无特殊说明

项目	2024/12/31 /2024年	2023/12/31 /2023年	2022/12/31 /2022年
资产总额	1,742,196.67	1,549,762.42	1,534,761.09
归属于母公司所有者权益	851,481.36	922,405.46	938,914.78

资产负债率(母公司)	27.62%	16.08%	12.25%
资产负债率(合并)	51.13%	40.48%	23.65%
营业收入	212,145.26	147,376.14	105,469.31
净利润	-73,764.25	-68,337.45	-53,287.69
归属于母公司所有者净利润	-73,764.25	-57,797.00	-41,182.08
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	-76,255.09	-69,233.88	-41,553.42
基本每股收益(元/股)	-0.21	-0.17	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.21	-0.17	不适用
加权平均净资产收益率	-8.32%	-6.02%	-8.34%
经营活动产生现金流量净额	81,547.82	31,990.45	4,673.76
现金分红	-	-	-
研发投入占营业收入比例	12.20%	11.63%	13.84%

七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

财务报告审计截止日至本招股说明书签署日期间,公司经营模式、主要原材料采购、技术研发、生产及销售等业务、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。

八、发行人选择的具体上市标准

公司选择适用《上市规则》2.1.2 规定的上市标准中的“(四)预计市值不低于人民币 30 亿元,且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元”。

九、发行人公司治理特殊安排

截至本招股说明书签署日,公司治理结构方面不存在特殊安排事项。

十、募集资金运用与未来发展规划

(一) 募集资金运用概况

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	西安奕斯伟硅产业基地二期项目	1,254,400.00	490,000.00
	合计	1,254,400.00	490,000.00

注：西安奕斯伟硅产业基地二期项目即“第二工厂”，产能为50万片/月。

(二) 未来发展规划

公司坚持“以客户为中心、以技术为基石、以品质为生命、以成果为导向、以奋斗者为本、以自省促卓越”的核心价值观，秉持“成为半导体硅材料领域受人尊敬的伟大企业”的企业愿景，始终将提升产品品质、提高技术能力、丰富产品结构和股东价值最大化作为推动企业发展的重要策略。

公司已制定2020-2035年的15年长期战略规划，通过挑战者、赶超者等5个阶段的努力，到2035年打造2-3个核心制造基地，若干座现代化的智能制造工厂，实现更优经济规模，聚焦技术力、品质力和管理力，成为半导体硅材料领域全球头部企业，服务全球客户。

截至本招股说明书签署日，公司2020-2023年第一阶段“挑战者”，即国内产销规模第一的目标已实现，正在努力实现2024-2026年第二阶段“赶超者”目标。

第三节 风险因素

投资者在评价公司本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素,排序并不表示风险因素依次发生。

一、与发行人相关的风险

(一) 作为全球 12 英寸硅片的新进入“挑战者”,在波动的半导体周期中面临行业固有的投资强度大、技术门槛高、客户认证及正片放量周期长的挑战,报告期内公司扣除非经常性损益后尚未实现盈利,最近一期期末存在未弥补亏损

(二) 公司研发不能紧跟半导体工艺制程演进和客户技术迭代的风险

(三) 控制权稳定风险

(四) 产品结构尚需优化的风险

(五) 存货跌价风险

上述(一)至(五)详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、(一)特别风险因素”。

(六) 技术人员流失和核心技术泄密风险

公司高度重视对核心技术的保护,与核心人员签署保密协议,且与核心人员签署的劳动合同中包含竞业禁止条款,但仍不排除因核心技术人员流失、员工个人工作疏漏、外界窃取等原因导致公司核心技术失密的风险。若上述情形发生,会对公司经营造成不利影响。

(七) 客户集中度高的风险

由于下游晶圆厂行业集中度较高,报告期各期公司合并口径前五大客户营业收入当期占比均超过 60%。公司客户集中度较高可能会导致公司在商业谈判中处于弱势地位,且公司的经营业绩与下游晶圆厂的产能利用率密切相关,客户自身经营状况变化也可能对公司产生较大的影响。如果公司后续不能持续开拓新客户或对少数客户形成重大依赖,将不利于公司持续稳定发展。

（八）无法有效开拓全球战略级晶圆厂客户的风险

目前 12 英寸硅片下游客户主要为存储 IDM 厂商及逻辑晶圆代工厂。目前全球 NAND Flash 和 DRAM 领域中三星电子、SK 海力士等厂商占据 90%以上市场份额；晶圆代工领域，台积电占据全球 50%以上的市场份额。前述均为公司需要服务的全球战略级客户，其对 12 英寸硅片的认证条件苛刻、议价能力强，并与全球前五大厂商常年合作，甚至双方签署确保最低采购量的长期协议。如公司无法通过全球战略级客户正片认证，或无法切入相应客户的先进制程工艺研发，或无法持续提升相应客户的采购占比，将对公司 2026 年消化第一和第二两个工厂产能造成挑战，不利于公司长期经营发展。

（九）汇率波动风险

报告期内，公司部分原材料和设备从境外进口，部分产品出口销售，相应进口采购和外销均以外币结算，汇率波动对公司经营业绩的影响较大。报告期各期，公司汇兑损失分别为 2,319.53 万元、-73.81 万元和 -1,867.04 万元。随着公司境外采购、出口销售规模不断扩大，如果未来人民币对主要结算外币的汇率波动加剧或者汇率政策发生重大变化，将对公司业绩产生一定的影响。

（十）规模增长带来的管理风险

报告期内，随着公司第一工厂达产和第二工厂建设，公司的业务体量和资产规模不断扩张，相应的在研发、采购、生产、销售和信息化等环节的资源配置和内控管理的复杂程度也在不断提升，对公司组织架构和管理层的挑战和能力要求不断加强。若公司的组织模式和经营管理制度未能随着公司业务规模的扩大及时调整与完善，未能建立起有效的多工厂运营模式，公司将面临规模扩张导致的管理和内控风险，从而给公司的稳定发展带来不利影响。

二、与行业相关的风险

（一）公司服务全球客户，面对全球前五大厂商在 12 英寸硅片领域多年寡头垄断竞争格局的风险以及国内厂商同台竞争的风险

（二）国际贸易摩擦的风险

上述（一）、（二）与行业相关的风险详见本招股说明书“第二节 概览”

之“一、（一）特别风险因素”。

（三）宏观经济、半导体行业周期波动的风险

电子级硅片行业受到下游客户以及终端消费市场的需求波动影响较大。若未来宏观经济发生周期性波动，导致计算机、消费电子、网络通信、汽车电子、物联网和机器人等终端消费市场需求下降，下游客户将面临产能或库存过剩，继而大幅削减采购需求。由于公司投资规模大，固定成本高，若订单大幅下滑，则公司业绩可能大幅下滑。

同时，在半导体行业景气度提升的周期，公司必须保证备货和产品交付以满足客户需求。若公司不能及时应对客户需求的快速增长，或对需求增长的期间或幅度判断错误，则可能会导致公司失去既有或潜在客户，进而对公司的业务、经营成果、财务状况或现金流量产生不利影响。

（四）知识产权争议风险

公司所处行业为知识与技术密集的行业，知识产权至关重要。公司在产品研发过程中，涉及到的专利及非专利技术知识产权众多，需通过申请专利等方式保护自身核心技术并避免侵犯他人知识产权。但不能排除与竞争对手等相关方产生知识产权争议的可能性，亦不能排除公司的知识产权被竞争对手等相关方侵权的可能性，此类知识产权争议将有可能对公司的正常经营活动产生不利影响。

（五）政府补助与税收优惠政策变动的风险

报告期内，公司获得一定规模政府补助。报告期各期，政府补助确认的其他收益金额分别为 1,136.04 万元、1,817.45 万元和 **3,490.25 万元**。如果未来相关政府部门对公司所处行业的政策支持力度调整或其他产业政策发生不利变化，公司取得的政府补助金额可能有所降低，进而对公司的经营业绩造成一定的影响。

所得税方面，公司及部分子公司为高新技术企业，报告期内享受高新技术企业所得税的优惠税率。增值税方面，根据国家有关政策，公司及部分子公司报告期内享受增值税留抵税额返还、出口退税以及增值税加计抵减的税收优惠。未来如果相应税收优惠政策发生不可预测的调整，或者公司不能持续获得高新技术企业资质认定，公司的盈利能力和资金周转能力将受到影响。

三、其他风险

除上述风险因素外，投资者在评价公司本次发行的股票时，还应特别认真地考虑整体变更存在未弥补亏

损风险、发行失败风险、募投项目实施效果未达预期的风险、即期回报被摊薄与净资产收益率下降的风险、股票价格可能发生较大波动的风险、安全生产、环境保护、不可抗力等风险。

第四节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司名称	西安奕斯伟材料科技股份有限公司
英文名称	Xi'an ESWIN Material Technology Co., Ltd.
注册资本	350,000.00 万元
法定代表人	杨新元
股份公司成立日期	2023 年 03 月 15 日
公司住所	陕西省西安市高新区西沣南路 1888 号 1-3-029 室
邮政编码	710114
联系电话	029-6827 8899 (分机号: 6927)
传真号码	029-6827 9537
互联网网址	https://www.eswinsi.com
电子信箱	ir@eswinsi.com
信息披露和投资者关系的部门、负责人及电话	董秘办, 杨春雷, 029-6827 8899 (分机号: 6927)

二、公司的设立情况

(一) 有限公司设立情况

奕斯伟材料有限的法人主体前身为 2016 年 3 月设立的北京奕思众合科技有限公司, 2016 年 9 月其更名为“北京奕斯伟科技有限公司”, 2019 年 9 月至 11 月其连续实施两次存续分立(具体详见本节之“二、(一)、3、(1)北京奕斯伟科技架构重组, 奕斯伟集团创立”)。两次存续分立后, “北京奕斯伟科技有限公司”作为存续主体更名为“北京奕斯伟材料技术有限公司”, 并于 2020 年 4 月迁址西安, 并同步更名为“西安奕斯伟材料科技有限公司”(即“奕斯伟材料有限”)。2020 年 4 月迁址西安之前, 奕斯伟材料有限的法人主体前身简要历史沿革如下:

1、海外收购阶段(2016 年 3 月至 2017 年 9 月), 该阶段奕斯伟材料有限的法人主体前身为北京奕思众合科技有限公司

(1) 北京奕思众合科技有限公司设立

2012年后,全球显示面板行业已形成韩国、日本、中国台湾和中国大陆厂商为主的“三国四地”竞争格局。对于中国本土产业链,显示面板的核心部件,显示驱动芯片等相关集成电路产品主要依赖进口,制衡国内产业发展。尤其是以京东方为代表的中国本土厂商在全球显示面板领域的市占率不断攀升,相关集成电路产品的供需矛盾持续加剧。

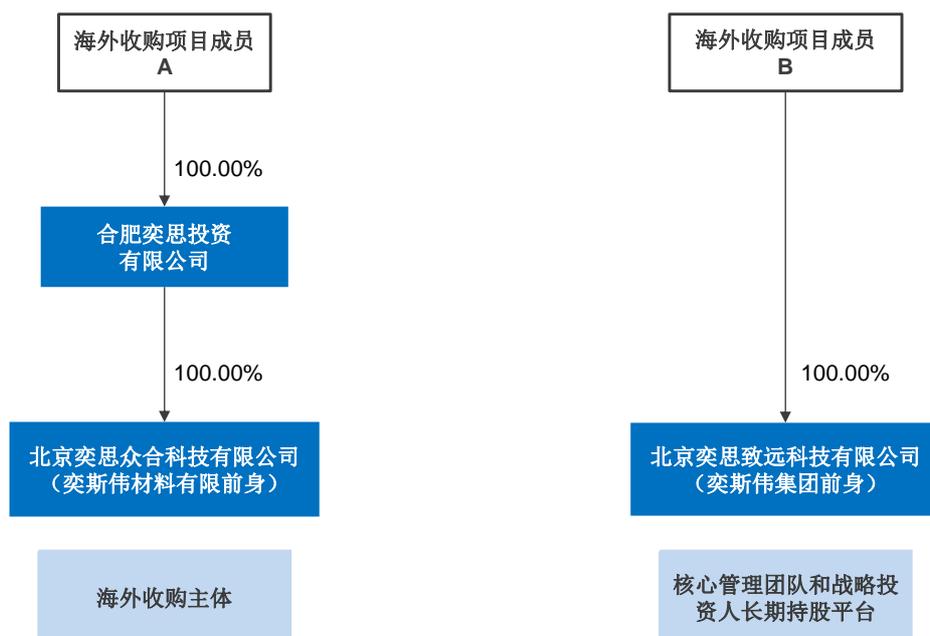
2015年下半年,具有产业背景的管理团队与国家集成电路产业投资基金股份有限公司、京东方和北京亦庄国际新兴产业投资中心(有限合伙)共同出资组建北京芯动能基金,聚焦显示面板相关的集成电路上下游产业及其相关应用领域投资。北京芯动能基金发起设立后,聚焦解决中国显示驱动芯片的“痛点”,2015年下半年开始,基金管理人北京芯动能管理公司先后与两家海外有意出让控股权的全球知名显示驱动芯片设计企业对接、沟通和谈判,计划联合国内财务投资者收购,收购后实现运营和研发本土化落地。

2015年11月,北京芯动能管理公司员工A(海外收购项目成员)认缴10,000.00万元设立合肥奕思投资有限公司(该公司始终无实际业务,始终未实缴出资,已于2018年9月注销),拟作为海外收购的收购主体。后续考虑项目变更为北京落地,2016年3月11日,合肥奕思投资有限公司签署《公司章程》,约定认缴出资1,000.00万元设立北京奕思众合科技有限公司,作为新收购主体,计划在该主体层面引入国内财务投资者,募集并购资金。

2016年3月16日,北京奕思众合科技有限公司办理完毕工商设立登记。至此,奕斯伟材料有限的法人主体前身设立,其设立时股权结构如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
合肥奕思投资有限公司	1,000.00	-	100.00
合计	1,000.00	-	100.00

同时,基于对海外收购项目有出资意向的主要投资人要求,2016年3月,北京芯动能管理公司员工B(海外收购项目成员)认缴1,000.00万元设立北京奕思致远科技有限公司,拟作为新收购主体北京奕思众合科技有限公司的核心管理团队和战略投资人的长期持股平台。北京奕思致远科技有限公司即为奕斯伟集团的法人主体前身。届时,相应结构如下:



上述自然人持股期间均未实缴，两人已于 2016 年 9 月直接和间接层面完全退出北京奕思众合科技有限公司和北京奕思致远科技有限公司，不存在股权纠纷。

(2) 北京奕思众合科技有限公司股东结构调整，注册资本缴足

考虑海外收购风险高，对海外收购项目有出资意向的主要投资者希望北京芯动能管理公司部分核心员工投资入股，一起承担投资风险。若完成收购，相应人员后续考虑作为核心管理团队，与被收购的境外公司管理团队和技术团队共同组建一体化全球运营团队，有利于海外被并购主体的技术消化和吸收。基于前述考虑，相应架构调整如下：

主体更名：2016 年 8 月至 9 月，“北京奕思众合科技有限公司”更名为“北京奕斯伟科技有限公司”。“北京奕思致远科技有限公司”更名为“北京奕成科技有限公司”。

核心管理团队和战略投资人入股，原海外收购项目成员退出：北京奕成科技定位为后续核心管理团队和战略投资人长期持股平台。北京奕成科技原股东全部退出，由核心管理团队和战略投资人通过受让原股东认缴出资额入股，新股东于 2016 年 10 月以货币完成对北京奕成科技全部实缴出资。

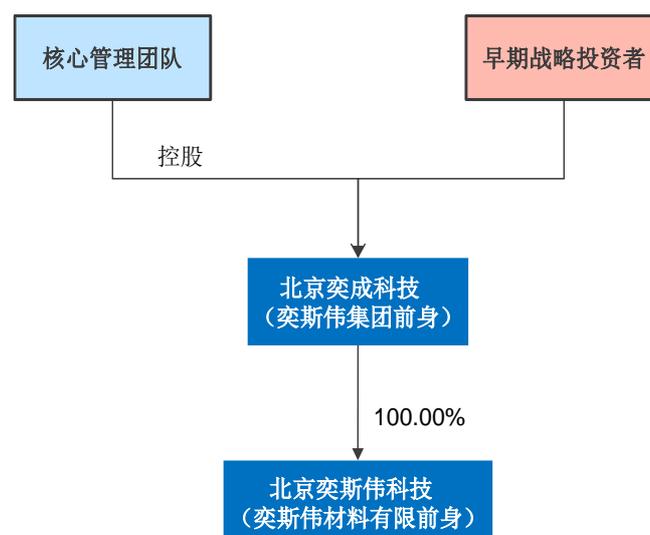
调整为核心管理团队控制架构：通过股权调整，2016 年 9 月北京奕斯伟科技成为北京奕成科技全资子公司。2016 年 11 月 16 日，北京奕成科技以货币完成对北京奕斯伟科技全部实缴出资，该事项由毕马威会计师于 2024 年 9 月 3 日

出具的《验资报告》（毕马威华振验字第 2400477 号）确认。

股权调整及实缴完成后，北京奕斯伟科技股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
北京奕成科技	1,000.00	1,000.00	100.00
合计	1,000.00	1,000.00	100.00

经过上述调整后，整体结构如下：



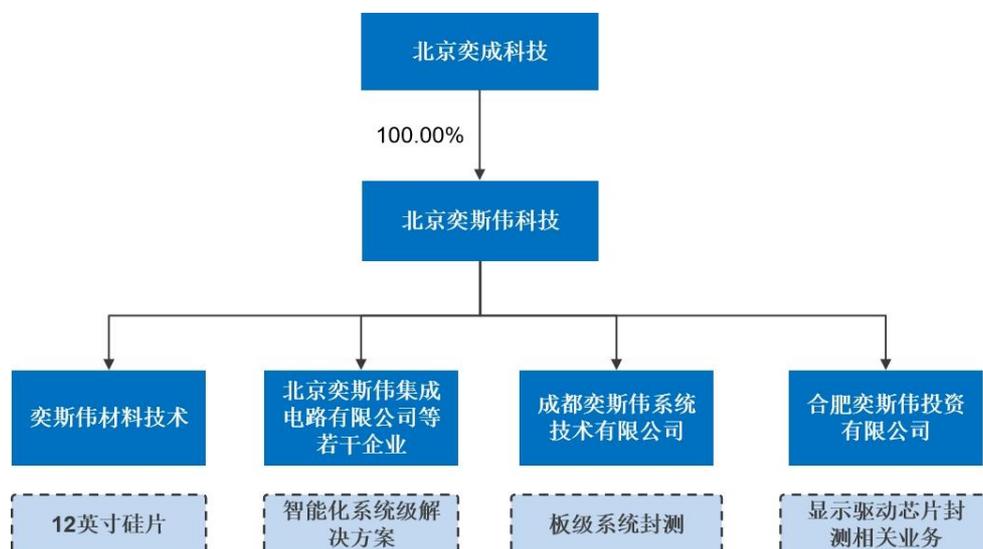
2、孵化探索阶段（2017年9月至2019年7月），该阶段奕斯伟材料有限法人主体前身为北京奕斯伟科技有限公司

（1）境外收购受阻，改为自主孵化

前述两个海外收购项目由于种种原因无法继续推进。自 2016 年下半年起，北京奕斯伟科技管理团队考虑核心集成电路产品的“痛点”很难通过收购方式彻底解决，摆脱芯片受制于人需要两条腿走路。在海外收购的同时，北京奕斯伟科技已在国内同步组建本土化的研发和运营团队，便于后续消化吸收海外收购项目。2017 年 9 月后，海外收购项目终止，管理团队决心引进人才、组建团队、自主孵化。

前述背景下，北京奕斯伟科技由之前海外收购项目收购主体转变为自主孵化的项目平台公司，并在此期间经过孵化探索，至 2019 年 7 月，逐渐形成四大板块业务：1）12 英寸硅片业务，北京奕斯伟科技为管理中心，主要业务由旗下的奕斯伟材料技术运营；2）智能化系统级解决方案业务，北京奕斯伟科技为管理

和运营中心，主要业务除由北京奕斯伟科技运营外，也涉及旗下的北京奕斯伟集成电路有限公司等若干企业；3）板级系统封测业务：由旗下的成都奕斯伟系统技术有限公司孵化；4）显示驱动芯片封测相关业务：由合肥奕斯伟投资有限公司通过管理专项基金孵化。具体如下：



(2) 2019年3月北京奕斯伟科技A轮融资

2019年3月至7月，鉴于北京奕斯伟科技开展业务的资金需求，北京奕斯伟科技引入天津博思、北京芯动能基金、三行资本等多家投资者以货币5.05亿元增资35.95%，实施A轮融资。

2019年8月20日，除天津博思7,500.00万元尚未实缴外，其他股东均以货币完成实缴出资，该事项由毕马威会计师2024年9月3日出具的《验资报告》（毕马威华振验字第2400478号）确认。至此，奕斯伟材料有限法人主体前身北京奕斯伟科技的股权结构如下：

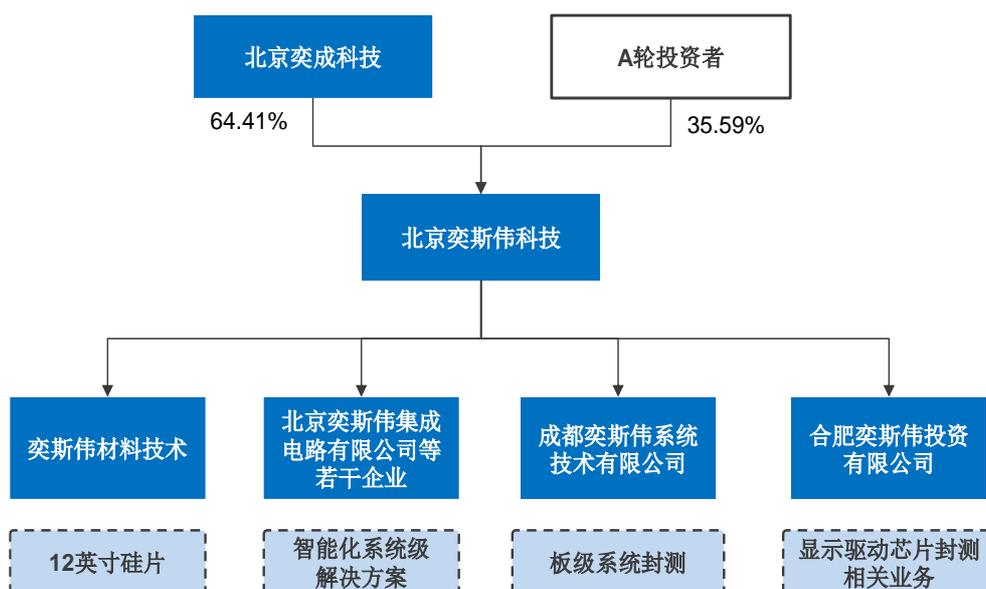
序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京奕成科技	1,005.5556	1,005.5556	64.41
2	北京芯动能基金	244.4444	244.4444	15.66
3	天津博思	166.6667	83.3334	10.68
4	三行资本	77.7778	77.7778	4.98
5	博华资本	66.6666	66.6666	4.27
	合计	1,561.1111	1,477.7778	100.00

3、有序发展阶段（2019年7月至2020年4月），北京奕斯伟科技架构重组、奕斯伟集团创立，存续主体更名为“西安奕斯伟材料科技有限公司”，迁址西安

（1）北京奕斯伟科技架构重组，奕斯伟集团创立

2019年7月，王东升先生应邀加入北京奕斯伟科技担任董事长。王东升先生加入后，带领核心团队制定了北京奕斯伟科技不同业务板块的长期战略，利用自身影响力吸引全球人才。考虑混业经营不利于市场化融资和专业化发展，决定将北京奕斯伟科技分拆成四个不同法人主体，各自承接不同主业，确保不同主业独立发展，独立融资，并积累各自领域的核心竞争力。

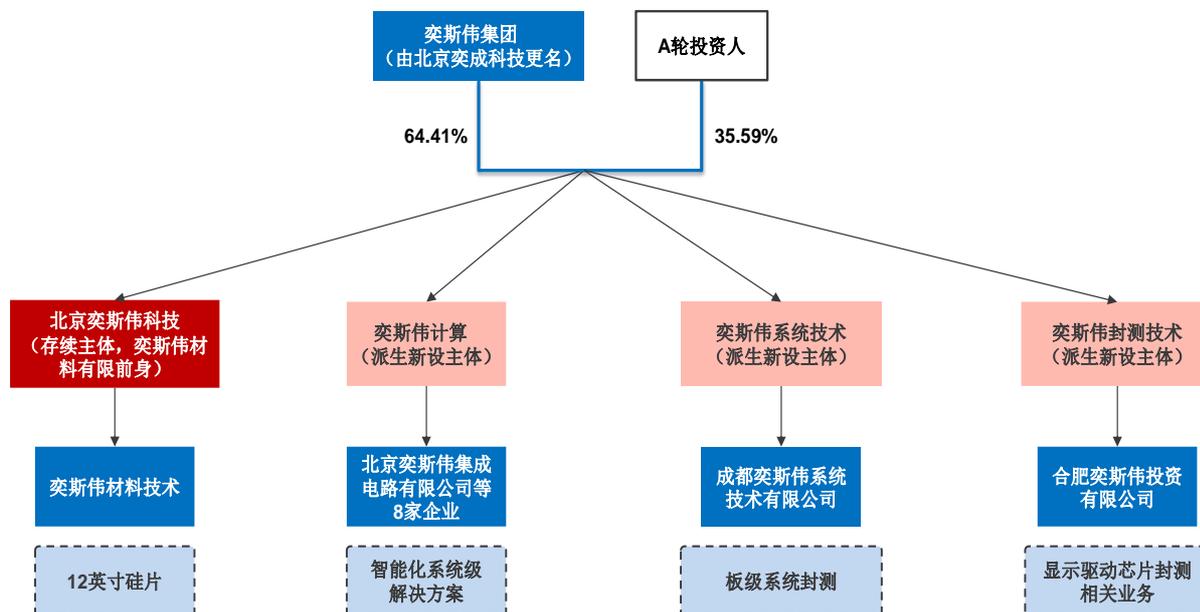
同时，北京奕成科技更名为“北京奕斯伟科技集团有限公司”（即“奕斯伟集团”），其职能定位于不同业务主体的控股或投资平台，至此奕斯伟集团“创立”，相关板块业务进入有序发展阶段。重组前，北京奕斯伟科技架构如下：



1) 整体分立方案概览

整体分立过程具体包括连续两次存续分立。2019年9月第一次存续分立派生新设奕斯伟计算承接智能化系统级解决方案业务，其余分立前业务由北京奕斯伟科技保留；2019年11月第二次存续分立派生新设北京奕斯伟系统技术承接孵化的板级系统封测业务，派生新设北京奕斯伟封测技术承接孵化的显示驱动芯片封测相关业务，其余分立前业务（12英寸硅片业务）由存续主体北京奕斯伟

科技承接,从而北京奕斯伟科技为奕斯伟材料有限的法人主体前身。两次分立前后北京奕斯伟科技的股权结构不变。连续两次存续分立后结构如下:



2) 具体分立方案

根据 2019 年 8 月 6 日和 2019 年 9 月 30 日签署的两份《分立协议》，具体约定如下:

项目	具体内容
注册资本	分立前北京奕斯伟科技注册资本为 1,561.11 万元, 两次分立后存续主体北京奕斯伟科技注册资本变更为 50.00 万元, 派生新设的奕斯伟计算注册资本为 1,461.11 万元, 派生新设的北京奕斯伟系统技术注册资本为 40.00 万元, 派生新设的奕斯伟封测技术注册资本为 10.00 万元。存续主体与派生新设主体股权结构一致
业务	奕斯伟计算: 承接智能化系统级解决方案业务 奕斯伟系统技术: 承接板级系统封测业务 奕斯伟封测技术: 承接显示驱动芯片封测相关业务 北京奕斯伟科技: 承接 12 英寸硅片业务
资产	奕斯伟计算: 北京奕斯伟集成电路有限公司等 8 家涉及智能化系统级解决方案业务的公司股权 奕斯伟系统技术: 成都奕斯伟系统技术有限公司 100% 股权 奕斯伟封测技术: 合肥奕斯伟投资有限公司 75% 股权 北京奕斯伟科技: 主要为奕斯伟材料技术 100% 股权
债权债务	奕斯伟计算: 承继全部债权和除应付未付各项税负外的全部债务 奕斯伟系统技术: 不涉及 奕斯伟封测技术: 不涉及 北京奕斯伟科技: 应付未付各项税负

人员	奕斯伟计算：大部分员工 奕斯伟系统技术：不涉及 奕斯伟封测技术：不涉及 北京奕斯伟科技：17名员工
其他	天津博思对北京奕斯伟科技 7,500.00 万元未实缴出资由分立后的奕斯伟计算承接。根据毕马威会计师 2020 年 12 月 11 日出具的《验资报告》（毕马威华振验字第 2000880 号），验证截至 2019 年 10 月 21 日，天津博思未实缴的 7,500.00 万元已用货币对派生新设的奕斯伟计算缴足

3) 2019 年 9 月第一次存续分立具体过程

2019 年 8 月 5 日，北京奕斯伟科技股东会通过：1) 北京奕斯伟科技进行存续分立，分立后北京奕斯伟科技注册资本变更为 100.00 万元，派生新设主体奕斯伟计算注册资本为 1,461.1111 万元。2) 本次分立前后北京奕斯伟科技股权结构不变。

2019 年 8 月 6 日，北京奕斯伟科技与奕斯伟计算（筹）签署《分立协议》，截至 2019 年 7 月 31 日，北京奕斯伟科技净资产为 51,126.72 万元。本次分立后，北京奕斯伟科技的净资产减为 21,175.03 万元，奕斯伟计算承继净资产 29,951.69 万元，其余资产、业务、人员和债权债务分立方案详见前文。根据《分立协议》，北京奕斯伟科技编制截至 2019 年 7 月 31 日资产负债表及财产清单。同日，北京奕斯伟科技在《新京报》刊登分立公告，**并履行债权人公告程序。**

2019 年 9 月 23 日，北京奕斯伟科技办理完毕工商变更登记。

根据毕马威会计师于 2024 年 9 月 3 日出具的《验资报告》（毕马威华振验字第 2400479 号），截至 2019 年 9 月 24 日，北京奕斯伟科技变更后注册资本为 100.00 万元，累计实收资本为 100.00 万元。鉴于天津博思未实缴的 7,500.00 万元出资由派生新设主体奕斯伟计算承接，从而本次分立后北京奕斯伟科技注册资本不存在未缴足情况。

第一次存续分立完成后，北京奕斯伟科技的股权结构如下：

序号	股东名称	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	奕斯伟集团	64.41	64.41
2	北京芯动能基金	15.66	15.66
3	天津博思	10.68	10.68

4	三行资本	4.98	4.98
5	博华资本	4.27	4.27
合计		100.00	100.00

4) 2019年11月第二次存续分立具体过程，存续主体更名为“北京奕斯伟材料技术有限公司”

2019年9月27日，北京奕斯伟科技股东会通过：1) 北京奕斯伟科技进行第二次存续分立，分立后北京奕斯伟科技注册资本变更为50.00万元，派生新设主体奕斯伟系统技术注册资本为40.00万元，派生新设主体奕斯伟封测技术注册资本为10.00万元。2) 公司名称由“北京奕斯伟科技有限公司”变更为“北京奕斯伟材料技术有限公司”。3) 本次分立前后北京奕斯伟科技股权结构不变。

2019年9月30日，北京奕斯伟科技与奕斯伟系统技术(筹)、奕斯伟封测技术(筹)签署《分立协议》：截至2019年9月30日，北京奕斯伟科技净资产为20,365.51万元。本次分立后，北京奕斯伟科技的净资产减为12,605.51万元，奕斯伟系统技术承继净资产7,010.00万元，奕斯伟封测技术承继净资产750.00万元。其余资产、业务、人员和债权债务分立方案详见前文。根据《分立协议》，北京奕斯伟科技编制截至2019年9月30日资产负债表及财产清单。同期，北京奕斯伟科技在《新京报》刊登分立公告，**并履行债权人公告程序。**

2019年11月19日，北京奕斯伟科技办理完毕工商变更登记，并更名为“北京奕斯伟材料技术有限公司”。

根据毕马威会计师2024年9月3日出具的《验资报告》(毕马威华振验字第2400480号)，截至2019年11月20日，北京奕斯伟科技(即更名后的“北京奕斯伟材料技术有限公司”)变更后注册资本为50.00万元，累计实收资本为50.00万元。

本次分立完成后，北京奕斯伟材料技术有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	奕斯伟集团	32.2050	64.41
2	北京芯动能基金	7.8300	15.66
3	天津博思	5.3400	10.68

4	三行资本	2.4900	4.98
5	博华资本	2.1350	4.27
合计		50.0000	100.00

(2) 2020年4月北京奕斯伟材料技术有限公司迁址西安，并更名为“西安奕斯伟材料科技有限公司”

2020年4月23日，北京奕斯伟材料技术有限公司通过股东会决议：同意将公司迁址至西安，名称由“北京奕斯伟材料技术有限公司”变更为“西安奕斯伟材料科技有限公司”。

就前述名称变更事项，北京奕斯伟材料技术有限公司于2020年4月24日办理完毕工商变更登记程序。至此，进入奕斯伟材料有限发展阶段。

(二) 股份公司设立情况

2023年2月10日，毕马威会计师以2022年11月30日为审计基准日，出具奕斯伟材料有限《审计报告》（毕马威华振审字第2300060号）。

2023年2月10日，天健兴业以2022年11月30日为评估基准日，出具奕斯伟材料有限《资产评估报告》（天兴评报字[2023]第0153号）。截至2022年11月30日，奕斯伟材料有限经评估的净资产值高于经审计的净资产。

2023年2月14日，奕斯伟材料有限股东会通过决议：同意奕斯伟材料有限整体变更为股份有限公司，公司以截至2022年11月30日经毕马威会计师审计的公司账面净资产折合股本223.8607万股，股本与股改前奕斯伟材料有限注册资本保持一致，每股面值1.00元。

2023年2月20日，奕斯伟材料有限全体股东作为股份公司发起人共同签署《发起人协议》。

2023年3月1日，发行人召开创立大会暨第一次临时股东大会。

2023年3月15日，西安市市场监督管理局高新区分局向公司核发了《营业执照》。

2023年4月7日，毕马威会计师出具《验资报告》（毕马威华振验字第2300565号），发行人已收到全体股东以净资产缴纳的注册资本。

发行人设立时的股权结构如下:

序号	股东名称	股数(万股)	持股比例
1	奕斯伟集团	32.21	14.39%
2	奕斯欣盛	2.22	0.99%
3	奕斯欣诚	1.67	0.74%
4	奕斯欣合	1.67	0.74%
5	宁波奕芯	25.29	11.30%
6	陕西集成电路基金	22.93	10.24%
7	宁波庄宣	10.19	4.55%
8	中建材新材料基金	8.85	3.95%
9	嘉兴隼望	8.43	3.77%
10	渝富芯材	8.22	3.67%
11	中芯熙诚	6.32	2.82%
12	国寿惠泉	6.23	2.78%
13	西安汇奕	6.03	2.69%
14	中证投资	5.56	2.48%
15	中网投	5.56	2.48%
16	嘉兴顾嘉	5.47	2.45%
17	天津博思	5.34	2.39%
18	陕西民营基金	4.63	2.07%
19	创合材丰	4.44	1.98%
20	众励投资	4.26	1.90%
21	宏兆天实	3.70	1.65%
22	长峡金石	3.33	1.49%
23	三行资本	3.12	1.39%
24	烟台中冀	2.85	1.27%
25	建投投资	2.53	1.13%
26	北京硅新	2.33	1.04%
27	苏州芯动能	2.22	0.99%
28	泓生嘉启	2.14	0.95%

29	川投金石	1.85	0.83%
30	建银国际	1.85	0.83%
31	广东星耀	1.67	0.74%
32	毅达鑫业	1.57	0.70%
33	源轩投资	1.52	0.68%
34	亓泉绿色基金	1.48	0.66%
35	上海澜翎	1.36	0.61%
36	普耀芯业	1.33	0.59%
37	上海综改基金	1.26	0.56%
38	江阴毅达	1.20	0.54%
39	越秀智创	1.11	0.50%
40	道禾源信	0.96	0.43%
41	博达奕行	0.93	0.41%
42	中小企业基金	0.93	0.41%
43	东方电气基金	0.93	0.41%
44	嘉兴翊榛	0.93	0.41%
45	烟台伯和	0.93	0.41%
46	宁波卓煌	0.93	0.41%
47	天堂硅谷领新	0.93	0.41%
48	天堂硅谷恒新	0.93	0.41%
49	青岛远润	0.93	0.41%
50	国开科创	0.63	0.28%
合计		223.86	100.00%

公司在有限公司设立及股份公司设立过程中,均履行了相应的内部审议程序及必要的评估程序,且进行了验资,符合法律法规的规定。

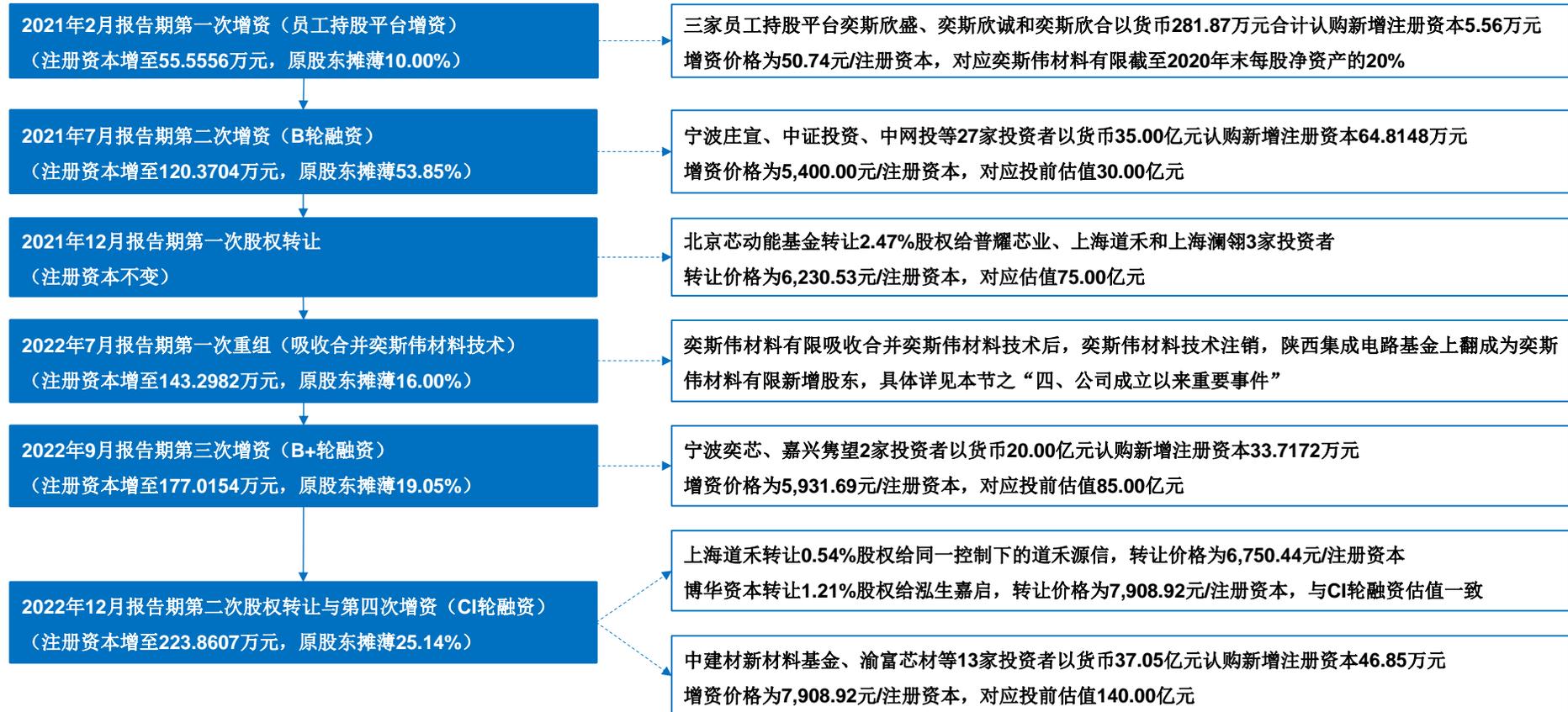
三、报告期内公司股本和股东变化情况

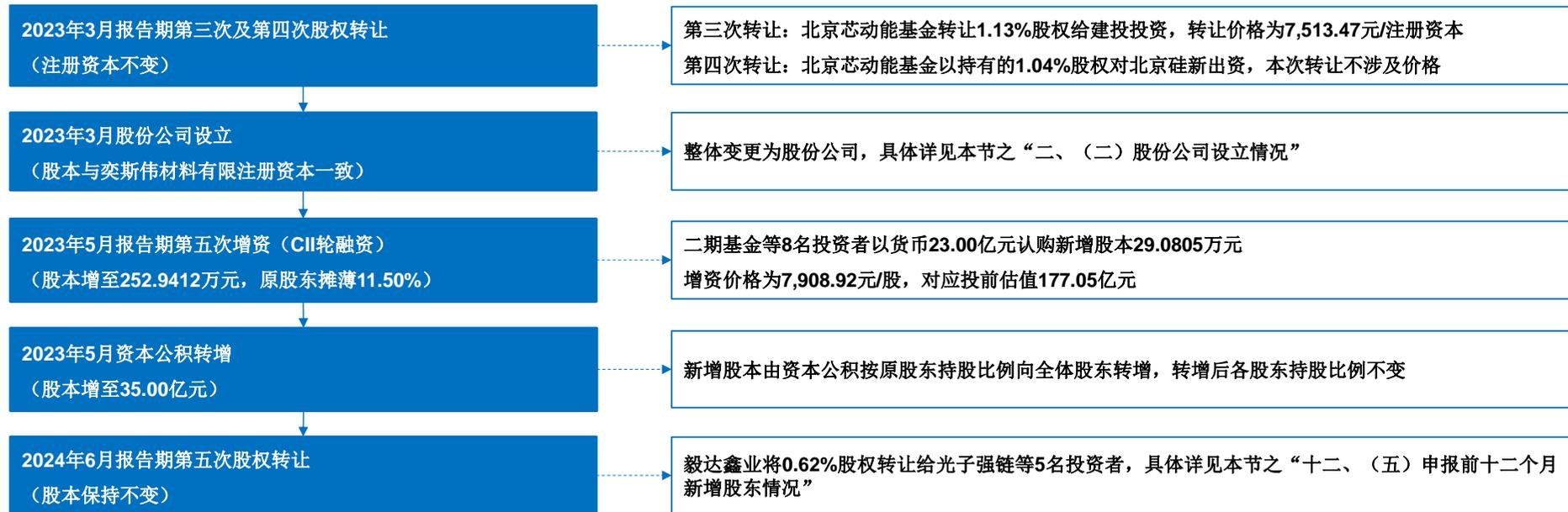
报告期期初,奕斯伟材料有限股权结构与其2020年4月迁址更名后并无变化,具体如下:

序号	股东名称	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
----	------	-----------	---------

1	奕斯伟集团	32.2050	64.41
2	北京芯动能基金	7.8300	15.66
3	天津博思	5.3400	10.68
4	三行资本	2.4900	4.98
5	博华资本	2.1350	4.27
合计		50.0000	100.00

报告期内，公司股本和股东变化情况具体如下：





截至本招股说明书签署日，发行人股权结构详见本节之“十二、（一）本次发行前后股本情况”。

报告期内，公司历次股本和股东变化已履行必要的决策程序，符合法律法规的规定。

四、公司成立以来重要事件

报告期内,发行人不存在重大资产重组情况。公司成立以来重要事件如下:

(一) 2019年7月至11月,北京奕斯伟科技连续两次存续分立

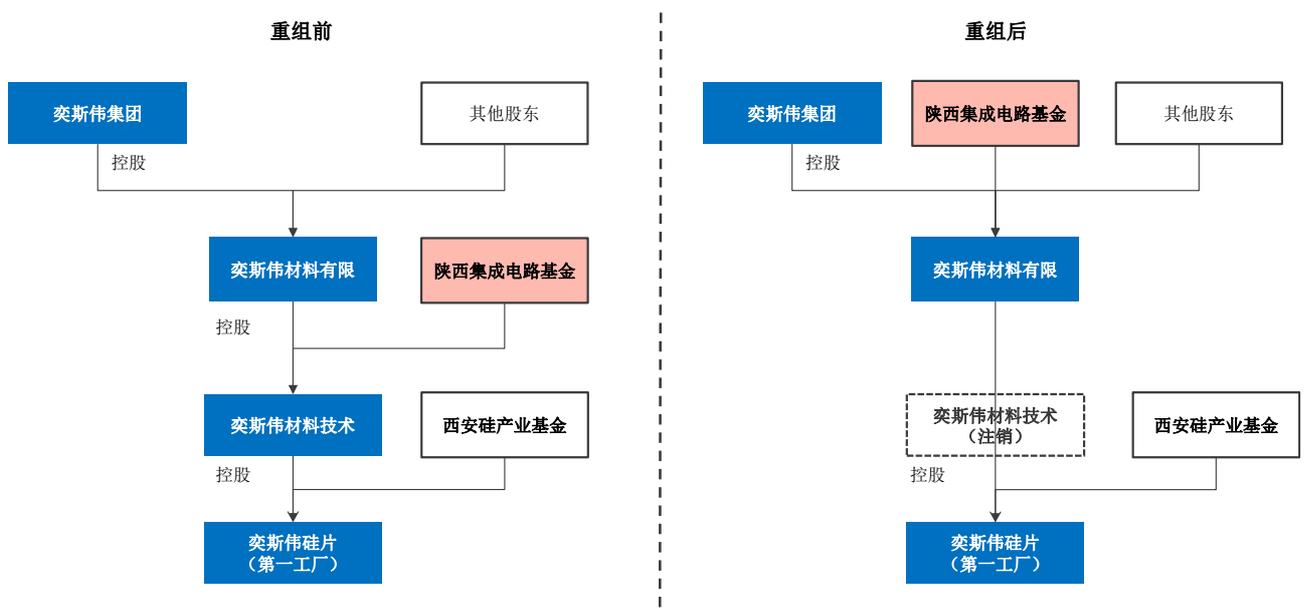
报告期前,奕斯伟有限法人主体前身北京奕斯伟科技2019年7月至11月连续实施两次存续分立,最终存续主体更名为“西安奕斯伟材料科技有限公司”(即奕斯伟材料有限),具体详见本节之“二、(一)、3、(1)北京奕斯伟科技架构重组,奕斯伟集团创立”。

(二) 2022年7月,奕斯伟材料有限吸收合并控股子公司奕斯伟材料技术

1、吸收合并背景

根据2017年北京奕斯伟科技与西安高新技术产业开发区等相关方签订的《西安硅产业基地投资意向书》、2018年各方进一步签订的《西安硅产业基地项目投资合作协议》及《西安硅产业基地项目补充协议》约定:陕西集成电路基金对奕斯伟材料技术出资,陕西集成电路基金出资设立的专项产业基金西安硅产业基金对奕斯伟硅片出资,支持发行人第一工厂建设。

鉴于奕斯伟材料有限确定为最终上市主体,考虑缩减管理层级,统一发行人全体股东权益。2022年7月,由奕斯伟材料有限吸收合并奕斯伟材料技术,后续奕斯伟材料技术注销,重组前后结构如下:



2、履行的法定程序

2022年4月26日,奕斯伟材料有限召开股东会,审议吸收合并方案。主要方案包括:1)奕斯伟材料有限吸收合并奕斯伟材料技术,奕斯伟材料技术注销,奕斯伟材料有限存续,吸收合并后陕西集成电路基金成为奕斯伟材料有限股东;2)合并前,奕斯伟材料有限注册资本为120.3704万元,合并后奕斯伟材料有限注册资本为143.2982万元;3)合并后,奕斯伟材料技术的全部债权债务由奕斯伟材料有限承继。2022年6月30日,西安高新技术产业开发区管理委员会与奕斯伟材料有限等相关方签署《西安硅产业基地项目投资合作协议补充协议(II)》,同意前述吸收合并方案。至2022年7月14日,奕斯伟材料有限全体股东一致同意前述吸收合并方案。

2022年6月6日,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)以2022年3月31日为审计基准日出具奕斯伟材料有限的《审计报告》(希会审字[2022]4548号)和奕斯伟材料技术的《审计报告》(希会审字[2022]4549号)。

2022年6月6日,天健兴业以2022年3月31日为评估基准日出具《西安奕斯伟材料科技有限公司拟吸收合并西安奕斯伟材料技术有限公司涉及的西安奕斯伟材料科技有限公司股东全部权益资产评估报告》(天兴评报字[2022]第1073号)、《西安奕斯伟材料科技有限公司拟吸收合并西安奕斯伟材料技术有限公司涉及的西安奕斯伟材料技术有限公司股东全部权益资产评估报告》(天兴评报字[2022]第1074号),分别确定奕斯伟材料有限净资产以及奕斯伟材料技术净资产的评估值。

2022年7月14日,交易各方签署《合并协议》,约定吸收合并相关事项。

2022年7月29日,西安市市场监督管理局高新区分局出具《准予注销登记通知书》([西市监高新]登字[2022]第372223号),奕斯伟材料技术注销。

2022年7月29日,奕斯伟材料有限就吸收合并事项完成工商变更登记。

2024年9月3日,毕马威会计师出具《验资报告》(毕马威华振验字第2400482号),验证:截至2022年7月29日,奕斯伟材料有限变更后的注册资本为143.2982万元,累计实收资本为137.7426万元。其中,注册资本未实缴部分系奕斯伟材料有限的三个员工持股平台。

2024年9月20日,根据西安高新技术产业开发区财政金融局出具的《确认函》,确认本次奕斯伟材料有限吸收合并奕斯伟材料技术经济行为有效性以及交易结果未造成国有资产流失。

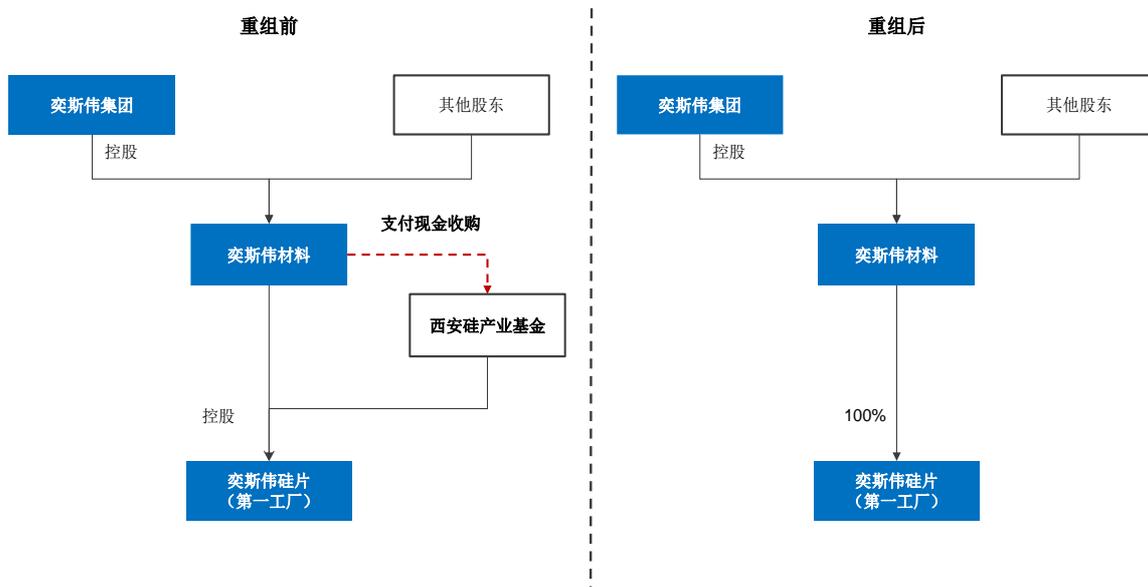
3、对公司管理层、控制权、业务发展及经营业绩的影响

通过本次吸收合并,缩短了管理层级,统一了发行人全体股东权益。本次吸收合并为发行人对控股子公司少数股东权益的收购,发行人管理层、控制权、业务发展及经营业绩未发生其他变化。

(三) 2023年6月,发行人收购控股子公司奕斯伟硅片少数股权

1、本次收购背景

考虑提升第一工厂公司治理效率和公司未来盈利潜力,奕斯伟材料有限现金收购西安硅产业基金持有第一工厂的少数股权。收购后,第一工厂成为发行人的全资子公司。重组前后结构如下:



2、履行的法定程序

2023年1月16日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)以2022年11月30日为审计基准日出具奕斯伟硅片的《审计报告》(XYZH/2023XAAA1B0001)。

2023年5月11日,中和资产评估有限公司以2022年11月30日为评估基准日出具《资产评估报告》(中和评报字(2022)第XAV1294号)确定奕斯伟硅片净资产的评估值,相应评估值已履行国资备案程序。

2023年5月23日,西安硅产业基金于西部产权交易所挂牌出让其所持有奕斯伟硅片(第一工厂)47.75%股权。

2023年5月28日,发行人召开2022年年度股东大会,审议通过《关于第一工厂股权回购的议案》,即发行人按评估价格参与摘牌受让。

2023年6月19日,发行人与西安硅产业基金签署《股权交易合同》。

2023年6月20日,发行人向西安硅产业基金按评估值支付完毕股权转让价款,西部产权交易所出具《西部产权交易所有限责任公司产权交易凭证》。

同日,奕斯伟硅片完成工商变更登记。

2024年9月20日,根据西安高新技术产业开发区财政金融局出具的《确认函》,确认奕斯伟材料有限收购奕斯伟硅片少数股权经济行为有效性以及交易结果未造成国有资产流失。

3、对公司管理层、控制权、业务发展及经营业绩的影响

本次收购,实现了地方政府产业基金合理退出,同时也提升了发行人对第一工厂管理的决策效率和未来业绩潜力。本次收购为发行人对控股子公司少数股东权益的收购,发行人管理层、控制权、业务发展及经营业绩未发生其他变化。

(四) 2023年6月,发行人以所持奕斯伟设备75%股权认购芯晖装备股权

1、本次换股背景

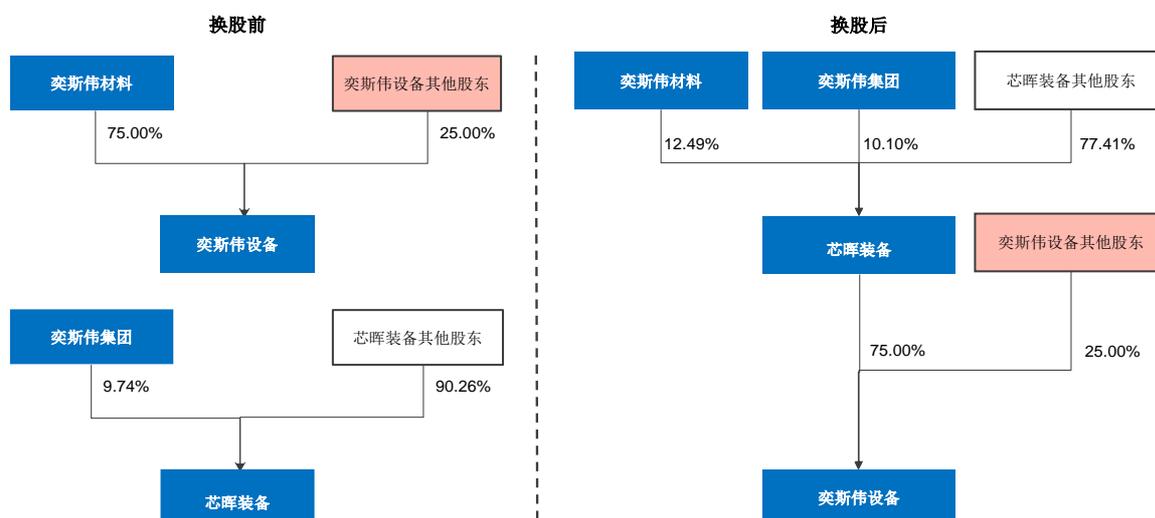
奕斯伟设备为发行人与西安理工大学和相应科研团队孵化的专注于12英寸硅片拉晶设备的企业,产品已在发行人产线量产使用。芯晖装备为奕斯伟集团生态链投资的半导体设备和解决方案企业,业务涉及电子级硅片研磨及抛光设备、晶圆前道量测、后道自动化测试设备等多个品类设备。

若奕斯伟设备始终在发行人体内发展,一是设备公司与材料公司的商业模式、估值逻辑和发展战略具有差异;二是奕斯伟设备产品线单一,发行人控股的股权结构下缺乏多元化客户的市场能力。换股后,奕斯伟设备不再纳入发行人合并报

表范围,成为芯晖装备的控股子公司,可与芯晖装备其他产品线互补,具有更强的整体方案服务能力,团队更具有市场独立意识,有利于自身发展。

根据《换股收购协议》约定:本次交易交割后,1)奕斯伟设备需优先保证满足发行人设备供应,需优先满足发行人的定制需求;2)同等条件下,需保证给予发行人最优惠设备价格;3)就发行人曾经或将来委托奕斯伟设备、芯晖装备定制设备所交付的 IP、Know-How 和相关技术文件,所有权仍归属发行人;4)发行人与奕斯伟设备的共有专利继续保持共有状态,奕斯伟设备利用共有专利制作的设备可以出售给第三方,但应晚于发行人首批采购相应设备之日起 18 个月。

本次换股前后结构如下:



注:奕斯伟集团同步以所持的西安埃纳检测技术有限公司(重组后更名为“西安芯晖检测技术有限公司”)50%股权认购芯晖装备股权,使得重组后奕斯伟集团持有芯晖装备的股权比例大于重组前。

2、履行的法定程序

2022年9月1日,奕斯伟材料有限股东会审议通过换股交易的决议案。

2022年7月22日,天健兴业以2022年6月30日为评估基准日出具《资产评估报告》(天兴评报字[2022]第1319号)和《资产评估报告》(天兴评报字[2022]第1249号)分别确定芯晖装备股东全部权益和奕斯伟设备净资产的评估值。

2023年6月16日,发行人、芯晖装备及奕斯伟设备签署《换股收购协议》,约定参考评估值并经协商确定最终交易价格。

2023年6月28日,芯晖装备完成本次换股交易的工商变更登记。

2023年6月30日,奕斯伟设备完成本次换股交易的工商变更登记。

2025年3月,芯晖装备股东海宁毅晟半导体投资合伙企业(有限合伙)和海宁市泛半导体产业投资有限公司的主要出资人浙江钱塘江投资开发有限公司(实际控制人为海宁市财政局)已出具本次换股估值公允确认的签章访谈记录。

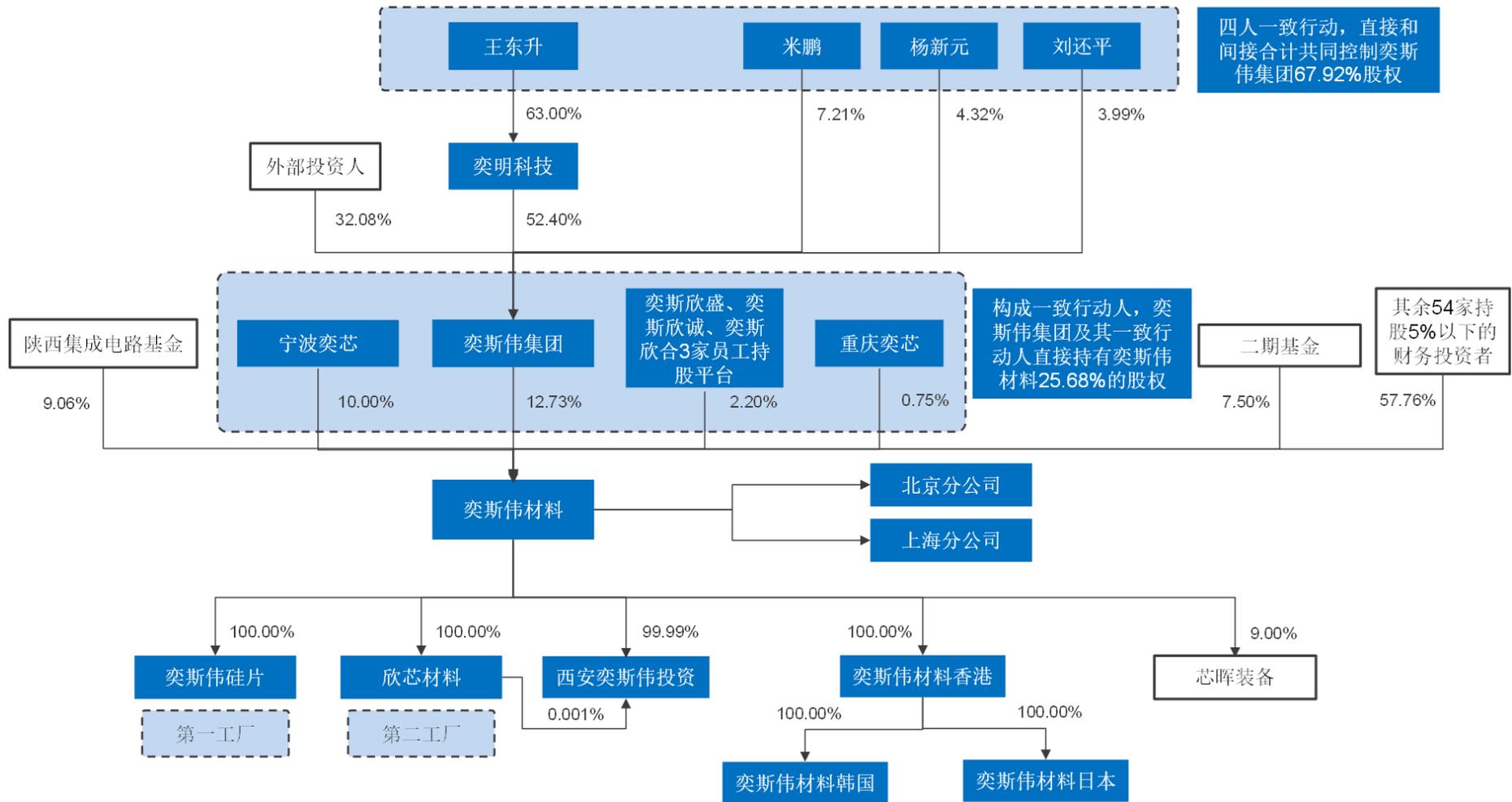
3、对公司管理层、控制权、业务发展及经营业绩的影响

本次换股交易完成后,奕斯伟设备不再纳入发行人合并报表范围,芯晖装备成为发行人参股子公司。发行人主业更集中于12英寸硅片业务,并通过参股芯晖装备保障了其拉晶设备、研磨及抛光设备等相关产品对发行人的综合服务能力。除此之外,发行人管理层、控制权及业务发展未发生重大变化。

五、公司不存在其他证券市场的上市及挂牌情况

六、发行人的股权结构

截至本招股说明书签署日,发行人股权结构图如下:



七、发行人子公司、分公司及参股公司情况

截至本招股说明书签署日,公司下设5家全资子公司、1家控制的合伙企业、1家参股子公司和2家分公司。报告期内,公司注销1家控股子公司,转让1家控股子公司,具体如下:

公司名称	类型	定位
奕斯伟硅片	全资子公司	第一工厂法人主体
欣芯材料	全资子公司	第二工厂法人主体,本次发行募投项目实施主体
奕斯伟材料香港	全资子公司	境外客户服务及市场拓展
奕斯伟材料韩国	全资子公司	境外客户服务及市场拓展
奕斯伟材料日本	全资子公司	境外客户服务及市场拓展
西安奕斯伟投资	欣芯材料作为执行事务合伙人和普通合伙人,发行人作为有限合伙人的合伙企业	奕斯伟硅片(第一工厂)原少数股东西安硅产业基金的普通合伙人之一。2023年6月西安硅产业基金持有的第一工厂少数股权被发行人收购(具体详见本节之“四、(三)2023年6月,发行人收购控股子公司奕斯伟硅片少数股权”)后,目前无实际业务
奕斯伟材料技术(已注销)	控股子公司	奕斯伟硅片(第一工厂)原控股股东,2022年7月被奕斯伟材料有限吸收合并后注销(具体详见本节之“四、(二)2022年7月,奕斯伟材料有限吸收合并控股子公司奕斯伟材料技术”)
奕斯伟设备(已转让)	控股子公司	发行人孵化的12英寸硅片拉晶设备公司,2023年6月发行人通过换股方式实现股权转让(具体详见本节之“四、(四)2023年6月,发行人以所持奕斯伟设备75%股权认购芯晖装备股权”)
芯晖装备	参股公司	控股股东奕斯伟集团生态链投资的半导体设备和解决方案业务主体,产品涉及电子级硅片研磨及抛光设备、晶圆前道量测、后道自动化测试设备等。受让奕斯伟设备控股权后,产品品类新增电子级硅片拉晶设备
北京分公司	分公司	销售分公司,负责国内北方区域客户
上海分公司	分公司	销售分公司,负责国内华东、华南区域客户

注:报告期内,公司合并报表范围内全资及控股子公司/企业财务数据均已按照企业会计准则的规定编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由毕马威会计师进行审计并出具了无保留意见的《审计报告》。

(一) 奕斯伟硅片

企业名称	西安奕斯伟硅片技术有限公司				
成立时间	2018年02月09日				
注册资本	660,000.00 万元				
实收资本	660,000.00 万元				
注册地和主要生产经营地	陕西省西安市高新区西沣南路 1888 号				
股东构成及控制关系	发行人持股 100.00%				
主营业务及在发行人业务板块中定位	第一工厂主体，其与母公司分工为：1) 母公司为管理总部、研发与技术中心、市场及供应链管理中心，第一工厂为具体的采购和生产主体；2) 第一工厂根据母公司安排与供应商签订采购合同，组织生产，并将产成品销售给母公司，母公司与客户签订销售合同，负责产品交付，收取回款；3) 涉及产线工艺及设备研发项目，由母公司为主，第一工厂为辅，联合研发				
最近一年主要财务数据	项目(万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2024年末/2024年	1,085,598.71	653,552.50	200,932.45	-30,414.98

(二) 欣芯材料

企业名称	西安欣芯材料科技有限公司				
成立时间	2022年08月03日				
注册资本	504,400.00 万元				
实收资本	355,000.00 万元				
注册地和主要生产经营地	陕西省西安市高新区西沣南路 1888 号 1 号办公楼 1-1-046 室				
股东构成及控制关系	发行人持股 100.00%				
主营业务及在发行人业务板块中定位	第二工厂主体，截至本招股说明书签署日，约 8 万片/月产能已达产，产能尚在爬坡过程中，与母公司分工与第一工厂一致				
最近一年主要财务数据	项目(万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2024年末/2024年	544,987.91	336,024.37	10,231.84	-18,039.63

(三) 奕斯伟材料香港

企业名称	奕斯伟材料科技(香港)有限公司				
成立时间	2023年09月05日				
注册资本	100.00万港元				
实收资本	100.00万港元				
注册地和主要生产经营地	Room 601, 6th Floor, Wah Yuen Building, 145-149 Queen's Road Central, Hong Kong				
股东构成及控制关系	发行人持股 100.00%				
主营业务及在发行人业务板块中定位	境外客户服务及市场拓展				
最近一年主要财务数据	项目(万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2024年末/2024年	91.93	91.93	-	-0.67

(四) 奕斯伟材料韩国

企业名称	奕斯伟材料科技(韩国)有限公司				
成立时间	2024年03月05日				
注册资本	14,000.00万韩元				
实收资本	14,000.00万韩元				
注册地和主要生产经营地	韩国京畿道城南市盆塘区板桥驿路230号B栋413、414、415(三坪洞, Samhwan HIPEX)				
股东构成及控制关系	奕斯伟材料香港持股 100.00%				
主营业务及在发行人业务板块中定位	境外客户服务及市场拓展				
最近一年主要财务数据	项目(万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2024年末/2024年	129.47	49.36	24.85	-25.05

(五) 奕斯伟材料日本

企业名称	奕斯伟材料科技日本株式会社
成立时间	2024年07月16日
注册资本	130.00万日元
实收资本	130.00万日元
注册地和主要生产经营地	东京都港区高轮四丁目23番6号ハイホーム高轮708
股东构成及控制关系	奕斯伟材料香港持股100.00%
主营业务及在发行人业务板块中定位	境外客户服务及市场拓展
最近一年一期主要财务数据(不适用)	奕斯伟材料日本2024年7月设立,最近一期尚未开展业务,财务数据不适用

(六) 西安奕斯伟投资

企业名称	西安奕斯伟投资合伙企业(有限合伙)				
成立日期	2018年12月14日				
出资额	1,000.01万元				
主要经营场所	陕西省西安市高新区西沣南路1888号1-3-017室				
主营业务及其与发行人主营业务的关系	目前无实际业务				
出资人构成	发行人全资子公司欣芯材料出资0.001%担任普通合伙人及执行事务合伙人,发行人出资99.999%担任有限合伙人				
最近一年主要财务数据	项目(万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2024年末/2024年	331.58	331.58	-	0.51

(七) 奕斯伟材料技术(2022年7月29日工商注销)

企业名称	西安奕斯伟材料技术有限公司
成立时间	2018年01月30日

注册资本	2,645.50 万元				
实收资本	2,645.50 万元				
注册地和主要生产经营地	陕西省西安市高新区西沣南路 1888 号 1-3-068				
股东构成及控制关系	注销前奕斯伟材料有限持股 84.00%，陕西集成电路基金持股 16.00%				
主营业务及在发行人业务板块中定位	奕斯伟硅片（第一工厂）原控股股东，仅为持股平台，无实际业务。2022 年 7 月被奕斯伟材料有限吸收合并后注销，具体详见本节之“四、（二）2022 年 7 月，奕斯伟材料有限吸收合并控股子公司奕斯伟材料技术”				
注销前一年主要财务数据	项目（万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2021 年末 /2021 年	243,260.81	240,427.46	-	-16,103.08

注：奕斯伟材料技术 2021 年亏损为奕斯伟硅片（第一工厂）的投资亏损。

（八）奕斯伟设备（2023 年 6 月 30 日完成转让工商变更）

企业名称	西安芯晖设备技术有限公司				
成立时间	2019 年 07 月 25 日				
注册资本	6,000.00 万元				
实收资本	6,000.00 万元				
注册地和主要生产经营地	陕西省西安市高新区翠北路 219 号 E6 座-001				
股东构成及控制关系	转让前发行人持股 75.00%，西安芯磁智能科技合伙企业（有限合伙）持股 20.00%，西安理工大资产经营管理有限公司持股 5.00%；转让后芯晖装备持股 75.00%，其他股东持股比例不变。 截至本招股说明书签署日，芯晖装备持股 79.00%，西安芯磁智能科技合伙企业（有限合伙）持股 20.00%，西安理工大资产经营管理有限公司持股 1.00%				
主营业务及在发行人业务板块中定位	发行人孵化的 12 英寸硅片拉晶设备公司，2023 年 6 月发行人通过换股实现股权转让，具体详见本节之“四、（四）2023 年 6 月，发行人以所持奕斯伟设备 75%股权认购芯晖装备股权”				
转让前一年主要财务数据	项目（万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2022 年末 /2022 年	12,908.96	7,296.67	10,157.16	2,067.44

(九) 芯晖装备

企业名称	浙江芯晖装备技术有限公司				
成立时间	2018年04月24日				
注册资本	5,169.35 万美元				
实收资本	4,652.19 万美元				
注册地和主要生产经营地	浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区漕河泾路 17 号 03 幢				
股东构成及控制关系	截至本招股说明书签署日, 海宁毅晟半导体投资合伙企业(有限合伙)持股 30.15%, 株式会社微铁克持股 11.76%, 发行人持股 9.00%, 奕斯伟集团持股 8.57%, 新理益集团持股 8.44%, 嘉兴芯欣企业管理合伙企业(有限合伙)持股 7.10%, 北京奕盛科技有限公司持股 5.85%, 其他持股 5%以下股东合计持股 19.13%				
主营业务及在发行人业务板块中定位	控股股东奕斯伟集团生态链投资的半导体设备和解决方案业务主体, 产品涉及电子级硅片研磨及抛光设备、晶圆前道量测、后道自动化测试设备。整合奕斯伟设备后, 产品品类新增电子级硅片拉晶设备。报告期内芯晖装备与发行人关联交易具体详见本招股说明书“第八节 公司治理与独立性”之“七、(三) 报告期内关联交易情况”				
最近一年主要财务数据	项目(万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2024年末/2024年	114,445.32	67,237.29	23,089.21	-8,142.36

(十) 北京分公司

企业名称	西安奕斯伟材料科技股份有限公司北京分公司
注册地和主要经营地	北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 1 号楼 3 层 301 室
成立时间	2022 年 04 月 12 日
主营业务	销售分公司, 负责国内北方区域客户

(十一) 上海分公司

企业名称	西安奕斯伟材料科技股份有限公司上海分公司
注册地和主要经营地	上海市闵行区号文路 111 号 503B 室
成立时间	2022 年 07 月 21 日
主营业务	销售分公司, 负责国内华东、华南区域客户

八、持有发行人百分之五以上股份的主要股东和实际控制人情况

(一) 控股股东情况

截至本招股说明书签署日，奕斯伟集团直接持有公司 12.73% 的股份，为发行人第一大股东。鉴于：1) 根据《上市公司收购管理办法》，奕斯伟集团与宁波奕芯、重庆奕芯、三家员工持股平台（奕斯欣盛、奕斯欣诚、奕斯欣合）构成一致行动人。截至本招股说明书签署日，奕斯伟集团及其一致行动人直接控制公司 25.68% 的股份，控制比例远高于其他任何股东；2) 根据发行人《公司章程》，发行人董事会成员共 9 席，其中独立董事 3 名，6 名非独立董事中 5 名由奕斯伟集团提名，奕斯伟集团可提名发行人非独立董事中半数以上成员。

综上，奕斯伟集团为发行人控股股东，对发行人合并报表。具体如下：

股东名称	北京奕斯伟科技集团有限公司		
成立时间	2016 年 03 月 21 日		
注册资本	3,608.26 万元		
实收资本	3,608.26 万元		
注册地和主要生产经营地	北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 1 号楼 4 层		
主营业务及其与发行人主营业务关系	奕斯伟集团是一家专注于集成电路产业发展和生态链建设的科技平台型公司。奕斯伟集团通过控股方式专注智能化系统级解决方案和 12 英寸硅片两大业务，并孵化投资半导体生态链项目（包括碳化硅材料与器件、板级系统封测、显示驱动芯片封测、半导体设备等）		
股东构成	股东名称	股东性质	持股比例
	奕明科技	间接控股股东	52.40%
	宁波盈泰泓投资合伙企业（有限合伙）	外部投资人	21.61%
	米鹏	实际控制人之一	7.21%
	天津皓天中佳股权投资合伙企业（有限合伙）	外部投资人	6.59%
	杨新元	实际控制人之一	4.32%
	刘还平	实际控制人之一	3.99%
	方向明	早期投资人	3.88%

	合计			100.00%	
最近一年主要 财务数据	项目(万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2024年末 /2024年	2,370,430.53	1,338,796.89	420,232.73	-239,604.27

截至本招股说明书签署日，奕明科技持有奕斯伟集团 52.40%的股权，为发行人间接控股股东，具体如下：

股东名称	北京奕明科技合伙企业（有限合伙）			
成立日期	2021年06月11日			
出资额	1,890.74 万元			
主要经营场所	北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 1 号院楼 4 层			
主营业务及其与发行人主营业务关系	奕斯伟集团的控股股东，奕斯伟集团核心骨干的持股平台			
出资人构成	合伙人	合伙人类型及职位		出资比例
	王东升	普通合伙人、执行事务合伙人，奕斯伟集团董事长，公司实际控制人之一		63.00%
	王辉	有限合伙人，奕斯伟集团总经理		9.00%
	王波	有限合伙人，奕斯伟计算副董事长		5.00%
	楼晓东	有限合伙人，奕斯伟计算计算连接事业部 CEO		5.00%
	王雯琦	有限合伙人，奕斯伟计算首席人事官		3.00%
	倪恩伟	有限合伙人，奕斯伟计算显示交互事业部 CEO		3.00%
	蔡培锋	有限合伙人，奕斯伟材料副总裁		3.00%
	龚发华	有限合伙人，奕斯伟计算首席生产采购官		3.00%
	胡巍浩	有限合伙人，奕斯伟计算首席营销官		3.00%
	何宁	有限合伙人，奕斯伟计算首席技术官		3.00%
	合计			100.00%

为推动奕斯伟集团高质量发展，保障奕斯伟集团发展的战略定力，担当其下属控股子公司的控股股东责任，打造集成电路领域受人尊敬的伟大企业，奕斯伟集团制定《北京奕斯伟科技集团有限公司核心骨干持股管理办法》，约定如下：

适用范围:通过持有奕明科技财产份额而间接持有奕斯伟集团股权的王东升及奕斯伟集团及其下属控股子公司核心骨干成员,以及直接持有奕斯伟集团股权的米鹏、杨新元和刘还平,以下简称“持股人员”。

持股人员条件:认同奕斯伟集团价值观,承诺所任职的奕斯伟集团下属控股主体上市后十年不主动离职,在奕斯伟集团或下属控股主体担任主要经营责任岗位三年以上且每年考核为优良。

收益分配:奕斯伟集团当年实现现金利润,年末累计未分配利润为正数,且无重大投资或重大现金支出方可分红。

退出机制:为推动奕斯伟集团永续经营,成为集成电路领域基业长青的公司,奕斯伟集团实行事业发展传承及股权退出转让机制,持股人员是否持股与其是否在奕斯伟集团及其控股子公司任职相挂钩,若持股人员从奕斯伟集团及其控股子公司离职,则其所持股权要转让给下一代核心创业骨干,事业传承,股权传承。股权只能在奕斯伟集团及其控股子公司的核心骨干之间转让,不允许对外转让。

股权转让的对价计算方法:持股人员的原始出资额加一定溢价。其中溢价部分,原则上参照中国人民银行同期贷款年利率,单利计算,同时考虑持股人员对公司的贡献、服务年限、业绩考核情况等因素综合确定。同时,还需将转让对价与转让时对应奕斯伟集团实际可变现的股权市场估算价格对比,两者取其小。

截至本招股说明书签署日,公司控股股东直接和间接持有的本公司股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。

(二) 实际控制人情况

2019年11月,奕斯伟集团部分股东将表决权委托于王东升先生。基于前述表决权委托,王东升先生与米鹏、杨新元和刘还平三位奕斯伟集团的管理团队股东于2019年12月签署《一致行动协议》,约定:“四人行使(奕斯伟集团)相应提案权、表决权前,各方应先协商一致,形成一致意见后,按照一致意见行使相关提案权、表决权。若经协商后无法形成一致意见的,以王东升的表决结果为一致意见”。四人自协议签署后至今,始终保持稳定的一致行动关系。2022年7月,王东升先生通过货币增资完成对奕斯伟集团的间接持股,夯实了上述共同

控制结构。截至本招股说明书签署日，四人直接和间接控制发行人控股股东奕斯伟集团合计 67.92%的股权。四人简历具体如下：

王东升，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 1101051957*****1X。男，1957 年出生，硕士研究生，管理工程专业。王东升先生于 1993 年创立京东方并担任董事长、执行委员会主席等职务，领导京东方解决了中国“少屏”的问题，并使京东方成长为全球半导体显示领域的领军企业，被业界誉为“中国半导体显示产业之父”。他曾获得国际信息显示学会授予的“大卫·萨诺夫产业成就奖”、“中国信息产业领袖人物”等多项荣誉。2019 年 6 月，王东升先生从京东方卸任，并于 2019 年 7 月应邀加入北京奕斯伟科技，开始致力于“芯”的事业，并于 2019 年 11 月担任奕斯伟集团董事长和奕斯伟计算董事长至今。在 2019 年 7 月至 2023 年 2 月期间，王东升先生担任奕斯伟材料有限董事长；考虑人才梯队建设，2023 年 3 月股份公司设立时，推荐杨新元先生为公司董事长。杨新元先生被选举为公司董事长后，王东升先生仍任公司董事、董事会战略与投资委员会主席至今。

米鹏，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 1427031980*****7X。男，1980 年出生，硕士研究生，经济学专业。2001 年 7 月至 2015 年 6 月，历任京东方下属子公司财务部科长、总部预算部部长，总部投资部部长，总部经营企划中心长等职务；2015 年 6 月至 2017 年 12 月，任北京芯动能管理公司副总经理。2018 年 1 月至 2019 年 9 月，任北京奕斯伟科技总经理；2019 年 9 月起，历任奕斯伟计算董事、财务总监、车载事业部总经理等职务；2023 年 12 月起，担任奕斯伟计算总经理至今。2019 年 11 月起，担任奕斯伟集团董事至今。

杨新元，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 6223221978*****16。男，1978 年出生，硕士研究生，工业工程专业。2003 年 7 月至 2018 年 7 月，历任京东方下属子公司品质科科长、品质部部长、品质总监，工厂长，子公司总经理等职务。2018 年 7 月起，历任公司董事、总经理，首席执行官等职务；2023 年 3 月至今，担任公司董事长、执行委员会主席。杨新元先生主要负责奕斯伟集团下属 12 英寸硅片板块（即奕斯伟材料）的公司治理、战略规划和公司经营目标达成等全面经营工作。

刘还平，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 4224251979*****33。男，1979 年出生，硕士研究生，物理学专业。2004 年 4 月至 2017 年 11 月，历任京东方下属子公司技术部科长、部长、副总经理、总经理等职务。2018 年 2 月至 2024 年 2 月，历任第一工厂总经理，公司总裁等职务；2024 年 3 月至今，任公司总经理、执行委员会副主席。刘还平先生主要负责奕斯伟集团下属 12 英寸硅片板块（即奕斯伟材料）的市场与客户、技术与研发、生产管理、品质与供应链、IT 与自动化等日常经营工作。

截至本招股说明书签署日，公司实际控制人直接和间接持有的本公司股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。

（三）控股股东的一致行动人情况

截至本招股说明书签署日，宁波奕芯、重庆奕芯、奕斯欣盛、奕斯欣诚、奕斯欣合为控股股东奕斯伟集团的一致行动人。具体情况如下：

1、宁波奕芯（持股比例 10.00%）

股东名称	宁波奕芯股权投资合伙企业（有限合伙）		
成立日期	2022 年 04 月 25 日		
出资额	150,410.00 万元		
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 E1858		
主营业务及其与发行人主营业务的关系	与发行人主营业务无关，为投资发行人的专项基金		
出资人构成	合伙人	类型	出资比例
	奕斯伟集团	普通合伙人、执行事务合伙人	0.07%
	北京奕行私募基金管理有限公司	普通合伙人、私募基金管理人	0.01%
	国华人寿保险股份有限公司	有限合伙人	99.93%
	合计		100.00%

2、重庆奕芯（持股比例 0.75%）

股东名称	重庆两江奕芯私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
------	--------------------------

成立日期	2023年04月23日		
出资额	40,100.00万元		
主要经营场所	重庆市江北区聚贤街25号2幢第30-1号		
主营业务及其与发行人主营业务的关系	与发行人主营业务无关，为投资发行人的专项基金		
出资人构成	合伙人	类型	出资比例
	北京奕行私募基金管理有限公司	执行事务合伙人、私募基金管理人	0.25%
	重庆兴农融资担保集团有限公司	有限合伙人	49.88%
	重庆两江新区开发投资集团有限公司	有限合伙人	49.88%
	合计		100.00%

3、奕斯欣盛（持股比例 0.88%）

股东名称	西安奕斯欣盛科技合伙企业（有限合伙）		
成立日期	2021年01月29日		
出资额	112.75万元		
主要经营场所	陕西省西安市高新区西沣南路1888号1-3-016室		
主营业务及其与发行人主营业务的关系	发行人直接员工持股平台之一		
出资人构成	合伙人	类型	出资比例
	奕斯伟集团	普通合伙人、执行事务合伙人	0.0001%
	欣盛一号	有限合伙人	84.31%
	欣盛二号	有限合伙人	15.69%
	合计		100.00%

4、奕斯欣诚（持股比例 0.66%）

股东名称	西安奕斯欣诚科技合伙企业（有限合伙）		
成立日期	2021年01月29日		
出资额	84.56万元		

主要经营场所	陕西省西安市高新区西沣南路 1888 号 1-3-012 室		
主营业务及其与发行人 主营业务的关系	发行人直接员工持股平台之一		
出资人构成	合伙人	类型	出资比例
	奕斯伟集团	普通合伙人、执行事务合伙人	0.0001%
	欣诚一号	有限合伙人	61.42%
	欣诚二号	有限合伙人	38.58%
	合计		100.00%

5、奕斯欣合（持股比例 0.66%）

股东名称	西安奕斯欣合科技合伙企业（有限合伙）		
成立日期	2021 年 01 月 28 日		
出资额	84.56 万元		
主要经营场所	陕西省西安市高新区西沣南路 1888 号 1-3-018 室		
主营业务及其与发行人 主营业务的关系	发行人直接员工持股平台之一		
出资人构成	合伙人	类型	出资比例
	奕斯伟集团	普通合伙人、执行事务合伙人	0.0001%
	欣合一号	有限合伙人	82.38%
	欣合二号	有限合伙人	5.13%
	欣合三号	有限合伙人	3.93%
	欣合四号	有限合伙人	4.64%
	欣合五号	有限合伙人	3.91%
	合计		100.00%

公司员工持股平台具体情况详见本节之“十五、发行人本次申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排”。

截至本招股说明书签署日，公司控股股东的一致行动人直接和间接持有的本公司股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。

(四) 其他持有发行人 5%以上股份的主要股东情况

1、陕西集成电路基金（持股比例 9.06%）

股东名称	陕西省集成电路产业投资基金（有限合伙）		
成立日期	2016年08月25日		
出资额	363,300.00 万元		
主要经营场所	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座1幢1单元11804室		
主营业务及其与发行人主营业务的关系	与发行人主营业务无关，主要从事半导体产业链企业的股权投资		
基金管理人	西安高新技术产业风险投资有限责任公司		
出资人构成	合伙人名称	类型	出资比例
	西安高新技术产业风险投资有限责任公司	普通合伙人、执行事务合伙人	0.91%
	西安高新新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	38.54%
	西安高新硬科技产业投资控股集团有限公司	有限合伙人	27.53%
	西安投资控股有限公司	有限合伙人	16.52%
	西安经恒金融服务有限公司	有限合伙人	8.26%
	西安产业投资基金有限公司	有限合伙人	8.26%
	合计		100.00%

2、二期基金（持股比例 7.50%）

股东名称	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
成立日期	2019年10月22日
注册资本	20,415,000.00 万元
实收资本	13,297,383.79 万元
注册地	北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7层701-6
主要生产经营地	北京市西城区真武庙1号职工之家C座21-23层
主营业务及其与发行人主营业务的关系	与发行人主营业务无关，主要从事半导体产业链企业的股权投资
基金管理人	华芯投资管理有限责任公司

股东情况	股东名称	持股比例
	中华人民共和国财政部	11.02%
	国开金融有限责任公司	10.78%
	浙江富浙集成电路产业发展有限公司	7.35%
	成都天府国集投资有限公司	7.35%
	上海国盛(集团)有限公司	7.35%
	武汉光谷金融控股集团有限公司	7.35%
	重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7.35%
	中国烟草总公司	7.35%
	其他持股5%以下股东合计	34.12%
	合计	100.00%

九、发行人不存在特别表决权股份或类似安排情况

十、发行人不存在协议控制架构情况

十一、控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为

报告期内，发行人控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产及破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

十二、发行人股本情况

(一) 本次发行前后股本情况

序号	股东名称	发行前		发行后	
		股数(万股)	持股比例	股数(万股)	持股比例
1	奕斯伟集团	44,562.73	12.73%	44,562.73	11.04%
2	宁波奕芯	34,991.39	10.00%	34,991.39	8.67%
3	奕斯欣盛	3,074.90	0.88%	3,074.90	0.76%

4	奕斯欣诚	2,306.25	0.66%	2,306.25	0.57%
5	奕斯欣合	2,306.25	0.66%	2,306.25	0.57%
6	重庆奕芯	2,624.23	0.75%	2,624.23	0.65%
7	陕西集成电路基金	31,725.67	9.06%	31,725.67	7.86%
8	二期基金	26,243.51	7.50%	26,243.51	6.50%
9	宁波庄宣	14,093.47	4.03%	14,093.47	3.49%
10	中建材新材料基金	12,246.90	3.50%	12,246.90	3.03%
11	嘉兴隼望	11,663.80	3.33%	11,663.80	2.89%
12	渝富芯材	11,372.52	3.25%	11,372.52	2.82%
13	中芯熙诚	8,747.74	2.50%	8,747.74	2.17%
14	国寿趵泉	8,623.90	2.46%	8,623.90	2.14%
15	西安汇奕	8,345.36	2.38%	8,345.36	2.07%
16	中证投资	7,687.40	2.20%	7,687.40	1.90%
17	中网投	7,687.40	2.20%	7,687.40	1.90%
18	嘉兴顾嘉	7,575.59	2.16%	7,575.59	1.88%
19	天津博思	7,389.07	2.11%	7,389.07	1.83%
20	陕西民营基金	6,406.07	1.83%	6,406.07	1.59%
21	创合材丰	6,140.95	1.75%	6,140.95	1.52%
22	众励投资	5,893.68	1.68%	5,893.68	1.46%
23	宏兆天实	5,124.89	1.46%	5,124.89	1.27%
24	长峡金石	4,612.36	1.32%	4,612.36	1.14%
25	三行资本	4,320.11	1.23%	4,320.11	1.07%
26	烟台中冀	3,938.35	1.13%	3,938.35	0.98%
27	建投投资	3,499.01	1.00%	3,499.01	0.87%
28	北京硅新	3,227.11	0.92%	3,227.11	0.80%
29	苏州芯动能	3,074.90	0.88%	3,074.90	0.76%
30	泓生嘉启	2,954.24	0.84%	2,954.24	0.73%
31	睿势六期	2,624.23	0.75%	2,624.23	0.65%
32	钛信九期	2,589.36	0.74%	2,589.36	0.64%

33	川投金石	2,562.51	0.73%	2,562.51	0.63%
34	建银国际	2,562.51	0.73%	2,562.51	0.63%
35	广东星耀	2,306.25	0.66%	2,306.25	0.57%
36	源轩投资	2,099.38	0.60%	2,099.38	0.52%
37	建泉绿色基金	2,049.98	0.59%	2,049.98	0.51%
38	上海澜翎	1,879.23	0.54%	1,879.23	0.47%
39	普耀芯业	1,840.49	0.53%	1,840.49	0.46%
40	国合新力	1,784.45	0.51%	1,784.45	0.44%
41	上海综改基金	1,749.44	0.50%	1,749.44	0.43%
42	华泰紫金	1,749.44	0.50%	1,749.44	0.43%
43	长安汇通	1,749.44	0.50%	1,749.44	0.43%
44	江阴毅达	1,665.58	0.48%	1,665.58	0.41%
45	越秀智创	1,537.45	0.44%	1,537.45	0.38%
46	道禾源信	1,332.38	0.38%	1,332.38	0.33%
47	博达奕行	1,281.19	0.37%	1,281.19	0.32%
48	中小企业基金	1,281.19	0.37%	1,281.19	0.32%
49	东方电气基金	1,281.19	0.37%	1,281.19	0.32%
50	嘉兴翊榛	1,281.19	0.37%	1,281.19	0.32%
51	烟台伯和	1,281.19	0.37%	1,281.19	0.32%
52	天堂硅谷领新	1,281.19	0.37%	1,281.19	0.32%
53	天堂硅谷恒新	1,281.19	0.37%	1,281.19	0.32%
54	青岛远润	1,281.19	0.37%	1,281.19	0.32%
55	宁波卓煌	1,281.19	0.37%	1,281.19	0.32%
56	国开科创	874.65	0.25%	874.65	0.22%
57	佰仕德	874.65	0.25%	874.65	0.22%
58	光子强链	726.04	0.21%	726.04	0.18%
59	鑫华半导体	726.04	0.21%	726.04	0.18%
60	王建成	290.42	0.08%	290.42	0.07%
61	盛剑科技	217.81	0.06%	217.81	0.05%

62	海南瑞麟	217.81	0.06%	217.81	0.05%
63	A股新增股东	-	-	53,780.00	13.32%
合计		350,000.00	100.00%	403,780.00	100.00%

(二) 本次发行前十名股东持股情况

序号	股东名称	股数(万股)	持股比例
1	奕斯伟集团	44,562.73	12.73%
2	宁波奕芯	34,991.39	10.00%
3	陕西集成电路基金	31,725.67	9.06%
4	二期基金	26,243.51	7.50%
5	宁波庄宣	14,093.47	4.03%
6	中建材新材料基金	12,246.90	3.50%
7	嘉兴隼望	11,663.80	3.33%
8	渝富芯材	11,372.52	3.25%
9	中芯熙诚	8,747.74	2.50%
10	国寿聿泉	8,623.90	2.46%
合计		204,271.64	58.36%

(三) 前十名自然人股东及其在发行人担任的职务

本次发行前，公司有且仅有一名直接持股的自然人股东王建成。王建成直接持股数量为 290.42 万股，直接持股比例为 0.08%，为外部财务投资人，在公司无任职。

(四) 发行人股份中国有股份及外资股份情况

截至本招股说明书签署日，公司股东中共有 4 名国有股东符合《上市公司国有股权监督管理办法》第三条规定的情形。根据财政部 2024 年 9 月 3 日出具的《财政部关于确认国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司西安奕斯伟项目国有股权管理方案的函》（财建函[2024]42 号），下表股东标注“SS”标识。

股东名称	股数(万股)	持股比例	股东性质
二期基金	26,243.51	7.50%	SS

建投投资	3,499.01	1.00%	SS
建银国际	2,562.51	0.73%	SS
国开科创	874.65	0.25%	SS
合计	33,179.68	9.48%	-

截至本招股说明书签署日，公司不存在直接持股的外资股东。

(五) 申报前十二个月新增股东情况

截至本招股说明书签署日，申报前十二个月发行人新增股东共 5 家。相应股东看好公司及行业发展前景，于 2024 年 6 月通过受让原股东毅达鑫业所持全部股份完成入股。本次股权转让以公司最近一轮估值、实际经营情况、成长性和所处行业估值为参考，经交易各方协商确认交易价格。具体如下：

序号	股东名称	入股时间	入股轮次	转让金额 (万元)	认购股数 (万股)	持股比例	入股价格及 定价依据
1	光子强链	2024 年 6 月	报告期奕斯 伟材料第五 次股权转让	5,000.00	726.04	0.21%	转让方与受让方协商 定价，转让价格估值在 2023 年 5 月 CII 轮融资 投后估值 200.05 亿 元基础上溢价约 20%， 折合每股价格 6.89 元/ 股
2	鑫华半导体			5,000.00	726.04	0.21%	
3	王建成			2,000.00	290.42	0.08%	
4	盛剑科技			1,500.00	217.81	0.06%	
5	海南瑞麟			1,500.00	217.81	0.06%	

上表新增股东中，持有鑫华半导体 20.62%股份的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司与持有发行人 7.50%股份的股东二期基金的基金管理人均为华芯投资管理有限责任公司；光子强链的普通合伙人之一长安汇通私募基金管理有限公司为发行人股东长安汇通（持股比例 0.50%）与西安汇奕（持股比例 2.38%）的基金管理人。其余新增股东与公司其他股东均不存在关联关系。

上表新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系，新增股东不存在股份代持情形，新增股东具体情况详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二：申报前十二个月新增股东基本信息”。

(六) 本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

序号	关联股东	持股比例	关联关系
----	------	------	------

1	奕斯伟集团	12.73%	奕斯欣盛、奕斯欣诚和奕斯欣合的普通合伙人、执行事务合伙人均为奕斯伟集团，宁波奕芯的普通合伙人之一、执行事务合伙人亦为奕斯伟集团。宁波奕芯、重庆奕芯、奕斯欣盛、奕斯欣诚和奕斯欣合为奕斯伟集团的一致行动人
2	宁波奕芯	10.00%	
3	重庆奕芯	0.75%	
4	奕斯欣盛	0.88%	
5	奕斯欣诚	0.66%	
6	奕斯欣合	0.66%	
合计		25.68%	
1	宁波奕芯	10.00%	重庆奕芯与宁波奕芯的基金管理人均为北京奕行私募基金管理有限公司
2	重庆奕芯	0.75%	
合计		10.75%	
1	奕斯伟集团	12.73%	奕斯伟集团 21.61%的外部投资人股东宁波盈泰泓投资合伙企业(有限合伙)和宁波庄宣的执行事务合伙人均为宁波宣岳股权投资有限公司
2	宁波庄宣	4.03%	
合计		16.76%	
1	奕斯伟集团	12.73%	奕斯伟集团 6.59%的外部投资人股东天津皓天中佳股权投资合伙企业(有限合伙)和天津博思的执行事务合伙人委派代表均为牛奎光
2	天津博思	2.11%	
合计		14.84%	
1	奕斯伟集团	12.73%	奕斯伟集团 21.61%的外部投资人股东宁波盈泰泓投资合伙企业(有限合伙)、宁波奕芯和嘉兴隽望的唯一有限合伙人，宁波庄宣的主要有限合伙人城市更新股权投资(青岛即墨)合伙企业(有限合伙)的有限合伙人均为国华人寿保险股份有限公司
2	宁波奕芯	10.00%	
3	宁波庄宣	4.03%	
4	嘉兴隽望	3.33%	
合计		30.09%	
1	二期基金	7.50%	国开科创为国开金融有限责任公司的全资子公司，国开金融有限责任公司持有二期基金 10.78%的股份
2	国开科创	0.25%	
合计		7.75%	
1	二期基金	7.50%	二期基金与持有鑫华半导体 20.62%股权比例的国家集成电路产业投资基金股份有限公司的基金管理人均为华芯投资管理有限责任公司
2	鑫华半导体	0.21%	
合计		7.71%	
1	中证投资	2.20%	中证投资为中信证券子公司，长峡金石的执行事务合伙人长峡金石(武汉)私募基金管理有限公司的股东和川
2	长峡金石	1.32%	

3	川投金石	0.73%	投金石的执行事务合伙人均为中信证券子公司金石投资有限公司
合计		4.25%	
1	中建材新材料基金	3.50%	中证投资为中建材新材料基金出资比例约 0.67%的有限合伙人
2	中证投资	2.20%	
合计		5.70%	
1	西安汇奕	2.38%	长安汇通与西安汇奕的基金管理人均为长安汇通私募基金管理有限公司，长安汇通私募基金管理有限公司为光子强链的普通合伙人之一
2	长安汇通	0.50%	
3	光子强链	0.21%	
合计		3.09%	
1	三行资本	1.23%	北京三行资本管理有限责任公司为三行资本的执行事务合伙人，为博达奕行的执行事务合伙人和基金管理人，为青岛远润的基金管理人，
2	青岛远润	0.37%	
3	博达奕行	0.37%	
合计		1.97%	
1	北京硅新	0.92%	苏州芯动能的执行事务合伙人张家港益辰管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为北京益新创业投资管理有限公司，北京益新创业投资管理有限公司同时为北京硅新的执行事务合伙人
2	苏州芯动能	0.88%	
合计		1.80%	
1	烟台中冀	1.13%	广东星耀的执行事务合伙人为天津中冀普银股权投资基金管理有限公司，烟台中冀的执行事务合伙人为天津中冀万泰投资管理有限公司。天津中冀普银股权投资基金管理有限公司和天津中冀万泰投资管理有限公司均为中冀投资股份有限公司的全资子公司
2	广东星耀	0.66%	
合计		1.79%	
1	江阴毅达	0.48%	江阴毅达的执行事务合伙人南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）的执行事务合伙人西藏爱达汇承企业管理有限公司系江苏毅达股权投资基金管理有限公司的全资子公司。江苏毅达股权投资基金管理有限公司亦为中小企业基金的执行事务合伙人
2	中小企业基金	0.37%	
合计		0.85%	
1	天堂硅谷恒新	0.37%	天堂硅谷恒新的执行事务合伙人、基金管理人和天堂硅谷领新的基金管理人均为天堂硅谷资产管理集团有限公司
2	天堂硅谷领新	0.37%	
合计		0.74%	

(七) 现有股东的私募投资基金备案情况

截至本招股说明书签署日, 发行人共有 62 名股东, 其中机构股东 61 名, 自然人股东 1 名。机构股东中 41 名股东为私募基金, 均已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等规定进行登记或备案, 具体情况如下:

序号	股东名称	基金备案号	基金管理人	管理人登记编号
1	宁波奕芯	SVT999	北京奕行私募基金管理有限公司	P1072815
2	重庆奕芯	SZZ436		
3	陕西集成电路基金	SM5861	西安高新技术产业风险投资有限责任公司	P1002877
4	二期基金	SJU890	华芯投资管理有限责任公司	P1009674
5	中建材新材料基金	SSG288	中建材私募基金管理(北京)有限公司	P1072218
6	中网投	SS8838	中国互联网投资基金管理有限公司	P1060330
7	长峡金石	S32153	长峡金石(武汉)私募基金管理有限公司	PT2600031631
8	川投金石	SNA902	金石投资有限公司	PT2600030645
9	国寿惠泉	SJZ124	国寿股权投资有限公司	P1033329
10	天津博思	SGF749	和谐天明投资管理(北京)有限公司	P1032842
11	烟台中冀	SQA797	天津中冀普银股权投资基金管理有限公司	P1061163
12	广东星耀	SQF981	骆驼股权投资基金管理(广东)有限公司	P1067341
13	宏兆天实	SQC754	深圳前海宏兆基金管理有限公司	P1015204
14	博达奕行	SQF986	北京三行资本管理有限责任公司	P1031588
15	青岛远润	SQW285		
16	越秀智创	SEY649	广州越秀产业投资基金管理股份有限公司	P1000696
17	中小企业基金	SR1700	江苏毅达股权投资基金管理有限公司	P1001459

18	江阴毅达	SCU058	南京毅达股权投资管理企业(有限合伙)	P1032972
19	东方电气基金	SJJ122	东方江峡产业投资私募基金管理(成都)有限公司	P1070317
20	苏州芯动能	SQP703	北京芯动能投资管理有限公司	P1025879
21	嘉兴翊榛	SQL810	上海博池资产管理有限公司	P1063585
22	陕西民营基金	SJL036	陕西投资基金管理有限公司	P1034063
23	天堂硅谷领新	SLW022	天堂硅谷资产管理集团有限公司	P1000794
24	天堂硅谷恒新	SQY140		
25	亵泉绿色基金	SEX992	兴投(北京)资本管理有限公司	P1070313
26	道禾源信	SVD027	上海道禾源信私募基金管理有限公司	P1073087
27	泓生嘉启	SXJ135	泓生投资管理有限公司	P1065428
28	嘉兴隼望	SVW756	上海上汽恒旭投资管理有限公司	P1070270
29	中芯熙诚	SXQ619	中芯熙诚私募基金管理(北京)有限公司	P1072072
30	嘉兴顾嘉	SXS116	上海尚顾投资管理合伙企业(有限合伙)	P1002076
31	西安汇奕	SXP034	长安汇通私募基金管理有限公司	P1072443
32	长安汇通	SZA656		
33	创合材丰	SXL382	国投创合(上海)投资管理有限公司	P1069374
34	渝富芯材	SXT456	重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司	P1004104
35	上海综改基金	STY311	国新国同(杭州)股权投资有限公司	P1070382
36	佰仕德	SZL404	湖北佰仕德私募基金管理有限公司	P1002155
37	睿势六期	SZS502	天津睿势私募股权投资基金管理有限公司	P1073604
38	国合新力	SZU963	国合新力(北京)基金管理有限公司	P1071103
39	华泰紫金	SVE440	华泰紫金投资有限责任公司	PT2600011618

40	钛信九期	SZH283	深圳钛信私募股权投资基金管理有限公司	P1025377
41	光子强链	SB0829	陕西科迈投资管理合伙企业(有限合伙)	P1064094

公司其他 21 名股东不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形、不存在资产由基金管理人管理的情形、亦未担任任何私募投资基金的管理人,均不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规规定的私募投资基金或私募投资基金管理人,无需履行私募投资基金备案或私募投资基金管理人登记程序。

(八) 发行人本次公开发行不存在股东公开发售股份的情况

十三、股东特殊权利安排的终止

(一) 发行人股东特殊权利安排的约定与清理情况

1、发行人股东特殊权利安排的约定

发行人在历次融资中,与相应投资方签订的不同版本的《股东协议》《<股东协议>之补充协议》《增资协议》《<增资协议>之补充协议》《<股东协议>之加入协议》(前述协议以下合称“全部交易文件”)中约定了多项股东特殊权利,发行人作为签署方之一签署了上述“全部交易文件”。发行人历次股权转让中,新股东继承了原股东享有的股东特殊权利,即老股转让并未新增股东特殊权利,从而下文仅列示历次增资涉及的股东特殊权利,具体如下:

序号	时间与事项	协议名称	享有股东特殊权利的主体	股东特殊权利
1	2019年3月第一次增资(A轮融资)	《股东协议》 《增资协议》 《<增资协议>之补充协议》	天津博思、三行资本、北京芯动能基金、博华资本、上海中联信资本管理有限公司	优先认购权、股权转让限制及锁定、优先购买权和共同出售权、领售权、反稀释权、奕斯伟集团回购权、知情权和检查权、公司治理、清算优先权、最优惠条款、连带赔偿责任
2	2021年7月第三次增资(B轮融资)	《股东协议》 《<股东协议>之补充协议》 《<股东协议>之加入协	除控股股东及员工持股平台外的宁波庄宣、北京芯动能基金、中证投资、中网投、天津博思等 31	较 A 轮投资者特殊权利, B 轮融资投资者增加发行人回购权

		议》《增资协议》《<增资协议>之补充协议》	名股东	
3	2022年7月吸收合并奕斯伟技术	《股东协议》《<股东协议>之补充协议》	除控股股东及员工持股平台外的陕西集成电路基金、宁波庄宣、中证投资、中网投、天津博思等34名股东	与B轮融资投资者特殊权利一致
4	2022年9月第四次增资(B+轮融资)	《股东协议》《<股东协议>之补充协议》《增资协议》	除控股股东及员工持股平台外的宁波奕芯、陕西集成电路基金、宁波庄宣、嘉兴隼望、中证投资等36名股东	与B轮融资投资者特殊权利一致
5	2022年12月(CI轮融资)	《股东协议》《增资协议》	除控股股东及员工持股平台外的宁波奕芯、陕西集成电路基金、宁波庄宣、中建材新材料基金、嘉兴隼望等45名股东	因发行人回购权清理,与B轮融资投资者特殊权利相比,股东已不具有发行人回购权
6	2023年5月第六次增资(CII轮融资)	《股东协议》《增资协议》	除控股股东及员工持股平台外的宁波奕芯、陕西集成电路基金、二期基金、宁波庄宣、中建材新材料基金等54名股东	与CI轮融资投资者特殊权利一致,其中约定的控股股东奕斯伟集团回购权触发条件为发行人未在规定时间内完成合格上市

2、发行人股东特殊权利安排的清理情况

时间	协议名称	享受特殊权利主体	特殊权利约定终止情况
2022年12月	《承诺函》	2022年12月公司除控股股东及员工持股平台外的36名机构股东	自签署承诺函之日起,“全部交易文件”项下所有涉及发行人减资或由发行人回购投资人出资份额相关义务或因其他方违约而导致的发行人承担连带赔偿责任和义务的任何条款不可撤销地终止且不可恢复,该等终止效力追溯至交易文件签订之日,即交易文件中前述条款自始无效
2023年9月	《关于西安奕斯伟材料科技股份有限公司股东特殊权利之终止协议》	2023年9月公司除控股股东及员工持股平台外的54名机构股东	1) 确认“全部交易文件”中发行人作为回购义务人的条款已清理,自发行人股改基准日(即2022年11月30日)起彻底终止,自始无效且不可恢复; 2) 除前述条款外,《股东协议》中的其他

			<p>股东特殊权利条款于发行人向证券交易所提交上市申报文件之日终止，但若发行人合格上市的申请提交后未获得受理、被撤回或主动撤回、被终止审查或者不予批准或不予注册，则已终止的条款自动恢复法律效力且视为从未失效或被终止（即附条件可恢复权利）；</p> <p>3）若因法律法规或上市审核政策要求彻底终止 2023 年 5 月签署的《股东协议》的终止条款且不附带恢复条款，投资人应在十个工作日或公司要求的其他期限内积极配合签署相关文件（如有）或提供必要资料，以便顺利推动合格上市申请的提交、审核以及上市</p>
--	--	--	---

注：2023 年 9 月《关于西安奕斯伟材料科技股份有限公司股东特殊权利之终止协议》签署后，2024 年 6 月光子强链、鑫华半导体、盛剑科技、海南瑞麟、王建成 5 家投资者通过受让原股东毅达鑫业所持全部股份完成入股，前述投资者承继毅达鑫业在《股东协议》项下对应的权利和义务，亦应被视为《股东协议》和《关于西安奕斯伟材料科技股份有限公司股东特殊权利之终止协议》的一方当事人，受其约束，从而目前享有附条件可恢复权利的股东除控股股东奕斯伟集团和三个员工持股平台外，合计 58 家。

（二）对公司的影响

公司作为回购义务人涉及的股东特殊权利已基于 2022 年 12 月各方签署的《承诺函》彻底终止并自始无效，《承诺函》的签署在股改审计报告出具日之前。

除此之外，根据发行人作为签署方之一的《关于西安奕斯伟材料科技股份有限公司股东特殊权利之终止协议》，其他特殊股东权利在发行人向上交所提交上市申报文件之日终止，其中《股东协议》中涉及的非发行人回购义务的特殊股东权利附条件可恢复，附条件恢复的相关约定在公司本次发行在审期间及上市后均不会恢复，不存在对发行人构成重大不利影响或严重影响投资者权益的情形。

严谨起见，公司正积极沟通彻底终止且不可恢复目前除控股股东和三个员工持股平台之外的 58 家股东享有的附条件可恢复权利。

十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员概况

1、董事会成员

截至本招股说明书签署日，公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名，均为中国国籍，均无境外永久居留权，具体如下：

姓名	职位	提名人	本届任职期间
杨新元	董事长	奕斯伟集团	2023 年 3 月至 2026 年 3 月
王东升	董事		2023 年 3 月至 2026 年 3 月
方向明	董事		2023 年 3 月至 2026 年 3 月
王辉	董事		2023 年 3 月至 2026 年 3 月
郭辉	董事		2023 年 3 月至 2026 年 3 月
杨卓	董事	二期基金	2023 年 7 月至 2026 年 3 月
郑丽丽	独立董事	奕斯伟集团	2023 年 3 月至 2026 年 3 月
商文江	独立董事		2023 年 3 月至 2026 年 3 月
陈磊	独立董事		2023 年 3 月至 2026 年 3 月

杨新元，具体详见本节之“八、（二）实际控制人情况”。

王东升，具体详见本节之“八、（二）实际控制人情况”。

方向明，男，1963 年出生，硕士研究生，工商管理专业。1985 年 7 月至 1999 年 8 月，任中国青年报社经济版副主编；1999 年 9 月至今，任北京竞争力智库咨询有限公司执行董事，东方微巨传媒策划（北京）有限公司执行董事、经理等职位；2016 年 9 月至今，任奕斯伟集团董事；2017 年 9 月至今，任公司董事。

王辉，男，1982 年出生，硕士研究生，金融学专业。2006 年 7 月至 2015 年 9 月，历任京东方董秘室科员、京东方下属子公司企划部部长等职务。2015 年 10 月至 2019 年 7 月，任北京芯动能管理公司融资部总监；2019 年 8 月至 2022 年 2 月，历任奕斯伟计算董事会秘书、公司董事会秘书，牵头奕斯伟集团下属主要业务板块的融资工作；2022 年 1 月至今，任奕斯伟集团总经理；2021 年 6 月至今，任公司董事。

郭辉，男，1978 年出生，硕士研究生，国际商法专业。2004 年 3 月至今，历任北京天达律师事务所律师，瑞士文斐律师事务所高级顾问，圆基环保资本有限公司高级副总裁，国新国际投资有限公司投资总监，北京国家新能源汽车技术

创新中心有限公司副总经理，中建材新材料基金总经理；2022年12月至今，任公司董事。

杨卓，男，1986年出生，硕士研究生，经济学专业。2009年7月至今，历任国家开发银行深圳市分行评审处处员、副处长、客户五处处长，华芯投资管理有限责任公司投资三部总经理；2023年7月至今，任公司董事。

郑丽丽，女，1962年出生，博士研究生，物理学专业。1988年2月至今，历任上海交通大学电力学院能源系助教，英国剑桥大学工程系博士后，美国纽约州立大学石溪分校材料科学与工程系博士后、助理教授、副教授、终身教职，清华大学航天航空学院院长聘教授；2023年3月至今，任公司独立董事。

商文江，男，1965年出生，博士研究生，法学专业。2001年3月至今，历任中国信达资产管理股份有限公司法律事务部处长、资产处置审核委员会处长，重庆市巴南区人民政府区长助理（挂职），重庆市人民政府金融工作办公室主任助理、副主任，重庆两江新区管理委员会副主任，西南政法大学副校长、工会主席，中国政法大学商学院教授、院长、MBA教育中心主任；2023年3月至今，任公司独立董事。

陈磊，男，1972年出生，博士研究生，经济学专业。2004年8月至今，历任美国佐治亚州立大学会计系助理教授，北京大学光华管理学院会计系助理教授、副教授，中国注册会计师协会主办的《中国管理会计》副主编、编委会副主任；2023年3月至今，任公司独立董事。

2、监事会

截至本招股说明书签署日，公司监事会成员5名，其中职工代表监事2名，均为中国国籍，均无境外永久居留权，具体如下：

姓名	职位	提名人	本届任职期间
董铁牛	监事会主席	陕西集成电路基金	2023年7月至2026年3月
俞信华	监事	宁波奕芯	2023年3月至2026年3月
苗嘉	监事	长峡金石、川投金石	2023年7月至2026年3月
宋胜宏	职工代表监事	职工代表大会	2023年3月至2026年3月

张鹏	职工代表监事	2023年7月至2026年3月
----	--------	-----------------

董铁牛，男，1978年出生，博士研究生，管理学专业。2009年2月至今，历任西部证券股份有限公司研发中心行业研究员，西安高新技术产业风险投资有限责任公司创新业务部总经理和监事会主席，西安高新金融控股集团有限公司投资管理部副部长；2022年12月至2023年6月，任公司董事；2023年7月至今，任公司监事会主席。

俞信华，男，1974年出生，博士研究生，工商管理专业。1997年7月至今，历任上海西门子移动通讯有限公司市场经理、西门子中国有限公司市场部经理，国际数据（中国）投资有限公司项目经理、IDG资本投资顾问（北京）有限公司合伙人等职务；2019年3月至2023年2月，任公司董事；2023年3月至今，任公司监事。

苗嘉，女，1977年出生，硕士研究生，金融学专业。2013年6月至今，历任金石投资有限公司总监、执行总经理；2023年7月至今，任公司监事。

宋胜宏，女，1984年出生，硕士研究生，法学专业。2009年7月至2017年7月，历任京东方制造工程法务部专员、部长等职务；2018年1月至2023年4月任公司法务部部长，2023年4月至今任公司首席法务官；2023年3月至今，任公司职工监事。

张鹏，男，1991年出生，硕士研究生，新闻传播学专业。2016年7月至2019年5月，历任京东方及其下属子公司企业文化/党群工作部专员等职务，碧桂园控股有限公司豫南区域办公室主管；2019年6月至今，历任公司人力专员、文化专员、企业文化部副部长、行政服务中心副中心长、工会主席等职务；2023年7月至今，任公司职工监事。

3、高级管理人员

根据《公司章程》，公司总裁、常务副总裁（职位暂时空缺）、首席财务官、首席技术官和董事会秘书为公司高级管理人员。截至本招股说明书签署日，公司高级管理人员共4名，均为中国国籍，均无境外永久居留权，具体如下：

姓名	职位	本届任职期间
----	----	--------

刘还平	总裁	2023年3月至2026年3月
王琛	首席财务官	2023年7月至2026年3月
兰洵	首席技术官	2023年7月至2026年3月
杨春雷	董事会秘书	2023年3月至2026年3月

刘还平，具体详见本节之“八、（二）实际控制人情况”。

王琛，女，1988年出生，硕士研究生，管理学专业。2014年6月至2021年8月，历任京东方下属子公司高管秘书、财务部专员、财务部部长等职务；2021年9月至2023年6月，历任公司董事会秘书办公室部长、财务部部长等职务；2023年7月至今，任公司首席财务官。

兰洵，女，1982年出生，博士研究生，物理学专业，材料学高级工程师。2010年7月至2018年8月，历任天威新能源控股有限公司技术研发中心开发工程师、硅片技术部部长，电子科技大学材料与能源学院博士后。2018年9月至2023年6月，历任公司第一工厂拉晶部工程师、拉晶工艺科副科长、开发一部技术企划科科长、公司副首席技术官；2023年7月至今，任公司首席技术官。

杨春雷，男，1990年出生，本科学历，财务管理专业。2013年3月至2018年2月，历任京东方下属子公司预算管理中心专员、运营革新中心科长等职务；2018年2月至2022年2月，任公司财务负责人；2022年3月至今，任公司董事会秘书。

4、核心技术人员

姓名	职位	国籍	是否拥有境外居留权
刘还平	总裁	中国	无
兰洵	首席技术官		
郭宏雁	首席制造官		
YEOM ILLKWON	首席产品官组织下设的开发管理部部长	韩国	
KIM JINKUN	首席产品官组织下设的拉晶工艺开发部部长		

刘还平，具体详见本节之“八、（二）实际控制人情况”。作为公司总裁，刘还平先生主要负责市场与客户、技术与研发、生产管理、品质与供应链、IT与自动化等运营管理工作。重大研发课题及研发成果方面，其主持陕西省科技重大专项课题“12英寸高端抛光硅片及成套工艺技术开发”；核心技术方面，其统筹研发团队完成了“无缺陷晶体生长技术”“翘曲和弯曲控制技术”“硅片表面平坦度控制技术”“表面污染控制技术”和“外延设备基座和反应腔室改善设计”公司五项核心技术的量产研发和持续优化；荣誉方面，其个人获得西安市国家级领军人才、2019年度西安市高新区“双爱双评”优秀经营者荣誉。

兰洵，具体详见本节之“十四、（一）3、高级管理人员”。兰洵女士在公司任职前期，专注于12英寸硅片核心的拉晶工艺，参与公司初期拉晶技术路线制定和设备选型，组织统筹公司首批拉晶设备的安装和调试，作为项目牵头人完成了“无缺陷晶体生长技术”公司一项核心技术的量产研发。担任公司首席技术官后，兰洵女士目前负责制定公司产品的未来技术发展方向，推进先进制程产品和新品类产品的技术开发。重大研发课题及研发成果方面，其作为核心人员参与陕西省科技重大专项课题“12英寸高端抛光硅片及成套工艺技术开发”。

郭宏雁，男，1981年出生，本科学历，微电子学专业。2003年7月至2021年7月，历任京东方下属子公司技术员、工程师、工厂科长、工厂长等职务；2021年8月至今，历任公司第一工厂的工厂长助理、工厂长、公司首席制造官。在公司任职期间，郭宏雁先生作为第一工厂负责人统筹管理公司拉晶、成型、抛光、清洗、外延五大工艺部门及配套工艺支持部门，配合首席产品官组织下设的技术开发部实现工艺达成，尤其是牵头负责“翘曲和弯曲控制技术”和“硅片表面平坦度控制技术”两项公司核心技术的量产落地。郭宏雁先生牵头制定工艺技术作业标准超过240项，建立品质检测及缺陷评价技术规范近100项，梳理并完善产品/设备/工艺技术流程超过20类。

YEOM ILLKWON，男，1968年出生，本科学历，冶金工程专业。1996年7月至2019年2月，在海外硅片大厂工作；2020年9月至今，在公司首席产品官组织下设的开发管理部担任部长。在公司任职期间，YEOM ILLKWON先生主要负责新产品开发工作，作为主要人员牵头完成了多款存储芯片用抛光片和逻辑芯片用外延片的首件开发和客户认证工作。核心技术方面，作为主要人员完成“硅

片表面平坦度控制技术”一项公司核心技术的量产研发。作为研发项目主要牵头人，YEOM ILLKWON 先生目前负责立式研磨工艺技术开发项目、CIS 芯片外延重掺片开发项目、功率器件用抛光片开发项目等公司重点在研项目。

KIM JINKUN，男，1968 年出生，本科学历，电子学专业。1992 年 11 月至 2018 年 6 月，在海外硅片大厂工作；2020 年 1 月至今，在公司首席产品官组织下设的拉晶工艺开发部担任部长。在公司任职期间，KIM JINKUN 先生主要负责拉晶工艺的技术开发和持续提升，作为主要技术人员完成了“无缺陷晶体生长技术”一项公司核心技术的量产研发。作为研发项目主要牵头人，KIM JINKUN 先生目前负责基于熔炉对流模型的三维开发项目、轴向均匀性无缺陷晶棒开发项目等公司重点在研项目。

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在其他单位（除公司及公司控制的企业外）兼职情况，所兼职单位与公司除公司任职外其他关联关系情况如下：

姓名	公司职务	兼职单位	兼任职务	兼职单位与公司的其他关联关系
王东升	董事	奕斯伟集团	董事长	控股股东
		奕斯伟计算	董事长	控股股东控制的企业
王辉	董事	奕斯伟集团	总经理	控股股东
		芯晖装备	董事	控股股东的联营企业
		重庆奕能科技	董事长	控股股东控制的企业
		珠海奕源科技	董事长	控股股东控制的企业
方向明	董事	北京竞争力智库咨询有限公司	执行董事	无
		东方微巨传媒策划（北京）有限公司	执行董事、经理	无
		竞争力方略信息科技研究院（北京）有限公司	董事、经理	无
		海宁奕联科技有限公司	董事	控股股东控制的企业
		北京智库信息咨询有限责任公司	监事	无

		奕斯伟集团	董事	控股股东
郭辉	董事	中建材(安徽)新材料基金管理有 限公司	董事、总经理	公司股东中建材新材 料基金(持股 3.50%) 的执行事务合伙人
		中材锂膜有限公司	董事	无
		江苏青昀新材料有限公司	董事	无
杨卓	董事	华芯投资管理有限责任公司	投资三部总经理	公司股东二期基金 (持股 7.50%)的基 金管理人
		中微半导体设备(上海)股份有 限公司	董事	无
		北方华创科技集团股份有限公司	董事	无
		通富微电子股份有限公司	董事	无
		沪硅产业	副董事长	无
		拓荆科技股份有限公司	董事	无
		宁波南大光电材料有限公司	董事	无
俞信华	监事	奕斯伟计算	董事	控股股东控制的企业
		高景太阳能股份有限公司	董事	无
		广州市远能物流自动化设备科技有 限公司	董事	无
		欣旺达动力科技股份有限公司	董事	无
		Newnagy Holdings., Inc.	董事	无
		珠海迪安娜投资有限公司	执行董事、经理	无
		珠海畅新游创投资有限公司	执行董事、总经理	无
		西安奇点能源股份有限公司	董事	无
		上海世禹精密设备股份有限公司	董事	无
		瑞浦兰钧能源股份有限公司	董事	无
		珠海尚方清洁能源科技有限公司	董事	无
		苏州腾圣技术有限公司	董事	无
		海南汉草生物科技有限公司	监事	无

董铁牛	监事会主席	西安高新金融控股集团有限公司	投资管理部部长	公司股东陕西集成电路基金(持股 9.06%)的执行事务合伙人西安高新技术产业风险投资有限责任公司的控股股东
		西安高新金融数据管理有限公司	董事长	公司股东陕西集成电路基金(持股 9.06%)的执行事务合伙人西安高新技术产业风险投资有限责任公司的控股股东西安高新金融控股集团有限公司的全资子公司
苗嘉	监事	金石投资有限公司	执行总经理	公司股东长峡金石(持股 1.32%)的执行事务合伙人的控股股东和公司股东川投金石(持股 0.73%)的执行事务合伙人
		北京芯驰半导体科技股份有限公司	董事	无
陈磊	独立董事	北京大学光华管理学院	会计系副教授	无
		中国注册会计师协会	《中国管理会计》编委会执行副主任	无
		宇华教育集团有限公司(6169.HK)	独立董事	无
		和泓服务集团有限公司(6093.HK)	独立董事	无
		有研新材料股份有限公司(600206.SH)	独立董事	无
商文江	独立董事	中国政法大学商学院	教授、院长、MBA教育中心主任	无
		華潤新能源控股有限公司	独立董事	无
郑丽丽	独立董事	清华大学航天航空学院	长聘教授	无

(三) 截至本招股说明书签署日, 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在亲属关系

(四) 报告期内, 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均不存在被行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况

(五) 截至本招股说明书签署日, 本公司未与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签署除劳动合同(含竞业禁止条款)、保密协议等常规协议外的其他协议

公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员做出的重要承诺详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件一: 本次发行相关承诺”。

(六) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况

截至本招股说明书签署日, 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接持有公司股份, 部分人员通过公司直接和间接控股股东、公司员工持股平台等间接持有公司股份, 具体如下:

序号	姓名	职务	直接持股主体	对直接持股主体的持股比例	穿透后对公司的持股比例(注1)
1	杨新元	董事长	奕斯伟集团	4.32%	0.55%
			欣盛一号	26.70%	0.20%
2	王东升	董事	奕明科技(注2)	63.00%	4.20%
3	王辉	董事	欣盛一号	17.80%	0.13%
			奕明科技	9.00%	0.60%
4	方向明	董事	奕斯伟集团	3.88%	0.49%
5	郭辉	董事	安徽纬聿壹号股权投资合伙企业(有限合伙)、安徽纬聿贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	10.43%、9.10%	0.0003%
6	宋胜宏	职工监事	欣盛一号	2.00%	0.01%

7	张鹏	职工监事	欣诚一号	2.64%	0.01%
7	刘还平	总裁	奕斯伟集团	3.99%	0.51%
8			欣盛一号	24.73%	0.18%
9	王琛	首席财务官	欣盛一号	2.15%	0.02%
10	兰洵	首席技术官	欣盛一号	2.76%	0.02%
11	杨春雷	董事会秘书	欣诚一号	3.93%	0.02%
12	郭宏雁	核心技术人员	欣盛一号	3.37%	0.03%
13	YEOM ILLKWON	核心技术人员	欣合一号	2.29%	0.01%
14	KIM JINKUN	核心技术人员	欣合一号	3.24%	0.02%

注 1: 穿透持有公司的股权比例=自然人对公司直接股东的持股比例*直接股东对公司的持股比例。

注 2: 王东升和王辉为奕斯伟集团控股股东奕明科技的合伙人, 奕明科技持有奕斯伟集团 52.40% 股权。

注 3: 郭辉为安徽纬聿壹号股权投资合伙企业(有限合伙)、安徽纬聿贰号股权投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人(上表中直接持股比例为郭辉在两家有限合伙企业的出资比例), 两家合伙企业持有安徽纬聿叁号股权投资有限责任公司 100.00% 股权, 安徽纬聿叁号股权投资有限责任公司作为有限合伙人持有合肥纬聿股权投资合伙企业(有限合伙) 96.77% 的出资比例, 合肥纬聿股权投资合伙企业(有限合伙)作为有限合伙人持有中建材新材料基金 0.10% 的出资比例, 中建材新材料基金作为公司直接股东持有公司 3.50% 股权。综上, 郭辉穿透持有公司 0.0003% 的股权。

截至本招股说明书签署日, 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接或间接持有的本公司股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。

(七) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员近两年变动情况

1、董事变动情况及原因

时间	人员	变动原因
2022 年 1 月至 2022 年 11 月	王东升、杨新元、方向明、王家恒、俞信华、孙达飞、刘还平、王辉、方浩	-
2022 年 11 月至 2023 年 2 月	王东升、杨新元、郭辉、方向明、王辉、俞信华、董铁牛、刘还平、方浩	发行人完成报告期第一次重组和 CI 轮融资, 新增股东中建材新材料基金提名郭辉担任董事, 新增股东陕西集成电路基金提名董铁牛担任董事, 原董事王家恒和孙达飞卸任
2023 年 3 月至 2023 年 7 月	杨新元、王东升、郭辉、方向明、王辉、董铁牛、郑丽丽、商文江、陈磊	首先, 股份公司设立新增独立董事郑丽丽、商文江、陈磊; 其次, 为保证公司治理效率, 董事会维持 9 人规模, 原董事

		俞信华、方浩、刘还平卸任；第三，原董事郭辉变更为控股股东奕斯伟集团提名
2023年7月至今	杨新元、王东升、方向明、王辉、郭辉、杨卓、郑丽丽、商文江、陈磊	发行人完成 CII 轮融资，新增股东二期基金提名杨卓担任董事，原董事董铁牛卸任

2、监事变动情况及原因

时间	人员	变动原因
2022年1月至2023年2月	吴茜	-
2023年3月至2023年7月	俞信华、吴茜、宋胜宏	股份公司设立监事会，控股股东奕斯伟集团提名监事吴茜留任，新增宁波奕芯提名监事俞信华和职工代表监事宋胜宏
2023年7月至今	董铁牛、俞信华、苗嘉、宋胜宏、张鹏	新增股东陕西集成电路基金提名监事董铁牛、新增长峡金石和川投金石联合提名监事苗嘉，新增职工代表监事张鹏，原监事吴茜卸任

3、高管变动情况及原因

时间	人员	变动原因
2022年1月至2022年2月	杨新元、刘还平、YOUNG RAK HONG、MUN YOUNG HEE、王辉、杨春雷	-
2022年3月至2023年2月	杨新元、刘还平、YOUNG RAK HONG、MUN YOUNG HEE、张淑军、杨春雷	杨春雷承接王辉担任董事会秘书，张淑军承接杨春雷担任财务负责人
2023年3月至2023年7月	刘还平、张淑军、YOUNG RAK HONG、MUN YOUNG HEE、杨春雷	杨新元当选董事长，不再担任首席执行官
2023年7月至今	刘还平、王琛、兰洵、杨春雷	因年龄和个人原因，YOUNG RAK HONG、MUN YOUNG HEE 和张淑军不再担任发行人高管，公司内部提拔兰洵和王琛进入高管序列

4、核心技术人员变动情况及原因

2022年1月至今，发行人核心技术人员未发生变动。

公司董事、监事和高级管理人员近两年的变动已履行必要的决策程序，主要系公司新增股东提名、完善公司治理结构、内部人员改选等原因所致，不构成重大不利变动，未对生产经营产生重大不利影响；公司核心技术人员近两年无变动。

(八) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外直接投资的与半导体行业相关的企业(不包括与发行人及其业务不相关的非半导体产业链对外投资和个人在二级市场买卖股票形成的投资)，与公司不存在利益冲突。除发行人直接控股股东奕斯伟集团、间接控股股东奕明科技和发行人员工持股平台，其他对外投资如下：

公司职务及姓名	其他直接对外投资情况	被投资企业主营业务
监事俞信华	上海硕昉管理咨询有限公司，出资 200.00 万元，占比 18.18%	投资平台，通过间接投资社保基金长三角科技创新股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)，间接参股投资爱科微半导体(上海)有限公司，爱科微半导体(上海)有限公司主要从事无线连接芯片设计业务

(九) 董事、监事、高级管理人员和其他核心人员薪酬

1、薪酬组成和确定依据

公司董事会下属提名薪酬与考核委员会根据《公司章程》及法律法规，负责审核公司董事、高级管理人员及核心技术人员的整体薪酬方案。

公司担任具体生产经营职务的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成包括工资和奖金两个部分。工资包括相对固定的基本工资(根据人员的职务、资历、学历、专业能力等因素确定)和不固定的绩效工资，奖金则根据年度表现、绩效考核及公司经营情况发放。

公司独立董事每年领取 12 万元的独立董事津贴。

2、履行的程序

报告期内，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案已经由第一届董事会第六次会

议、2023 年度股东大会审议批准。

3、薪酬占利润总额的比例

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额分别为 3,779.41 万元、4,854.91 万元和 **2,611.71 万元**。

报告期各期公司尚未盈利，薪酬总额占同期公司合并报表利润总额的比例不具有参考性。

4、最近一年从发行人领取薪酬情况

公司董事王东升、王辉、方向明、郭辉和杨卓不在本公司领薪，监事董铁牛、俞信华、苗嘉不在本公司领薪。

独立董事在本公司只领取独立董事津贴，不享有其他福利待遇。

除上述人员外的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在公司及/或公司控股子公司领取薪酬，**2024** 年度从发行人处领取薪酬合计为 **2,611.71 万元**。

除上述薪酬待遇外，公司现任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未在公司享受其他待遇和退休金计划。

十五、发行人本次申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排

(一) 股权激励实施情况

1、股票期权阶段

2021 年 1 月，奕斯伟材料有限召开 2021 年度第一次临时股东会审议通过的《关于员工持股平台增资》议案，由奕斯伟集团作为普通合伙人和执行事务合伙人的奕斯欣盛、奕斯欣诚和奕斯欣合三个员工持股平台合计认缴奕斯伟材料有限新增注册资本 5.56 万元，认购后合计持股比例为 10.00%。

2021 年 7 月，奕斯伟材料有限第一届董事会第五次会议审议通过《员工持股管理制度》，向员工授予股票期权，每份股票期权授予被激励对象满足考核条件后，可按特定价格认购 1 元公司注册资本的权利。相应股票期权计划考核期及行权期为“2+3 年”，第一次行权考核期为前 2 年，结合考核结果确定行权比例，

行权比例最高为股票期权金额的 40%；第二次及以后考核期均为前 1 年，每年行权 1 次，结合考核结果确定行权比例，每次行权比例最高为股票期权金额的 20%。行权股票来源为上述三个员工持股平台认缴的公司注册资本。

2021 年 9 月 15 日至 2022 年 3 月 25 日期间，奕斯伟材料有限董事会向员工共授予股票期权 35,740.70 份（以下简称“2021 年计划”），相应激励对象均签订了《授予员工股票期权协议》，协议签署当日完成股票期权授予。

2、限制性股票阶段：已授予股票期权加速行权，并额外授予限制性股票

考虑公司发展已步入良性循环，2023 年 5 月，公司第一届董事会第三次会议审议通过《关于股权激励加速行权》议案及更新后的《员工持股管理制度》。被激励对象已授予的股票期权当期全部行权。被激励对象通过实缴认购上层员工持股平台份额，完成工商变更显名，实现行权。

2023 年 5 月 31 日，公司与所有被激励对象签署了《授予员工股票期权协议之补充协议》及《员工股票期权行权协议》，已授予股票期权行权后按 2023 年 5 月资本公积转增股本等比例折算后的激励股票数量共计 46,613,631 股。

2023 年 9 月 1 日，公司根据各员工对公司的贡献以及入职时间，与满足条件的员工签订了《授予员工股票期权协议之补充协议（二）》，根据协议约定，满足条件的被授予员工的行权等待期有所缩短，为有利修改，公司按照修改后等待期摊销确认股份支付费用。

2023 年 5 月 31 日、2023 年 12 月 15 日及 2024 年 7 月 31 日，公司新增授予员工 35,794,503 股限制性股票，并与员工签署授予协议。被激励对象通过实缴认购上层员工持股平台份额，完成工商变更显名。

3、截至目前股权激励情况

截至本招股说明签署日，公司被激励对象通过 3 个直接员工持股平台和对应的 9 个上层员工持股平台合计获配激励 76,873,994 股，占目前公司总股本的 2.20%，共涉及员工 342 人次（未剔除少量员工多个上层平台同时持股情况），相应被激励对象均为公司现任或离任但符合条件的董事、高级管理人员和核心技术人员或其他正式员工。具体如下：

层级	持股平台名称	持有发行人股份比例(注)	自然人合伙人数量
直接持股平台 1	奕斯欣盛	0.88%	-
上层持股平台 1-1	欣盛一号	0.74%	43
上层持股平台 1-2	欣盛二号	0.14%	48
直接持股平台 2	奕斯欣诚	0.66%	-
上层持股平台 2-1	欣诚一号	0.40%	45
上层持股平台 2-2	欣诚二号	0.25%	46
直接持股平台 3	奕斯欣合	0.66%	-
上层持股平台 3-1	欣合一号	0.54%	47
上层持股平台 3-2	欣合二号	0.03%	31
上层持股平台 3-3	欣合三号	0.03%	27
上层持股平台 3-4	欣合四号	0.03%	27
上层持股平台 3-5	欣合五号	0.03%	28
合计		2.20%	342

注：上层持股平台持有发行人股份比例=上层持股平台持有直接持股平台财产份额比例*直接持股平台直接持有发行人股份比例。

(二) 股权激励的约定

根据奕斯欣盛、奕斯欣诚、奕斯欣合对应的《合伙协议》《员工股票期权行权协议》及《关于股份锁定、持股意向、减持意向及其约束措施的承诺函》等协议及承诺：

1、行权期约定

股票期权阶段：受激励对象被授予的股票期权分为 5 年行权，每次行权要通过业绩考核。第一次行权考核期为前 2 年，结合考核结果确定行权比例，行权比例最高为股票期权金额的 40%；第二次及以后考核期均为前 1 年，每年行权 1 次，结合考核结果确定行权比例，每次行权比例最高为股票期权金额的 20%。

限制性股票阶段：受激励对象被授予的限制性股票分为 5 年行权，每次行权要通过业绩考核。第一次行权考核期为前 2 年，结合考核结果确定行权比例，行权比例最高为限制性股票金额的 40%；第二次及以后考核期均为前 1 年，每年行权 1 次，结合考核结果确定行权比例，每次行权比例最高为限制性股票金额的

20%。其中，加速行权的股票期权考核期持续计算，原股票期权新增公允价值部分自转换之日起为考核期起始日，新授予限制性股票部分自授予之日起为考核期起始日。

2、转让与退伙

情形	条款约定
员工离职、考核不达标	按照原始取得价格加 4%年息（单利）一次性转让给员工持股平台执行事务合伙人（即奕斯伟集团）、公司指定的其他受激励员工或其他人员。针对公司做出卓越贡献的创始员工离职的，保留其任职期间且完成业绩考核的股权，其余部分按照前述要求收回
员工过错	全部按照原始取得价格一次性转让给员工持股平台执行事务合伙人（即奕斯伟集团）、公司指定的其他受激励员工或其他人员
员工因工作原因而丧失民事行为能力、失踪、死亡	员工或其继承人、法定代理人、监护人可全部保留

（三）股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响及上市后的行权安排

1、股权激励涉及的股份支付会计处理

公司股权激励涉及股份支付会计处理，按员工等待期进行分摊确认的股份支付费用，计入经常性损益；视同加速行权的股份支付费用计入非经常性损益，相关处理符合企业会计准则要求。

等待期假设：1) **股票期权阶段：**受激励员工每次被授予的股票期权分四批行权，等待期分别为 2 年、3 年、4 年和 5 年；2) **限制性股票阶段：**授予协议约定了服务年限及上市条件，综合考虑服务年限及上市条件约定，选较长时间逐月摊销确认股份支付费用，确认等待期为授予之日起算至 2029 年 7 月 31 日。

公允价值：1) **股票期权阶段：**按照相近时点机构投资者的出资价格利用二叉树模型计算股票期权的公允价值；2) **限制性股票阶段：**对于公司员工持股平台，授予日权益工具公允价值参考授予日相近时点外部投资者的出资价格确定。

离职员工处理：受激励对象离职时，根据前述规定，其所持有资产份额转予员工持股平台执行事务合伙人、公司指定的其他受激励员工或其他人员，对于离

职员工所持有的财产额对应的股份支付原分摊金额冲回,同时需要对发行人股权激励对象因离职退伙受让的财产份额,当期再次全部确认股份支付。

股份支付的修改、终止情况:

2023年5月31日的修改:“2021年计划”的被激励对象分别与公司签署《授予员工股票期权协议之补充协议》及《员工股票期权行权协议》,根据新签订的协议及新管理制度,被激励对象原获授的股票期权转为限制性股票,替换后限制性股票的等待期较替换前股票期权的等待期有所延长,为不利修改,对于等比例折算后被激励对象享有的权益工具,仍按照“2021年计划”剩余等待期摊销确认股份支付费用。原股票期权于替换日的公允价值大于限制性股票的公允价值,因此公允价值无增加,为不利修改,仍按照“2021年计划”剩余等待期摊销确认股份支付费用;

2023年9月1日的修改:公司根据各员工对公司的贡献以及入职时间,与满足条件的员工签订了《授予员工股票期权协议之补充协议(二)》,约定满足条件的被授予员工的行权等待期有所缩短,为有利修改,公司按照修改后等待期摊销确认股份支付费用。

2、报告期内股份支付情况

报告期内,股份支付金额分别为5,869.46万元、9,411.03万元和**5,364.14万元**。上述股权激励有利于公司管理团队和人才队伍稳定。除上述已实施完毕的股权激励外,报告期公司不存在尚未实施完毕的股权激励计划,亦未存在上市后的行权安排。

十六、发行人的员工情况

(一) 员工人数及其结构

1、员工人数及其变化情况

报告期内,公司第一工厂逐步达产,同时考虑第二工厂扩产,提前培养员工和储备人才,员工人数整体呈现增长。报告期各期末,公司员工人数分别为**1,808人**、**1,869人**和**1,941人**。

2、员工专业结构、受教育及年龄分布情况

截至 2024 年末，公司员工结构如下：

专业结构			受教育情况			年龄分布		
专业	人数	比例	学历	人数	比例	年龄	人数	比例
生产及采购	1,359	70.02%	博士	4	0.21%	30 岁以下	1,554	80.06%
研发	235	12.11%	硕士	301	15.51%	30-40 岁	309	15.92%
管理	240	12.36%	本科	535	27.56%	40-50 岁	62	3.19%
销售	75	3.86%	大专	828	42.66%	50-60 岁	15	0.77%
财务	32	1.65%	大专以下	273	14.06%	60 岁以上	1	0.05%
合计	1,941	100.00%	合计	1,941	100.00%	合计	1,941	100.00%

3、社会保险和住房公积金缴纳规范性

报告期各期末，公司员工的社会保险和住房公积金缴纳情况如下：

截至日期	险种	员工人数	应缴人数 (注 1)	实缴人数 (注 2)	缴纳比例 (注 3)	未缴人数
2024/12/31	社会保险	1,941	1,941	1,845	95.05%	96
	住房公积金	1,941	1,905	1,903	99.90%	38
2023/12/31	社会保险	1,869	1,867	1,816	97.27%	51
	住房公积金	1,869	1,831	1,828	99.84%	3
2022/12/31	社会保险	1,808	1,806	1,524	84.39%	282
	住房公积金	1,808	1,777	1,755	98.76%	22

注 1：住房公积金应缴人数与员工人数差异主要为公司存在外籍员工以及退休返聘员工，相应员工无需缴纳住房公积金。

注 2：社会保险中存在不同险种实缴人数不同的情况，实缴人数以社会保险全部险种均足额缴纳人数为准。

注 3：缴纳比例=实缴人数/应缴人数。

截至 2024 年末，公司及其子公司未为 96 个员工缴纳社保，其中：1) 56 人当月入职无法在公司缴纳，已从次月开始由公司缴纳；2) 36 人非中国大陆籍员工，自愿放弃在公司缴纳社保；3) 剩余 4 人因在其他单位缴纳，自愿放弃在公司缴纳社保。

截至 2024 年末，公司及其子公司未为 38 名员工缴纳住房公积金，其中：

1) **36人非中国大陆籍员工，自愿放弃在公司缴纳公积金**；2) 剩余2人因在其他单位缴纳，自愿放弃在公司缴纳住房公积金。

根据属地对应社保以及住房公积金主管部门的相关证明，发行人及子公司在报告期内未因违反国家及地方劳动和社会保障的法律、法规及规范性文件受到行政处罚，未因违反住房公积金管理的法律、法规及规范性文件受到行政处罚。公司直接控股股东奕斯伟集团已出具关于承担社会保险和住房公积金补缴风险的承诺。

(二) 劳务派遣及劳务外包

报告期内，公司存在聘用劳务派遣人员的情形，劳务派遣人员在境外子公司从事客户维持及营销相关工作，后续将与公司直接签署劳动合同。报告期各期末，发行人及其子公司劳务派遣的人数合计分别为**0人**、**0人**、**3人**。截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司劳务派遣用工人数未超过用工总量**10%**。

第五节 业务与技术

一、发行人主营业务、主要产品及变化情况

(一) 公司主营业务、主要产品、主营业务收入构成及特征

1、主营业务

秉持“成为半导体硅材料领域受人尊敬的伟大企业”的长期愿景，报告期内公司始终专注于 12 英寸硅片的研发、生产和销售。基于 2024 年月均出货量和截至 2024 年末产能规模统计，公司均是中国大陆第一、全球第六的 12 英寸硅片厂商，前述月均出货量和产能规模全球同期占比约为 6%和 7%。同时，截至 2024 年末，公司是中国大陆 12 英寸硅片领域拥有已授权境内外发明专利最多的厂商。公司产品已用于 NAND Flash/DRAM/Nor Flash 等存储芯片、CPU/GPU/手机 SOC/嵌入式 MCU 等逻辑芯片、电源管理、显示驱动、CIS 等可实现数据计算、数据存储、数据传输、人机交互等核心功能的多品类芯片的量产制造，最终应用于智能手机、个人电脑、数据中心、物联网、智能汽车和机器人等人工智能时代下的各类智能终端。

硅片是芯片制造的“地基”，硅片的性能和供应能力直接影响半导体产业链的竞争力。尤其是人工智能时代需要更强的数据算力、更快的数据传输、更大的数据存储和更灵敏的人机交互，实现前述功能技术和工艺制程最主流和最先进的逻辑和存储芯片（一般 90 纳米工艺制程以下）以及部分高端模拟和传感器芯片均采用 12 寸晶圆制造工艺，从而 12 英寸硅片是目前业界最主流规格的硅片。根据 SEMI 统计，12 英寸硅片贡献了 2024 年全球所有规格硅片出货面积的 75% 以上，12 英寸产能也是目前全球晶圆厂扩产的主流方向。随着人工智能应用不断普及，未来 12 英寸硅片全球出货面积占比将持续提升。12 英寸硅片全球寡头垄断格局已持续多年，2024 年全球前五大厂商供货占比高达 80%，而我国 12 英寸晶圆厂产能全球占比预计 2026 年将超过 30%，这一自给结构矛盾对我国半导体产业链的发展形成制约。公司在进入该领域之初即制定了 2020 至 2035 年的 15 年战略规划，计划到 2035 年打造 2 至 3 个核心制造基地，建设若干座现代化的智能制造工厂，聚焦技术力、品质力和管理力，成为半导体硅材料领域头

部企业，服务全球客户。

截至本招股说明书签署日，公司首个核心制造基地已落地西安，该项目第一工厂已于 2023 年达产，本次发行上市募投项目的第二工厂已于 2024 年正式投产，计划 2026 年达产。截至 2024 年末，公司合并口径产能已超过 70 万片/月，全球 12 英寸硅片同期产能占比已约 7%。根据 SEMI 统计，2026 年全球 12 英寸硅片需求将超过 1,000 万片/月，中国大陆地区需求将超过 300 万片/月。通过技术革新和效能提升，公司已将第一工厂 50 万片/月产能提升至 60 万片/月以上，2026 年第一和第二两个工厂合计可实现 120 万片/月产能，可满足届时中国大陆地区 40% 的 12 英寸硅片需求，公司全球市场份额预计将超过 10%。

公司高度重视自主研发和知识产权保护，进入该领域之初即对全球前五大厂商近 30 年的半导体硅片专利全面检讨，制定差异化技术路线。目前，公司已形成拉晶、成型、抛光、清洗和外延五大工艺环节的核心技术体系，产品的晶体缺陷控制水平、低翘曲度、超平坦度、超清洁度和外延膜层形貌与电学性能等核心指标已与全球前五大厂商处于同一水平。公司产品已量产用于 2YY 层 NAND Flash 存储芯片、先进际代 DRAM 存储芯片和先进制程逻辑芯片；更先进制程 NAND Flash 存储芯片、更先进际代 DRAM 存储芯片以及更先进制程逻辑芯片的 12 英寸硅片均已经在主流客户验证。人工智能高端芯片领域，除了公司正在验证适配先进制程的高性能专用逻辑芯片外，公司也在同步配合客户开发下一代高端存储芯片，相应产品可用于 AI 大模型训练和推理数据的实时处理，可用于 AI 大模型训练数据和模型参数的定制化存储需求。截至 2024 年末，公司已申请境内外专利合计 1,635 项，80% 以上为发明专利；已获得授权专利 746 项，70% 以上为发明专利。公司相应专利均围绕 12 英寸硅片。截至 2024 年末，公司是中国大陆 12 英寸硅片领域拥有已授权境内外发明专利最多的厂商。

截至 2024 年末，公司已通过验证的客户累计 144 家，其中中国大陆客户 108 家，中国台湾及境外客户 36 家；已通过验证的测试片超过 390 款，量产正片超过 90 款，其中中国大陆客户正片已量产 80 余款，中国台湾及境外客户正片已量产近 10 款，2024 年量产正片已贡献公司主营业务收入的比例超过 55%。目前，公司实现了国内一线逻辑晶圆代工厂和存储 IDM 厂大多数主流量产工艺平台的正片供货，已成为国内主流存储 IDM 厂商全球 12 英寸硅片厂商中供货

量第一或第二大的供应商，已成为国内一线逻辑晶圆代工厂中国大陆 12 英寸硅片供应商中供货量第一或第二大的供应商，已成为目前国内新建 12 英寸晶圆厂的首选硅片供应商之一。公司不仅立足国内需求，更放眼全球市场。目前，公司已向客户 D、联华电子、力积电、客户 P、客户 O、格罗方德等大多数中国大陆以外主流晶圆厂批量供货。报告期各期，公司外销收入占比稳定在 30%左右。公司已从全球 12 英寸硅片的新进入“挑战者”快速成长为颇具影响力的“赶超者”。

2、主要产品

公司 12 英寸硅片根据用途可分为正片和测试片，其中测试片用于晶圆厂对产线设备工艺环境的调试和检测，并不直接用于晶圆制造。一般情况下，新进入者需首先通过客户端测试片验证，方可进一步验证用于晶圆制造的正片。公司目前正片均为 P 型硅片（占目前全球 12 英寸硅片市场的 90%以上），正片又可进一步细分为抛光片和外延片。具体如下：

1) 抛光片

项目	具体情况
目前应用	主要应用于 NAND Flash、DRAM、Nor Flash 等存储芯片制造，也应用于部分制程工艺的模拟芯片（显示驱动芯片、电源管理芯片等）等
量产客户	中国大陆地区：国内主流存储 IDM 厂商 中国台湾地区及境外：客户 O、客户 P 等
下游特点	1) 根据 WSTS 统计，2024 年全球存储芯片市场约 1,671 亿美元，占全球半导体市场的 27% 2) 不考虑 Nor Flash，供给厂商高度集中，DRAM 国际主流厂商仅有 3 家，NAND 国际主流厂商仅有 5 家 3) 存储芯片客户大多采用 IDM 模式，以产定销，具有一定累库能力，终端需求变化对其产能利用率和硅片采购调整存在一定滞后性，从而存储 IDM 厂商能完全决定硅片采购 4) 根据 SEMI 统计，存储 IDM 厂商每年采购全球 12 英寸硅片的 50%左右
产品特点	1) 单个客户需求量大，产品规格种类相对集中，客户对上游议价能力强，关注供应稳定性和产能保障能力 2) 产品单价高于测试片，但低于外延片 3) 产品无外延层，硅片的晶体缺陷控制水平是存储芯片用抛光片的核心要求，此外也对低翘曲度、超平坦度、清洁度等指标具有较高要求
公司已量产最先进制程	先进际代 DRAM 和 2YY 层 NAND Flash

公司在客户端验证制程	更先进际代 DRAM 和更先进制程 NAND Flash
------------	------------------------------

2) 外延片

项目	具体情况
目前应用	主要应用于集成电路品类中的逻辑芯片（CPU/GPU/手机 SOC/嵌入式 MCU 等）、存储芯片（部分制程工艺的 Nor Flash）、模拟芯片（显示驱动芯片等）和传感器品类中的 CIS 芯片制造
量产客户	大陆地区：包括国内大多数一线逻辑晶圆代工厂 中国台湾地区及境外：一线逻辑晶圆代工厂均在验证或小批量量产
下游特点	<ol style="list-style-type: none"> 1) 根据 WSTS 统计，2023 年外延片下游可应用芯片所对应的市场规模超过 3,000 亿美元，占全球半导体市场的 50% 以上 2) 下游客户主要为逻辑晶圆代工厂，以销定产，芯片设计终端厂商的采购需求变化直接传递并影响晶圆代工厂的产能利用率和硅片采购需求 3) 全球 50% 以上的晶圆代工市场均由台积电一家贡献，鉴于终端芯片种类繁多，工艺差异大，全球和中国大陆厂商数量远多于存储 IDM 厂商领域，台积电外的市场集中度远低于存储芯片领域 4) 根据 SEMI 统计，晶圆代工厂需求约占全球 12 英寸硅片需求的 30%，小于存储 IDM 厂商主要系部分成熟制程逻辑芯片仍采用 8 英寸硅片制造
产品特点	<ol style="list-style-type: none"> 1) 产品规格种类繁多，即使同一制程同一品类芯片制造，不同晶圆代工厂的工艺平台会有差异，对所采购硅片规格有差异。客户不仅关注供应的稳定性，也关注硅片厂商的研发能力，是否能够适配自身不断迭代的工艺平台 2) 产品单价最高 3) 对外延层品质（如膜层厚度均匀性、电阻率均匀性）存在特殊要求，先进制程逻辑芯片对清洁度、低翘曲度、超平坦度等指标要求更苛刻
公司已量产最先进制程	先进制程逻辑芯片
公司在客户端验证制程	更先进制程逻辑芯片

3) 测试片

项目	具体情况
目前应用	用于晶圆厂对产线设备工艺环境的调试和检测，不直接用于成品晶圆制造
量产客户	大陆地区：所有主流晶圆厂客户 中国台湾地区及境外：客户 D、联华电子、客户 O、客户 P、力积电、格罗方德等已量产供货，SK 海力士已通过验证
下游特点	1) 无论是 IDM 厂还是晶圆代工厂，均对测试片采购有自主决策权，并对测试

	<p>片价格敏感</p> <p>2) 测试片需求与晶圆厂客户的产能利用率密切相关</p> <p>3) 产线制程越先进对特殊应用的测试片要求越高, 部分先进制程产线所需测试片的品质要求与抛光片相近, 甚至更高</p>
产品特点	<p>1) 一般情况下, 测试片品质参数低于正片, 测试片具有不同等级和规格</p> <p>2) 一般情况下, 测试片平均单价最低, 但具有相对稳定的客户需求</p> <p>3) 公司高端测试片应用于国际一线晶圆厂客户先进制程产线需求, 其销售价格和品质与抛光片正片接近</p> <p>4) 由于单晶硅棒拉制过程中的物理特性, 同一根单晶硅棒会同时产出正片和测试片, 测试片不会进入外延工序</p>

3、主营业务收入构成及特征

报告期内, 公司主营业务收入按产品分类构成情况如下:

单位: 万元、%

类别	2024 年		2023 年		2022 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
抛光片	83,075.61	39.36	64,717.58	44.32	41,881.97	40.71
外延片	35,348.39	16.75	8,608.51	5.89	13,494.15	13.12
测试片	92,663.27	43.90	72,705.36	49.79	47,496.58	46.17
其中: 高端测试片	44,683.83	21.17	30,854.60	21.13	2,550.82	2.48
合计	211,087.28	100.00	146,031.45	100.00	102,872.70	100.00
正片合计	118,424.00	56.11	73,326.09	50.21	55,376.12	53.83

(二) 主要经营模式

1、采购模式

首先, 公司母公司为供应链企划和管理中心, 做出采购决策; 奕斯伟硅片(第一工厂)及欣芯材料(第二工厂)为具体采购主体, 与供应商签订采购合同。

其次, 公司制定了严格的合格供应商准入制度和供应商管理制度, 综合评估产品质量、经营规模、供应能力等因素, 参考全球硅片行业头部企业和自身实际情况, 将优质供应商纳入合格供应商名录, 并对合格供应商实施筛选、调查、分级管理及评价。同时考虑供应商多元化和采购成本优化, 公司积极培育 12 英寸硅片所需原材料、耗材及设备本土供应商, 是陕西省工业和信息化厅确定的“第

一批陕西省重点产业链“链主”企业”。

第三，公司通过询价、比价、议价、招投标方式确定供应商。对于主要原材料，公司采用“以产定采，适量备货”的采购模式，一般根据未来一年经营规划制定年度采购方案，根据具体的生产计划、研发计划和安全库存制定采购计划并向供应商下达采购订单。为确保物资供应的稳定性和品质，公司建立了多元化的供应商体系，主要物资合格供应商数量不少于两家，并与合格供应商签订框架协议。对于采购占比最大的电子级多晶硅，全球技术成熟且具有一定规模的厂商数量较少，公司通过与主流供应商签订长期协议，确保电子级多晶硅的长期稳定供应。对于主要设备采购，公司根据产能建设计划制定设备采购计划，通过招投标、询价、比价方式进行采购。

2、生产模式

首先，公司以奕斯伟硅片（第一工厂）及欣芯材料（第二工厂）为生产主体，产品完成生产后，销售至母公司，最终由母公司统一外售。

其次，公司主要采用以销定产的模式，首席营销官组织与主要客户一般于年末提前沟通下一年度的采购需求，对生产进行预计和规划；首席营销官组织根据客户具体采购意向和采购订单（一般提前 3 个月）提出具体生产需求，并制定销售计划；首席制造官组织下设的生产管理部门结合销售计划、材料库存信息制定生产计划，制造部门根据生产计划进行生产；生产完成后，由首席品质官组织对产品质量进行检验后完成入库。鉴于客户认证数量不断增长，考虑新客户采购需求以及生产周期等诸多因素，公司会根据市场和客户的判断提前备货生产。

第三，公司首席制造官组织下设智造技术中心推进智能化工厂建设，旨在实现产品个性化、设计协同化、供应敏捷化、制造柔性化、服务主动化、决策智能化。在生产过程中，公司利用自动派送系统（RTD）实现对硅片位置的准确定位、智能化分析，从而达到高效的生产运营管理；利用 AMHS 系统对 OHT（天车）与移动机器人的管理调派实现硅片在设备及库房间的自动转运，是目前国内自动化程度最高的硅片工厂之一。同时，公司以 ERP 系统为企业运营管理的核心系统，综合运用负责产品研发和管理的 PLM 系统、负责生产制造的 MES 系统、负责成品入库及交付管理的 FGMS 系统、负责设备自动化程序的 EAP 系统等，

实现企业运营的高效决策和执行。

3、销售模式

首先，母公司为市场销售中心，为销售合同签订主体和回款主体。

其次，行业惯例，晶圆厂在引入新供应商时，会在审查通过供应商的技术实力、品控体系和产能规模等条件后，要求硅片供应商先行提供测试片进行认证，认证周期正常为 3-6 个月；测试片认证通过后，可以进行量产供货。测试片量产供货后，根据晶圆厂内部评估，可进一步开展正片验证，验证周期正常为 9-12 个月；正片验证通过后，方实现正片量产供货，后续晶圆厂根据对供应商定期评价增减其供货比例。整体来看，新进入者仅考虑测试片送样到正片量产至少需要 1-2 年周期，由于认证周期较长并且认证成本较高，一旦认证通过，晶圆厂商通常不会轻易更换供应商。公司自进入该领域之初即确定了“服务全球客户”战略，将全球客户划分为中国大陆地区战略客户、中国台湾地区及海外战略客户和细分领域客户，不同国家和地区客户均有专人服务，工厂建设初期即与客户直接沟通，调研客户的需求制定匹配的客户导入方案，并在导入客户后，持续密切跟踪市场发展动向，向客户持续提供有竞争力的技术支持和产品服务。

第三，考虑实时了解客户需求，减少中间环节，公司对主要客户均直销供货，并根据行业惯例及客户需求采用寄售直销模式对部分客户销售。此外，基于特定地方政策，公司通过代理商代销供货。报告期各期，该类代销模式主营业务收入占比均不超过 4%。

4、研发模式

首先，母公司为研发与技术中心。若研发项目涉及使用产线，由母公司为主，奕斯伟硅片（第一工厂）及欣芯材料（第二工厂）为辅，双方联合研发。公司研发部门具体分工职责详见本节之“七、（三）1、研发部门”。

其次，公司研发活动分为技术研发、产品研发、工艺研发、设备及系统研发四大类。**1) 技术研发：**公司基于现有能力，针对新技术的创新性研发活动，包括但不限于针对新技术自主设计设备核心部件、新工艺的前瞻性设计、模拟及测试开发等，取得的研发成果一般为新工艺技术、先进的量测技术或创新性成果专

利；**2) 产品研发**：根据行业规格现状或公司发展计划将新技术应用于产品之上，以满足下游客户技术迭代和应用需求，取得的研发成果一般为导入量产的新产品；**3) 工艺研发**：针对已有的工艺流程、工艺方法和材料耗用及配比等方面进行优化调整及设备智能化改造开发，包含原材料、耗材和设备的二元化导入研发项目，取得的研发成果一般为工艺方案文档等；**4) 设备及系统研发**：仅指发行人历史控股子公司奕斯伟设备的 12 英寸硅片拉晶设备相关研发项目。

此外，公司在现有研发体系基础上，不断推进研发体系数字化、标准化，逐步形成多个标准化研发平台，提升研发效率。

5、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势

与国内外友商不同，公司仅专注于 12 英寸硅片，不涉及 8 英寸及以下硅片业务，全部主营业务收入和技术专利均基于 12 英寸硅片。主要原因系：

首先，国内外友商电子级硅片业务运营远早于发行人，大多经历了硅片主流规格从 8 英寸向 12 英寸的技术路线转换，前期 8 英寸硅片固定资产大多已折旧完毕，友商产品具备极强成本竞争力。

其次，12 英寸硅片占 **2024 年**全球硅片出货面积的 **75%**以上，已经是市场主流。考虑到性价比，目前贡献全球半导体市场 **80%**以上的集成电路芯片大多采用或正在转向 12 英寸硅片制造；贡献全球半导体市场约 **20%**的 O-S-D 器件中，功率器件、CIS 等产品一部分开始转向 12 英寸硅片制造，一部分开始转向碳化硅衬底制造。

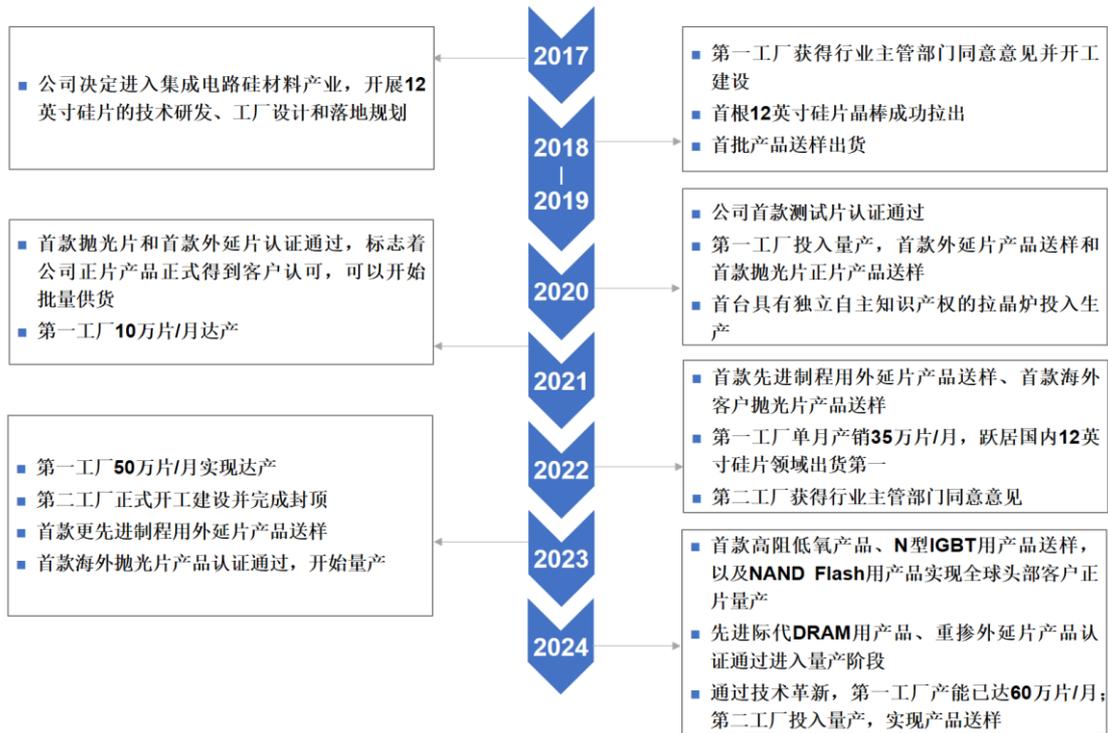
最后，8 英寸及以下硅片主要用于 90 纳米及以上成熟制程半导体产品，国内硅片友商已具备一定市场影响力，国内 12 英寸硅片供需结构的矛盾更加突出。

公司所采用的经营模式和影响经营模式选择的关键影响因素在报告期内未发生重大变化，预计未来短期内不会发生重大变化。

(三) 公司设立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况

报告期内，公司主营业务及主要产品未发生重大变化。公司成立以来的发展

阶段演变情况如下:



(四) 主营业务经营情况和核心技术产业化情况

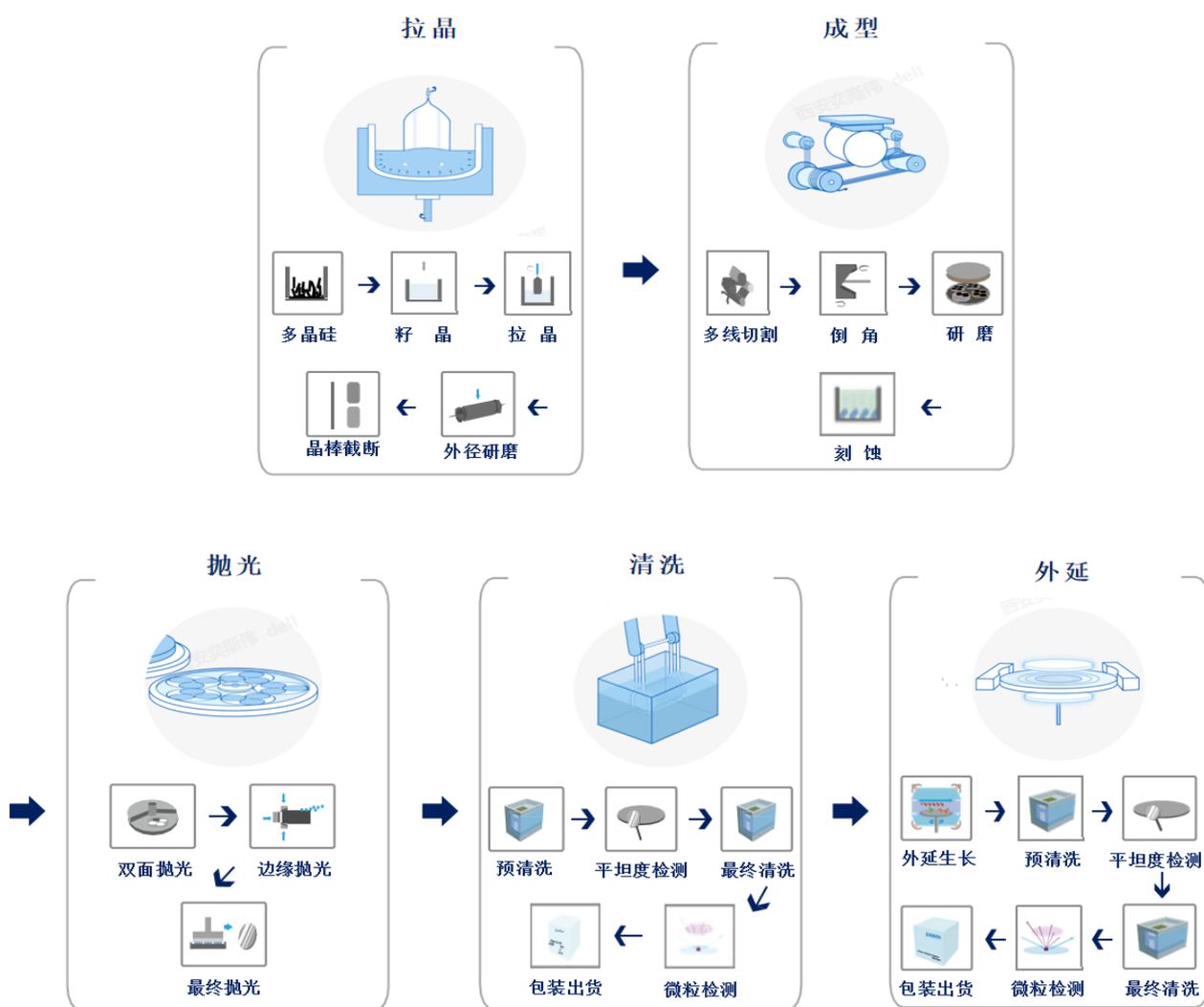
作为新进入的“挑战者”,公司进入该领域之初即组建全球研发团队,规划与全球前五大厂商的差异化技术路线,在产能爬坡过程中通过自主研发形成了拉晶、成型、抛光、清洗和外延五大工序的核心技术体系。基于前述核心技术,公司积极市场开拓,截至2024年末,公司已通过验证的客户累计144家,其中中国大陆客户108家,中国台湾及境外客户36家;已通过验证的测试片超过390款,量产正片超过90款,其中中国大陆客户正片已量产80余款,中国台湾及境外客户正片已量产近10款,2024年量产正片已贡献公司主营业务收入的比例超过55%。

报告期内,公司核心技术与产品和市场深度融合。公司年度出货量从2022年的234.62万片增至2024年的625.46万片,复合增长率约63%;营业收入从2022年的10.55亿元增至2024年的21.21亿元,复合增长率达到41.83%。基于2024年月均出货量和截至2024年末产能规模统计,公司均是大陆第一、全球第六的12英寸硅片厂商,前述月均出货量和产能规模全球同期占比约为6%和7%。同时,公司产品不断技术迭代,公司产品已量产用于2YY层NAND

Flash 存储芯片、先进际代 DRAM 存储芯片和先进制程逻辑芯片。先进制程 NAND Flash 存储芯片、更先进际代 DRAM 存储芯片以及更先进制程逻辑芯片的 12 英寸硅片均已经在主流客户验证。

(五)主要产品的工艺流程及核心技术在生产过程中的具体使用情况和效果

公司以电子级多晶硅为原料,通过直拉法拉晶制成单晶硅棒,之后经过成型、抛光、清洗三道工序形成 12 英寸抛光片,部分产品再进行外延工序后形成 12 英寸外延片,具体工艺流程如下:



上图各工艺环节的具体过程如下:

工艺环节	具体内容
拉晶	纯度高达 99.99999999%的电子级多晶硅、掺杂剂等原材料投入拉晶设备

	<p>中的石英坩埚，在拉晶设备中通过热场加热将多晶硅为主的原材料融化，并利用籽晶旋转牵引、冷却，生产出单晶硅棒，再经过滚磨、切割，得到半成品晶锭。</p> <p>拉晶环节前，发行人即可区分目标产出为抛光片还是外延片，不同种类产品对投料、工艺和所领用的单晶硅棒品质要求有别。从而，外延片仅是除外延之外工艺环节与抛光片类似，并非抛光片成品进行外延工序即为外延片成品</p>
成型	晶锭多线切割成独立的硅片，再对各硅片表面的切割损伤层通过倒角、研磨和湿法刻蚀的方式进行去除、减薄及边缘形状加工，确保单个硅片具有低翘曲度和高平坦度的几何品质
抛光	在成型工艺基础上，经过双面抛光、边缘抛光、最终抛光等步骤对硅片进一步加工，提升硅片表面的局域平坦度、边缘平坦度和纳米形貌
清洗	使用多种化学试剂对硅片循环进行清洗和检测，去除硅片表面的金属离子、颗粒和有机物污染，确保硅片表面清洁度满足客户需求，品质部门检测合格后，分出符合客户要求的抛光片进行包装，进入产成品库
外延	用外延设备对清洗后的抛光片采用化学气相沉积方法沉积一层单晶外延膜形成外延片，之后在此循环进行清洗和检测提升硅片表面清洁度，品质部门检测合格后，分出符合客户要求的外延片进行包装，进入产成品库

公司核心技术在生产流程中的具体使用情况和效果详见本节之“七、（一）1、核心技术先进性和具体表征”。

（六）公司具有代表性的业务指标、技术先进性及具体表征

报告期内，公司具有代表性的业务数据，包括产品种类、产销量及收入规模等，均有良好表现。相关业务数据的变动情况及原因请详见本节之“三、（一）主要产品的生产情况”和本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“八、经营成果分析”中的有关内容。

（七）符合产业政策和国家经济发展战略情况

公司专注于 12 英寸硅片业务，符合产业政策和国家经济发展战略，对于我国半导体产业链具有重要意义，具体情况请详见本节之“二、（二）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策”。

二、发行人所处行业基本情况

(一) 发行人所属行业及确定依据

公司专注于 12 英寸硅片的研发、生产和销售。根据《产业结构调整指导目录(2024 年本)》，公司所属行业领域属于“鼓励类”，第二十八条第 4 款“集成电路”中包含“线宽小于 0.25 微米(含)的特色工艺集成电路生产(含掩模版、8 英寸及以上硅片生产)”。

根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》，公司所属行业领域属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“电子元件及电子专用材料制造”(代码：C3985)。

根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》，公司所属行业领域属于“3 新材料产业”之“3.4 先进无机非金属材料”之“3.4.3 人工晶体制造”之“3.4.3.1 半导体晶体制造”。

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引(2023 年 5 月)》，公司所处行业为“C 制造业”之“CH 电气、电子及通讯”之“CH39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“CH398 电子元件及电子专用材料制造”。

根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司属于“新一代信息技术领域”中的“半导体和集成电路”。

(二) 行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策

1、行政主管部门及监管体系

公司所属行业的行政主管部门主要为国家发改委、工信部和科技部。公司所属行业的全国性自律组织主要为中国半导体行业协会(主要职责为负责制(修)订行业标准、国家标准及推荐标准,并推动标准执行)、集成电路材料产业技术创新战略联盟(主要职责为组织行业内部技术交流和学术交流,推动行业发展)。

2、近五年行业主要法律法规和政策

时间	颁布部门	文件名称	主要内容
2023 年 12 月	国家发改委	《产业结构调整指导目录(2024 年本)》	鼓励类第二十八条第 4 款“集成电路”中包含“线宽小于 0.25 微米(含)的特色工艺集成电路生产(含掩模版、8 英寸及以上硅片生产)”

2023年08月	工信部	《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》	面向个人计算、新型显示、VR/AR、5G通信、智能网联汽车等重点领域，推动 电子材料 、电子专用设备和电子测量仪器技术攻关；面向数字经济等发展需求，优化集成电路、新型显示等产业布局并提升高端供给水平， 增强材料、设备及零配件等配套能力
2022年03月	国家发改委、工信部、财政部、海关总署、税务总局	《关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单指定工作有关要求的通知》	提及集成电路产业的关键原材料、零配件(靶材、光刻胶、掩模版、封装基板、抛光垫、抛光液、 8英寸及以上硅单晶 、 8英寸及以上硅片)生产企业享受税收优惠的政策条件
2022年01月	国务院	《“十四五”数字经济发展规划》	提出着力提升关键基础材料 和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。完善 5G、集成电路 、新能源汽车、人工智能、工业互联网等 重点产业供应链体系
2021年12月	工信部	《重点新材料首批次应用示范指导目录(2021年版)》	8-12英寸硅单晶抛光片 、 8-12英寸硅单晶外延片 属于先进半导体材料列入指导目录并列为先进半导体材料
2021年03月	第十三届全国人大四次会议	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	聚焦 高端芯片 、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域，加快推进基础理论、基础算法、 装备材料 等研发突破与迭代应用
2020年09月	国家发改委、科技部、工信部、财政部	《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》	通过围绕微电子制造等重点产业链供应链稳定， 加快大尺寸硅片等领域实现突破 ，增强新材料产业弱项
2020年07月	国务院	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》	国家鼓励的集成电路设计、装备、材料等企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。一定时期内，线宽小于 0.25微米 (含)的特色工艺集成电路生产企业(含掩模版、 8英寸及以上硅片生产企业)进口自用生产性原材料、消耗品，配套系统和集成电路生产设备零配件等，免征进口关税
2019年10月	国家发改委	《产业结构调整指导目录(2019年本)》	鼓励类第九条第4款“信息、新能源有色金属新材料”中的第一项“(1)信息： 直径200mm以上的硅单晶及抛光片 、直径 125mm 以上直拉或直径 50mm 以上水平生长化合物半导体材料...”

上述可见,在目前国际形势和国家发展阶段的背景下,我国将集成电路和新材料产业均确定为战略性产业。公司主要产品不仅具有新材料属性,也是集成电路产业链的重点攻关领域。公司业务符合产业政策和国家发展战略,上述法律法规和政策重点鼓励公司所处半导体衬底材料领域经营发展,并从财政、税收、人才和技术等多方面提供支持,为公司提供了良好的经营环境。

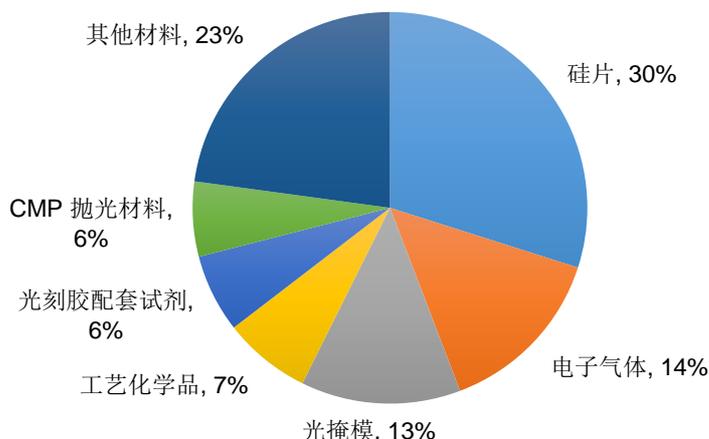
(三) 行业发展情况

1、12 英寸硅片行业概况

(1) 硅片是芯片制造的“地基”,是需求量最大的晶圆制造材料,2024 年全球市场需求约 115 亿美元,其与全球半导体市场同频共振,目前短期波动,但长期向好

硅元素在地球中含量仅次于氧元素,占地球地壳总质量的 26%,其性质稳定、获取成本低、提纯工艺成熟,在半导体领域得到广泛应用。目前全球 95%以上的半导体器件采用硅片作为衬底,占半导体器件 80%的集成电路产品中 99%以上采用硅片作为衬底。在硅片衬底的基础上,通过光刻、刻蚀、薄膜沉积、离子注入等多道工序完成各类半导体器件制作,从而硅片是芯片制造的地基。根据 SEMI 统计,九大类晶圆制造材料中硅片占比 30%,是晶圆制造耗用最大的材料。

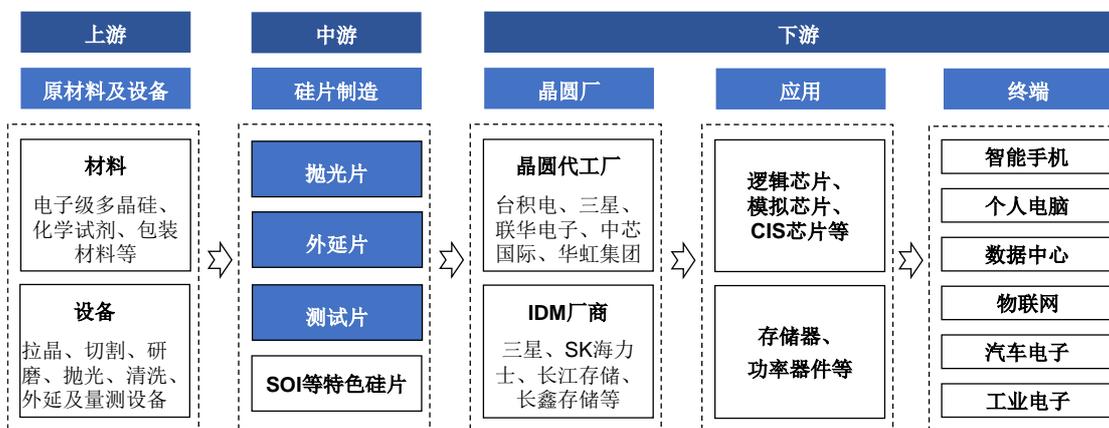
晶圆制造材料市场规模各品类占比



资料来源: SEMI

受益于智能手机、个人电脑、物联网、汽车电子、人工智能和高性能计算等

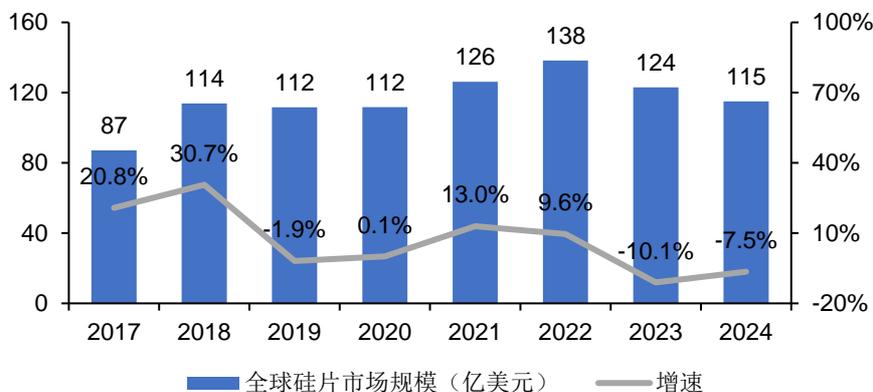
终端需求持续涌现,根据 WSTS 统计,全球半导体市场规模从 2017 年的 4,122 亿美元提升至 2024 年的 6,269 亿美元,年均复合增长率为 6.17%。半导体硅片市场景气度与下游半导体和终端应用市场高度相关,其产业链环节以及上下游行业之间的关联性如下:



注:蓝色底纹方框为公司涉及的产品范围

根据 SEMI 统计,全球电子级硅片(不含 SOI 硅片)销售规模随之从 2017 年 87 亿美元增长到 2024 年的 115 亿美元,年均复合增长率为 4.07%。

2017-2024年全球硅片(不含SOI)
市场规模及增速



资料来源: SEMI

2022 年四季度开始,随着宏观经济波动和消费电子产品需求放缓,全球主要晶圆厂 2023 年产能利用率不足,导致 2023 年全球电子级硅片市场规模同比行业景气峰值的 2022 年下滑至 124 亿美元。2024 年下半年随着下游复苏,半导体行业开始回暖,但电子级硅片属于半导体产业链最上游,前期库存仍需一定时间消化,导致电子级硅片市场回暖存在滞后性,2024 年全球电子级硅片市场

规模进一步降至 115 亿美元，但下降幅度同比 2023 年收窄，且 12 英寸硅片出货面积同比 2023 年已有所回升。在宏观政治环境维持稳定的情况下，预计 2025 年电子级硅片市场规模同比回升。

长期来看，智能化是全球经济发展的必然趋势，而半导体是人工智能时代的核心基础设施。随着全球贸易格局变化，各国已将半导体产业，尤其是半导体产业链的制造产能视为战略资源，美国、日本、韩国、欧盟与我国等纷纷推动半导体产业振兴相关政策，战略扶持本土半导体产业链以及先进半导体技术的研发。根据 SEMI 预计，2030 年全球半导体市场规模有望达到万亿美元，假设保持现有增速，全球半导体硅片市场规模届时有望翻倍，预计超过 200 亿美元。

(2) 12 英寸硅片已成为电子级硅片的市场主流，且出货面积占比持续增大

电子级硅片按直径大小可分为 6 英寸及以下、8 英寸和 12 英寸三类规格。硅片面积越大，生产的芯片数量越多，硅片边缘浪费面积越小，单位芯片的成本越低。12 英寸硅片的理论面积是 8 英寸硅片的 2.25 倍，相同工艺条件下的可使用率（单位硅片可生产的芯片数量）约为 8 英寸硅片的 2.5 倍。

虽然 12 英寸硅片理论面积是 8 英寸硅片的 2.25 倍，但 12 英寸硅片每片单价远高于 8 英寸硅片单价的 2.25 倍，其单位面积的单价更高，从而附加值高、制程更先进的芯片采用 12 英寸硅片生产能获得最大经济效益。一般而言，90 纳米以上的制程主要使用 8 英寸及以下的半导体硅片，而 90 纳米及以下的制程主要使用 12 英寸硅片。

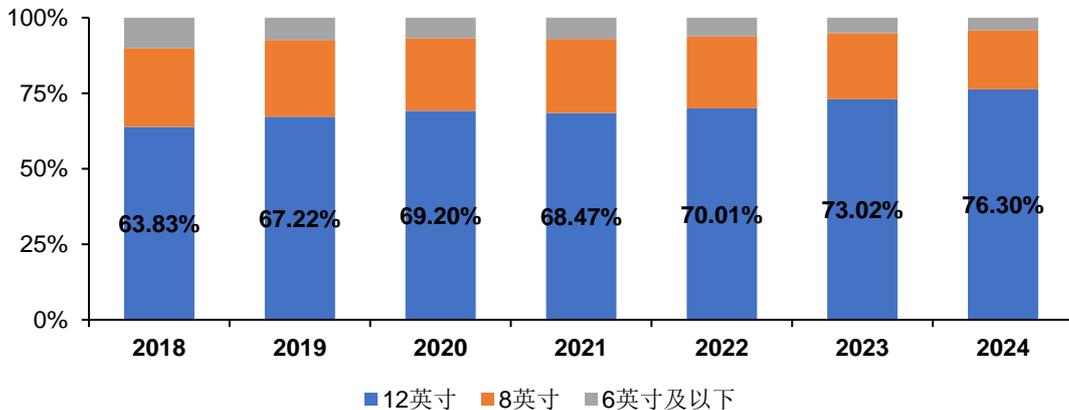
根据 SEMI 统计，12 英寸硅片的出货面积占比从 2018 年的 63.83% 增长至 2024 年的 76.30%，已成为市场绝对主流，且预计未来 12 英寸硅片出货面积占比将进一步提升，规模不断增长，主要基于以下原因：

首先，人工智能时代需要更强的数据算力、更快的数据传输、更大的数据存储和更灵敏的人机交互，实现前述功能技术和工艺制程最主流和最先进的逻辑和存储芯片（一般 90 纳米工艺制程以下）以及部分高端模拟和传感器芯片均采用 12 寸晶圆制造工艺，从而 12 英寸硅片是目前业界最主流规格的硅片，12 英寸产能也是全球晶圆厂扩产的主力方向。根据 SEMI 统计，2025 年至 2027 年，全球 12 英寸晶圆厂设备支出预计将达到创纪录的 4,000 亿美元。其中 2025 年

将首次突破 1,000 亿美元,达到 1,232 亿美元,这一数字基本与全球半导体设备市场规模一致,充分说明未来全球晶圆厂扩产很少考虑非 12 英寸产能。

其次,新产品新技术催生 12 英寸硅片更多消耗。以人工智能催生下目前供不应求的高带宽内存(HBM)产品为例,根据 SEMI 统计,由于生产良率、堆叠工艺复杂度以及更大的芯片尺寸,同等存储容量的 HBM 对 12 英寸硅片的需求量是目前主流 DRAM 产品的 3 倍。此外,随着 NAND Flash 堆叠层数提升至 200 层、300 层,甚至 400 层,按目前业内技术路线共识,所有厂商均会切换至通过 2 片晶圆键合制作 1 个 NAND Flash 完整晶圆的工艺,相当于 12 英寸硅片需求翻倍。

2018-2024年全球不同尺寸半导体硅片出货面积占比



资料来源: SEMI

(3) 全球 12 英寸硅片需求预计到 2026 年将超过 1,000 万片/月, 中国大陆地区届时需求将超过 300 万片/月, 约占全球需求的 1/3

全球半导体市场本轮从 2020 年开始进入景气上升周期,叠加全球各国将晶圆制造产能视为核心战略资源,纷纷推出政府补贴计划。各国晶圆厂加速资本支出,仅 2020 至 2023 年,全球新增投资超过 30 条 12 英寸晶圆产线。根据 SEMI 统计,截至 2024 年末,全球共有 193 条 12 英寸量产晶圆厂,预计到 2026 年全球 12 英寸晶圆厂量产数量将达到 230 座,将对 12 英寸硅片带来巨大的需求。根据 SEMI 预测,全球 12 英寸晶圆厂产能将从 2024 年的 834 万片/月增长至 2026 年的 989 万片/月,年复合增长率达到 8.9%,下游晶圆厂产能的快速扩张将大幅拉升 12 英寸硅片需求。

中国大陆地区上一轮晶圆厂产能扩张基本为 12 英寸产线。根据 SEMI 统计，截至 2024 年末，中国大陆地区有 62 座 12 英寸量产晶圆厂（包含西安三星、无锡 SK 海力士、南京台积电等外资晶圆厂），预计 2026 年中国大陆地区 12 英寸晶圆厂量产数量超过 70 座，相应产能增长至 321 万片/月，约占届时全球 12 英寸晶圆厂产能的 1/3，其中以中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储为代表的内资 12 英寸晶圆厂产能将增至约 250 万片/月。目前，我国 12 英寸硅片，尤其是中高端硅片，仍大部分依赖进口，供需结构矛盾影响我国半导体产业链的供应链安全。

（4）全球 12 英寸硅片供给呈现全球前五大厂商寡头垄断格局，国内产业起步较晚，国内友商竞争格局初显

根据 TECHCET 数据及同行业上市公司公告数据统计，考虑目前国内外 12 英寸硅片厂商达产产能规模，全球前五大半导体硅片厂商 12 英寸硅片产能占比仍高达 76%，出货量占比预计高达 80%，尤其是前两大厂商，约占据全球 12 英寸硅片产能和出货量的 50%。

境内厂商技术研发和产业化起步较晚。2010 年，有研硅承接国家科研任务建成了 1 条 1 万片/月的中试线，但并未产业化。上海新昇 2018 年完成 10 万片/月的量产线建设，首次实现规模化量产。此后以公司、中环领先为代表的多家厂商进入该领域或实施扩产。鉴于 12 英寸硅片技术门槛高，投资强度大，前期部分新进入厂商项目停滞或实施重组（如中环领先收购徐州鑫晶、金瑞泓收购国晶半导体），目前成规模国内厂商有 7 家，各自 12 英寸硅片产能现状如下：

单位：万片/月

公司名称	现有产能	国内产能占比
上海新昇	65	28.26%
中环领先	35	15.22%
立昂微	30	13.04%
中欣晶圆	20	8.70%
上海超硅	未披露	未披露
山东有研艾斯	10	4.35%

公司	超过 70	30.43%
合计	230	100.00%

数据来源：上海新昇产能数据来源为沪硅产业 2024 年度业绩快报；中环领先产能数据来源为公开报道；立昂微产能数据来源其 2023 年年报；中欣晶圆产能数据来源为其招股说明书和公开报道；山东有研艾斯产能数据来源为有研硅招股说明书和公开报道。

2、行业技术水平及技术发展趋势

(1) 12 英寸硅片是市场、技术和经济效益动态均衡的产品

12 英寸硅片目前主要应用于技术迭代最快的存储和逻辑芯片领域。目前全球最先进的逻辑芯片已进入 3 纳米制程，DRAM 已进入 1β 际代，NAND Flash 已进入 2YY 层堆叠结构。随着芯片线宽进一步升级，结构堆叠层数进一步增加，对作为“地基”的 12 英寸硅片的晶体缺陷控制水平、低翘曲度、超平坦度、超清洁度和外延膜层形貌与电学性能提出了更苛刻的要求。对于拉晶工艺，需要更高的控制精度，通过对温度、提拉速度、籽晶和石英坩埚旋转速度、超导磁场等方面施加更为精密控制，不断提升晶体缺陷控制水平；对于成型、抛光和清洗工艺，需要不断优化设备、改进工艺、完善原材料配比，保障硅片品质；对于外延工艺，需要在外延设备的基础上自主优化核心部件，控制多重工艺参数，满足客户规格要求。同时，12 英寸硅片投资规模大，一方面需要不断切入晶圆厂新工艺研发，增加认证种类，确保规模效应，消化固定成本；一方面需要通过工艺优化提升不同工序的投入产出比，确保成本竞争力。因此，12 英寸硅片是市场、技术和经济效益动态均衡的产品。

(2) 晶圆产能不断向 12 英寸切换导致 12 英寸硅片产品种类更加丰富

首先，12 英寸硅片现有产品规格种类繁多。尤其是对于逻辑芯片晶圆代工工厂客户，即使同一制程同一品类芯片制造，不同客户的工艺平台会有差异，对所采购硅片规格具有差别。同时，基于经济性考虑和产业技术水平迭代升级趋势，以功率分立器件和 CIS 为代表的晶圆厂产线开始从 8 英寸向 12 英寸切换。12 英寸硅片厂商需要依据对未来下游市场发展趋势的研判，提前研发相应技术路线和新建产能。例如根据掺杂剂种类的不同，12 英寸硅片进一步细分为 P 型和 N 型；根据掺杂浓度的不同，不同类别又可进一步分为轻掺和重掺。不同类型硅片对应的具体应用场景如下：

硅片类型			主要应用场景
P 型	抛光片	轻掺	存储芯片（DRAM、NAND Flash、部分制程 Nor Flash）、CIS 芯片中逻辑晶圆、模拟芯片（部分制程显示驱动芯片、电源管理芯片等）
	外延片	轻掺	逻辑芯片、存储芯片（部分制程 Nor Flash）、模拟芯片（部分制程显示驱动芯片等）
		重掺	CIS 芯片中像素传感器晶圆等
N 型	抛光片	轻掺	功率器件（IGBT）
		重掺	功率器件（MOSFET）
	外延片	重掺	

鉴于逻辑和存储芯片主要采用 12 英寸晶圆产能制造，参考上表产品应用场景，P 型硅片全球 12 英寸硅片市场占比超过 90%，公司目前主要生产 12 英寸 P 型硅片，第二工厂将生产 12 英寸 N 型硅片。

（3）国产厂商不仅需要自身努力，更需与国内产业链形成合力实现突破

首先，全球前五大厂商已形成较强技术优势，各家专利申请量门槛在 1,000 项左右，最多达 3,500 项以上，国产厂商需要制定差异化的技术路线，规避知识产权风险。

其次，设备是工艺的核心。尤其是拉晶设备，全球前五大半导体硅片厂商或自主研发制造，或者购买第三方的拉晶设备供应商产品，并对与设备商联合研发的 IP 和 Know-How 签有严格的技术保密协议，其他厂商无法直接购买具有国际友商知识产权的设备。即使采购第三方拉晶设备，也需硅片厂商自主设计所匹配的热场、石英坩埚和磁场等核心部件，形成自身的 IP 和 Know-How，方能保证晶体品质。

第三，国内 12 英寸硅片产业起步晚，上游配套设备、原材料和耗材的国产化率极低。基于目前国际贸易摩擦风险，与国产供应商联合研发，不断验证是保障产业链安全的必然手段。

3、行业壁垒

（1）技术壁垒

电子级硅片对于原子排列缺陷、几何形貌、电阻率、表面洁净度等核心指标有着苛刻要求。芯片制造工艺对硅片缺陷尺寸与缺陷密度容忍度极低，技术节点越先进，特征尺寸越小，对上述指标的控制越严格，技术壁垒越高。同时，全球前五大厂商已提前布局硅片制造领域的专利，形成较强的专利壁垒，对后续进入者带来一定的挑战。

(2) 设备壁垒

12英寸硅片的核心设备是拉晶设备，其数量直接决定硅片厂商的产能空间。国际主流厂商或自主研发制造，或者购买第三方的拉晶设备供应商产品，并对与设备商联合研发的IP和Know-How签有严格的技术保密协议，其他厂商无法直接购买具有国际友商知识产权的设备。即使采购第三方拉晶设备，也需硅片厂商自主设计所匹配的热场、石英坩埚和磁场等核心部件，形成自身的IP和Know-How，方能保证晶体品质。此外，成型、抛光、清洗、外延等其他环节设备也关乎产品品质，相应设备大致有120余种，大部分设备需要不断优化参数调试、自主设计核心部件方能满足客户要求。同时，所需设备国产化率极低，部分设备尚无国产化替代方案。

(3) 认证壁垒

根据行业惯例，晶圆厂在引入新供应商时，会在审查通过供应商的生产资质、技术实力、生产能力等条件后，要求半导体硅片供应商先行提供测试片进行试生产认证，认证周期正常为3-6个月；待测试片认证通过后，可以量产供货测试片。在量产供货测试片后，公司需进一步开展正片验证，验证周期正常为9个月-1年；正片验证通过后，方可实现正片的量产供货，后续根据定期评价增减供货比例。整体来看，新进入者仅考虑测试品送样到正片量产至少需要1-2年周期，价格更高的高端正片的认证周期更长，再考虑前期工厂建设、设备交付和调试以及工艺研发所耗周期，时间成本惊人。由于认证周期较长并且认证成本较高，一旦认证通过，晶圆厂商通常不会轻易更换供应商，双方就此建立长期、稳固的合作关系。

(4) 资金和产能壁垒

12英寸硅片制造业务在半导体产业链中单位产能投资强度仅次于逻辑及存储晶圆厂。公司第一工厂（50万片/月产能）总投资额高达110亿元，80%为设

备支出，每 10 万片/月产能投入约需 20 亿元。一方面，对于全球主流客户，没有一定的产能保障，无法导入客户；另一方面，产能过低无法实现规模效应，需要具有产能规模才能保证企业具有盈利空间。

(5) 人才壁垒

12 英寸硅片的研发和生产过程复杂，涉及机械、化学、材料等多学科领域交叉，故需要具备综合专业知识和丰富生产经验的复合型人才。尤其是国内缺乏具有产业经验的管理和技术人才，对后续进入者形成了较大的阻碍。

4、行业面临的机遇与风险

(1) 面临的机遇

1) 国家产业政策的有力支持

2014 年国务院即出台了《国家集成电路产业发展推进纲要》，着力推动中国集成电路产业的发展，在关键材料领域形成突破，开发大尺寸硅片等关键材料，加快产业化进程，增强产业配套能力。2017 年工信部出台的《新材料产业发展指南》，明确提出加强大尺寸硅材料研发及产业化，解决极大规模集成电路材料制约。2021 年，工信部出台的《重点新材料首批次应用示范指导目录(2021 版)》，将 12 英寸硅单晶抛光片、12 英寸硅单晶外延片确定为先进半导体材料。

(2) 国际竞争环境下与本土供应商展开合作成为大势所趋

基于国内明确的晶圆厂扩建计划，预计 2026 年中国大陆地区对 12 英寸硅片的需求将超过 300 万片/月，占届时全球 12 英寸硅片需求的 1/3，其中以中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储为代表的全部内资晶圆厂 12 英寸硅片需求将超过 250 万片/月。目前，我国 12 英寸硅片，尤其是中高端硅片，仍大部分依赖进口，供需结构矛盾严重影响我国半导体产业链的供应链安全。随着国际贸易摩擦加剧，国内尤其是内资晶圆厂客户对国产 12 英寸硅片厂商合作态度日益开放，甚至是必选项，12 英寸硅片国产化率提升将成为长期趋势。

(2) 面临的風險

1) 我国 12 英寸硅片企业起步晚、技术积累较少，整体规模偏小，全球市场

竞争力较弱

发行人所处的 12 英寸硅片行业已形成全球前五大厂商寡头竞争的供给格局,由于技术难度高、客户认证周期长等特点,率先掌握先进技术和具有产能优势的全球龙头厂商占据着绝大部分的全球市场份额,已形成良好的规模效应,在技术、价格、产品丰富度等方面具有很强的竞争力。中国大陆企业起步晚、技术积累较少,整体规模偏小,后发劣势短期内无法改变,面临较强的市场竞争。

2) 12 英寸硅片的供应链基础仍较为薄弱

由于起步晚,基础相对薄弱,我国 12 英寸硅片制造所需的设备、材料和耗材主要向境外发达国家和地区进口,国产化率极低。在目前全球贸易摩擦加剧的背景下,国产供应商短期仍需成长,从而对国内 12 英寸硅片厂商的供应链安全产生制约。

3) 高端专业技术人才不足

12 英寸硅片产业属于技术密集型行业,对于技术人员知识背景、研发能力和应用经验积累均有较高要求。人才的培养需要一定的时间和相应的环境,同时需要扎实的基础学科知识,现有国内人才和技术水平难以满足行业内日益增长的人才需求。此外,由于发达国家对半导体核心材料的核心技术、工艺以及人才流动限制较为严格,也在一定程度上制约了行业的快速发展。

5、行业周期性、季节性、区域性特征

(1) 周期性

半导体产业链受宏观经济景气周期影响较大,智能手机、个人电脑、数据中心、智能汽车等半导体终端市场需求的波动直接影响晶圆厂客户的采购需求,进而影响到 12 英寸硅片行业的景气度。

(2) 季节性

季节性不明显。

(3) 区域性

我国半导体硅片企业主要集中在长三角、环渤海等产业链集群地区。

(四) 细分行业竞争格局与发行人产品市场地位

1、竞争格局与行业内主要企业

(1) 公司行业及市场地位

根据 TECHCET 报告及同行业公司公开数据统计，假设全球前五大厂商 12 英寸硅片产能与 2023 年末一致，截至 2024 年末全球 12 英寸硅片产能估计为 970 万片/月，约 76% 被信越化学、SUMCO 等全球前五大厂商占据。截至 2024 年末，公司两个工厂合计产能已超过 70 万片/月，全球 12 英寸硅片产能占比已达约 7%，中国大陆排名第一，全球排名第六。具体如下：

公司	国家或地区	截至2024年末投产产能（万片/月）	截至2024年末全球产能占比
信越化学	日本	约 230	23.71%
SUMCO	日本	约 210	21.65%
环球晶圆	中国台湾	三家合计约 300	三家合计约 31%
德国世创	德国		
SK Siltron	韩国		
公司	中国大陆	超过 70	7.22%
上海新昇	中国大陆	65	6.70%
中环领先	中国大陆	35	3.61%
立昂微	中国大陆	30	3.09%
中欣晶圆	中国大陆	20	2.06%
山东有研艾斯	中国大陆	10	1.03%
上海超硅	中国大陆	未披露	未披露
合计	-	970	100.0%

数据来源：全球前五大厂商产能数据来源为 TECHCET 报告，统计截止时间为 2023 年末。国内可比公司产能数据来源与前文一致，部分国内可比公司统计截止时间为 2024 年末。

注：上表中合计产能为假设全球前五大厂商目前产能与 2023 年末一致，截至 2024 年末的全球 12 英寸硅片粗略估算的总体产能。

根据 SEMI 统计及同行业公司公开数据统计，2024 年全球 12 英寸硅片月均出货量约 865 万片/月，2024 年公司月均出货量为 52.12 万片/月，同比 2023 年水平实现 65% 的增长，占 2024 年全球月均出货量比例约 6%，持续保持中国

大陆厂商第一，全球第六的行业地位。2024 年全球出货量具体如下：

公司	国家或地区	2024 年月均出货量 (万片/月)	2024 年月均出货量 占比
信越化学	日本	684	79.08%
SUMCO	日本		
环球晶圆	中国台湾		
德国世创	德国		
SK Siltron	韩国		
公司	中国大陆	超过 52	6.01%
其他厂商	-	约 129	14.91%
合计	-	865	100.00%

数据来源：根据 SEMI 统计的《WAFER MARKET MONITOR》（未披露各家具体月均出货量）和相关上市公司公开披露信息估算。

公司第二工厂（50 万片/月产能）已于 2024 年投产，计划 2026 年达产。预计 2026 年，全球 12 英寸硅片需求将超过 1,000 万片/月，公司第一和第二两个工厂达产并进一步提升效能实现 120 万片/月产能后，将满足全球 12 英寸硅片需求的 10%以上，有望进入全球 12 英寸硅片领域的第二梯队。

（2）行业内主要企业介绍

1) 信越化学（东京证券交易所上市，4063.JP）

1926 年在日本成立，是一家综合性的化学工业集团，业务涵盖基础材料、电子材料、功能材料、专业服务四大事业部，其中电子材料业务（包含电子级硅片、光刻胶、掩膜版等）2023 财年收入占比为 35%。信越化学是全球产能和出货量最大的电子级硅片生产企业，也是全球第一家（2001 年）量产 12 英寸硅片的厂商，具有领先的技术和稳定的市场份额，是业内唯一一家常年持续盈利的电子级硅片公司。

2) SUMCO（东京证券交易所上市，3436.JP）

1999 年在日本由住友金属工业、三菱材料和三菱材料硅事业部合资成立，过去十年借助一系列并购整合快速发展，目前是全球产能和出货量排名第二的电

子级硅片制造商，也是电子级硅片领域申请专利最多的厂商。公司目前专注于电子级硅片业务，产品包括抛光片、外延片、SOI片等，产品以12英寸硅片为主。根据其年报披露，SUMCO应用于先进制程逻辑芯片的外延片全球市占率居首。

3) 环球晶圆（中国台湾证券交易所上市，6488.TWO）

2011年在中国台湾成立，前身为1981年成立的中美矽晶制品股份有限公司的半导体事业处，成立后陆续收购美国Globitech取得外延技术以及日本的Covalent公司拓展至12英寸硅片生产，同时并购了美国SunEdison Semiconductor公司，成为全球产能和出货量前五大的电子级硅片供应商，主要产品为外延片、抛光片等。

4) 德国世创（法兰克福证券交易所上市，WAF.DF）

1953年在德国成立，是德国化工巨头WACKER集团（全球电子级多晶硅主要供应商之一）的子公司，是全球首个研发推出12英寸硅片的厂商。在6英寸和8英寸硅片制造领域占据领先地位，除抛光片和外延片外，还具有独特的区熔硅单晶、HIREF晶片等特殊产品，当前全球产能和出货量排名前五。

5) SK Siltron（未上市）

1983年在韩国成立，目前是韩国SK集团的子公司，12英寸硅片主要产品面向三星、SK海力士等存储IDM客户，是韩国唯一一家电子级硅片专业制造商，发展期间受到韩国政府与韩国厂商的大力支持，当前全球产能和出货量排名前五。

6) 上海新昇（沪硅产业（688126.SH）的全资子公司）

沪硅产业于2015年成立，先后收购上海新昇、新傲科技、Okmetic三家子公司，主要产品涉及8英寸、12英寸抛光和外延片、SOI硅片。上海新昇为国内首家实现12英寸硅片规模化量产的企业，2023年12英寸硅片收入占沪硅产业合并收入超过40%。

7) 中环领先（TCL中环（002129.SZ）的控股子公司）

TCL中环于1999年成立，是国内光伏单晶硅片的龙头企业之一。下属控股子公司中环领先整合了TCL中环内部8英寸及以下和12英寸硅片业务，在功

率半导体用的重掺硅片领域具有较强优势，也是国内 8 英寸硅片规模最大的厂商。中环领先于 2023 年收购徐州鑫晶，进一步提升了 12 英寸硅片能力。

8) 立昂微 (605358.SH)

2002 年成立，主营业务为半导体功率器件和化合物半导体射频芯片、电子级硅片。其中电子级硅片 2023 年收入占比约 56%，是国内 8 英寸硅片的主要厂商，在功率半导体用重掺硅片领域具有较强优势。立昂微控股的金瑞泓微电子专注于 12 英寸硅片业务，2022 年收购国晶半导体进一步提升了 12 英寸硅片能力。

9) 山东有研艾斯 (有研硅 (688432.SH) 的参股子公司)

有研硅成立于 2001 年，主要产品包括 8 英寸及以下抛光片、刻蚀设备用硅材料、区熔硅单晶等，通过参股公司山东有研艾斯布局 12 英寸硅片业务。

10) 中欣晶圆 (未上市)

成立于 2017 年，前身为日本半导体企业 Ferrotec 下设的晶圆硅片事业部。根据其招股说明书披露，产品以 8 英寸及以下抛光片为主，12 英寸抛光片及外延片收入占 2022 年上半年合并报表收入的 1/3。此外，公司还从事半导体硅片受托加工和单晶硅棒出售业务。

11) 上海超硅 (未上市)

上海超硅成立于 2008 年，主营业务为 8 英寸及 12 英寸硅片、先进装备、先进材料的研发、生产和销售，其中 8 英寸硅片业务主要由下属子公司重庆超硅负责，母公司为 12 英寸硅片的业务主体。

2、可比上市公司的选择依据及相关业务可比程度

选择 SUMCO、环球晶圆、德国世创、沪硅产业为可比上市公司，未选择其他国内外友商具体原因如下：

可比公司	对应上市公司	原因
信越化学	信越化学	电子材料（包括电子级硅片、光刻胶、掩膜版等）2023 财年收入占比约 35%，无电子级硅片业务单独披露数据

SK Siltron	不适用	未上市
中环领先	TCL 中环	2023 年光伏硅片收入占比超过 70%，其他硅材料（包括电子级硅片）收入占比约 6%，8 英寸及以下硅片占有一定比例，且下游应用主要为功率器件，可比性低
立昂微	立昂微	电子级硅片 2023 年收入占比约 56%，8 英寸及以下硅片占有一定比例，下游应用主要为功率器件，可比性低
山东有研艾斯	有研硅	上市公司有研硅不涉及 12 英寸硅片业务，山东有研艾斯为有研硅参股公司，无详细财务数据
上海超硅	不适用	未上市
中欣晶圆	不适用	未上市

3、发行人与同行业可比公司的比较情况

(1) 关键业务数据比较

公司名称	12 英寸硅片全球产能占比(注 1)	2023 年 12 英寸硅片月均出货量(万片)(注 2)	2024 年末总资产(亿元)	2024 年收入(亿元)	2024 年毛利率
SUMCO	21.65%	150-200	542.17	183.37	18.34%
环球晶圆	约 10%	80-100	500.59	139.97	31.62%
德国世创	约 10%	80-100	未披露	未披露	未披露
沪硅产业	6.70%	24	未披露	未披露	未披露
发行人	7.22%	32	174.22	21.11	5.49%

注 1：产能数据来源和占比测算逻辑与前文一致。

注 2：2023 年 12 英寸硅片月均出货量中 SUMCO、环球晶圆、德国世创数据根据 SEMI 报告中的总出货量和 TECHCET 报告中的 2022 年各家出货量占比估算，沪硅产业数据根据其 2023 年年报。

注 3：财务数据来源于各可比公司 2024 年年报，各家财年均与自然年度一致。

注 4：境外可比公司未单独披露 12 英寸硅片产品数据，因此境外可比公司选取营业收入和综合毛利率。2024 年发行人选取主营业务收入和主营业务毛利率列示。

注 5：汇率采用 Wind 金融终端的历史汇率，财务数据单位均为人民币。

(2) 产品技术实力

公司 12 英寸产品指标已与全球前五大厂商处于同一水平，代表性产品可应用于相对先进制程的存储芯片和逻辑芯片。比较选取以下 12 英寸硅片技术指标：

氧化诱生层错数量：硅片在热氧化处理后，通过湿法刻蚀放大后，形成的条状缺陷。此类缺陷的存在会引起后续制造芯片“短路”，数量越少，缺陷控制水

平越高，该指标主要取决于拉晶、抛光和清洗工艺。

翘曲度：硅片翘曲最高点与基准平面的垂直距离，是硅片整体弯曲程度的量化指标，数值越小，对芯片制造工艺精度的不利影响也越小，该指标主要取决于成型工艺。

总平坦度：硅片相对于理想的背面基准面的厚度偏差。该指标越小，硅片表面越平坦，质量越好，该指标主要取决于抛光工艺。

表面金属沾污（铜、铁、镍、锌等原子）：单位面积相应金属原子的数量，数量越少，硅片表面清洁度越高，主要取决于清洗工艺。

表面大于 26 纳米的光散射颗粒数量：表面大于 26 纳米的光散射颗粒数量主要表征抛光片的表面品质水平。该指标越小，表面光散射颗粒越少，硅片质量越好，该指标主要取决于拉晶、抛光和清洗工艺。

表面大于 200 纳米的光散射颗粒数量：表面大于 200 纳米的光散射颗粒数量主要表征外延片的表面品质水平，数量要求比抛光片对光散射颗粒尺寸要求更苛刻。表面光散射颗粒越少，硅片质量越好，该指标主要取决于外延工艺。

外延层电阻率均匀性：外延片正片专用测试指标。该指标越小，说明外延片电阻率分布更均匀，对晶圆制造的不利影响越小，主要取决于外延工艺。

公司 12 英寸硅片技术指标与国际同业和国内业界应用于先进制程存储和逻辑芯片的标准对比如下：

具体指标	单位	抛光片			外延片		
		公司代表性产品水平	同类型产品国际同业平均水平(注 1)	国内业界先进制程标准(注 2)	公司代表性产品水平	同类型产品国际同业平均水平	国内业界先进制程标准
氧化诱生层错数量	每平方米厘米数量	无	≤1	供需双方协商确定	0.17	≤1	供需双方协商确定
翘曲度	微米	7	≤7	≤18	7.9	≤10	≤10
总平坦度	微米	0.35	≤0.20	≤0.50	0.35	≤0.20	≤0.50
表面金属沾污（铜、	每平方米厘米	≤5E8	≤5E8	≤5E8	≤5E8	≤5E8	≤5E8

铁、镍、锌等原子)	米面积的原子数量						
表面大于 26 纳米的光散射颗粒数量	每片数量	5.8	≤30	≤30 (注 3)	不适用	不适用	不适用
表面大于 200 纳米的光散射颗粒数量	每片数量	不适用	不适用	不适用	0.7	≤1	≤1 (注 3)
外延层电阻率均匀性	%	不适用	不适用	不适用	0.9	≤3	≤4

注 1: 公司代表性产品及同类型产品国际同业平均水平的数据, 其中抛光片技术指标来自某国际头部存储 IDM 厂商出具的硅片供应商对标检测报告, 外延片技术指标来自客户 C 出具的供应商对标检测报告, 国际同业平均水平是各家国际同业检测指标区间结果取平均后的合并范围。

注 2: 国内业界先进制程标准团体标准水平数据来自中关村集成电路材料产业技术创新联盟出具的《先进存储工艺用 300mm p-型硅单晶抛光片团体标准》《集成电路线宽 65nm-14nm 逻辑工艺用 300mm P/P-型硅外延片团体标准》, 相应指标由国内主流晶圆厂和 12 英寸硅片厂商联合制定。其中抛光片技术指标为报告中可应用于先进制程 DRAM 和 NAND Flash 的数值范围, 外延片技术指标为报告中可应用于先进制程逻辑芯片的数值范围。

注 3: 抛光片的国内业界先进制程标准中标准为表面大于 37 纳米光散射颗粒数量, 外延片的国内业界先进制程标准中标准为表面大于 300 纳米光散射颗粒数量。

4、发行人主要竞争优势与竞争劣势

(1) 竞争优势

1) 清晰的战略规划及卓越的落地执行力

公司进入该领域之初就制定 2020 至 2035 年的 15 年长期战略规划, 致力于成为半导体硅材料领域全球头部企业。基于前述战略规划, 公司就技术研发、市场开拓、产能建设等多个方面提前布局。技术研发方面, 公司基于拉晶、成型、抛光、清洗和外延五大核心工艺组建全球研发团队, 并在完成全球前五大厂商近 30 年硅片专利检讨的基础上, 制定差异化的技术路线和知识产权布局战略; 市场开拓方面, 公司进入该领域初期即确定了“立足国内需求, 放眼全球市场, 服务全球客户”战略, 不同国家和地区客户由指定团队覆盖, 工厂建设初期即与客户直接沟通, 调研客户的需求制定匹配的客户导入方案; 产能建设方面, 基于半导体产业运营经验, 在设备选型方面对标全球前五大厂商同型号工艺设备, 并提前与西安理工大学合作, 孵化具有自主知识产权的拉晶设备。

截至本招股书签署日, 公司第一工厂已达产, 第二工厂已正式投产。基于截至 2024 年末产能和 2024 年月均出货量统计, 公司均为中国大陆第一, 全球第六的 12 英寸硅片厂商。2020 至 2023 第一阶段“挑战者”目标如期达成, 彰显了公司在清晰战略规划下具备卓越的落地执行力。

2) 优秀的技术创新能力和领先的产品品质

公司坚持“以技术为基石”的核心价值观，持续比照全球前五大厂商技术标准，不断自主研发，提升自身产品的技术水平和工艺能力。目前，公司已形成拉晶、成型、抛光、清洗和外延五大工艺环节的核心技术体系，具有自己的 IP 和 Know-How 等知识产权，产品的缺陷控制能力、低翘曲和超平坦的几何形貌、颗粒和金属原子的超清洁度和外延层性能等核心指标已与全球五大厂商处于同一水平。公司正片已量产用于国内先进制程逻辑芯片、先进际代 DRAM 和 2YY 层 NAND Flash，更先进制程应用的硅片产品正在客户端正片验证。同时在 CIS 芯片等细分领域已形成了具有独特技术优势的产品，相关产品已批量出货。

此外，公司对现有研发体系不断完善，不断推进研发体系的数字化和平台化，逐步形成具有共性的多个标准化研发平台，从而大幅提升研发效率，加快产品技术迭代。

3) 具有国内最大的产能规模，国内一线晶圆厂客户几乎全覆盖，国际战略级客户持续导入

一定的产能规模是全球战略级客户导入的前提，是保障上游电子级多晶硅等核心原材料稳定供应的基础，也是最大化规模效应，实现公司长期战略规划的必要手段。公司将持续缩短与全球五大厂商的产能差距，持续保持相对国内友商的产能优势，稳步推进产能扩张。

产能扩张的前提是市场开拓的匹配和客户订单的消化。截至 2024 年末，公司已通过验证的客户累计 144 家，其中中国大陆客户 108 家，中国台湾及境外客户 36 家；已通过验证的测试片超过 390 款，量产正片超过 90 款，其中中国大陆客户正片已量产 80 余款，中国台湾及境外客户正片已量产近 10 款。目前，公司实现了国内一线晶圆代工厂和存储 IDM 厂大多数主流量产工艺平台的正片供货，已成为国内主流存储 IDM 厂商全球 12 英寸硅片厂商中供货量第一或第二大的供应商，已成为国内一线逻辑晶圆代工厂中国大陆 12 英寸硅片供应商中供货量第一或第二大的供应商，已成为目前国内新建 12 英寸晶圆厂的首选硅片供应商之一。正片已进入客户 D、客户 O、客户 P 等全球战略级客户，测试片几乎覆盖了全球所有一线晶圆厂客户。由于 12 英寸硅片行业认证周期长，具有较

高的客户粘性，公司的客户数量和与客户的稳定合作关系，是持续产能扩张的坚实基础。

4) 一流的供应链保障能力，积极推进供应商国产化

基于公司团队半导体产业链资源和影响力，发行人已与境外全球核心原材料供应商建立了稳定的合作关系，已经与部分原厂供应商通过长期协议锁定了长期稳定供应。同时，公司也与全球顶级半导体设备商建立长期战略合作关系，确保后续扩产的设备供应。

公司持续培育本土化 12 英寸硅片装备和材料的供应商，推动上游供应链多元化，是陕西省工业和信息化厅确定的“第一批陕西省重点产业链‘链主’企业”。目前无论从上游原材料（包括耗材），还是工艺设备，公司通过合作开发不断提升本土化供应商的量产供应的比例，特别是晶体生长、硅片抛、量测等部分核心设备、超导磁场和热场等部分关键设备的核心零部件也已实现本土供应商配套。随着公司上市融资，第二工厂将进一步推动本土化设备和材料的突破全面提升国内电子级硅片产业链的竞争力。

5) 经验丰富的技术和管理团队，完备的团队管理体系

公司拥有一支成功运营半导体产业的优秀管理团队，具备一流的战略运筹、市场开拓、技术研发和运营管理能力。公司核心管理团队具有丰富的重资产半导体产业成功运营经验，在工厂建设、工艺提升、质量管理、自动化布局等方面具有深厚的产业运营经验。公司的研发团队由海内外具有丰富电子级硅片成功量产经验的专家团队组成，相关人员在五大核心工艺环节均拥有深厚的技术背景及成熟量产经验。

公司充分重视人才培养及技术团队梯次化配置，具有完备的团队人才管理体系，在设立之初即开展人才培养出储备工作，持续提升公司的技术人才储备纵深。截至 2024 年末，公司共有 1,941 人，其中 30 岁以下员工占比约 80%，40 岁以下员工占比约 96%，在技术和管理核心团队带动下，年轻员工快速成长，迅速进入核心研发及运营岗位。

(2) 竞争劣势

1) 行业已形成寡头垄断，公司作为新进入者先天后发劣势

作为新进入“挑战者”，与全球前五大厂商相比，公司在产能规模、产品丰富度、产品制程先进性和客户议价能力等方面存在一定差距。尤其是全球前五大厂商开展 12 英寸硅片业务大多早于公司 15 年以上，无论是下游台积电、三星电子等全球战略级晶圆厂客户，还是上游电子级多晶硅、石英制品和硅片工艺设备等核心设备和材料供应商，均已形成稳定合作（包括但不限于签订确保最低采购量的长期协议、优先参与客户更先进制程晶圆工艺的研发等），甚至是控股或参股的投资关系。同时，国际同业对硅晶体的基础理论研究、晶体生长和硅片加工具有深厚的技术底蕴，建立了森严的专利技术壁垒，具有技术先发优势。此外，相应厂商前期高额的设备投入部分已折旧完毕，固定成本压力小，生产工艺相对成熟，良率相对稳定，已实现一定规模效应，具有较好的盈利能力。

2) 融资渠道受限

半导体硅片行业属于资金密集型行业，设备、原材料采购等需要大量的资金。近年来，随着公司经营规模快速扩张，资金不足已成为制约公司发展的主要瓶颈之一，扩大生产迫切需要资金的支持。

（五）盈利能力或财务状况的主要影响因素分析

1、行业景气度波动对公司盈利能力的影响

公司所处 12 英寸硅片行业与整体半导体行业景气度及终端消费市场密切相关。自 2020 年起，受下游智能手机、物联网、汽车电子等新应用需求强劲影响，行业景气度旺盛。2022 年下半年起，受终端消费电子需求放缓及国际摩擦加剧，行业景气度反转，2023 年全球半导体销售额和 12 英寸硅片出货面积均同比大幅下滑。根据 WSTS 和 SEMI 预测，随着终端消费市场回暖和人工智能等新应用驱动，逻辑和存储芯片将带动全球半导体市场 2024 年反弹，但鉴于 12 英寸硅片处于产业链最上游，下游晶圆厂需要一定时间消化前期原材料库存，预计 12 英寸硅片的反弹将略滞后于半导体市场。截至本招股书签署日，随着晶圆代工厂产能利用率在 2024 年二季度开始回升，2024 年三季度开始，12 英寸硅片行业出货面积已有回升。

行业	项目	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年
全球半导体 销售额	金额(亿美元)	6,269	5,269	5,741	5,559	4,404
	同比变动率	18.98%	-8.22%	3.27%	26.23%	-
12英寸硅片 出货面积	面积(亿平方英寸)	93	91	102	96	85
	同比变动率	1.80%	-10.65%	6.24%	12.84%	-

数据来源: WSTS、SEMI

2、国际贸易摩擦带来的机遇大于挑战

基于国内产业发展需求和产业政策支持,国内晶圆厂均制定了大规模的长期资本开支计划。根据 SEMI 统计,截至 **2024 年末**,中国大陆有 **62 座 12 英寸**晶圆厂量产(包含西安三星、无锡 SK 海力士、南京台积电等外资晶圆厂),预计 2026 年中国大陆地区 12 英寸晶圆厂量产数量将超过 70 座,相应产能将达到 **321 万片/月**,占届时全球 12 英寸晶圆厂产能的 1/3,其中以中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储为代表的全部内资 12 英寸晶圆厂产能将提升至约 **250 万片/月**。随着国际贸易摩擦不断加剧,半导体材料国产化成为行业主流。在此背景下,报告期内公司中国大陆客户收入高速增长,成为产能消化的基本盘。

基于目前国际贸易形势和后续景气度回升预期,为保证供应链稳定,发行人对于国产化率较低电子级多晶硅等核心原材料提前长协锁定采购,战略储备。

3、12 英寸硅片行业为重资产运营模式,高昂固定成本的消化不仅需要销量提升,而且需要持续技术投入优化产品结构

12 英寸硅片行业投资强度大,固定成本消化是实现盈利的最大挑战。1) 需要尽快实现产能满产满销,考虑客户认证周期长,需要提前布局市场和销售团队,加快客户导入,提升客户数量,由价格较低的测试片量产向价格较高的正片和高端测试片量产过渡,这导致初期由于送样和频繁客户沟通等,销售费用占比较高; 2) 公司需要不断提升技术力,根据客户需求增加产品丰富度,持续优化投入产出比和良率水平,同时通过积极多元化原材料、设备供应商,不断优化成本结构,这导致公司始终保持研发强度,同时大量研发项目往往依赖于产线和工艺研发人员; 3) 抛光片主要应用于存储芯片,客户集中,产品规格相对较少,且下游需求变动对存储 IDM 厂商影响具有滞后性,正片认证通过,容易相对快速形成规

模效应，保证产能利用率。但消化固定成本，更需要不断提升附加值更高、单价更高的外延片收入占比，其主要客户均为逻辑晶圆代工厂，下游需求直接影响其产能利用率。同时，外延片技术规格严苛，认证周期更长，从而外延片收入占比的提升，尤其在行业尚未完全回暖的阶段，相对缓慢，需要一定过程。

三、发行人主要产品销售情况和主要客户

(一) 主要产品的生产情况

报告期内，随着公司不断提升效能，产能持续保持增长。2023年6月，公司第一工厂50万片/月产能实现达产。截至2024年末，通过技术革新和效能提升，公司已将第一工厂50万片/月产能提升至**62万片/月**，同时**第二工厂产能爬坡已到达8万片/月**。报告期各期，公司产能、产量和销量情况如下：

单位：万片

年度	期末产能 (万片/月)	期间产能	当期产量	产能利用率	当期销量	产销率
2024年	71.22	696.43	643.21	92.36%	625.46	97.24%
2023年	50.00	572.61	417.55	72.92%	379.47	90.88%
2022年	41.45	318.31	260.10	81.71%	234.62	90.20%

注1：期末产能为报告期各期最后一个月公司月产能，期间产能为当期各月理论产能加总数。

注2：公司产品包括抛光片、外延片和测试片。不同种类产品除外延工艺段外的工艺流程基本一致，公司根据客户订单，在同一产线调配不同种类产品产能，不同产品产能并未区分。

注3：上表数据均为合并口径数据，包含第一工厂和第二工厂。

注4：上表中产能为公司已充分考虑良率损耗后的有效产能。

报告期内，虽然产能持续扩张，公司始终保持90%以上产销率，体现了公司的生产管理、技术研发和市场开拓良好匹配了产能扩张节奏。

(二) 主要产品的销售情况

1、销售收入及产品均价

报告期内，公司各类产品的销售收入、平均单价、销量情况详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“八、（一）营业收入分析”。

2、报告期各销售模式规模及占比

报告期各期，公司95%以上主营业务收入为直销。具体如下：

单位：万元、%

渠道	2024年		2023年		2022年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销模式	205,293.52	97.26	140,526.58	96.23	99,848.96	97.06
—终端客户	189,298.13	89.68	125,638.57	86.04	91,385.32	88.83
—卖断贸易商	15,995.39	7.58	14,888.02	10.20	8,463.64	8.23
代销模式	5,793.75	2.74	5,504.87	3.77	3,023.75	2.94
合计	211,087.28	100.00	146,031.45	100.00	102,872.70	100.00

(三) 报告期内主要客户情况

报告期内,公司前五大客户以中国大陆晶圆代工厂商和存储IDM厂商为主。报告期各期,由于下游晶圆厂行业集中度高,公司前五大客户营业收入占比始终在60%以上,具有商业合理性。

报告期内,公司不存在向单个客户销售比例超过营业收入50%的情形。公司与报告期内前五大客户均不存在关联关系。报告期内,公司前五大客户(合并口径)均为直销,具体销售情况如下:

单位：万元

期间	客户名称	营业收入	客户类别	销售内容	营业收入占比
2024年	客户B	38,184.24	存储IDM、 晶圆代工	抛光片、外延片、测试片	18.00%
	客户C	33,456.17	晶圆代工	抛光片、外延片、测试片	15.77%
	客户A	32,852.63	存储IDM	抛光片、外延片、测试片	15.49%
	客户D	16,696.43	晶圆代工	测试片	7.87%
	晶合集成	10,870.57	晶圆代工	抛光片、外延片、测试片	5.12%
	总计	132,060.05	-	-	62.25%
2023年	客户B	33,139.58	存储IDM、 晶圆代工	抛光片、外延片、测试片	22.49%

	客户 A	32,212.85	存储 IDM	抛光片、外延片、测试片	21.86%
	客户 D	16,654.66	晶圆代工	测试片、外延片	11.30%
	客户 C	13,800.30	晶圆代工	抛光片、外延片、测试片	9.36%
	晶合集成	6,968.43	晶圆代工	抛光片、外延片、测试片	4.73%
	总计	102,775.81	-	-	69.74%
2022 年	客户 A	21,534.67	存储 IDM	抛光片、测试片	20.42%
	客户 B	21,355.78	存储 IDM、晶圆代工	抛光片、外延片、测试片	20.25%
	客户 C	13,956.73	晶圆代工	抛光片、外延片、测试片	13.23%
	华虹集团	11,585.16	晶圆代工	抛光片、外延片、测试片	10.98%
	客户 D	6,875.90	晶圆代工	测试片、外延片	6.52%
	总计	75,308.24	-	-	71.40%

四、发行人采购情况和主要供应商

(一) 报告期内采购情况

1、主要原材料采购情况

类别	具体内容
电子级多晶硅	电子级多晶硅大块、电子级多晶硅颗粒
化学试剂	抛光液、切割冷却液、湿电子化学品、活性添加剂等
包装材料	晶圆运输盒、包装箱等
石英制品	石英坩埚、石英管等
切磨抛耗材	碳化硅粉、研磨粉等
其他	电子气体、切割钢线、籽晶、掺杂剂、备品备件等

公司主要原材料的采购类别及结构与可比公司基本一致。具体如下：

单位：万元、%

项目	2024 年		2023 年		2022 年	
	采购额	占比	采购额	占比	采购额	占比
电子级多晶硅	36,538.47	39.06	32,954.15	41.31	26,866.24	41.18
化学试剂	15,074.44	16.11	11,913.20	14.93	11,787.72	18.07
包装材料	14,870.13	15.90	11,315.80	14.19	7,642.97	11.72
石英制品	14,362.67	15.35	13,310.15	16.69	9,567.20	14.67
切磨抛耗材	7,506.38	8.02	6,569.88	8.24	5,816.62	8.92
其他	5,200.13	5.56	3,704.00	4.64	3,555.59	5.45
总计	93,552.22	100.00	79,767.18	100.00	65,236.35	100.00

2、报告期内主要原材料采购价格变动情况

报告期内，假设 2022 年采购价格指数为 100.00，后续各期采购价格指数以 2022 年采购价格指数为基数进行计算的主要品类原材料采购价格指数如下：

采购项目	2024 年	2023 年	2022 年
电子级多晶硅	93.30	106.58	100.00
石英制品	105.57	106.27	100.00
化学试剂	94.70	101.45	100.00
包装材料	96.68	101.47	100.00
切磨抛耗材	81.48	101.76	100.00

电子级多晶硅：报告期内采购占比最大，采购单价为全部供应商全部品类电子级多晶硅的均值。2023 年部分原厂供应商基于成本上涨和自身产能有限提价，带动当年整体采购单价上升；2024 年随着电子级多晶硅供应商进一步多元化，采购单价同比下降。

石英制品：由于尺寸、品类、性能和规格存在差异，采购大类平均单价不可比，取石英制品中采购占比最大的石英坩埚统计采购单价。2023 年海外供应商基于 2022 年石英坩埚上游高纯石英砂涨价，2022 年末提升 2023 年全年报价，带动全年采购单价同比上升；2024 年随着石英坩埚供应商进一步多元化提升以

及高纯石英砂价格企稳，采购单价略有下降。

化学试剂：与石英制品类似，采购大类平均单价不可比，选取化学试剂中采购占比大的抛光液统计采购单价。报告期内随着公司采购量不断增加，供应商不断多元化，发行人议价能力提升，**2024年采购单价同比下降。**

包装材料：与石英制品类似，采购大类平均单价不可比，选取包装材料中采购占比较大的晶圆运输盒统计采购单价。发行人通过多元化货源等方式实施降本，**2024年采购单价同比下降。**

切磨抛耗材：与石英制品类似，采购大类平均单价不可比，选取切磨抛耗材中采购占比较高的碳化硅粉统计采购单价。**2022年与2023年**，由于碳化硅粉上游原料涨价，采购单价维持高位；**2024年**，随着上游原料价格下降，采购单价同比大幅下滑。

2、主要能源采购情况

报告期内，公司生产所需能源主要为电力和水，供应稳定。随着公司产能产量攀升，能源采购量逐年攀升，采购单价均为当地基础能源价格。公司第一工厂已分批取得《西安高新区行政审批服务局关于西安奕斯伟硅产业基地项目节能评估报告的批复》（西高新审批发[2018]28号）、《陕西省发展和改革委员会关于奕斯伟硅产业基地项目一期二阶段节能报告的审查意见》（陕发改环资[2021]1951号）、《西安高新区行政审批服务局关于西安奕斯伟硅产业基地公用辅助设施项目节能报告审查意见》（西高新审批发[2023]67号）、《陕西省发展和改革委员会关于西安奕斯伟硅产业基地一期三阶段项目节能报告的审查意见》（陕发改环资[2024]299号），第二工厂已取得《陕西省发展和改革委员会关于西安奕斯伟硅产业基地二期项目节能报告的审查意见》（陕发改环资[2024]266号）。

类型	项目	2024年	2023年	2022年
水	金额（万元）	2,367.65	1,723.68	1,319.35
	采购量（万立方米）	415.54	302.90	231.87
	采购单价（元/立方米）	5.70	5.69	5.69

电	金额(万元)	16,045.58	12,372.64	7,807.84
	采购量(万度)	31,776.19	22,968.96	14,494.72
	采购单价(元/度)	0.50	0.54	0.54

(二) 前五名供应商的采购情况

报告期内,公司不断多元化供应商,尤其是积极培育本土供应商,本土供应商采购占比整体呈现上升趋势。

报告期内,公司部分前五大供应商为贸易商,主要是原厂供应商基于当地行业惯例,选择长期合作的指定贸易商向发行人出口。

报告期内,公司不存在向单个供应商采购比例超过采购总额 50%的情形。公司与前五大供应商之间不存在关联关系。报告期内,公司前五大供应商(合并口径)采购情况如下:

单位:万元

年度	供应商名称	采购金额	供应商类别	采购内容	采购占比
2024年	鑫华半导体	18,707.88	原厂	电子级多晶硅	20.00%
	供应商 A	17,830.59	原厂	电子级多晶硅	19.06%
	供应商 N	8,749.14	贸易商	包装材料	9.35%
	供应商 D	5,749.53	原厂	石英制品	6.15%
	赛米芯技术	5,722.73	贸易商	切磨抛耗材	6.12%
	总计	56,759.87	-	-	60.67%
2023年	供应商 A	19,975.55	原厂	电子级多晶硅	25.04%
	供应商 O	8,564.35	贸易商	电子级多晶硅、化学试剂、切磨抛耗材等	10.74%
	鑫华半导体	6,740.74	原厂	电子级多晶硅	8.45%
	供应商 N	5,804.08	贸易商	包装材料	7.28%
	供应商 B	3,816.99	原厂	石英制品	4.79%
	总计	44,901.71	-	-	56.29%
2022年	供应商 A	16,689.98	原厂	电子级多晶硅	25.58%
	供应商 O	10,286.57	贸易商	电子级多晶硅、化学试剂	15.77%

				剂、切磨抛耗材等	
	鑫华半导体	4,157.21	原厂	电子级多晶硅	6.37%
	供应商 C	3,818.08	原厂	化学试剂	5.85%
	连云港众成	2,929.62	原厂	切磨抛耗材	4.49%
	总计	37,881.45	-	-	58.07%

五、发行人的主要固定资产及无形资产情况

(一) 固定资产

1、整体情况

12 英寸硅片单位产能投资强度在半导体制造产业链中仅次于晶圆厂，公司第一工厂总投资规模 110 亿元，其中约 80%为机器设备支出。截至 2024 年末，公司固定资产以机器设备为主。具体如下：

单位：万元

类别	原值	原值占比	账面价值	成新率
机器设备	1,064,918.26	83.28%	848,842.87	79.71%
房屋建筑物	192,008.65	15.02%	183,132.77	95.38%
办公设备及其他	21,670.36	1.69%	6,066.13	27.99%
运输工具	75.28	0.01%	-	不适用
合计	1,278,672.56	100.00%	1,038,041.77	81.18%

2、房屋建筑物

(1) 自有房屋及建筑物情况

截至本招股说明书签署日，公司及其子公司自有房屋及建筑物共计 28 项，均已取得不动产权证书，其中 12 项为抵押状态。具体情况详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件三：发行人及其子公司拥有或使用的房屋及建筑物清单”。

(2) 租赁房屋及建筑物情况

截至 2024 年末，公司及其子公司租赁房产共计 15 项，8 项为宿舍、5 项为办公、1 项用于奕斯伟材料日本注册地址、1 项为仓库。截至本招股说明书签署

日，其中 1 项房产未办理租赁合同备案，存在数额较低的罚款风险，已由直接控股股东奕斯伟集团提供兜底保障。具体情况详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件三：发行人及其子公司拥有或使用的房屋及建筑物清单”。

公司租用关联方西安奕斯伟产业公司部分房屋作为员工宿舍、临时仓库等，关联租赁具体详见本招股说明书“第八节公司治理与独立性”之“七、（三）报告期内关联交易情况”。

（二）无形资产

1、整体情况

截至 2024 年末，公司无形资产主要为土地使用权，具体如下：

单位：万元

项目	金额	占无形资产原值比例
土地使用权	16,155.24	60.74%
计算机软件及其他	10,440.88	39.26%
原值合计	26,596.12	100.00%
累计摊销	3,743.82	14.08%
减值准备	-	-
账面价值合计	22,852.30	85.92%

2、拥有的土地使用权

截至 2024 年末，发行人及其下属子公司拥有土地使用权 2 处，均为工业用地，具体如下：

权利人	证书号码	坐落	具体用途	终止日期	土地使用权面积 (m ²)	他项权利
奕斯伟硅片	陕(2022)西安市不动产权第 0540416 号	西安高新区西沣南路以西	第一工厂	2068.10.14	248,726.20	抵押
欣芯材料	陕(2024)西安市不动产权第 0365410 号	西安高新区盛丰路以北	第二工厂	2068.10.14	111,148.40	-

注：以上涉及的土地使用权抵押，所担保的债权均为发行人及其下属子公司的银行贷款债权

3、商标

截至**2024年末**，发行人及其子公司在中国境内未拥有自有注册商标。根据奕斯伟集团与发行人于**2024年1月18日**签订的《商标使用许可协议》（以下简称“协议”）和**2024年9月19日**签订的《商标使用权协议》之补充协议，奕斯伟集团许可发行人及其直接或间接控制的子公司、直接或者间接控制的其他任何实体自“协议”签署生效之日起在电子级硅片领域使用上述注册商标许可。对于在“协议”生效前核准注册或许可方受让的许可商标，许可期限向前追溯至奕斯伟集团享有许可商标的商标专用权之日，至“协议”有效期终止。对于在“协议”有效期内获准注册的许可商标，许可期限自许可商标获准注册之日起至“协议”有效期终止。“协议”有效期为“协议”签署生效之日起五年，到期后“协议”自动续期五年。

截至**2024年末**，发行人被许可使用**116**项注册商标，其中被许可使用**94**项境内商标，**22**项中国台湾及境外商标，上述**116**项注册商标具体情况详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件四：发行人及其子公司拥有或使用的商标清单”。

4、专利

截至**2024年末**，发行人及其子公司合计已申请境内外专利**1,635**项，已达到全球前五大厂商门槛水平，已获授权专利**746**项，中国大陆专利**484**项，中国台湾及境外专利**262**项，均衡分布在五大工艺领域。已获授权专利中，发明专利**539**项，占全部已获授权专利的**72.25%**。具体情况详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件五：发行人及其子公司拥有的专利权清单”。

5、软件著作权

截至**2024年末**，发行人及其子公司拥有的计算机软件著作权共计**4**项，具体情况详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件六：发行人及其子公司拥有的软件著作权清单”。

6、域名

截至**2024年末**，发行人及其子公司拥有域名**1**个，具体情况如下：

序号	所有者	网站域名	网站备案/许可证号	注册日期
1	奕斯伟材料	eswinsi.com	陕 ICP 备 2023001178 号-1	2019 年 7 月 17 日

(三) 业务许可或资质

截至**2024年末**，发行人及其子公司具备开展经营业务所需的全部资质许可，具体详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件七：发行人及其子公司拥有的业务许可或资质清单”。

六、截至本招股说明书签署日，发行人不存在特许经营情况

七、发行人核心技术及研发情况

(一) 核心技术情况

1、核心技术先进性和具体表征

公司核心技术覆盖 12 英寸硅片生产的所有工艺环节，基于外购和自研的工艺设备已形成独立自主的包括 IP、专利、Know-How 的技术路线和技术体系，目前已达到国际同业同等水平，均有专利和技术秘密保护。具体如下：

核心技术名称	技术来源	应用的工艺环节	所处阶段	已授权发明专利数量	技术先进性
无缺陷晶体生长技术等	自主研发	拉晶工艺	量产	143	国际同业同等水平
翘曲和弯曲控制技术等		成型工艺		104	
硅片表面平坦度控制技术等		抛光工艺		85	
表面污染控制技术等		清洗工艺		58	
外延设备基座、反应腔室改善设计等		外延工艺		56	

(1) 无缺陷晶体生长技术

晶体的原子排列缺陷会影响芯片的栅氧化层，导致芯片出现短路失效，尤其是用于 NAND Flash 和 DRAM 等存储芯片制造的抛光片产品，由于缺少外延层掩瑕，原生晶体的无缺陷是其核心品质要求。公司无缺陷晶体生长技术是指通过自主设计的热场和自主研发的拉晶工艺，使得生长出的晶体原生缺陷尺寸控制在

10 纳米以内，最终硅片的氧化诱生层错数量控制在每平方厘米 1 个以内。

公司无缺陷晶体生长技术具体包含：1) 建立晶体生长理论模型，模拟晶体生长过程的熔体对流，热量和杂质的输运，计算不同工艺下杂质和缺陷的分布，为拉晶设备热场设计及工艺调试提供理论支持；2) 自主设计拉晶设备的热场，优化晶体生长涉及的固液界面形状、扩充无缺陷晶体生长的工艺窗口，提升晶体含氧量分布的均一性；3) 优化拉晶控制系统，通过优化籽晶转速、晶棒拉速、生长温度反馈等多个参数的控制精度，提升晶体生长的工艺控制水平；4) 建立多种检测方式结合的晶体缺陷综合评价体系，可实现在晶棒段的硅片全口径缺陷分析，为持续提升无缺陷晶体占比提供快速评价依据。

(2) 翘曲和弯曲控制技术

硅片的几何形貌是影响芯片制程的关键指标，代表性量化指标为硅片的翘曲度(表征硅片不同区域的最大翘曲程度)和弯曲度(表征硅片整体的弯曲程度)。随着芯片制程升级以及 3D 结构的堆叠层数增加，对硅片几何形貌要求越来越高，硅片加工的成型和抛光工艺决定了硅片的几何形貌。

发行人的翘曲和弯曲控制技术包含：1) 多线切割工艺技术：通过对不同结构切割线和不同粒型粒径砂浆的配比，结合切割线的张力调控、进给/送线速度调控及切割液流量等工艺参数的调控，提升硅片切割形貌；2) 研磨工艺技术：通过调试研磨定盘的转速，精准控制研磨压力，调整研磨颗粒和砂浆的配比，控制硅片与定盘及载具间的摩擦应力，降低研磨损伤，优化硅片纳米形貌；3) 抛光工艺：通过对定盘、抛光垫和硅片之间的间隙微调以及定盘的温度和形貌的调试，优化抛光浆料的配比和硅片的去除量，提升硅片的几何形貌。

目前公司基于翘曲度的控制技术，可实现抛光片翘曲度不超过 7 微米、外延片翘曲度不超过 8 微米，和国际同行处于相同水平。

(3) 硅片表面平坦度控制技术

硅片平坦度包含全局平坦度、局域平坦度和纳米形貌，各参数分别从全局和局域定义了硅片表面平坦度的水平，是衡量硅片品质的核心参数之一。硅片全局和局域越平坦，越能满足芯片先进制程的要求。

公司采用三步抛光工艺控制硅片表面平坦度：**1) 双面抛光**：调整抛光垫材质和抛光浆料的配比，调整最佳的硅片抛光形貌，优化硅片表面平坦度。同时，对双面抛光设备实施硅片自动化传输接口改造，提升了生产效率；**2) 边缘抛光**：以液态化学品与硅片边缘进行化学反应，通过抛光垫和抛光浆料物理机械作用调整硅片边缘形貌，去除前段工艺发生的边缘损伤，降低破片比例；**3) 最终抛光**：决定硅片平坦度最核心的步骤。公司通过最终抛光工艺技术可进一步控制硅片表面平坦度、局部平坦度及纳米形貌。此外，通过与设备供应商共同研发，将最终抛光设备与下一步清洗设备实现互连，提升了硅片洁净度和自动化效率。

目前公司基于硅片表面平坦度控制技术，可实现抛光片和外延片产品平坦度均低于 0.35 微米水平，领先于国内同行。

(4) 表面污染控制技术

随着芯片制程的不断升级，对硅片的洁净度提升到近乎苛刻的程度，硅片表面在生产中附带的金属、有机物等颗粒需要控制在极低的水平，否则将严重影响下游晶圆厂的生产良率。

公司表面污染控制技术包含：**1) 金属评价**：利用多种检测方式对表面金属、体金属检测，大部分金属最低检测极限可达到每平方厘米内 $1E6$ 个原子数量；**2) 清洗技术**：实施清洗设备调试和清洗化学液体配比，通过预清洗、最终清洗两步清洗，结合清洗后的金属检测工序可达到先进制程所要求的超洁净抛光片；**3) 流程管控技术**：为防止清洗后硅片的二次污染，在洁净间管控（采用业界最高的 10 级洁净间）、设备供给系统的过滤、杂质监控和工艺流程上都进行了指标跟踪和优化，确保硅片表面品质。

目前，公司针对整体硅片污染的管控可达到万亿分之一的级别，对先进制程要求的 16 种表面金属原子，抛光片和外延片表面均可控制在每平方厘米硅片仅有 $5E8$ 个原子以内，和国际同行处于相同水平。表面大于 200 纳米散射颗粒数量外延片可做到平均每片不高于 0.7 个，表面大于 26 纳米的散射颗粒数量抛光片可做到平均每片不高于 5.8 个，和国际同行处于相同水平。

(5) 外延设备基座、反应腔室改善设计

公司外延片主要用于逻辑芯片。相比抛光片，外延片除了对硅片平坦度、洁净度有更高要求，也对外延层厚度、电阻率的均匀性、边缘形貌和纳米形貌有特殊要求。

公司在现有外延设备基础上，自主设计并开发了适用于先进制程的外延设备基座、反应腔等核心部件，结合相匹配的外延层生长工艺，优化外延层的电阻率均匀性、厚度均匀性，提升外延层片的边缘形貌和纳米形貌。

目前公司外延片外延层电阻率均匀性可低于 1%，和国际同行处于相同水平。

2、核心技术在主营业务及产品中的应用及核心技术产品收入占比

报告期内，核心技术产品收入占营业收入比例均超过 97%，具体如下：

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	2022 年
核心技术产品收入	211,087.28	146,031.45	102,872.70
营业收入	212,145.26	147,376.14	105,469.31
核心技术产品收入占比	99.50%	99.09%	97.54%

(二) 科研实力和成果情况

1、主要荣誉、奖项以及资质

获得时间	颁发部门	荣誉名称
2020 年	西安市科学技术局、西安市外国专家局	西安市国际科技合作基地(I 型)先进硅材料国家联合研究中心
2020 年	陕西省科学技术厅	国家级高新技术企业
2022 年	陕西省人民政府	陕西省技术发明一等奖
2022 年	陕西省工业和信息化厅	第一批陕西省重点产业链“链主”企业
2022 年	国家知识产权局	国家级知识产权优势企业
2022 年	西安市发展和改革委员会	西安市工程研究中心
2023 年	工信部	国家级绿色工厂
2023 年	科技部	国家引才引智示范基地

2024 年	陕西省工业和信息化厅	陕西省制造业单项冠军示范企业
--------	------------	----------------

2、重大科研项目

2020 年，发行人主持陕西省科技重大专项课题项目“省科技重大专项定向委托：12 英寸单晶硅片生产设备及制造工艺”，该课题项目共包含两个子课题，“子课题 1：12 英寸电子级硅单晶炉性能优化”由奕斯伟设备承担实施，“子课题 2：12 英寸高端抛光硅片及成套工艺技术开发”由奕斯伟硅片承担实施。

3、在研项目情况

截至本招股说明书签署日，公司正在从事的对目前或未来经营有重大影响的研发项目、进展情况及拟达到目标如下：

序号	项目名称	进展情况	拟达到目标
1	CIS 芯片外延重掺片开发项目	试生产	1、进一步提升 12 英寸重掺外延片吸杂效果，提升重掺硅片几何形貌，提升产品在客户端的应用； 2、技术指标：硅片氧沉淀含量提高 10 倍以上，弯曲度、翘曲度优化 20%，金属含量降低 10%； 3、满足 CIS 芯片用重掺外延硅片需求，技术达到国内先进水准
2	功率器件用抛光片开发项目	试生产	1、技术指标：晶棒电阻率、晶体原生缺陷、氧含量等技术指标优化 20%以上，达到下游客户要求 2、该项目致力于开发应用于 IGBT 器件需求的高性能 12 英寸抛光片量产技术
3	基于熔炉对流模型的三维开发项目	测试验证	1、开发三维熔体对流模型，引入磁场调控因子，预测晶体生长实验结果，降低研发成本，缩短研发周期 2、形成匹配公司生产工艺的热传热和热对流模型、杂质输运模型等，技术达到国内领先水平
4	轴向均匀性无缺陷晶棒开发项目	测试验证	1、技术指标：氧含量、轴向氧变化、晶体缺陷等技术指标降低 10%以上，优化产品在客户端的应用 2、通过控制径向氧含量分布，开发满足先进制程存储芯片所需的高端硅片，达到国际先进水平
5	N 型单晶技术开发项目	测试验证	1、技术指标：N 型重掺技术开发，达到细分领域产品要求 2、该项目通过掺杂装置的设计与工艺开发，开发出符合目标电阻率的重掺 N 型长晶量产技术，达到国内先进水平

4、研发投入情况

报告期内，公司研发投入分别为 14,599.00 万元、17,142.25 万元和 25,882.00 万元，占各期营业收入的比例分别为 13.84%、11.63%和 12.20%。

5、合作研发情况

发行人历史控股子公司奕斯伟设备与西安理工大学进行合作研发 12 英寸拉晶设备，2021 年 7 月已结项，报告期内，相应设备已在公司产线大比例量产使用。具体如下：

合作研发项目名称	陕西省重点产业链“卡脖子”补短板关键核心技术产业化“揭榜挂帅”项目——“高稳定 12 英寸电子级硅单晶炉关键技术”
合作研发的内容	奕斯伟设备负责高稳定 12 英寸电子级硅单晶炉本体优化设计及加工、系统功能测试、晶体生长控制开发；西安理工大学负责单晶炉先进控制系统及关键变量检测单元软件开发与设计
合作研发的成果分配	1、西安理工大学完成软件开发并可以正常运行后，向奕斯伟设备交付可运行的软件，包括源代码、系统技术文档、数据等所有成果； 2、项目执行过程中形成的全部技术成果及其知识产权归奕斯伟设备单独所有

根据发行人与奕斯伟设备 2021 年签订的《专利战略合作框架协议》（以下简称“协议”），约定：在发行人控制奕斯伟设备的前提下，奕斯伟设备在“协议”生效日及之后提出的国内外专利申请以及优先权日在“协议”生效日之前，但申请日在“协议”生效日及之后的国内外专利申请，对应的专利申请权及相应的专利权归双方共同所有。

截至本招股说明书签署日，奕斯伟设备已不再纳入发行人合并报表范围，具体详见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“四、（四）2023 年 6 月，发行人以所持奕斯伟设备 75%股权认购芯晖装备股权”，发行人与奕斯伟设备存续的共有专利为 32 项。根据《换股收购协议》约定：本次交易交割后，1）奕斯伟设备需优先保证满足发行人设备供应，需优先满足发行人的定制需求；2）同等条件下，需保证给予发行人最优惠设备价格；3）就发行人曾经或将来委托奕斯伟设备、芯晖装备定制设备所交付的 IP、Know-How 和相关技术文件，所有权仍归属发行人；4）发行人与奕斯伟设备的共有专利继续保持共有状态，奕

斯伟设备利用共有专利制作的设备可以出售给第三方,但应晚于发行人首批采购相应设备之日起 18 个月。

(三) 研发部门与研发人员情况

1、研发部门

公司研发活动分为技术研发、产品研发、工艺研发、设备及系统研发四大类。具体详见本节之“一、(二)、4、研发模式”。前述研发活动需要多个部门共同配合完成。具体参与部门如下:

首席技术官组织包括特性研究部、技术企划与管理部和知识产权部,主要负责公司前沿技术研发、细分邻域技术开拓、技术路线制定和管理、知识产权体系建设和完善,专利申请和布局,主要参与技术研发和产品研发项目。

首席产品官组织包括开发管理部、拉晶开发部、硅片开发部和外延开发部,主要负责新产品的研发项目以及对应的拉晶、硅片和外延工艺段的技术研发,主要参与技术研发和产品研发项目。

工艺开发部门包括首席制造官组织下属的拉晶、成型、抛光、清洗和外延五大工艺部、制程优化部门和设备智造技术中心和首席品质官组织下属的品质管理部,主要负责工艺研发项目,也会辅助参与技术研发和产品研发项目。

公司历史控股子公司奕斯伟设备负责设备及系统研发项目,目前已转让。

2、研发人员与核心技术人员占比

公司研发活动中的产品研发需要新产品导入量产,工艺研发需要针对产线已有工艺流程、方法和配方不断优化,鉴于发行人并无专用的研发产线,因此研发活动与生产活动存在共用生产设备的情形,发行人存在非全时研发人员。

公司根据所属部门性质、岗位职责、参与研发项目情况和对研发项目实际贡献,将当期研发工时占比不低于 50%的人员认定为研发人员。其中,首席技术官组织和首席产品官组织人员基本为全时研发人员,首席制造官组织下属的工艺开发等部门存在非全时研发人员。报告期各期末,公司研发人员具体情况如下:

项目	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
----	------------	------------	------------

全时研发人员	115	110	84
非全时研发人员	120	112	117
研发人员数量	235	222	201
研发人员占员工总数比例	12.11%	11.88%	11.12%

其中，核心技术人员的基本情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十四、（一）4、核心技术人员”。

3、核心技术人员激励约束措施

（1）股权激励措施

公司实施骨干员工股权激励，将核心技术人员与研发团队中的骨干人员引入员工持股平台，充分调动研发团队的积极性和创造性，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，员工与股东的利益共享、风险共担、事业共创，促进公司的可持续发展。

（2）知识产权保护机制

公司高度重视知识产权，搭建了完善的知识产权管理体系，通过了三方《企业知识产权管理规范 GB/T29490》贯标，分别于 2021 年和 2022 年获得陕西省和国家知识产权优势企业称号。公司制定了《技术成果管理细则》《研发知识产权管理细则》等制度，提升研发人员对知识产权的重视，促进技术成果转化。在技术项目开发的过程中，知识产权工程师深入开发立项、项目中期评估和结项等过程，跟踪并企划核心技术专利，确保对核心技术的知识产权保护。

（3）保密信息保护和竞业禁止措施

公司与核心技术人员签订《员工任职保密协议书》，约定相关人员需要对任职期间或因工作原因知悉的商业秘密和其他保密信息承担保密义务；公司与核心技术人员签订的《劳动合同书》包含竞业限制条款，相关人员承诺在公司任职期间及解除或终止劳动合同之日起两年内均遵守竞业限制义务，且同意竞业限制的范围为全球。

4、核心技术人员变动及影响

报告期内公司无核心技术人员变动。

(四) 技术创新机制、技术储备与技术创新安排

1、技术创新机制

公司对技术开发项目设置了激励机制及专项奖励金，依据项目等级、开发难度和收益贡献度进行综合评级，并按照综合评级、里程碑节点及贡献比例给予项目成员阶段性激励，从而促进公司技术开发项目达成和项目成果积累，不断提升公司技术实力。

通过引入创新知识和方法的培训、举办创新大赛挖掘创新项目、实行一对一的项目辅导等举措，培养技术创新人员的创新能力。开展专利挖掘专项辅导，有针对性的挖掘员工工作中的创新点，制定《专利激励管理规定》，通过专利奖金和年度专利奖的方式进一步激励员工的创新工作，提升员工的创新意识。

2、技术储备及技术创新的安排

建立理论研究开发平台：公司搭建了硅材料基础特性研究平台，针对客户不同制程需求，建立涵盖缺陷分布、吸杂分析、失效分析等多种特性分析平台，为各技术开发项目给予理论支撑和指导，有效提升技术开发项目的效率。

聚焦先进制程领域的技术提升：公司将持续夯实现有技术，遵循集成电路技术发展趋势，针对不同产品制程需求，提升产品核心品质指标，推进先进制程产品技术开发。抛光片方面，进一步提升缺陷控制水平、硅片几何形貌等品质参数，开发应用于更先进 DRAM、NAND Flash 用高端抛光片；外延片方面，进一步优化晶棒缺陷分布，提升边缘品质和纳米形貌，优化体金属水平，开发应用于更先进制程的逻辑芯片用高端外延片。

开拓细分领域的产品应用：P 型重掺硅片，聚焦吸杂特性的提升和重掺产品缺陷的管控水平，进一步开拓 CIS 芯片的应用；N 型硅片方面，聚焦应用于 IGBT 器件的 N 型抛光片和应用用于中低压功率 MOSFET 器件的 N 型外延片，开发相

应器件所需的低氧含量、低电阻率、多层外延膜等技术，推进 N 型硅片的基础特性和评价体系的开发。

材料及设备的国产化：公司根据自身技术路线，针对 12 英寸硅片的所有种类设备、耗材及材料均对国产厂商持开放合作态度。目前无论从上游原材料（包括耗材），还是工艺设备，公司通过合作开发不断提升本土化供应商的量产供应的比例，特别是晶体生长、硅片抛、量测等部分核心设备、超导磁场和热场等部分关键设备的核心零部件也已实现本土供应商配套。

八、安全生产及环境保护情况

（一）发行人环境保护情况

公司不属于重污染行业企业。公司拥有与生产经营过程产生的污染物相匹配的废水、废气、固体废弃物和噪声处理相关的环保装置和防护措施，环保设施运行情况良好。具体如下：

污染类型	主要污染物	主要处理设施及处理能力
废气	酸性废气、碱性废气、外延废气、锅炉废气、废水处理系统废气、 线切割回收系统废气	拉晶厂房碱液洗涤塔+30m 排风，风量：50,000m ³ /h； 酸性废气碱液洗涤+30m 排风，风量：75,000m ³ /h； 碱性废气酸液洗涤+30m 排风，风量：65,000m ³ /h； 外延废气处理设施 POU+碱液洗涤塔，排气筒设计排气量为 20,000m ³ /h； 低氮燃烧+烟气回流系统；锅炉排气筒； 酸性洗涤塔、碱性洗涤塔、30m 排风，设计风量为 30,000m ³ /h； 线切割回收系统废气处理设施：活性炭吸附塔+26m 排风，风量：10,000m³/h
废水	工艺废水、废气治理设施废水、纯水制备系统废水、冷却系统废水、锅炉房废水	污水处理站处理（酸碱中和、调节、硝化反硝化、絮凝），处理能力：21,528m ³ /d； 纯水制备废水用于废水处理洗涤塔补水； 冷却系统排水及锅炉循环使用定期排水，直接纳入市政雨水管网
固废	废石英坩埚、废石墨、废砂浆、废钢线、废磨轮等	委托有资质的单位统一处理

报告期内，公司严格遵守环境保护各项法律法规，环保手续齐全，环保设施运行正常，各项污染因子均达标排放，在生产经营过程中未发生过严重违反环境保护相关法律法规的行为，也未受到过环保方面的行政处罚，并取得西安高新区生态环境局出具的未收到环境行政处罚的证明。

（二）发行人安全生产情况

公司不属于高危险行业。公司以《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）为依据，结合公司实际，组织建立了较为完善的安全生产管理制度体系，制定了《EHS 目标、指标和方案管理程序》《风险分级管控管理程序》等规章制度，并得到有效执行。

报告期内，公司在生产经营过程中未发生过安全生产违法违规行为，也未受到过任何安全生产行政处罚，并取得了西安高新区应急管理局出具的未收到安全生产责任事故举报和投诉的证明。

九、发行人中国台湾及境外经营情况

公司涉及中国大陆以外的地区和国家客户销售。为更好服务海外客户，公司已设立子公司奕斯伟材料香港、奕斯伟材料韩国、奕斯伟材料日本，主要负责销售，不从事生产业务。相应子公司经营和财务情况详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“七、发行人子公司、分公司及参股公司情况”。

第六节 财务会计信息与管理层分析

本节财务会计数据及有关分析说明反映了本公司报告期经审计的财务状况、经营成果和现金流量。本章引用的财务数据，非经特别说明，均引自毕马威会计师事务所审计的财务报表。毕马威会计师事务所对本公司报告期财务报表进行了审计，出具了无保留意见的“毕马威华振审字第 2507188 号”审计报告。投资者欲对本公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解，请查阅前述审计报告相关内容。

一、财务会计报表

(一) 合并资产负债表

单位：万元

项目	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
流动资产：			
货币资金	335,004.52	217,071.49	574,754.91
应收账款	63,243.92	35,157.59	39,234.45
预付款项	3,690.18	3,682.02	9,229.11
其他应收款	2,737.91	1,151.84	796.53
存货	106,233.67	88,868.60	56,603.94
一年内到期的其他非流动资产	1,276.66	1,887.48	-
其他流动资产	5,338.38	23,856.15	9,653.54
流动资产合计	517,525.22	371,675.17	690,272.49
非流动资产：			
其他权益工具投资	15,097.46	17,764.75	-
固定资产	1,038,041.77	758,744.61	680,782.16
在建工程	88,721.82	309,642.05	88,862.91
使用权资产	17,437.71	18,753.59	522.66
无形资产	22,852.30	19,785.02	16,446.32
长期待摊费用	6,375.96	4,225.58	-

其他非流动资产	36,144.42	49,171.66	57,874.54
非流动资产合计	1,224,671.45	1,178,087.26	844,488.60
资产总计	1,742,196.67	1,549,762.42	1,534,761.09
流动负债:			
短期借款	-	7,624.33	11,838.06
应付票据	9,954.27	5,595.53	-
应付账款	56,147.20	16,324.79	24,571.13
合同负债	141.68	41.73	78.45
应付职工薪酬	7,177.42	6,368.63	5,999.39
应交税费	1,216.16	925.40	1,266.66
其他应付款	103,252.47	150,306.89	114,935.43
一年内到期的非流动负债	96,245.23	37,999.52	27,471.96
其他流动负债	350.97	286.70	317.34
流动负债合计	274,485.40	225,473.52	186,478.43
非流动负债:			
长期借款	586,759.64	373,379.28	170,146.53
租赁负债	17,663.92	18,532.78	348.73
递延收益	11,806.36	9,971.39	5,932.42
非流动负债合计	616,229.91	401,883.45	176,427.68
负债合计	890,715.31	627,356.96	362,906.11
股本/实收资本	350,000.00	350,000.00	223.86
资本公积	698,111.13	692,746.99	1,035,837.76
其他综合收益	-4,043.71	-1,371.16	-
专项储备	164.58	16.02	-
盈余公积	-	-	3.20
未分配利润	-192,750.64	-118,986.39	-97,150.05
归属于母公司所有者权益合计	851,481.36	922,405.46	938,914.78
少数股东权益	-	-	232,940.20

所有者权益合计	851,481.36	922,405.46	1,171,854.98
负债和所有者权益总计	1,742,196.67	1,549,762.42	1,534,761.09

(二) 合并利润表

单位：万元

项目	2024年	2023年	2022年
一、营业收入	212,145.26	147,376.14	105,469.31
减：营业成本	199,536.02	145,066.82	92,803.43
税金及附加	2,156.06	2,012.39	1,586.17
销售费用	6,623.03	5,278.34	3,326.13
管理费用	20,827.04	22,431.23	17,885.92
研发费用	25,882.00	17,142.25	14,599.00
财务费用	13,884.80	5,713.36	2,889.40
加：其他收益	7,188.97	3,796.27	1,163.29
投资收益	1,351.14	11,268.87	-
信用减值损失	-126.55	-21.75	-151.80
资产减值损失	-25,570.48	-33,184.31	-26,681.15
资产处置损益	3.04	-	-
二、营业利润	-73,917.57	-68,409.18	-53,290.39
加：营业外收入	153.32	237.10	58.63
减：营业外支出	-	19.35	0.09
三、利润总额	-73,764.25	-68,191.43	-53,231.85
减：所得税费用	-	146.02	55.84
四、净利润	-73,764.25	-68,337.45	-53,287.69
归属于母公司所有者净利润	-73,764.25	-57,797.00	-41,182.08
少数股东损益	-	-10,540.46	-12,105.61
五、其他综合收益的税后净额	-2,672.55	-1,371.16	-
六、综合收益总额	-76,436.80	-69,708.61	-53,287.69
归属于母公司所有者综合收益总额	-76,436.80	-59,168.16	-41,182.08

归属于少数股东综合收益的总额	-	-10,540.46	-12,105.61
----------------	---	------------	------------

(三) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	2022 年
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	204,635.77	164,478.63	86,055.62
收到的税费返还	40,354.15	36,696.78	49,485.78
收到其他与经营活动有关的现金	9,284.69	13,790.14	7,132.61
经营活动现金流入小计	254,274.62	214,965.56	142,674.01
购买商品、接受劳务支付现金	129,384.41	137,508.66	103,751.18
支付给职工以及为职工支付现金	36,699.90	35,738.51	28,874.22
支付的各项税费	1,908.11	3,967.60	2,312.71
支付其他与经营活动有关的现金	4,734.38	5,760.33	3,062.13
经营活动现金流出小计	172,726.80	182,975.11	138,000.25
经营活动产生的现金流量净额	81,547.82	31,990.45	4,673.76
投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	870,000.00	331.52	-
取得投资收益所收到的现金	1,351.14	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	50.76	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,714.19	1,552.40	1,210.22
投资活动现金流入小计	873,065.33	1,934.68	1,210.22
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	209,141.61	374,152.95	353,928.74
投资支付的现金	870,000.00	-	-
处置子公司支付的现金净额	-	3,634.59	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	3,714.19	650.00
投资活动现金流出小计	1,079,141.61	381,501.73	354,578.74
投资活动产生的现金流量净额	-206,076.28	-379,567.05	-353,368.52

筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	229,995.24	576,077.43
取得借款收到的现金	323,489.48	265,243.46	197,146.53
筹资活动现金流入小计	323,489.48	495,238.70	773,223.96
偿还债务所支付的现金	60,713.88	74,954.25	2,288.95
购买子公司股权支付的现金	-	419,028.55	-
偿付利息支付的现金	18,797.04	11,004.61	3,300.26
支付其他与筹资活动有关的现金	1,428.82	5,169.73	108.56
筹资活动现金流出小计	80,939.74	510,157.14	5,697.77
筹资活动产生的现金流量净额	242,549.74	-14,918.44	767,526.20
汇率对现金及现金等价物影响	397.08	303.24	1,271.00
现金及现金等价物净增加额	118,418.37	-362,191.79	420,102.44
加：期初现金及现金等价物余额	207,753.92	569,945.71	149,843.27
期末现金及现金等价物余额	326,172.29	207,753.92	569,945.71

二、审计意见、关键审计事项及与财务会计信息相关的重大事项的判断标准

（一）审计意见

毕马威会计师认为：“公司的财务报表在所有重大方面按照财政部颁布的《企业会计准则》的规定编制，公允反映了奕斯伟材料 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度、2023 年度及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

（二）关键审计事项

1、销售商品的收入确认

公司收入主要来源于销售电子级硅片。报告期各期，公司销售商品产生的营业收入分别为 105,458.61 万元、147,342.09 万元和 212,090.55 万元，收入是公司关键业绩指标之一，存在管理层为达到特定目标或预期而提前或推迟确认收入的固有风险，因此将销售商品收入确认识别为关键审计事项。

与评价销售商品收入确认相关的审计程序中包括:

- (1) 了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性;
- (2) 检查奕斯伟材料与客户签订的销售合同或销售订单, 识别与控制权转移相关的主要条款, 评价收入确认的会计政策是否符合《企业会计准则》的要求;
- (3) 对收入及毛利率执行分析程序, 判断报告期内销售收入和毛利率变动的合理性;
- (4) 选取重要客户进行走访, 询问其与奕斯伟材料的业务往来情况, 以识别是否存在异常情况;
- (5) 检查主要客户报告期内的收入核对至销售合同或销售订单、销售发票、报关单、运输单及签收单等支持性文件, 以评价相关收入是否按照奕斯伟材料的会计政策予以确认;
- (6) 选取主要客户于资产负债表日的应收账款余额及报告期内的销售交易金额执行函证程序;
- (7) 选取临近资产负债表日前后记录的销售, 与销售合同或销售订单、销售发票、报关单、运输单及签收单等支持性文件进行核对, 以评价相关收入是否已记录于恰当的会计期间。

2、存货跌价准备计提

报告期各期末, 公司存货账面余额分别为 70,948.86 万元、111,910.53 万元和 124,651.02 万元, 存货跌价准备分别为 14,344.92 万元、23,041.93 万元和 18,417.35 万元。由于存货跌价准备计提对财务报表影响重大, 且确定存货跌价准备涉及管理层的重大会计判断和估计, 因此将存货跌价准备识别为关键审计事项。

与评价存货跌价准备计提相关的审计程序中包括以下程序:

- (1) 了解和评价与存货跌价准备计提相关的关键内部控制的设计和运行的有效性;
- (2) 获取存货跌价准备计算表并检查计算过程, 复核管理层计提存货跌价

准备的方法,评估其进行测试时所使用的假设和数据合理性,包括存货预计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用等;

(3) 将管理层预计售价与期后实际售价进行比较。将管理层估计的成本、销售费用等与期后或历史实际数据进行比较;

(4) 结合存货监盘,检查期末存货中是否存在库龄较长、产品呆滞或毁损等情形,分析存货跌价准备计提是否充分合理;

(5) 检查与存货跌价准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(三) 与财务会计信息相关的重大事项及重要性水平的判断标准

公司根据自身所处的行业和发展阶段,从项目的性质和金额两方面判断财务会计信息的重要性。从性质来看,主要考虑该事项在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素。从金额来看,公司确定与财务会计信息相关的重大事项和重要性水平标准如下:

项目	重要性标准
重要的账龄超过 1 年的预付款项	单项金额超过资产总额的 0.5%
重要的账龄超过 1 年的合同负债	单项金额超过资产总额的 0.5%
重要的账龄超过 1 年的应付账款	单项金额超过资产总额的 0.5%
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	单项金额超过资产总额的 0.5%
重要的在建工程	单个项目期末账面价值超过人民币 1 亿元
重要的非全资子公司	非全资子公司的总资产超过合并口径资产总额的 10%, 或非全资子公司的对外交易超过合并口径收入总额的 10%

金额虽未达到上表标准,但公司认为较为重要的相关事项,亦属于公司认定的重要财务会计信息。

三、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况

(一) 编制基础

公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体

会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定编制，同时符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

公司财务报表以持续经营为基础编制。

(二) 合并报表合并范围及变化情况

报告期内，公司合并报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称	成立时间	持股比例	是否在合并范围内		
				2024 年	2023 年	2022 年
1	奕斯伟硅片	2018/02/09	100.00%	是	是	是
2	欣芯材料	2022/08/03	100.00%	是	是	是
3	西安奕斯伟投资	2018/12/14	100.00%	是	是	是
4	奕斯伟材料香港	2023/09/05	100.00%	是	是	否
5	奕斯伟设备（注 1）	2019/07/25	75.00%	否	否	是
6	奕斯伟材料技术（注 2）	2018/01/30	84.00%	否	否	否
7	奕斯伟材料韩国	2024/03/05	100.00%	是	否	否
8	奕斯伟材料日本	2024/07/16	100.00%	是	否	否

注 1：2023 年 6 月，发行人以所持有的奕斯伟设备 75% 的股权认购芯晖装备的股权。2023 年 6 月 30 日，奕斯伟设备完成本次交易工商变更，至此奕斯伟设备不再纳入合并报表范围。

注 2：2022 年 7 月，奕斯伟材料技术被奕斯伟材料有限吸收合并后注销。

四、重要会计政策及会计估计

(一) 收入确认原则和具体方法

1、直销模式

(1) 一般直销

具体模式：公司根据与客户依批次签订的采购订单发货。公司会与部分主要客户签署《框架协议》《合作备忘录》等长期合作协议约定基本条款，但销售的产品类型、价格、数量、涉及运输风险的承担方、约定了货物所有权和风险转移条件的贸易条款以采购订单约定为准。

收入确认具体凭证：根据采购订单中约定的不同贸易条款，以客户签字的签收单（对应具有 DAP、DDP、FCA 等贸易条款的订单）、指定货代签字的提货单（对应具有 EXW、CIP 等贸易条款的订单）或报关完成后的提单（对应具有 CIF 等贸易条款的订单）作为收入确认的具体凭据。

（2）寄售直销

2022 年起，根据客户要求，公司逐步对客户 D1 和客户 B1 由一般直销过渡为寄售直销模式；2024 年起，根据客户要求，公司逐步对客户 A 和客户 O 的部分主体由一般直销过渡为寄售直销模式。报告期各期，公司涉及寄售直销模式的主营业务收入占比分别为 4.70%、25.37%和 24.76%。

具体模式：与一般直销模式相同，唯一区别为客户领用前将已签收货物仅作为寄存产品管理，货物签收公司不确认收入。根据约定客户领用货物视为控制权转移，公司方可确认收入，公司根据客户领用情况与客户定期对账。

收入确认具体凭证：以客户供应商管理系统显示的或客户提供的领用记录作为收入确认的具体凭据。

2、代销模式

根据特定地区规定，公司对部分客户通过代理商销售，具体情况详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“一、（二）、3、销售模式”。报告期内，公司涉及代销模式主营业务收入占比分别为 2.94%、3.77%和 2.74%。

具体模式：公司与终端客户沟通产品方案和采购需求，并与代理商签订《代理合同》。终端客户向代理商发送采购需求，代理商依据终端客户需求向公司发送采购订单。公司根据采购订单组织生产，直接发货至代理商，再由代理商交付至终端客户签收。代理商不定期向公司提供销售明细表（含佣金），公司核对无误后，向代理商支付佣金。

收入确认具体标准：公司以收到的终端客户向代理商出具的签收单、或终端客户向代理商发送的领用记录作为收入确认具体凭据，公司向代理商支付的佣金计入销售费用。

(二) 成本核算方法

公司借助 ERP 系统进行成本核算管理,不断优化生产工艺。12 英寸硅片在生产过程中需经历晶锭和硅片两种形态,从而成本归集可分为拉晶段和硅片段先后两个生产环节,不同环节分别设置生产工单进行成本归集,并采用逐步结转法核算产品最终成本。具体如下:

1、直接材料

公司采用移动加权平均计价法领用原材料,按照不同产品标准成本归集至各生产工单,并每月将实际原材料耗用与标准成本差额分摊至相应生产工单。

2、直接人工

直接人工是指从事产品生产的直接制造人员的薪酬成本。公司先根据各生产工序直接制造人员数量占比,将全部直接人工成本分摊至各生产工序;再由 ERP 系统根据各生产工单在相应生产工序耗用的机器工时,将各生产工序的直接人工成本进一步分摊至各生产工单。

3、制造费用

制造费用包括折旧摊销费、备件及耗材成本、间接生产管理人员成本、燃料动力费等。

公司先将不同类型制造费用分摊或归集至各生产工序。一般而言,归属生产区域的厂房建筑物的折旧费根据不同生产工序所需工艺设备对应的洁净区占地面积作为基准分摊;设备折旧费根据不同生产工序实际使用的设备进行归集;备件及耗材成本根据不同生产工序设备实际或计划耗用情况进行归集,燃料动力费根据不同生产工序设备的合计额定功率作为基准进行分摊。

制造费用分摊或归集至各生产工序后,公司再根据各生产工单在相应生产工序耗用的机器工时进一步分摊至各生产工单。

(三) 研发支出核算方法

报告期内,公司研发支出根据研发项目归集,全部费用化。各研发项目归集的研发费用包括研发专属费用和研发试制费用两部分。具体如下:

1、研发专属费用

研发专属费用指可直接归属于具体研发项目的费用，主要包括：

(1) 研发专属人工：根据各研发项目人员月度工时统计表，将当月相应研发人员薪酬计入各研发项目。

(2) 研发专属材料：根据研发项目实际所需材料，经审批后直接领用，计入各研发项目。

(3) 研发专属设备折旧：研发专属设备由研发部门专管专用，设备折旧按实际归属研发项目直接投入（包括直接材料、人工费用等）合计金额占比分摊至各研发项目。

2、研发试制费用

发行人并无专用的研发产线，研发活动与生产活动存在共用设备情形。研发试制费用指利用产线进行研发及所需测试等活动发生的费用，通过具体研发项目下开立工单进行归集核算，具体核算方法与上述“（二）成本核算方法”中的直接材料、直接人工、制造费用的核算方法一致。

根据《企业会计准则解释第 15 号》规定，对于研发过程中产出的具备销售条件可获得对价的产品，将对应成本结转至存货并冲减相应研发费用。后续对外销售的，确认收入并结转营业成本；用于免费送样的，结转销售费用。

（四）资产减值测试

1、金融工具减值计提

公司金融工具包括应收账款和其他应收款，报告期内公司不存在应收票据和应收款项融资。公司金融工具减值计提分为按照单项计提和按照组合计提。

（1）按照单项计提的金融工具

对于存在客观证据表明存在减值的应收账款、其他应收款等单独进行减值测试，确认并计提单项预期信用损失。报告期内，公司不存在按照单项计提减值的金融工具。

(2) 按照组合计提的金融工具

项目	确定组合的依据	计提方法
应收账款	根据历史经验, 不同客户群体发生信用损失的情况无显著差异, 因此将全部应收账款确定为同一个组合	根据账龄与预期信用损失率对照表为基础计算其预期信用损失。预期信用损失率基于应收账款过去期间的实际信用损失经验计算, 并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与发行人所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整
其他应收款	根据款项性质和不同对手方的信用风险特征, 将其他应收款划分为 3 个组合: ①应收政府单位押金和保证金组合; ②应收其他非政府单位押金保证金、往来款和员工备用金组合; ③应收合并范围内关联方款项	1、应收政府单位押金和保证金组合不存在减值迹象, 报告期内未计提坏账准备 2、其余组合根据账龄与预期信用损失率对照表为基础计算其预期信用损失。预期信用损失率基于其他应收款过去期间的实际信用损失经验计算, 并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与发行人所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整

公司按账龄组合的坏账准备计提比例如下:

账龄	应收账款	其他应收款计提比例
3 个月内 (含 3 个月)	0.5%	0.5%
3-6 个月 (含 6 个月)	1%	1%
6 个月-1 年 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年 (含 2 年)	100%	30%
2-3 年 (含 3 年)		80%
3 年以上		100%

报告期内, 公司与可比公司沪硅产业按组合计提的应收账款坏账计提比例不存在显著差异, 具体如下:

公司名称	6 个月以内	6 个月-1 年	1-2 年	2-3 年	3 年以上
沪硅产业	0.5-5.95%	0.66-7.00%	0.66-100%	100%	100%
发行人	0.5-1%	5%	100%		

注 1: 沪硅产业数据来源为其 2023 年年报。

注 2: 可比公司中, SUMCO 仅披露其根据历史损失情况对应收账款计提坏账准备, 但未披露不同组合具体计提比例; 环球晶圆根据不同客户的信用风险特征确定应收账款及应收票据分组, 根据其 2024 年年报, 半导体事业部根据应收票据及应收账款的逾期天数计提坏账, 其中未逾期不计提, 逾期超过 30 天计提 10%, 超过 60 天计提 30%, 超过 90 天计提 50%, 超过 180 天计提 100%; 德国世创根据客户历史信用记录确

定高中低三档内部客户评级, 计算预期损失率, 报告期内未计提坏账准备。鉴于中国台湾及境外可比公司坏账计提政策与公司可比性不强, 此处未列示比较。

2、存货跌价准备

(1) 存货跌价准备计提

公司期末存货账面价值采用成本与可变现净值孰低计量, 每季度末按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。报告期各期末, 存货可变现净值确认方式和跌价准备计提方法如下:

1) 库存商品及发出商品

相应存货预计售价减去预计的销售费用和相关税费后金额确定可变现净值。

报告期各季度末公司的库存商品及发出商品以签署的销售订单价格或同类别产品的期后市场销售价格作为可变现净值计量基础。

如库存商品为呆滞品或者存在质量问题, 则按账面余额 100%计提跌价准备。

2) 在产品

在产品对应的产成品预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

半成品: 对于在产品中的半成品(单晶硅棒拉晶出炉后, 截断形成晶锭, 进入半成品库), 根据其性能和品质差异, 对应抛光片、外延片、测试片等不同类别产成品。公司以不同类别产成品期后估计售价扣减所对应半成品的后续预计加工成本、销售费用和相关税费后的金额作为可变现净值。对于已过时、预计未来没有使用计划的半成品认定为呆滞半成品, 按账面余额 100%计提存货跌价准备。

在制品: 在产品中包括拉晶段和硅片段的在制品, 不同批次工单所处工序环节不同, 后续加工成本差异大。拉晶段在制品以同期同类别的半成品可变现净值为基础计算其可变现净值; 硅片段在制品与同期同类别的库存商品可变现净值为基础计算其可变现净值。

3) 原材料

公司的原材料是为生产库存商品而持有的,按照可以产出的不同类别库存商品的可变现净值是否高于成本判断是否应对原材料计提存货跌价准备。具体如下:

首先,公司根据不同类别产品(抛光片、测试片、外延片)的未来排产计划,将原材料按照物料号维度计算出 1-3 个月、4-6 个月、7-12 个月和 12 个月以上的不同期间的预计耗用金额。

其次,对上述每一个期间,公司将该原材料对应的产成品的可变现净值和原材料成本比较,如产成品可变现净值大于成本,则无需对原材料计提存货跌价准备;如产成品可变现净值小于成本,按其差额计提存货跌价准备。

4) 备品备件及低值易耗品

备品备件及低值易耗品主要为生产设备所使用的石英制品、石墨热场、托盘等。公司监控备品备件及低值易耗品的消耗情况,对于预计未来没有使用计划的备品备件及低值易耗品,按账面余额 100%计提存货跌价准备。

(2) 存货跌价准备转销

报告期每季度末,若公司已计提跌价准备的存货实现销售,则该季度初已计提的跌价准备转销冲减当期对应的主营业务成本。

库存商品和发出商品根据当期存货实际销售情况进行转销。

基于生产连续性,对原材料和在产品期初计提的跌价准备,综合考虑不同类别产品对应的原材料和在产品形成不同产品的生产周期、不同类别产成品的当期销售比例、以及不同类别产成品当期销售的负毛利金额等因素转销。

(3) 因亏损合同确认的预计负债

若销售合同预计为亏损合同,公司对用于履行合同的存货进行减值测试并按规定确认减值损失,如果预计亏损超过该减值损失,超过部分确认为预计负债。

(五) 固定资产折旧

公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率,具体如下:

类别	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	10-50	5%	1.90%-9.50%
机器设备	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输工具	4	0%	25.00%
办公设备及其他	2-5	0%	20.00%-50.00%

报告期内,公司固定资产折旧年限与同行业可比公司基本一致。具体如下:

类别	沪硅产业	SUMCO	环球晶圆	德国世创	公司
房屋及建筑物	10-62.5	31	2-60	8-30	10-50
机器设备	3-15	5	1-30	4-10	5-10
运输设备	3-5	5	1-40	3-10	4
办公设备及其他	3-5	5	1-40	3-10	2-5

数据来源:可比公司年报。

(六) 在建工程转固

报告期内,公司在建工程主要包括房屋建筑物及机器设备等,转固依据如下:

1、房屋建筑物

工程完工并达到预定可使用状态后,依据工程竣工验收报告转固。

2、机器设备

工厂的机器设备转固分为两个阶段。第一阶段为产线试车转固阶段,小批量产线打通投产并可稳定产出,通过公司各部门评审出具产线认证报告,将已达预定可使用状态的小批量产线涉及的全部机器设备一次性转为固定资产;第二阶段为单台设备转固阶段,随着后续产能扩张,新增设备完成安装调试后,依据单台设备验收报告转固。

(七) 股份支付费用

报告期内,公司股权激励涉及股份支付会计处理,按员工等待期进行分摊确认的股份支付费用,均计入经常性损益;视同加速行权的股份支付费用计入非经常性损益,相关处理符合《企业会计准则》要求。具体详见本招股说明书“第四

节“发行人基本情况”之“十五、发行人本次申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排”。

(八) 其它重大特殊事项会计政策

报告期内，公司不存在其他重大特殊事项的会计政策。

(九) 报告期内重大会计政策/会计估计变更事项分析

报告期内，公司无对财务状况和经营成果产生重大影响的会计政策变更，无会计估计变更，无会计差错更正。

五、非经常性损益

根据毕马威会计师审核并出具的《西安奕斯伟材料科技股份有限公司非经常性损益明细表的专项报告》（毕马威华振专字第 2501432 号），报告期内公司非经常性损益的具体内容、金额及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润如下：

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	2022 年
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	3.04	-12.84	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	983.33	643.52	473.41
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,351.14		
企业处置子公司、联营企业及合营企业获取对价大于处置投资时应享有被投资单位可辨认净资产账面价值产生的收益	-	11,268.87	-
一次性确认的股份支付费用	-	-477.52	-
除上述各项之外其他营业外收入和支出	153.32	230.59	58.54
税前非经常性损益合计	2,490.83	11,652.62	531.96

所得税影响额	-	-37.28	-28.53
少数股东权益影响额(税后)	-	-178.46	-132.09
归属于母公司股东的非经常性损益净额	2,490.83	11,436.88	371.34
扣除非经常性损益前归属母公司净利润	-73,764.25	-57,797.00	-41,182.08
扣除非经常性损益后归属母公司净利润	-76,255.09	-69,233.88	-41,553.42

2022年,公司非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助。

2023年公司非经常损益主要为转让奕斯伟设备75%股权实现的投资收益11,268.87万元,具体详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、(四)2023年6月,发行人以所持奕斯伟设备75%股权认购芯晖装备股权”。

2024年,公司非经常性损益主要为购买结构性存款产品获得投资收益。

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计缴标准
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入的13%、6%计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应缴增值税
城市维护建设税	实际缴纳增值税的7%
教育费附加	实际缴纳增值税的3%
地方教育费附加	实际缴纳增值税的2%

报告期内,公司合并范围内各纳税主体适用的所得税税率明细如下:

纳税主体	2024年	2023年	2022年
发行人	15%	15%	15%
奕斯伟硅片	15%	15%	15%
欣芯材料	15%	25%	25%
西安奕斯伟投资	不适用	不适用	不适用
奕斯伟材料香港	8.25%	8.25%	尚未设立
奕斯伟设备	已转让	15%	15%
奕斯伟材料技术	已注销	已注销	25%

奕斯伟材料韩国	10%	尚未设立	尚未设立
奕斯伟材料日本	15%	尚未设立	尚未设立

(二) 税收优惠

1、发行人于 2022 年 12 月 14 日取得编号为 GR202261004912 号《高新技术企业证书》，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。发行人**报告期各期**均按照 15%税率缴纳企业所得税。

2、奕斯伟硅片于 2020 年 12 月 1 日和 2023 年 12 月 12 日分别取得编号为 GR202061000498 号及 GR202361006854 号《高新技术企业证书》，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。奕斯伟硅片**报告期各期**均按 15%税率缴纳企业所得税。

3、历史子公司奕斯伟设备于 2021 年 10 月 14 日取得编号为 GR202161003648 号《高新技术企业证书》，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。奕斯伟设备在合并报表范围内的 2022 年及 2023 年 1-6 月按照 15%税率缴纳企业所得税。

4、根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号）及财政部、税务总局颁布的《关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（2022 年第 14 号），**报告期各期**，公司合计获得的增值税留抵退税金额分别为 49,485.78 万元、36,185.49 万元及 **24,695.98 万元**。

5、根据《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税〔2012〕39 号）规定，公司及子公司奕斯伟硅片出口产品享受增值税出口退税的优惠政策。**报告期各期**，发行人合计收到出口退税金额分别为 0.00 万元、511.29 万元及 **15,580.70 万元**。

6、根据《财政部、税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕17 号）规定，奕斯伟硅片可按照当期可抵扣进项税额的 15%计

提当期加计抵减额。2023 年和 2024 年，奕斯伟硅片增值税加计抵减金额分别为 1,951.31 万元和 3,663.05 万元，影响金额计入当期其他收益。

7、根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部税务总局国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）规定，本公司之子公司欣芯材料自 2024 年度起符合西部大开发企业所得税优惠事项规定的条件减按 15% 税率征收企业所得税。

七、报告期内主要财务指标

（一）基本财务指标

财务指标	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
流动比率（倍）	1.89	1.65	3.70
速动比率（倍）	1.50	1.25	3.40
资产负债率（母公司）	27.62%	16.08%	12.25%
资产负债率（合并）	51.13%	40.48%	23.65%
归属于母公司股东每股净资产（元/股）	2.43	2.64	不适用
财务指标	2024 年	2023 年	2022 年
应收账款周转率（次/年）	4.29	3.94	4.31
存货周转率（次/年）	1.69	1.59	2.03
息税折旧摊销前利润（万元）	36,400.12	14,713.76	-6,483.85
利息保障倍数（倍）	不适用	不适用	不适用
归属于母公司股东净利润（万元）	-73,764.25	-57,797.00	-41,182.08
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	-76,255.09	-69,233.88	-41,553.42
研发投入占营业收入的比例	12.20%	11.63%	13.84%
每股经营活动现金净流量（元）	0.23	0.09	不适用
每股净现金流量（元）	0.34	-1.03	不适用

注：上述财务指标计算公式如下，后文同此计算方式：

- （1）流动比率=流动资产/流动负债
- （2）速动比率=（流动资产 - 存货）/流动负债
- （3）资产负债率=（总负债/总资产）×100%
- （4）归属于母公司股东的每股净资产=归属于母公司股东的净资产/期末总股本
- （5）应收账款周转率=营业收入/（（期初应收账款余额 + 期末应收账款余额）/2）
- （6）存货周转率=营业成本/（（期初存货余额 + 期末存货余额）/2）

(7) 息税折旧摊销前利润=净利润+所得税费用+(利息费用-利息收入)+固定资产折旧+使用权资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

(8) 利息保障倍数=(利润总额+利息费用)/利息费用

(9) 研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入

(10) 每股经营活动产生现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

(11) 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本

(二) 净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，公司加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

科目	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益(元)	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	2024年	-8.32%	-0.21	-0.21
	2023年	-6.02%	-0.17	-0.17
	2022年	-8.34%	不适用	不适用
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2024年	-8.60%	-0.22	-0.22
	2023年	-7.21%	-0.20	-0.20
	2022年	-8.41%	不适用	不适用

八、经营成果分析

(一) 营业收入分析

1、营业收入构成及变动分析

单位：万元、%

项目	2024年		2023年		2022年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	211,087.28	99.50	146,031.45	99.09	102,872.70	97.54
其他业务收入	1,057.98	0.50	1,344.69	0.91	2,596.61	2.46
合计	212,145.26	100.00	147,376.14	100.00	105,469.31	100.00

报告期各期，公司营业收入的97%以上均源于主营业务。随着产能增长、技术提升和产品在客户端不断验证，公司营业收入的期间复合增长率达41.83%，

实现了高速增长。

2、主营业务收入构成分析

(1) 主营业务收入按产品类别构成分析

单位：万元、%

项目	2024 年		2023 年		2022 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
抛光片	83,075.61	39.36	64,717.58	44.32	41,881.97	40.71
外延片	35,348.39	16.75	8,608.51	5.89	13,494.15	13.12
测试片	92,663.27	43.90	72,705.36	49.79	47,496.58	46.17
其中：高端测试片	44,683.83	21.17	30,854.60	21.13	2,550.82	2.48
合计	211,087.28	100.00	146,031.45	100.00	102,872.70	100.00
正片合计	118,424.00	56.11	73,326.09	50.21	55,376.12	53.83

作为新进入硅片商，下游晶圆厂首先验证测试片，通过后测试片可批量供货，并根据客户评估进一步验证正片，通过后正片方可批量供货。深谙客户导入是产能消化前提，公司进入该领域之初即确定了不同目标客户象限，并由指定团队对接负责，工厂建设初期即开始与客户沟通，调研客户需求，制定匹配的客户导入方案。

报告期内，公司正片认证进展顺利，在主营业务收入整体高增长的趋势下，正片主营业务收入占比**已超过 55%**。报告期各期，公司正片收入中抛光片占比始终高于外延片，主要原因为抛光片主要供应存储 IDM 厂商，客户集中度高且需求量大，容易放量形成规模效应。公司选择抛光片为第一工厂产能爬坡、工艺磨合的基石产品，目前已成为国内主流存储 IDM 厂商的全球硅片供应商中采购占比第一或第二大的战略级供应商，并已向客户 O、客户 P 等国际主流存储 IDM 厂商正片量产供货。同时，随着主要客户 2024 年采购需求回暖以及公司更多规格产品量产导入，外延片收入放量，当年收入已达 2023 年的 4 倍以上，在主营业务收入增长的情况下，2024 年外延片主营业务收入占比同比 2023 年提升了 10 个百分点以上。

测试片是客户正片量产的前提。截至 2024 年末，公司已通过验证的客户累

计超 140 家，通过验证的测试片超过 390 款，公司已成为全球晶圆厂的测试片主力供应商之一，测试片也是报告期内公司收入贡献最大的产品。公司根据客户需求积极研发，2022 年推出应用于先进制程产线调试需求的高端测试片，相应产品已实现对客户 D、客户 O 等全球主流晶圆厂批量供货。2023 年和 2024 年，具有抛光片正片品质的高端测试片贡献主营业务收入的 20%以上。

(2) 主营业务收入按市场区域构成分析

单位：万元、%

项目	2024 年		2023 年		2022 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
内销	155,623.12	73.72	96,779.04	66.27	75,620.89	73.51
外销	55,464.15	26.28	49,252.42	33.73	27,251.82	26.49
合计	211,087.28	100.00	146,031.45	100.00	102,872.70	100.00

12 英寸硅片海外需求更大，公司立足国内需求，更放眼全球市场，服务全球客户。报告期内，公司外销主营业务收入占比始终维持在 30%左右。

3、主要产品价格及销量变化情况分析

(1) 抛光片

项目	2024 年		2023 年		2022 年	
	金额	变动率	金额	变动率	金额	变动率
销售收入(万元)	83,075.61	28.37%	64,717.58	54.52%	41,881.97	3,745.03%
销售量(万片)	229.76	58.31%	145.13	66.30%	87.27	3,186.89%
平均单价(元/片)	361.58	-18.91%	445.92	-7.08%	479.89	16.98%

抛光片是目前公司正片收入贡献最大的产品。单价方面，2022 年行业景气度高涨，硅片供不应求价格上涨且部分高规格抛光片完成客户导入后批量供货。2022 年下半年起，半导体行业进行下行周期，目前尤其是 2024 年下半年虽采购需求有所回暖，但 12 英寸硅片价格回暖呈现滞后效应，2023 年和 2024 年抛光片单价持续同比下滑，但发行人销量上涨抵消了单价下跌，收入仍实现快速增长。此外，2024 年抛光片单价降幅放大与国内 12 英寸友商加速国产化和公司自

身产品成本持续下降也有一定关系。

(2) 外延片

项目	2024 年		2023 年		2022 年	
	金额	变动率	金额	变动率	金额	变动率
销售收入(万元)	35,348.39	310.62%	8,608.51	-36.21%	13,494.15	1,893.93%
销售量(万片)	56.50	380.59%	11.76	-36.55%	18.53	1748.01%
平均单价(元/片)	625.69	-14.56%	732.30	0.54%	728.38	7.90%

目前公司外延片下游主要为国内一线逻辑晶圆代工厂，其相对抛光片品质要求更高，生产需要额外外延工序，同期外延片平均单价一般是抛光片平均单价的 1.5 到 2 倍。报告期内，公司外延片收入各期波动，但整体呈现高速增长。

2022 年，行业景气度高涨硅片供不应求价格上涨，同时随着公司产能提升，公司外延片通过认证的客户数量和规格不断丰富，当年外延片呈现量价齐升，收入同比大幅增长。

2023 年，外延片单价持平，但销量同比下降，主要系：1) 2023 年半导体行业在下行周期，晶圆代工厂的产能利用率下降，外延片采购需求下降；2) 部分下游晶圆代工厂与全球前五大硅片厂商在 2022 年行业景气度高时签订了具有最低采购量的长期供货协议，整体采购需求缩减情况下，新进入厂商外延片供货量受到一定“挤压”。上述因素导致当年外延片收入同比下滑。

2024 年，随着客户采购需求回暖、公司更多规格的外延片产品量产导入，外延片收入放量，已达 2023 年收入的 4 倍以上。外延片下游采购需求主要在 2024 年下半年开始回暖，价格尚待恢复，叠加公司外延片放量导致产品成本大幅降低，当期单价同比 2023 年仍有下降。

(3) 测试片

项目	2024 年		2023 年		2022 年	
	金额	变动率	金额	变动率	金额	变动率
销售收入(万元)	92,663.27	27.45%	72,705.36	53.07%	47,496.58	152.66%

销售量(万片)	339.20	52.40%	222.58	72.78%	128.82	99.63%
平均单价(元/片)	273.18	-16.37%	326.65	-11.41%	368.70	26.57%

报告期各期,测试片中的高端测试片价格及销量变化如下:

项目	2024年		2023年		2022年	
	金额	变动率	金额	变动率	金额	变动率
销售收入(万元)	44,683.83	44.82%	30,854.60	1,109.59%	2,550.82	不适用
销售量(万片)	125.58	75.67%	71.48	1,300.93%	5.10	不适用
平均单价(元/片)	355.83	-17.56%	431.64	-13.66%	499.92	不适用

随着客户和产品不断认证通过,销量持续攀升带动测试片收入的高速增长。尤其是公司自主研发的高端测试片,其产品品质、生产工艺和单价与抛光片接近,单价高于其他测试片产品。2022年,高端测试片开始批量供货,当年仅占同期测试片收入的5.37%;**2024年高端测试片已贡献当年测试片收入接近50%**,是测试片收入整体增长的核心原因之一。

单价方面,2022年行业景气度高涨硅片供不应求价格上涨,测试片单价较高;2023年至今,半导体市场进行下行周期,目前虽有回暖但尚未完全恢复,尤其是测试片作为测试产线所需的辅助材料,在供给不紧缺的情况下客户对测试片价格敏感更高,同时国内12英寸友商加速国产化,综合导致公司高端测试片和测试片单价持续回落,但回落幅度小于销量上涨幅度。

4、报告期内,公司主营业务收入不存在明显季节性特征

单位:万元、%

项目	2024年		2023年		2022年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	40,936.00	19.39	38,352.09	26.26	12,063.34	11.73
第二季度	47,567.87	22.53	40,627.13	27.82	20,054.73	19.49
第三季度	54,019.35	25.59	30,835.80	21.12	30,902.18	30.04
第四季度	68,564.06	32.48	36,216.43	24.80	39,852.46	38.74
合计	211,087.28	100.00	146,031.45	100.00	102,872.70	100.00

2022年,发行人持续产能扩张,各季度收入均高于前三季度。2023年,随着发行人第一工厂达产,收入不存在明显的季节性特征。2024年,随着行业回暖和产能继续扩张,各季度收入呈现高于前三季度的特征。

5、报告期内,公司主营业务收入96%以上均来自直销模式,代销模式收入占比极低

单位:万元、%

项目	2024年		2023年		2022年	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
直销模式	205,293.52	97.26	140,526.58	96.23	99,848.96	97.06
——一般直销	145,977.03	69.15	103,479.31	70.86	95,014.58	92.36
——寄售直销	59,316.49	28.10	37,047.27	25.37	4,834.38	4.70
代销模式	5,793.75	2.74	5,504.87	3.77	3,023.75	2.94
合计	211,087.28	100.00	146,031.45	100.00	102,872.70	100.00

(二) 营业成本分析

1、营业成本构成

单位:万元、%

项目	2024年		2023年		2022年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	199,500.43	99.98	145,061.45	100.00	92,744.26	99.94
其他业务成本	35.60	0.02	5.37	0.00	59.17	0.06
合计	199,536.02	100.00	145,066.82	100.00	92,803.43	100.00

公司其他业务主要为废料和废品销售。部分废品和废料随生产经营过程产生,相应生产成本由主营业务归集,导致营业成本构成与营业收入构成略有差异。

2、报告期各期,公司各类产品主营业务成本结构与主营业务收入基本一致,略有差异主要系毛利率区别

单位:万元、%

项目	2024年	2023年	2022年
----	-------	-------	-------

	金额	占比	金额	占比	金额	占比
抛光片	74,971.33	37.58	63,304.99	43.64	36,125.19	38.95
外延片	33,415.98	16.75	11,217.85	7.73	13,607.99	14.67
测试片	91,113.12	45.67	70,538.61	48.63	43,011.08	46.38
合计	199,500.43	100.00	145,061.45	100.00	92,744.26	100.00

3、主营业务成本构成分析

单位：万元、%

项目	2024年		2023年		2022年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	72,559.11	36.37	59,569.90	41.07	40,593.25	43.77
直接人工	3,411.03	1.71	4,092.09	2.82	3,329.91	3.59
制造费用	153,670.69	77.03	105,912.63	73.01	68,936.63	74.33
其他	-30,140.42	-15.11	-24,513.17	-16.90	-20,115.54	-21.69
合计	199,500.43	100.00	145,061.45	100.00	92,744.26	100.00

注：其他含存货跌价准备转销、亏损合同计提的预计负债以及产品质保金的影响金额，后同。

报告期各期，其他项目对各期主营业务成本金额和结构影响较大，主要为存货跌价准备转销。报告期内，公司存货跌价准备计提金额较高，主要系：1）公司产能从**2022年末41.45**万片/月增至**2024年末71.22**万片/月，产量和存货规模随之大幅提升；2）公司在半导体行业波动中处于产能爬坡期，部分产品销量尚需提升，单价波动，难以覆盖产能转固带来的成本提升，存在“负毛利”情况。在前述背景下，公司积极开拓市场，仍实现销量的持续增长，已计提存货跌价准备的存货销售后，存货跌价准备转销冲减主营业务成本，上表中的其他项目对各期主营业务成本金额产生负向影响。

若不考虑其他因素对主营业务成本的影响，则公司主营业务成本结构如下：

单位：万元、%

项目	2024年		2023年		2022年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	72,559.11	31.60	59,569.90	35.13	40,593.25	35.97

直接人工	3,411.03	1.49	4,092.09	2.41	3,329.91	2.95
制造费用	153,670.69	66.92	105,912.63	62.46	68,936.63	61.08
合计	229,640.84	100.00	169,574.62	100.00	112,859.79	100.00

报告期各期,随着第一工厂达产及第二工厂投产,相应房屋建筑物及机器设备陆续转固,主营业务成本中制造费用占比不断提升,直接材料和直接人工占比随之下降。

(三) 营业毛利变动分析

1、主营业务毛利构成分析

单位:万元

项目	2024年	2023年	2022年
抛光片	8,104.29	1,412.59	5,756.78
外延片	1,932.41	-2,609.34	-113.84
测试片	1,550.16	2,166.76	4,485.51
其中: 高端测试片	1,815.64	2,312.17	306.04
合计	11,586.85	970.00	10,128.45

公司投资规模大,固定成本高,产能爬坡期实现毛利转正需要综合技术研发、客户认证和市场拓展,持续提升产品销量、优化生产工艺和提升高附加值产品收入占比实现降本增效。

报告期各期,公司整体毛利已于2022年转正,主要类别产品中抛光片和测试片于2022年同步转正。单价最高的外延片由于认证周期长,2022年至2023年销量尚未充分释放,毛利为负;2024年,随着客户采购需求回暖,公司更多规格外延片量产导入,外延片开始放量,单位成本大幅下降,毛利已实现转正。

2、主营业务毛利率分析

(1) 主营业务毛利率分析

单位:元/片、%

项目	2024年	2023年	2022年
----	-------	-------	-------

	金额	变动率/额	金额	变动率/额	金额	变动率/额
平均单价	337.49	-12.30	384.83	-12.23	438.46	45.39
平均单位成本	318.97	-16.56	382.28	-3.29	395.29	-34.68
主营业务毛利率	5.49	4.83	0.66	-9.19	9.85	110.52

报告期内，公司主营业务毛利率受行业波动影响呈现先降后升的趋势。

2022年，公司毛利率同比大幅上升。首先，单价同比大幅提升，主要系：

1) 当年行业景气度高涨，硅片供不应求，下游上调采购报价；2) 公司正片导入后放量供应，比测试片单价更高的正片收入占比当年达到**53.83%**，带动整体单价提升；3) 更高规格的正片和测试片认证通过后批量供货也一定程度提升了整体单价。其次，公司单位成本同比大幅下降，主要系：1) 公司硅片放量，规模效应大幅摊低单位制造费用；2) 公司工艺优化，良率提升，单位直接材料同比下降。两个因素综合导致当年公司毛利率同比大幅上升。

2023年，公司毛利率同比下降。首先，公司单价同比下滑，主要系：1) 2023年行业进行下行周期，公司主要的抛光片和测试片产品单价均同比下调；2) 单价最高的外延片受行业景气度影响，收入金额及占比下降，降低了整体单价水平。公司单位成本同比下降，主要系：公司良率和工艺持续优化，销量继续攀升，单位直接材料和制造费用持续降低。综上，由于市场调整更快，单价下降幅度大于单位成本，当年毛利率同比下滑。

2024年，公司毛利率回暖。首先，公司单价维持下降趋势，主要系：1) 行业需求回暖，但由于下游仍需时间消化库存，12英寸硅片价格回暖存在滞后性，尚待反弹；2) 本土12英寸硅片友商国产化加速。其次，公司平均单位成本下滑主要系：1) 公司持续工艺优化，通过导入并应用本土化电子级多晶硅、电子气体和石英坩埚等核心材料、优化核心工序实现部分工艺材料（如砂浆）循环利用等方式实现单位直接材料同比大幅降低。2) 公司销量和良率持续提升，规模效应导致单位制造费用同比下降。综上，由于公司单位成本下降幅度大于单价，当年公司毛利率回升。

(2) 公司毛利率产品类型分析

1) 抛光片

单位: 元/片、%

项目	2024 年		2023 年		2022 年	
	金额	变动率/额	金额	变动率/额	金额	变动率/额
平均单价	361.58	-18.91	445.92	-7.08	479.89	16.98
平均单位成本	326.31	-25.19	436.19	5.38	413.93	-72.29
毛利率	9.76	7.58	2.18	-11.57	13.75	277.94

报告期内, 公司抛光片毛利率趋势与主营业务毛利率一致。

2022 年, 随着行业景气度提升硅片涨价, 公司抛光片在国内主流存储 IDM 厂放量以及良率提升, 抛光片单价同比提升, 单位成本同比大幅下降, 毛利率同比大幅提升。

2023 年, 随着行业进入下行周期, 客户下调采购报价, 同时本土 12 英寸硅片友商加速国产化, 抛光片单价同比下降。此外, 由于抛光片毛利水平改善, 当年对成本负向影响的存货跌价准备转销金额同比 2022 年下降导致单位成本同比提升。以上两个因素综合导致当年抛光片毛利率下降。

2024 年, 抛光片单价同比持续下滑, 但由于本土原材料导入、工艺优化以及抛光片持续放量带来的规模效应, 抛光片单位直接材料和单位制造费用同比下降, 综合导致单位成本下降比例大于单价, 毛利率回升。

2) 外延片

单位: 元/片、%

项目	2024 年		2023 年		2022 年	
	金额	变动率/额	金额	变动率/额	金额	变动率/额
平均单价	625.69	-14.56	732.30	0.54	728.38	7.90
平均单位成本	591.49	-38.02	954.27	29.92	734.52	-56.76
毛利率	5.47	35.78	-30.31	-29.47	-0.84	150.79

报告期内, 公司外延片毛利率趋势与主营业务毛利率一致。2024 年, 随着外延片放量, 毛利率已实现由负转正。

2022年，外延片毛利率大幅提升原因与抛光片基本一致。

2023年，外延片毛利率下降幅度远大于抛光片，主要系外延片单位成本大幅提升。1)行业处于下行周期，晶圆代工厂产能利用率不足削减硅片采购需求，同时下游晶圆代工厂与全球前五大厂商的最低采购量的长期协议进一步“挤压”新进入硅片厂商的采购需求；2)公司外延设备持续转固，但是由于下游需求不足，外延设备的开工率不足。前述原因综合导致外延片年度销量不及预期，但制造费用增长，单位制造费用大幅提升，单位成本上涨导致外延片毛利率下降。

2024年，外延片毛利率同比大幅提升转正，主要系外延片单位成本大幅降低。1)随着主要客户采购需求回暖、公司更多规格外延片量产导入，外延片开始放量，2024年公司外延片销量已达到2023年全年销量的4.8倍，当期单位制造费用同比下降超过50%；2)随着工艺优化和本土原材料导入，外延片单位材料同比下降。前述因素影响下，虽然当年外延片单价同比有所下降，但单位成本降幅比例大于单价，毛利率实现由负转正。

3) 测试片

单位：元/片、%

项目	2024年		2023年		2022年	
	金额	变动率/额	金额	变动率/额	金额	变动率/额
平均单价	273.18	-16.37	326.65	-11.41	368.70	26.57
平均单位成本	268.61	-15.24	316.91	-5.08	333.88	-39.48
毛利率	1.67	-1.31	2.98	-6.46	9.44	98.81

报告期内，测试片中的高端测试片毛利率变化如下：

单位：元/片、%

项目	2024年		2023年		2022年	
	金额	变动率/额	金额	变动率/额	金额	变动率/额
平均单价	355.83	-17.56	431.64	-13.66	499.92	-
平均单位成本	341.37	-14.51	399.29	-9.24	439.94	-
毛利率	4.06	-3.43	7.49	-4.50	12.00	-

2022年，测试片毛利率大幅提升原因与抛光片基本一致。

2023年，测试片毛利率下滑幅度小于抛光片。单价方面，虽然当年高单价的高端测试片收入占比大幅提升，但由于客户对测试片价格敏感度更高，同时本土12英寸硅片友商在低端测试片领域竞争加剧，综合导致测试片单价同比下降幅度超过正片。单位成本方面，公司开始导入成本更优的包装材料，首先经过下游客户许可在非高端测试片中导入，带动测试片单位直接材料同比下降。由于测试片单位成本下降幅度高于抛光片和外延片，一定程度抵消单价同比下降，测试片毛利率当年回落有限。

2024年，虽然工艺优化、原材料多元化导入带动测试片单位直接材料和单位成本同比进一步下降，但由于客户价格敏感和本土友商竞争，测试片单价持续下调，且下调幅度大于单位成本降幅，当期毛利率仍维持回落。

3、同行业可比公司毛利率比较分析

上市公司	2024年	2023年	2022年
沪硅产业	未披露	10.45%	12.35%
SUMCO	18.34%	25.41%	32.50%
环球晶圆	31.62%	37.42%	43.17%
德国世创	19.50%	24.59%	34.09%
平均值	24.98%	24.47%	30.53%
中国台湾及境外可比公司均值	24.98%	29.14%	36.59%
公司	5.49%	0.66%	9.85%

注1：2022年至2023年沪硅产业选取其12英寸硅片产品毛利率。

注2：中国台湾及境外可比公司年报均未披露12英寸硅片数据，选取相应公司综合毛利率。

报告期各期，公司毛利率低于中国台湾及境外可比公司平均水平。主要系：

1) 相应可比公司12英寸硅片技术成熟、工艺稳定，产线建设较早部分固定资产已折旧完毕，且产销规模均远大于发行人，规模效应更强。前述因素综合导致其12英寸硅片单位成本具有更强竞争力；2) 相应可比公司与台积电、三星电子等全球战略级晶圆厂客户长期战略合作，一方面应用于先进制程的高端产品收入贡献高，毛利率更高；另一方面根据公开披露，部分中国台湾及境外可比公司与主要晶圆厂客户签订具有最低采购量的长期协议，在行业下行周期仍能保证产能消

化和规模效应；3）相应可比公司产品毛利率包含 8 英寸及以下产品，对应的产能投资强度小，建设早，大部分固定资产折旧已完结，毛利率水平一般高于 12 英寸硅片。

2022 年及 2023 年，公司毛利率水平低于沪硅产业，主要系公司平均单价低于沪硅产业且平均单位成本相对较高所致。首先，沪硅产业作为国内首家规模化量产 12 英寸硅片的厂商，产品验证和导入具有先发优势，导入正片的规格更丰富，供货比例更高。鉴于正片单价一般高于测试片，同期沪硅产业综合单价均高于发行人。其次，沪硅产业单位成本低于发行人，原因系：1）根据公开资料，沪硅产业 12 英寸硅片 2022 年末产能为 30 万片/月，2023 年末产能为 45 万片/月；公司 2022 年末产能已超过 40 万片/月，2023 年 6 月末产能已达到 50 万片/月，公司产能规模更大，单位制造费用更高；2）公司报告期处于产能爬坡状态，工艺优化和良率提升需要过程，而沪硅产业具有先发优势，工艺和良率同期相对稳定；3）随着公司产品放量、工艺优化和供应商多元化，**公司 2024 年平均单位成本（不考虑存货跌价准备转销等其他影响因素）已低于沪硅产业 2023 年 12 英寸硅片平均单位成本。**

（四）期间费用分析

单位：万元、%

项目	2024 年		2023 年		2022 年	
	金额	营收占比	金额	营收占比	金额	营收占比
销售费用	6,623.03	3.12	5,278.34	3.58	3,326.13	3.15
管理费用	20,827.04	9.82	22,431.23	15.22	17,885.92	16.96
研发费用	25,882.00	12.20	17,142.25	11.63	14,599.00	13.84
财务费用	13,884.80	6.54	5,713.36	3.88	2,889.40	2.74
合计	67,216.87	31.68	50,565.18	34.31	38,700.45	36.69

报告期内，随着公司营业收入快速增长，规模效应逐步体现，各期期间费用率整体呈下降趋势。**2024 年财务费用率略有上涨主要系随着公司第二工厂建设，长期借款增加所致。**具体如下：

1、销售费用

(1) 销售费用明细

单位：万元、%

项目	2024 年		2023 年		2022 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	2,928.02	44.21	2,608.86	49.43	1,834.96	55.17
样品费	2,028.98	30.64	1,007.60	19.09	600.43	18.05
股权激励	533.43	8.05	564.49	10.69	280.43	8.43
业务招待费	297.74	4.50	223.75	4.24	256.42	7.71
销售代理费	255.31	3.85	319.21	6.05	128.89	3.87
其他	579.56	8.75	554.43	10.50	225.00	6.76
合计	6,623.03	100.00	5,278.34	100.00	3,326.13	100.00
销售费用率	3.12		3.58		3.15	
增长率	25.48		58.69		-6.46	

报告期内，公司销售费用以职工薪酬、样品费和股权激励费用为主。

2022年至2024年，销售费用规模随着公司收入规模增长总体呈上升趋势，主要原因：1)市场开拓是产能消化的保障，公司增加具有行业经验的销售人员，扩充售后人员，同时提升绩效薪酬给销售人员充足激励，职工薪酬持续增长；2)样品费为公司针对客户新品免费送样的成本，随着公司更多规格外延片以及新型产品认证导入，样品费亦有所上升。3)授予销售人员股权激励所带来的股份支付费用整体上涨。

随着收入高速增长，公司销售费用率整体呈现下降趋势，体现了规模效应。

(2) 销售费用率和同行业可比公司比较

上市公司	2024 年	2023 年	2022 年
沪硅产业	未披露	2.50%	1.92%
环球晶圆	2.14%	2.21%	2.35%
德国世创	未披露	2.32%	1.90%

平均值	未披露	2.34%	2.06%
中国台湾及境外可比公司均值	2.14%	2.26%	2.12%
公司	3.12%	3.58%	3.15%

数据来源：上市公司公开披露年报。

注：SUMCO 未分别披露管理费用及销售费用数据，此处未进行比较。

报告期内，公司销售费用率高于可比公司平均水平，主要原因：1) 公司放眼全球市场，为保障现有及未来产能消化，面对全球客户市场配置了经验丰富的销售团队，并对不同地区的主要客户针对性服务，销售人员数量逐年增加，职工薪酬及相应股权激励费用逐步提升；2) 公司报告期内处于密集客户认证期，样品费支出贡献了销售费用的一定比例，其他可比公司该类支出预计有限；3) 公司作为行业新进入的“挑战者”，收入规模相比可比公司仍较小。

2、管理费用

(1) 管理费用明细

单位：万元、%

项目	2024 年		2023 年		2022 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	10,382.32	49.85	9,229.81	41.15	6,543.66	36.59
股权激励	3,304.04	15.86	6,202.18	27.65	3,297.05	18.43
折旧及摊销	2,977.84	14.30	2,158.12	9.62	1,863.44	10.42
中介机构费	1,319.90	6.34	2,126.76	9.48	4,080.04	22.81
办公费	808.18	3.88	651.50	2.90	344.24	1.92
保险费	645.24	3.10	615.44	2.74	283.92	1.59
其他	1,389.53	6.67	1,447.44	6.45	1,473.58	8.24
合计	20,827.04	100.00	22,431.23	100.00	17,885.92	100.00
管理费用率	9.82		15.22		16.96	
增长率	-7.15		25.41		91.61	

报告期内，公司管理费用以职工薪酬、股权激励费用、折旧及摊销和中介机构费为主。

2022 年至 2023 年，管理费用整体呈现上升趋势，主要原因为：1) 为适应

规模扩张,公司管理人员数量增加,并对核心高管和管理人员实施股权激励,职工薪酬和股权激励费用持续上升;2)为保障产能建设,报告期内实施三轮股权融资,合计融资 80.05 亿元。此外报告期内,公司实施多次重组,相应资本运作支付的审计、法律、税务、评估、独立第三方财务顾问等专业机构费用较高;3)随着第一工厂及第二工厂建设,新建办公楼投入使用及相应办公设备等相关的折旧摊销费用也贡献了管理费用一定比例。

2024 年,管理费用相较 2023 年略有下降,主要系随着公司经营趋于稳定中介机构费大幅下降以及相应管理人员部分股权激励费用在 2023 年已分摊完毕,从而 2024 年股权激励费用下降。

随着收入高速增长,公司管理费用率整体呈现下降趋势,体现了规模效应。

(2) 管理费用率和同行业可比公司比较

管理费用率			
上市公司	2024 年	2023 年	2022 年
沪硅产业	未披露	8.74%	7.88%
环球晶圆	3.23%	3.46%	2.29%
德国世创	未披露	2.34%	1.87%
平均值	未披露	4.84%	4.01%
中国台湾及境外可比公司均值	3.23%	2.90%	2.08%
公司	9.82%	15.22%	16.96%
扣除股权激励费用后的管理费用率			
上市公司	2024 年	2023 年	2022 年
沪硅产业	未披露	8.66%	7.62%
公司	8.26%	11.01%	13.83%

数据来源:上市公司公开披露年报。

注 1: SUMCO 未分别披露管理费用及销售费用数据,此处未进行比较。

注 2: 中国台湾及境外可比公司未披露管理费用明细,无法计算扣除股权激励费用后的管理费用率。

报告期内,公司管理费用率高于可比公司平均水平,主要系公司收入规模尚需进一步释放且公司股权激励费用及因融资以及重组支付的中介机构费用占比较高所致。扣除股权激励费用后的管理费用率,公司逐渐与沪硅产业水平接近。

3、研发费用

(1) 研发费用明细

单位：万元、%

项目	2024年		2023年		2022年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	9,882.83	38.18	8,529.14	49.76	7,219.72	49.45
物料消耗	7,319.92	28.28	2,419.99	14.12	1,721.70	11.79
折旧及摊销	4,895.78	18.92	2,609.21	15.22	2,548.30	17.46
能源费用	1,516.00	5.86	474.13	2.77	488.67	3.35
股权激励费	1,067.52	4.12	2,011.64	11.73	1,561.24	10.69
其他	1,199.97	4.64	1,098.14	6.41	1,059.37	7.26
合计	25,882.00	100.00	17,142.25	100.00	14,599.00	100.00
研发费用率	12.20		11.63		13.84	
增长率	50.98		17.42		42.40	

公司报告期内不断加大研发投入,保持了较高研发强度。**2022年至2024年**,累计研发投入占累计营业收入的比例为**12.39%**,研发投入复合增长率为**33.15%**。其研发费用主要为职工薪酬、折旧及摊销和物料消耗。

报告期各期,公司研发费用职工薪酬占比高于物料消耗占比,主要系:1)公司组建了行业经验丰富的全球研发团队,提前战略规划技术和专利路线,在工厂建设之初即开展客户导入沟通和技术交流,**2022年及2023年**测试片和抛光片的研发试制成本有限,物料消耗相对较少;**2024年**物料消耗占比相对职工薪酬提升,主要系基于既定产品和技术路线,公司加大更先进制程和特色工艺的外延片和抛光片研发,相应研发项目技术和工艺难度大,研发试制成本高,导致相应物料消耗金额更大。2)根据公司会计政策,实现销售或免费送样的研发试制品成本结转至存货,冲减了研发费用,相应研发试制品成本构成与公司主营业务成本一致,直接材料和制造费用占比较高,若还原研发试制品成本则研发费用结构与可比公司沪硅产业趋同。

报告期内,公司按研发项目独立核算,报告期内累计研发费用投入前十大的

研发项目汇总情况如下:

单位: 万元

项目名称	2024年	2023年	2022年	报告期合计
高性能外延片项目	2,530.41	965.29	2,734.12	6,229.82
CIS 芯片外延重掺片开发项目	2,184.32	1,590.76	1,433.12	5,208.19
轴向均匀性无缺陷晶棒开发项目	2,112.53	1,319.70	361.10	3,793.34
NAND Flash 用抛光片开发项目	1,431.54	390.91	449.44	2,271.88
DRAM 用抛光片产品开发项目	882.29	512.49	562.27	1,957.05
功率器件用抛光片开发项目	838.84	639.42	343.90	1,822.16
功率控制技术开发项目	616.00	541.27	-	1,157.28
CIS 装载用抛光片产品开发项目	607.34	821.01	771.21	2,199.56
立式研磨工艺技术开发项目	141.49	352.02	509.72	1,003.23
基于逻辑片衬底氧沉淀技术开发项目	11.56	156.59	827.64	995.79
前十大合计	11,356.31	7,289.47	7,992.52	26,638.30
前十大合计当年研发费用占比	43.88%	42.52%	54.75%	46.23%

(2) 研发费用率和同行业可比公司比较

上市公司	2024年	2023年	2022年
沪硅产业	未披露	6.96%	5.87%
SUMCO	未披露	1.92%	1.49%
环球晶圆	3.70%	3.35%	2.97%
德国世创	未披露	5.79%	4.96%
平均值	未披露	4.50%	3.82%
中国台湾及境外可比公司均值	3.70%	3.68%	3.14%
公司	12.20%	11.63%	13.84%

数据来源: 上市公司公开披露年报。

报告期内, 公司研发费用率高于同行业可比公司平均水平, 主要系: 1) 公司进入该领域年限较短, 前期基础研发投入大, 且公司收入规模远低于可比公司; 2) 公司持续加大研发投入, 保持研发强度, 一方面积极开发应用于更先进制程

和特色工艺的硅片产品，另一方面不断优化工艺流程，提升投入产出比。

4、财务费用

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	2022 年
贷款的利息支出	19,002.25	11,189.00	3,525.30
租赁负债的利息支出	689.83	565.51	16.05
存款的利息收入	-4,006.31	-6,113.12	-3,257.51
净汇兑亏损/收益	-1,867.04	-73.81	2,319.53
其他财务费用	66.08	145.78	286.03
合计	13,884.80	5,713.36	2,889.40
占营业收入的比例	6.54%	3.88%	2.74%

报告期内，为保障产能建设，公司长期借款金额大幅增加，贷款利息支出大幅上涨，导致整体财务费用逐年增长。

此外，公司涉及进口采购和出口销售，外币结算导致的汇兑损益对公司财务费用也有一定影响。

(五) 利润表其他项目分析

1、其他收益

报告期各期，公司其他收益分别为 1,163.29 万元、3,796.27 万元和 **7,188.97 万元**，占营业收入比例分别为 1.10%、2.58%和 **3.39%**，主要为与资产相关的政府补助，根据对应的固定资产摊销计入其他收益。

2、信用减值损失和资产减值损失

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	2022 年
信用减值损失	126.55	21.75	151.80
其中：应收账款坏账损失	131.13	-3.45	151.76
其他应收款坏账损失	-4.58	25.20	0.03

资产减值损失	25,570.48	33,184.31	26,681.15
其中：存货跌价损失	25,570.48	33,184.31	26,681.15
合计	25,697.03	33,206.06	26,832.94
占营业收入比例	12.11%	22.53%	25.44%

上表可见，报告期内，由于公司固定成本高，半导体行业波动，部分产品存在“负毛利”情况，存货跌价损失对盈利有重要影响。

随着公司营业收入增长，存货跌价损失的营收占比逐年下降，对盈利负面影响不断减弱。尤其是2024年下半年以来，随着主要客户采购回暖和公司更多规格外延片实现量产导入，外延片放量，单位成本大幅下降，对应存货可变现净值回升使得2024年存货跌价损失大幅收窄。存货跌价准备计提的具体情况详见本节之“九、（一）1、（4）存货”。

报告期各期末，发行人已经对资产科目足额计提减值损失。

（六）纳税情况分析

单位：万元

项目	2024年	2023年	2022年
期初应缴所得税余额（a）	-77.47	53.62	-
本年计提应缴所得税金额（b）	-	146.02	55.84
本年实际缴纳金额（c）	-77.47	384.81	2.23
其他影响（d）	-	-107.70	-
期末应缴所得税余额（a+b-c-d）	-	-77.47	53.62

注1：发行人2023年预缴了部分企业所得税，导致2023年末和2024年初余额为负。

注2：其他影响为奕斯伟设备2023年6月30日后出表所致。

注3：2024年，公司2023年预缴的企业所得税金额退回，期末不再存在余额。

2022年及2023年1-6月，公司原子公司奕斯伟设备盈利，计提并实缴所得税。报告期内，发行人及其余子公司均未实现盈利，未缴纳企业所得税。

（七）报告期尚未盈利、最近一期期末存在未弥补亏损的分析

报告期内，公司净利润分别为-53,287.69万元、-68,337.45万元和-73,764.25万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-41,553.42万

元、-69,233.88 万元和-76,255.09 万元。截至 2024 年末,公司合并口径和母公司未弥补亏损分别为-192,750.64 万元和-49,592.97 万元。

1、具体原因

首先,行业投资规模大同时叠加周期波动,公司收入规模需要进一步提升覆盖固定成本。12 英寸硅片在半导体产业链中单位产能投资强度仅次于晶圆厂。报告期内,随着发行人第一工厂(总投资额 110 亿元)产能达产转固以及第二工厂主体房屋建筑物整体转固和产线设备陆续转固(总投资额 125 亿元),发行人计入营业成本的折旧摊销金额持续攀升,增速高于期间营业收入。在波动的半导体行业周期中快速提升收入规模、释放规模效应、覆盖高额固定成本是公司实现盈利的最大挑战。

其次,产能爬坡和研发投入。12 英寸硅片目前主要应用于制程更先进、技术迭代更快的逻辑和存储芯片制造。作为新进入“挑战者”,公司不仅需要快速设备调试、产能爬坡、实现达产,持续提升良率和优化成本,同时需契合下游客户技术路线迭代,持续对拉晶、成型、抛光、清洗和外延五大核心工艺进行大量研发投入。产能爬坡带来的阶段性产销量不足导致生产成本低以及针对核心技术和产品工艺的前期刚性研发投入影响公司短期盈利能力。

第三,产品结构优化,尤其是高端产品放量需要过程。公司作为新进入“挑战者”,产品验证需要遵循客户认证、测试片验证和正片验证主要过程,随着半导体行业波动,以及全球前五大厂商与部分晶圆厂客户在半导体上行周期签订长期协议的“挤出”效应,公司正片产品放量受到影响。报告期内,公司通过技术迭代和客户扩展,正片占主营业务收入比例已超过 55%,先进制程的正片产品实现量产,但正片收入比例仍需提升。尤其是正片中的外延片,应用于先进制程逻辑芯片,在 12 英寸硅片中单价高、技术难度大、客户认证周期长。高端产品收入放量需要过程,目前产品结构尚需优化影响了公司盈利能力。

第四,上述因素带来的存货跌价影响。报告期内,随着公司产能扩张,存货规模大幅提升,各期末存货账面余额分别为 70,948.86 万元、111,910.53 万元和 124,651.02 万元。同时,鉴于产能持续爬坡,公司产品单位固定成本较高,同时叠加行业波动,部分类别产品在报告期内存在负毛利情况,报告期各期直接

影响损益的存货跌价损失分别为 26,681.15 万元、33,184.31 万元和 **25,570.48 万元**，对公司盈利也有一定影响。

2、影响分析

报告期内，公司通过股权和债务融资方式获得较为充裕的现金流，用来保障产能建设、研发投入和业务运营，通过股权激励等方式引进优秀人才、保障公司现有团队的稳定。目前公司客户储备、产品技术、产能和产量规模均处于国内领先地位，经营性现金流和息税折旧摊销前利润报告期内均已经实现转正。

现金流方面：截至 2024 年末，公司货币资金余额 **335,004.52 万元**，资产负债率为 **51.13%**，负债水平合理，偿债能力较强。公司经营性现金流量净额由 2022 年的 0.47 亿元上升至 2024 年的 **8.15 亿元**，经营性现金流量净额的持续增长为公司带来可持续的经营性现金流入能力。同时，公司已通过长期借款等方式，较好地保障了公司未来的资金需求。报告期各期，公司偿债能力良好，不存在逾期未偿还、无法继续履行重大借款合同中的有关条款、无法获得研发所需资金等严重影响公司持续经营能力的情况。

业务拓展方面：公司具有中国大陆最大规模的 12 英寸硅片产能，国内一线晶圆厂客户几乎全覆盖，国际战略级客户持续导入。截至 2024 年末，公司已通过验证的客户累计 **144 家**，其中中国大陆客户 **108 家**，中国台湾及境外客户 **36 家**；已通过验证的测试片超过 **390 款**，量产正片超过 **90 款**，其中中国大陆客户正片已量产 **80 余款**，中国台湾及境外客户正片已量产近 **10 款**。目前公司量产正片已覆盖国内一线存储 IDM 厂商和逻辑晶圆代工厂的大多数主流工艺平台，已成为国内主流存储 IDM 厂商全球 12 英寸硅片厂商中供货量第一或第二大的供应商，已成为国内一线逻辑晶圆代工厂中国大陆 12 英寸硅片供应商中供货量第一或第二大的供应商，正片已进入客户 D、客户 O、客户 P 等全球战略级客户，测试片几乎覆盖了全球所有一线晶圆厂客户。由于 12 英寸硅片行业认证周期长，具有较高的客户粘性，公司的客户数量和与客户的稳定合作关系，产能持续扩张。

人才吸引和团队稳定性方面：公司拥有一支有成功运营半导体产业丰富经验的优秀管理团队，具备一流的战略运筹、市场开拓、技术研发和运营管理能力。

公司核心管理团队具有丰富的重资产半导体产业成功运营经验,在客户开拓、技术研发、工厂建设、生产管理、工艺提升、质量管理、自动化布局等方面具有深厚的产业运营经验。公司的研发团队由海内外具有丰富电子级硅片成功量产经验的专家团队组成,相关人员在五大核心工艺环节均拥有深厚的技术背景及成熟量产经验。公司核心技术人员保持稳定,与公司签订了保密与竞业禁止协议。同时,为最大限度的激励研发人员的主观能动性、保持技术研发团队的稳定性,公司对主要技术研发人员实施了股权激励。公司充分重视人才培养及技术团队梯次化配置,在设立之初即开展人才培养储备工作,持续提升公司的技术人才储备纵深。

研发投入方面:报告期各期,发行人研发投入分别为 14,599.00 万元、17,142.25 万元和 **25,882.00 万元**,发行人研发活动有序推进,产品技术不断迭代,产品已覆盖国内客户最先进制程,并实现了中国台湾及境外战略级客户量产导入,相应研发费用属于前期投入,有利于公司客户导入、工艺优化和高端产品放量,是未来盈利的保障。

产能投入方面:报告期内,公司持续进行产能扩张及建设投入。报告期各期,公司购建固定资产和其他长期资产支付的现金分别为 **353,928.74 万元**、**374,152.95 万元**和 **209,141.61 万元**,尤其自 2022 年四季度以来,半导体行业整体进入暂时性回调,下游需求短期下降,公司仍进行逆周期投资,持续进行固定资产和研发投入,为 2024 年以后行业逐渐回暖的情况下发行人各类产品迅速放量奠定了基础。

生产经营可持续性方面:报告期各期,发行人 12 英寸硅片产销量不断上升,自 2022 年 234.62 万片上升至 2024 年 625.46 万片,增长率为 **166.58%**,发行人营业收入随之快速增长。随着发行人销售规模提升及产品结构不断改善,第一工厂生产稳定性及生产效率进一步提升,第二工厂产能上升,发行人收入规模将持续增长,盈利能力进一步释放,发行人生产经营的可持续较强。

截至本招股说明书签署日,发行人尚未盈利、存在累计未弥补亏损未对发行人现金流、研发投入、人才吸引、核心团队稳定性和生产经营可持续性产生显著不利影响。

3、趋势分析

发行人管理层预计，公司**最早于 2026 年**合并报表可实现盈利，实现盈利的相关具体假设如下：

(1) 发行人收入预测的相关假设及依据

1) 销量及产品结构假设及依据

通过技术革新和效能提升，公司已将第一工厂 50 万片/月产能提升至 60 万片/月以上，预计 2026 年公司第一和第二两个工厂合计可实现 120 万片/月产能。根据 SEMI 对下游 12 英寸晶圆厂客户产能进度预测、公司不同细分品类产品在下游客户中的导入验证情况和销售计划、公司产能建设和生产安排，保守估计公司 2026 年可实现约 110 万片/月的 12 英寸硅片月均出货量，其中外延片销量占比提升至 20%-30%，抛光片及高端测试片销量占比提升至 60%以上。

2) 价格预测假设及依据

2025 年价格预测：考虑 2024 年半导体行业尚在景气度恢复期、12 英寸硅片回暖的滞后性以及国内外友商竞争格局，同时结合公司 2024 年末在手订单实际情况，出于谨慎性预期，2025 年各类产品平均价格相比 2024 年下降约 5%。但随着高单价正片产品销量占比的提升，综合单价同比 2024 年略有上涨。

2026 年价格预测：根据 SEMI 预测，2026 年半导体行业的景气度持续回暖。基于谨慎性预期，发行人各类产品与 2025 年单价持平，随着产品结构持续优化，综合单价同比 2025 年略有增长。

(2) 发行人成本费用预测的相关假设及依据

人工成本：根据公司人力资源计划，预测各年公司员工数量以及相应岗位的平均人工成本确认各年的总人力成本。根据相应人员所属成本中心(制造、管理、研发、销售等)进行相应归集分摊，其中生产人员按照各工序段所需的计划人员占比分摊至不同品类产品中。

材料成本：根据目前公司各类产品的实际 BOM、工艺优化，预测不同品类产品未来 BOM 和投入产出率，结合年度不同产品的预测销量确认相应产品的直

接材料成本。

折旧摊销：2025 年第一工厂折旧摊销预测期基本稳定，2026 年根据公司产能扩产需求和瓶颈工序产能情况，预计新增少量设备。第二工厂根据设备到场和安装调试计划预测转固时点，并根据转固资产相应属性、生产设备所属工序段情况进行相应归集分摊至制造费用、研发费用、管理费用等。

其他费用：包括动力费、备品备件费、消耗品费用、经费等，相应费用根据历史情况以及未来各年生产计划、人员计划、设备到场计划等预测各部门、各属性费用计划，并依据各部门、各工序段消耗比例进行归集分摊。

财务费用：不考虑上市融资的情况下，根据未来各年的资金安排计划，确认相应的财务费用。

(3) 公司预计最早于 2026 年可实现合并报表盈利

公司管理层根据产能建设及投放、技术研发、客户验证和销售计划，预计公司最早可于 2026 年实现合并报表盈利。

根据公司前瞻性信息预计，2026 年月均出货量达到 110 万片/月，当年外延片销量占比达到 15%是大致的盈亏平衡点。若 2026 年因外部环境原因业绩不达预期，在 2027 年各类产品单价与 2026 年一致的假设下，进一步考虑 2027 年的折旧摊销、期间费用等因素，当 2027 年月均出货量进一步提升至超过 120 万片/月，外延片销量占比达到 15%可实现当年合并报表盈利。

公司上述前瞻性信息是建立在推测性假设的数据基础上的预测，具有重大不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。

九、资产质量分析

(一) 资产构成分析

单位：万元、%

项目	2024/12/31		2023/12/31		2022/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	517,525.22	29.71	371,675.17	23.98	690,272.49	44.98

非流动资产	1,224,671.45	70.29	1,178,087.26	76.02	844,488.60	55.02
资产合计	1,742,196.67	100.00	1,549,762.42	100.00	1,534,761.09	100.00

报告期各期末，随着公司产能和业务扩张，资产规模整体呈现上升趋势，且以非流动资产为主。

2022年末，公司完成B+和C1轮市场化融资以及就第一工厂建设借入长期借款，资产规模提升，流动资产占比较高。

2023年末，公司完成CII轮市场化融资，同时现金回购奕斯伟硅片少数股权，期末总资产规模同比持平。随着第一工厂在2023年6月末实现达产以及第二工厂建设，非流动资产占比大幅提升。

2024年末，公司第二工厂建设借入长期借款，同时随着产能规模提升及下游市场回暖，收入增长导致应收账款及存货均有所增加，资产规模同比增长，流动资产占比增加。

公司资产构成以及报告期内的构成变化符合重资产运营模式以及产能爬坡的业务特点。

1、流动资产结构分析

报告期内，公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货组成，相应科目各期流动资产总计占比均在90%以上，具体如下：

(1) 货币资金

单位：万元、%

项目	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
银行存款	326,431.96	207,830.98	571,020.24
其他货币资金	8,572.55	9,240.50	3,734.68
合计	335,004.52	217,071.49	574,754.91
增长率	54.33	-62.23	242.23
占总资产比例	19.22	14.01	37.45

货币资金是公司产能建设的前提，公司报告期内通过股权和债权融资用于第

一和第二工厂建设，货币资金是报告期各期末流动资产的最大科目。

2022年末，公司货币资金同比大幅提升，主要系公司2022年当年B+轮和C1市场化融资合计57.05亿元，同时第一工厂建设的长期借款当年放款。

2023年末，公司完成CII轮市场化融资合计23.00亿元，但支付约42亿元回购子公司奕斯伟硅片少数股东权益，当期货币资金同比下降较大。

2024年末，随着第二工厂建设所需长期借款资金陆续到位，公司货币资金同比增长。

公司其他货币资金均为使用受限制的货币资金，由存放在商业银行的信用证、保函及银行承兑汇票保证金构成，由于公司需进口采购大量设备和原材料，其他货币资金维持一定规模。

(2) 应收账款

单位：万元、%

项目	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
账面余额	63,576.11	35,358.65	39,438.96
减：坏账准备	332.19	201.06	204.50
账面价值	63,243.92	35,157.59	39,234.45
增长率	79.89	-10.39	315.12
占总资产比例	3.63	2.27	2.56
营业收入	212,145.26	147,376.14	105,469.31
营业收入同比增长率	43.95	39.73	408.29
应收账款周转率	4.29	3.94	4.31

1) 账面价值分析

报告期内，公司收款均采用银行转账方式，不存在应收票据及应收款项融资。报告期各期末，随着收入扩大，公司应收账款规模持续攀升。公司下游客户均为境内外主流晶圆厂，信用良好，付款稳定，始终保持良好的应收账款周转水平。2024年末应收账款余额同比2023年大幅提升，主要原因是，随着2024年行业回暖和产能继续扩张，发行人各季度收入呈现高于前一季度的特征，当期第四季

度收入创历史单季度新高,约7亿元,同比2023年第四季度上涨近90%,年末确认的大量应收账款尚在信用期内未结算。

2) 应收账款账龄分析

单位:万元、%

期间	2024/12/31		2023/12/31		2022/12/31	
	应收账款	余额占比	应收账款	余额占比	应收账款	余额占比
0-3月	62,596.52	98.46	33,890.21	95.85	37,977.58	96.29
3-6月	863.26	1.36	1,045.41	2.96	1,461.37	3.71
6-12月	111.32	0.18	423.03	1.20	-	-
1年以上	5.01	0.01	-	-	-	-
合计	63,576.11	100.00	35,358.65	100.00	39,438.96	100.00

报告期各期末,公司账龄3个月以内的应收账款余额占比均在95%以上,账龄6个月以内的应收账款余额占比均在98%以上,账龄分布良好。

3) 应收账款对象分析

报告期各期末,公司应收账款账面余额占比前五名的客户如下:

单位:万元

报告期	公司名称	账面余额	应收账款余额占比
2024/12/31	客户 B1	11,022.76	17.34%
	客户 A1	8,005.80	12.59%
	客户 A2	4,145.76	6.52%
	客户 D1	3,107.04	4.89%
	客户 C2	2,932.35	4.61%
	合计	29,213.71	45.95%
2023/12/31	客户 B1	4,178.10	11.82%
	客户 A2	3,775.16	10.68%
	SVM	3,133.49	8.86%
	客户 D1	2,938.87	8.31%

	晶合集成	2,906.88	8.22%
	合计	16,932.50	47.89%
2022/12/31	客户 A3	6,991.89	17.73%
	客户 B1	6,850.30	17.37%
	客户 A2	4,712.28	11.95%
	客户 D1	4,704.29	11.93%
	上海华力集成电路制造有限公司	1,735.56	4.40%
	合计	24,994.33	63.38%

4) 应收账款质量分析

报告期各期末，公司与可比公司坏账准备计提比例对比如下：

项目	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
沪硅产业	未披露	1.89%	0.34%
环球晶圆	0.11%	0.19%	0.09%
德国世创	未披露	-	-
平均值	0.11%	0.69%	0.15%
中国台湾及境外可比公司均值	0.11%	0.10%	0.05%
公司	0.52%	0.57%	0.52%

注 1：数据来源于可比公司年报。

注 2：中国台湾及境外可比公司中，SUMCO 未单独披露应收账款坏账计提金额，仅合并披露 Allowance for doubtful accounts 金额，计提比例约 0.01%，考虑可比性上表未列示；德国世创 2022 年及 2023 年未计提坏账准备；环球晶圆仅披露应收票据和应收账款等合并计提的坏账准备，未进一步区分，相应计算的分子分母口径为应收票据和应收账款合并金额。

报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提比例高于中国台湾及境外可比公司均值，低于沪硅产业，报告期内公司应收账款坏账已充分计提，主要系：1) 报告期各期末，公司 95%以上应收账款的账龄集中在 3 个月内，98%以上集中在 6 个月内；2) 公司与沪硅产业坏账计提比例不存在显著差异，具体详见本节之“四、（四）1、（2）按照组合计提的金融工具”；3) 截至 2025 年 2 月末，2022 年末应收账款期后回款比例均为 100%，2023 年末应收账款期后回款比例超过 99%，2024 年末应收账款期后回款比例超过 70%，公司应收账款期后回款情况良好。

(3) 预付账款

单位：万元、%

项目	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
预付原材料款	3,522.27	3,610.76	8,867.75
其他	167.90	71.27	361.36
合计	3,690.18	3,682.02	9,229.11
增长率	0.22	-60.10	98.35
占总资产比例	0.21	0.24	0.60

报告期各期末，公司预付账款主要为预付原材料款，其他为备品备件维修费用、燃气费等。

2022年，随着公司高速扩张及产能提升，公司为未来生产储备的原材料及备品备件大幅增长，2022年末预付原材料采购款随之同比大幅提升。

2023年末，公司预付账款金额同比下降，主要系随着半导体行业进入下行周期，公司综合考虑目前已有原材料、备品备件和未来生产销售计划，优先使用现有存货进行排产并相应控制存货规模，从而使得原材料预付款有所下降。

2024年末，公司预付账款余额与2023年末持平，1年以内预付账款余额占比在80%以上，一年以上的预付账款主要为尚未交货预付原材料款。

(4) 存货

单位：万元、%

项目	2024/12/31		2023/12/31		2022/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	41,556.62	33.34	29,407.76	26.28	29,962.48	42.23
备品备件及低值易耗品	26,337.23	21.13	25,586.40	22.86	13,994.38	19.72
在产品	22,064.48	17.70	24,942.84	22.29	9,337.28	13.16
库存商品	26,426.02	21.20	20,874.42	18.65	16,090.69	22.68
发出商品	8,266.67	6.63	11,099.11	9.92	1,564.03	2.20

合计	124,651.02	100.00	111,910.53	100.00	70,948.86	100.00
存货跌价准备	18,417.35	14.78	23,041.93	20.59	14,344.92	20.22
账面价值	106,233.67	85.22	88,868.60	79.41	56,603.94	79.78
增长率	19.54%		57.00		293.56	
占总资产比例	6.10		5.73		3.69	
营业收入	212,145.26		147,376.14		105,469.31	
营业收入同比增长率	43.95		39.73		-	
存货周转率	1.69		1.59		2.03	

1) 存货构成分析

2022 年末至 2024 年末，随着公司产能扩张，业务规模增长，存货余额增长 53,702.16 万元。其中，主要存货科目增长及贡献占比如下：

单位：万元

项目	同比增加余额	占存货同比增加余额比例
原材料	11,594.15	21.59%
备品备件及低值易耗品	12,342.85	22.98%
在产品	12,727.20	23.70%
库存商品及发出商品	17,037.97	31.73%
合计	53,702.16	100.00%

报告期内，公司原材料余额整体增加，余额占比整体下降。主要原因：①2024 年末公司期末产能已超过 70 万片/月，考虑生产周期以及下游客户采购的连续性，公司结合现有产能规模、客户需求加大对储备原材料安全库存；②对于核心物料电子级多晶硅，全球供应商较为集中，公司基于供应链稳定和自身销售预期，与部分电子级多晶硅原厂签订具有指导采购量的长期协议。截至 2024 年末，电子级多晶硅占公司原材料余额的比例超过 70%；③原材料余额占比整体下降符合产能爬坡的特点，公司采购和排产衔接不断优化，运营效率不断提升。

报告期内，公司备品备件及低值易耗品大幅增加，余额占比基本稳定。主要原因为：部分备品备件如石墨热场、石英制品等属于基于公司自主设计的定制化

产品,且全球能稳定提供相应高品质定制备品备件的供应商较少,大部分需进口采购,产品交货周期较长,公司结合自身产能情况通常与供应商在第四季度确定下一年采购总量并签订订单,一次性集中采购;随着公司产能迅速扩张,为保证公司生产经营连续稳定,相应备品备件采购金额持续加大,并维持一定库存水平。

报告期内,公司在产品余额整体增长,余额占比先升后降,主要原因为:①随着公司产能扩张,考虑生产周期和生产连续性,需要为下游客户储备一定时间的产能库存;②2023年外延片订单量不足,公司备产的部分外延片在产品无法根据客户定制化需求完成全部工序生产,暂以在产品的形态存放。2024年,随着公司外延片订单放量,部分外延片在产品继续加工结转库存商品,期末在产品金额同比2023年末有所下降。

报告期内,公司库存商品及发出商品金额整体增加,其中发出商品余额占比提升,主要原因为:①部分主要客户逐步采用寄售模式,寄售涉及的发出商品占2024年末发出商品余额比例超过90%;②随着产能扩张以及订单放量,公司为及时响应客户需求生产的库存商品数量相应增加。报告期各期末,公司在手订单金额能够覆盖相应发出商品及库存商品余额。

2) 存货跌价计提情况

报告期各期末,公司基于部分产品负毛利的情况,足额计提存货跌价准备。2024年末,随着发行人产品负毛利情况的逐步好转,存货跌价准备余额有所下降。报告期各期末,公司存货跌价准备余额具体如下:

单位:万元、%

项目	2024/12/31		2023/12/31		2022/12/31	
	跌价准备	计提比例	跌价准备	计提比例	跌价准备	计提比例
原材料	3,603.43	8.67	3,884.89	13.21	6,139.78	20.49
备品备件及低值易耗品	1.18	0.00	60.68	0.24	13.78	0.10
在产品	4,967.95	22.52	9,411.41	37.73	2,585.93	27.69
库存商品	9,130.40	34.55	9,678.92	46.37	5,144.90	31.97

发出商品	714.39	8.64	6.02	0.05	460.51	29.44
合计	18,417.35	14.78	23,041.93	20.59	14,344.92	20.22

报告期内，发行人采用的存货跌价准备计提政策详见本节之“四、（四）2、存货跌价准备”。报告期各期末，发行人存货跌价准备计提比例高于同行业可比公司的平均水平，但**2024年末已与可比公司环球晶圆基本一致**。具体如下：

公司	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
沪硅产业	未披露	6.67%	3.89%
SUMCO	未披露	3.03%	2.65%
环球晶圆	13.01%	14.00%	11.49%
德国世创	未披露	5.05%	3.78%
平均值	13.01%	7.19%	5.45%
中国台湾及境外可比公司均值	13.01%	7.36%	5.97%
公司	14.78%	20.59%	20.22%

注 1：数据来源于可比公司年报。

注 2：中国台湾及境外可比公司中，SUMCO 及环球晶圆存货跌价准备余额依据递延所得税资产明细和有效所得税率计算得出；德国世创未披露存货跌价准备余额，上表中用当期存货跌价损失/存货账面价值指标替代。

报告期内，随着已计提存货跌价准备的存货实现销售或产品销售毛利改善，相应存货跌价准备转销或转回，具体政策详见本节之“四、（四）、2、存货跌价准备”。报告期内，公司存货跌价准备计提、转销和转回情况如下：

单位：万元

项目	2024/12/31 /2024 年	2023/12/31 /2023 年	2022/12/31 /2022 年
期初存货跌价准备余额	23,041.93	14,344.92	6,028.46
本期计提	31,443.49	33,343.89	26,704.54
存货跌价准备转回或转销	36,045.45	24,646.88	18,388.08
其他减少	22.61	-	-
期末存货跌价准备余额	18,417.35	23,041.93	14,344.92

注：其他减少为备品备件及低值易耗品的报废核销。

（5）其他应收款

报告期各期末,公司其他应收款主要是应收保证金、押金和备用金,金额较小,占总资产比例不足0.2%。报告期各期末,公司不存在其他应收关联方款项。

(6) 其他流动资产

单位:万元、%

项目	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
待抵扣进项税额	5,338.38	23,778.67	9,653.54
预缴所得税	-	77.47	-
合计	5,338.38	23,856.15	9,653.54
增长率	-77.62	147.12	135.93
占总资产比例	0.31	1.54	0.63

报告期各期末,公司其他流动资产主要为待抵扣进项税额。2022年末至2023年末,随着经营规模扩大以及公司第一和第二工厂的建设,公司原材料采购金额以及机器设备采购金额持续增长,待抵扣进项税额逐年上升。

2024年末,公司第二工厂完成产线试车,主要房屋建筑物及8万片/月产能的机器设备已转固,暂未进入后续产能提升阶段的机器设备密集采购搬入期,待抵扣进项税额下降。

2、非流动资产结构分析

报告期各期末,公司非流动资产以固定资产、在建工程及其他非流动资产为主,前述三项资产占非流动资产合计比例均在94%以上,具体分析如下:

(1) 固定资产

单位:万元、%

项目	2024/12/31		2023/12/31		2022/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
账面原值合计	1,278,672.56	100.00	906,951.43	100.00	753,762.91	100.00
房屋及建筑物	192,008.65	15.02	104,047.31	11.47	103,894.87	13.78
机器设备	1,064,918.26	83.28	785,790.16	86.64	637,720.69	84.60
运输设备	75.28	0.01	75.28	0.01	75.28	0.01

办公设备及其他	21,670.36	1.69	17,038.68	1.88	12,072.06	1.60
累计折旧合计	240,630.79	18.82	148,206.83	16.34	72,980.74	9.68
账面价值合计	1,038,041.77	81.18	758,744.61	83.66	680,782.16	90.32
增长率		36.81		11.45		-
占总资产比例		59.56		48.96		44.36

报告期各期末, 固定资产是公司最大的资产科目, 基本占到总资产规模的一半, 符合重资产业务模式特点。随着公司产能扩张, 固定资产原值持续增长。公司固定资产主要为机器设备。**截至 2024 年末, 机器设备原值占固定资产原值比例为 83.28%。**

截至 2024 年末, 公司涉及抵押的房屋及建筑物账面价值为 **91,531.58 万元**, 占同期房屋及建筑物账面价值的比例为 **49.98%**; 公司涉及抵押的机器设备账面价值为 **216,644.13 万元**, 占同期机器设备账面价值的比例为 **25.52%**; 公司未办妥产权证书的固定资产账面原值为 **80,127.56 万元**, 主要为第二工厂相关房屋建筑物。**截至本招股说明书签署日, 相应房屋建筑物产权均已办理完毕。**

(2) 在建工程

单位: 万元、%

项目	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
西安奕斯伟硅产业基地项目	23,112.74	41,818.24	83,585.06
西安奕斯伟硅产业基地项目二期	65,609.08	266,298.14	397.10
其他	-	1,525.66	4,880.75
合计	88,721.82	309,642.05	88,862.91
增长率	-71.21	248.45	57.61
占总资产比例	5.09	19.98	5.79

报告期各期末, 公司在建工程余额与第一工厂、第二工厂的建设及转固进度基本匹配。随着第一工厂机器设备陆续转固, 产能提升, 报告期各期末第一工厂在建工程余额逐年下降。**截至 2024 年末, 公司第一工厂存在少量仍在调试过程中的机器设备暂未完成转固, 不影响第一工厂整体产能达产和提升。**

2023 年末, 随着第二工厂建设的推进, 第二工厂期末在建工程余额持续增

加。2024年，随着第二工厂厂房建设以及首次产线试车完成，相应房屋建筑物及机器设备转固，**2024年末**第二工厂在建工程金额大幅下降。

2022年末在建工程中的其他主要是公司原子公司奕斯伟设备购入的暂未调试完成的设备。2023年末在建工程中的其他主要为公司购入的暂未调试完成的软件系统。

(3) 使用权资产

单位：万元、%

项目	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
关联租赁	19,174.01	19,174.01	-
其他租赁	125.45	827.20	700.91
账面原值合计	19,299.45	20,001.21	700.91
累计折旧合计	1,861.75	1,247.62	178.24
账面价值合计	17,437.71	18,753.59	522.66
增长率	-7.02	3,488.09	1,894.47
占总资产比例	1.00	1.21	0.03

报告期内，公司存在向第三方租赁办公室、仓库等情形。

2022年起，公司向西安美恩环保科技有限公司和西安烽火数字技术有限公司租赁库房存放存货，随着第二工厂建设及新建仓库陆续投入使用，公司仓库库容逐渐释放。**截至2024年末**，公司已不存在于租赁库房存放存货的情形。

2023年和**2024年**，公司向关联方西安奕斯伟产业公司租赁宿舍和临时仓库，向京东贝（北京）光电科技有限公司租赁办公房屋用于北京分公司开展业务。就上述事项，公司确认使用权资产及租赁负债，明细如下：

单位：万元

承租方名称	出租方名称	租赁资产分类	年份	应支付的租金及相关费用	承担租赁负债利息支出	增加的使用权资产
奕斯伟材料、奕斯伟	西安奕斯伟产业公司	房屋租赁	2024年	1,804.38	670.83	-
			2023年	758.75	530.05	18,819.12

硅片						
奕斯伟材料	京东贝(北京)光电科技有限公司	办公区租赁	2024年	83.64	10.34	-
			2023年	83.22	11.89	354.89

(4) 无形资产

单位：万元、%

项目	2024/12/31		2023/12/31		2022/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
账面原值合计	26,596.12	100.00	22,225.57	100.00	18,391.08	100.00
土地使用权	16,155.24	60.74	16,124.06	72.55	12,808.20	69.64
计算机软件及其他	10,440.88	39.26	6,101.51	27.45	4,082.88	22.20
专利权与非专利技术	-	-	-	-	1,500.00	8.16
累计摊销合计	3,743.82	14.08	2,440.54	10.98	1,944.76	10.57
账面价值合计	22,852.30	85.92	19,785.02	89.02	16,446.32	89.43
增长率	15.50		20.30		-0.58	
占总资产比例	1.31		1.28		1.07	

公司无形资产主要为土地使用权、计算机软件及其他(主要为所购买的排污许可权)。

2023年末,公司专利权与非专利技术减少1,500万元,系2023年6月30日起,奕斯伟设备不再纳入公司合并范围,奕斯伟设备于2020年8月作价1,500.00万元受让的拉晶设备相关非专利技术出表所致。

2024年末,公司无形资产账面原值增加,主要系随着公司第二工厂建设,软件系统等由在建工程转入无形资产所致。

截至2024年末,公司涉及抵押的土地使用权账面价值为9,271.48万元,占同期土地使用权账面价值的比例为64.37%。

(5) 其他权益工具投资

2023年末及2024年末,公司存在一项按公允价值计量且其变动计入其他

综合收益的其他权益工具投资，系公司持有的芯晖装备参股权，账面余额分别为17,764.75万元及**15,097.46万元**，占总资产比例较小，其源于2023年6月公司以其持有的奕斯伟设备75%股权认购芯晖装备12.49%股权，具体详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、（四）2023年6月，发行人以所持奕斯伟设备75%股权认购芯晖装备股权”。根据天健兴业出具的评估报告（天兴评报字[2024]第1981号），**2024年**发行人持有的芯晖装备参股权经收益法评估减值2,667.29万元，相应金额计入其他综合收益。

（6）其他非流动资产

单位：万元、%

项目	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
预付长期资产采购款	28,089.77	41,620.31	53,809.21
预付长期原材料采购款	6,955.74	8,215.41	4,065.33
中介机构服务费	1,322.36	223.41	-
大额存单	1,053.22	1,000.00	-
减：一年内到期的预付原材料采购款	1,276.66	1,887.48	-
总计	36,144.42	49,171.66	57,874.54
增长率	-26.49	-15.04	-42.70
占总资产比例	2.07	3.17	3.77

公司其他非流动资产主要为预付长期资产采购款及向某电子级多晶硅原厂预付的长期原材料采购款。

预付长期资产采购款：**报告期各期末**，随着公司第一工厂达产、第二工厂暂未进入产能进一步扩张阶段，公司预付设备采购款持续下降。

预付长期原材料采购款：**2022年及2024年**公司与某电子级多晶硅原厂供应商签订了约定指导价格和设定**2024至2028年**年度指导采购量的长期协议及**补充协议**。**2022年**和**2023年**，公司根据协议约定向该供应商分别预付了一定比例的材料采购款，相应款项不可退还、无条件且不可撤销，公司定期采购金额可从相应材料预付款中抵扣。**2024年**随着公司履行长期协议，相应预付长期原

材料采购款金额下降。

(二) 负债构成分析

单位：万元、%

负债	2024/12/31		2023/12/31		2022/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	274,485.40	30.82	225,473.52	35.94	186,478.43	51.38
非流动负债	616,229.91	69.18	401,883.45	64.06	176,427.68	48.62
负债总计	890,715.31	100.00	627,356.96	100.00	362,906.11	100.00

报告期内，随着业务扩张和产能建设，公司负债同步快速增长。负债结构由流动负债为主转换为非流动负债为主，主要系公司第一和第二工厂建设增加长期借款所致。

1、流动负债结构分析

(1) 短期借款

报告期各期末，公司短期借款分别为 11,838.06 万元、7,624.33 万元及 0.00 万元，主要为银行借款和信用证，不存在逾期未偿还的短期借款。

(2) 应付票据

报告期各期末，公司应付票据分别为 0.00 万元、5,595.53 万元及 9,954.27 万元，系公司考虑自身资金周转，采用银行承兑汇票支付部分供应商货款，期末应付票据均为一年内到期的应付票据。

(3) 应付账款

单位：万元、%

项目	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
应付关联方款项	-	29.04	200.37
应付第三方款项	56,147.20	16,295.75	24,370.76
合计	56,147.20	16,324.79	24,571.13
增长率	243.94	-33.56	311.01

占总负债比例	6.30	2.60	6.77
--------	------	------	------

1) 账面价值及账龄分析

报告期各期末,随着公司产能爬坡,业务扩张,应付原材料款大幅提升,99%以上的账龄均为1年以内,不存在偿付风险。

单位:万元、%

账龄	2024/12/31		2023/12/31		2022/12/31	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比
1年以内	55,994.93	99.73	16,307.37	99.89	24,480.75	99.63
1年以上	152.26	0.27	17.42	0.11	90.38	0.37
合计	56,147.20	100.00	16,324.79	100.00	24,571.13	100.00

2) 应付账款对象分析

报告期各期末,公司应付账款余额占比前五名的供应商均为公司非关联方,具体如下:

单位:万元

报告期	公司名称	账面余额	应付账款余额占比
2024/12/31	供应商 A	12,649.85	22.53%
	鑫华半导体	6,790.75	12.09%
	供应商 D1	3,271.25	5.83%
	供应商 N	2,915.59	5.19%
	蒲城鲲鹏半导体材料有限公司	2,851.99	5.08%
	合计	28,479.43	50.72%
2023/12/31	鑫华半导体	2,591.24	15.87%
	供应商 N	1,778.96	10.90%
	国网陕西省电力有限公司	1,252.89	7.67%
	蒲城鲲鹏半导体材料有限公司	939.57	5.76%
	供应商 O	543.52	3.33%
	合计	7,106.17	43.53%

2022/12/31	供应商 A	5,599.54	22.79%
	供应商 O	2,019.40	8.22%
	锆明电子科技(上海)有限公司	1,143.15	4.65%
	供应商 C	958.27	3.90%
	鑫华半导体	937.16	3.81%
	合计	10,657.52	43.37%

(4) 其他应付款

单位：万元、%

项目	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
应付工程设备款	97,927.77	143,352.08	104,169.62
其他	5,324.70	6,954.82	10,765.81
合计	103,252.47	150,306.89	114,935.43
增长率	-31.31	30.78	80.52
占总负债比例	11.59	23.96	31.67

报告期各期末,公司其他应付款主要为应付工程设备款,随着公司第一工厂、第二工厂的建设进展波动。其他应付款中的其他主要包含物流费、物业费、投标保证金等,整体保持在合理水平。

报告期内,公司存在向关联方采购设备、关联方替公司代为缴付社保公积金及向关联方支付物业租赁费等情形,应付关联公司款分析详见本招股说明书“第八节 公司治理与独立性”之“七、(三)8、(2)应付关联方款项”。

2、非流动负债结构分析

(1) 长期借款

单位：万元、%

项目	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
抵押借款	489,128.96	270,658.85	127,018.85
信用借款	191,788.69	139,653.67	70,352.72
减：一年内到期的长期借款	94,158.02	36,933.24	27,225.04

合计	586,759.64	373,379.28	170,146.53
增长率	57.15	119.45	-
占总负债比例	65.88	59.52	46.88

报告期各期，公司长期借款金额持续增长，主要系公司以部分固定资产、无形资产为抵押，基于产能建设、运营资金补充、奕斯伟硅片少数股权收购等合理商业需求向国内主要商业银行借入长期借款所致。

(2) 递延收益

单位：万元、%

项目	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
与资产相关政府补助	11,806.36	9,971.39	5,732.42
与收益相关政府补助	-	-	200.00
总计	11,806.36	9,971.39	5,932.42
增长率	18.40	68.08	-
占总负债比例	1.33	1.59	1.63

报告期内，公司递延收益均为政府补助，主要项目余额具体如下：

单位：万元

项目	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
2023年度外经贸发展专项资金（中央）进口资产补贴	2,784.53	3,168.60	-
奕斯伟西安硅片产业基地（二期）项目建设奖励政策补贴	1,916.67	-	-
2023年市工业（中小企业）发展专项资金	1,766.67	1,966.67	-
2022年度省级外贸发展促进专项资产补贴	943.34	1,065.08	1,186.82
陕西省“高端集成电路与先进半导体器件”科技重大专项定向委托补贴	909.83	1,049.83	1,189.83
2020年度陕西省外经贸发展专项资金进口补贴	751.74	860.43	969.11

关键核心技术产业化“揭榜挂帅”项目资金	500.00	-	-
2021年先进制造业支持政策资金	373.45	414.49	455.54
2022年陕西省省级产业结构调整引导专项资金	352.17	410.87	450.00
2023年度市级外经贸发展专项资金(对外贸易发展项目)	308.71	-	-
陕西省省级产业发展专项资金(工业转型升级资金)	277.48	325.05	372.61
2022年陕西省中小企业发展专项资金(含县域高质量发展专项)中小企业技术改造补贴	205.85	235.92	265.99
陕西省中小企业发展专项资金管理办法补贴	124.50	142.69	160.88
2020年度陕西省高新技术产业发展专项资金	-	-	501.56
陕西省科学技术厅第五批“揭榜挂帅”课题项目补贴	-	-	200.00
其他	591.42	331.77	180.08
合计	11,806.36	9,971.39	5,932.42

(3) 租赁负债

报告期各期,发行人因仓库、宿舍等租赁产生的租赁负债金额分别为 348.73 万元、18,532.78 万元及 17,663.92 万元,占总负债比例较小。2023 年起公司租赁负债金额大幅增加,原因为公司开始向关联方西安奕斯伟产业公司租赁宿舍和临时仓库,向京东贝(北京)光电科技有限公司租赁办公房屋用于北京分公司,具体详见本节之“九、(一)、2、(3)使用权资产”。

(三) 资产周转能力分析

1、应收账款周转率

可比公司	2024 年	2023 年	2022 年
沪硅产业	未披露	4.99	6.40

SUMCO	4.52	4.93	5.33
环球晶圆	6.19	7.03	7.35
德国世创	未披露	7.87	9.21
平均值	5.36	6.21	7.07
中国台湾及境外可比公司均值	5.36	6.61	7.29
公司	4.29	3.94	4.31

注 1: 数据来源于可比公司年报。

注 2: SUMCO 及环球晶圆未单独披露应收账款账面余额, 采用应收账款和应收票据的合计余额替代。

报告期内, 公司应收账款周转率整体处于合理水平, 公司下游客户均为境内外主流晶圆厂, 信用良好, 付款稳定, 各期末应收账款约 98% 在 6 个月以内, 公司应收账款回款情况良好。

报告期内, 公司应收账款周转率低于境内外可比公司均值, 主要系根据公开披露年报, 部分可比公司与客户签有保有最低采购量的长期协议, 存在一定规模长期预收款项可抵扣下游客户定期采购额。

2、存货周转率

可比公司	2024 年	2023 年	2022 年
沪硅产业	未披露	2.21	3.50
SUMCO	1.43	1.56	1.65
环球晶圆	4.16	4.31	4.38
德国世创	未披露	3.95	4.86
平均值	2.80	3.01	3.60
中国台湾及境外可比公司均值	2.80	3.27	3.63
公司	1.69	1.59	2.03

注 1: 数据来源于可比公司年报。

注 2: 德国世创公开披露数据有限, 分母采用存货账面价值替代存货余额计算周转率。

2023 年存货周转率同比下降, 主要系: 1) 2023 年末, 主要客户寄售直销模式放量, 发出商品同比大幅提升; 2) 随着第一工厂产能达产, 公司在产品和维持产能的备品备件及低值易耗品规模同比提升; 3) 下游订单需求不足, 部分外延片订单延迟产出累库。前述因素综合导致 2023 年末存货增长, 当期存货周

转率同比下降。**2024年**随着行业回暖以及公司持续优化运营效率，存货周转率有所提升。

报告期内，公司存货周转率水平始终低于可比公司平均水平。原因为：1) 公司**报告期内**始终处于扩产过程，为保障达产存货需提前储备，但投产后的产能释放和平稳运营需要磨合周期，再叠加行业周期波动影响，公司存货余额增长始终高于营业成本。其他可比公司产能规模同期内稳步扩张甚至保持不变，生产运营相对稳定，存货周转率较高；2) 可比公司中 SUMCO 主要收入来自于 12 英寸硅片，公司存货周转率均略高于 SUMCO 同期水平。公司存货周转率主要年份均低于沪硅产业、环球晶圆和德国世创，系前述三家可比公司收入中包含较高比例 8 英寸及以下硅片业务，相应产品生产周期较短，存货周转更快。

十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

(一) 偿债能力分析

1、偿债能力与资本结构情况

单位：万元

项目	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
流动比率(倍)	1.89	1.65	3.70
速动比率(倍)	1.50	1.25	3.40
资产负债率(母公司)	27.62%	16.08%	12.25%
资产负债率(合并)	51.13%	40.48%	23.65%
项目	2024年	2023年	2022年
息税折旧摊销前利润	36,400.12	14,713.76	-6,483.85
利息保障倍数(倍)	不适用	不适用	不适用
经营活动现金流量净额	81,547.82	31,990.45	4,673.76
归属于母公司股东净利润	-73,764.25	-57,797.00	-41,182.08

2022年末，随着公司股权融资规模的持续扩大、生产经营规模的稳步增长，公司流动比率和速动比率**较高**；2023年末，随着公司支付约 42 亿元回购子公司奕斯伟硅片少数股东股权，当期货币资金同比下滑，流动比率和速动比率相应下

降。**2024年末**，随着长期借款放款，期末货币资金增加，流动比率和速动比率回升。

报告期各期末，公司债权融资增加使得资产负债率提升，资产负债率总体维持在合理水平。

报告期内，公司息税折旧摊销前利润已于**2023年**实现由负转正，**2024年**同比增长**147.39%**，公司偿债能力不断改善。

2、公司偿债能力及资本结构与同行业可比上市公司比较情况

流动比率（倍）			
可比公司	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
沪硅产业	未披露	3.63	5.67
SUMCO	2.66	2.32	3.46
环球晶圆	1.24	1.21	3.06
德国世创	未披露	1.58	3.11
平均值	1.95	2.18	3.82
中国台湾及境外可比公司均值	1.95	1.70	3.21
公司	1.89	1.65	3.70
速动比率（倍）			
可比公司	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
沪硅产业	未披露	3.13	5.24
SUMCO	1.23	1.25	2.34
环球晶圆	1.06	1.09	2.82
德国世创	未披露	1.10	2.58
平均值	1.15	1.64	3.24
中国台湾及境外可比公司均值	1.15	1.15	2.58
公司	1.50	1.25	3.40
资产负债率（%）			
可比公司	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
沪硅产业	未披露	29.37	23.24

SUMCO	43.95	40.78	33.73
环球晶圆	59.47	64.84	67.95
德国世创	未披露	53.39	48.97
平均值	51.71	47.09	43.47
中国台湾及境外可比公司均值	51.71	53.00	50.22
公司	51.13	40.48	23.65

数据来源：上市公司公开披露年报。

报告期各期末，公司流动比率、速动比率与可比公司平均水平不存在显著差异。报告期各期末，因公司早期融资方式主要为股权融资，2022 年末资产负债率低于同行业平均水平。随着公司借款规模不断提升，资产负债率上升，2023 年末及 2024 年末与可比公司平均水平接近。

3、主要债项情况

截至 2024 年末，公司主要债项为银行借款和与原材料采购、厂房、产线工程建设相关的应付款，不存在逾期未偿还债项。

4、未来偿还债务及利息金额与偿债能力分析

公司各项偿债能力指标良好，营业收入整体呈增长趋势，同时公司银行资信状况良好，与大部分供应商保持了良好的合作关系，预计未来不存在债务无法偿还的风险。

(二) 报告期内股利分配的实施情况

报告期内，公司未实施股利分配。

(三) 现金流量分析

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	2022 年
经营活动产生的现金流量净额	81,547.82	31,990.45	4,673.76
投资活动产生的现金流量净额	-206,076.28	-379,567.05	-353,368.52
筹资活动产生的现金流量净额	242,549.74	-14,918.44	767,526.20
现金及现金等价物净增加额	118,418.37	-362,191.79	420,102.44

1、销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入匹配关系分析

报告期各期，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比例分别为81.59%、111.60%和**96.46%**，匹配关系良好。

2、经营活动现金流量净额与净利润匹配关系分析

报告期内，公司尚未实现盈利，经营活动现金流量净额已转正。公司经营活动产生的现金流量净额均高于净利润，主要原因为：1) 报告期内公司固定资产投资较大，固定资产折旧较高；2) 报告期内公司基于谨慎性原则足额计提资产减值损失；3) 报告期内随着业务规模扩张，公司加大采购，经营性应付项目中应付材料款等金额较大。具体匹配关系如下：

单位：万元

项目	2024年	2023年	2022年
净利润	-73,764.25	-68,337.45	-53,287.69
加：资产减值损失	25,570.48	33,184.31	26,681.15
信用减值准备	126.55	21.75	151.80
固定资产折旧	91,897.22	75,308.97	45,518.46
使用权资产折旧	1,184.88	1,069.38	165.14
无形资产摊销	1,056.24	822.49	780.55
长期待摊费用摊销	340.27	62.96	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	-3.04	-	-
递延收益摊销	-1,295.03	-886.50	-478.36
财务费用	17,542.69	11,695.11	6,190.23
投资收益	-1,351.14	-11,268.87	-
存货的增加	-42,935.54	-65,448.97	-68,902.53
与投资相关的进项税	20,361.97	44,951.19	51,283.34
经营性应收项目的增加	-10,802.68	-10,735.45	-40,293.77
经营性应付项目的增加	53,470.64	21,535.51	36,865.44
安全生产费	148.56	16.02	-

经营活动产生的现金流量净额	81,547.82	31,990.45	4,673.76
---------------	-----------	-----------	----------

3、投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动的现金流入主要为 2024 年赎回结构性存款收到的现金；投资活动产生的现金流出主要为报告期内购建固定资产和其他长期资产支付的现金及 2024 年购买结构性存款支付的现金。

4、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流入主要为吸收投资收到的现金及取得借款收到的现金。筹资活动现金流出主要为偿还银行借款及其利息支付的现金和 2023 年购买子公司少数股权支付的现金。

(四) 重大资本性支出计划及资金需求量

1、报告期内发生的重大资本性支出

报告期内，公司购建固定资产和其他长期资产支付的现金分别为 353,928.74 万元、374,152.95 万元和 209,141.61 万元，主要用于建设第一工厂和第二工厂。

2、未来可预见的重大资本性支出

截至本招股说明书签署日，公司重大资本性支出项目的具体情况详见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。

(五) 流动性风险分析

报告期各期末，公司营业收入持续增长、回款情况较好、资产负债率合理，流动比率、速动比率与同行业可比公司平均水平基本一致。

公司目前整体流动性较好，短期内流动性风险较低。

(六) 持续经营能力分析

首先，12 英寸硅片国内外市场需求长期向好。尤其是随着以人工智能为代表的新兴应用对芯片算力和存力的要求日趋增长，全球 12 英寸硅片市场稳步增长，特别是中高端硅片呈现全球需求旺盛、国内结构性紧缺的局面。作为国内 12

英寸硅片头部企业，公司已逐步得到全球晶圆厂客户认可，**出货量从 2022 年的 234.62 万片增至 2024 年的 625.46 万片，增长率为 166.58%。**

其次，公司所处行业上下游供求关系未发生重大不利变化。上游供应商方面，公司对关键物料已通过签订长期协议、提前备货、多元化采购以及合作培育国内供应商等方式保持供应链稳定和竞争力。报告期内，公司始终专注于 12 英寸硅片业务，不断提升竞争力，战略客户关系不断巩固，市场地位不断提升，发行人业务的稳定性和持续性无重大不利影响。

第三，截至本招股说明书签署日，公司不存在由于工艺过时、产品落后、技术更迭、研发失败等原因导致市场占有率持续下降、重要资产或主要生产线出现重大减值风险、主要业务停滞或萎缩的情形。报告期内，公司主要财务指标逐步向好。公司营业收入从 2022 年的 **10.55 亿元** 增至 2024 年的 **21.21 亿元**，复合增长率达到 **41.83%**。同时，公司经营活动产生的现金流量净额持续为正，息税折旧摊销前利润（EBITDA）逐年不断增长，**2023 年实现转正，2024 年同比增长 147.39%**。报告期内，对公司业务经营或收入实现有重大影响的商标、专利、软件著作权等重要资产或技术不存在重大纠纷或诉讼。

综上所述，公司管理层认为，在可预见的未来公司能够保持良好的持续经营能力。

十一、报告期重大投资或资本性支出等事项的基本情况

报告期内，公司重大资本性支出情况详见本节之“十一（四）重大资本性支出计划及资金需求量”。

报告期内，公司重大资产重组事项或股权收购合并事项详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、公司成立以来重要事件”。

十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项。

第七节 募集资金运用与未来发展规划

一、募集资金运用基本情况

(一) 募集资金运用概况

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	西安奕斯伟硅产业基地二期项目	1,254,400.00	490,000.00
	合计	1,254,400.00	490,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司可根据各募集资金投资项目的实际付款进度，通过自筹资金支付相关项目投资款。在本次发行募集资金到位后，部分募集资金将用于置换募集资金到位前预先投入的自筹资金。

如果本次发行实际募集资金金额未达到募集资金拟使用额，由董事会根据上述募集资金投资项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，公司将使用自有资金或采取债务融资等方式，补足项目投资金额缺口。

(二) 募集资金投资项目的确定依据

按出货面积计算，目前全球 70%以上芯片需要 12 英寸硅片制造，尤其是数字经济发展最需要的高端逻辑、存储芯片是 12 英寸硅片的主力需求。国内晶圆厂纷纷扩产 12 英寸产能，根据 SEMI 调研机构最新数据统计，截至 2024 年末，中国大陆有 62 座 12 英寸晶圆厂量产（含外资晶圆厂），预计 2026 年末国内 12 英寸晶圆厂量产数量超过 70 座，相应产能将增长至 321 万片/月，约占届时全球 12 英寸晶圆厂产能的 1/3。目前绝大部分 12 英寸硅片依赖进口局面虽有缓解，但全球仍有 80%的 12 英寸硅片被前五大厂商垄断，国内供需不平衡状态尤为明显。

随着第一工厂达产和第二工厂正式投产，截至 2024 年末公司合并产能已超过 70 万片/月，公司 12 英寸硅片产能和月均出货量已实现中国大陆第一、全球第六，产品的晶体缺陷控制水平、翘曲度、平坦度、洁净度等核心指标已比肩全球友商，从而第二工厂建设具有成熟的市场基础和技术支持。公司第二工厂达产

后,将与第一工厂通过技术提升形成 120 万片/月的产能,可满足中国大陆内资晶圆厂 2026 年 321 万片/月 12 英寸晶圆产能的 37%,全球产能占有率达到 10% 以上,极大缓解国内 12 英寸硅片供需失衡,减少对我国半导体行业发展的掣肘。

(三) 募集资金投资项目对同业竞争和独立性的影响

本次募集资金投资项目实施后,不会产生同业竞争,不会对本公司独立性产生不利影响。

(四) 募集资金对发行人主营业务发展的贡献和未来战略的影响

基于 2024 年月均出货量 and 截至 2024 年末产能规模统计,公司均是中国大陆第一、全球第六的 12 英寸硅片厂商,前述月均出货量和产能规模全球同期占比约为 6%和 7%。公司产品已经覆盖国内主流晶圆厂客户最先进工艺制程,根据公司的到 2035 年的长期战略,第一阶段“挑战者”目标已按计划在 2023 年实现。

本次募投项目是公司践行长期战略,实施第二阶段“赶超者”目标的必要手段。2026 年全球 12 英寸硅片需求将超过 1,000 万片/月,通过技术革新和效能提升,公司已将第一工厂 50 万片/月产能提升至 60 万片/月以上,公司 2026 年第一和第二两个工厂合计可实现 120 万片/月产能,跻身全球 12 英寸硅片头部厂商。

本次募集资金有助于公司产能的扩张,优化产品种类,增强技术实力,为公司未来经营战略的实施奠定基础,同时逐步拓展海外市场,延伸供应链和销售渠道,进一步服务国际客户,提升海外市场占有率和影响力。

(五) 募集资金使用管理制度和重点投向科技创新领域的具体安排

1、募集资金管理制度

公司制定了发行上市后所适用的《募集资金管理制度》。该制度经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过,对募集资金专户存储、使用、资金用途变更、管理与监督等方面进行了明确规定。

2、募集资金和重点投向科技创新领域的具体安排

本次募集资金项目的实施有助于提高 12 英寸硅片的国产化率，弥补市场短板和缺口，缓解国内市场供需不平衡的现状。西安奕斯伟硅产业基地二期项目将在持续耕耘、服务中国大陆地区市场及客户的同时，聚焦开拓全球客户，积极开发先进制程产品，持续提升制程能力和产品品质，攻关先进际代 DRAM 和先进制程 NAND Flash 用先进抛光片和更先进制程逻辑芯片用外延片，不断提升在产品和技術端持续的核心竞争力。

二、募集资金投资项目具体情况

(一) 西安奕斯伟硅产业基地二期项目

1、项目概述

本项目拟建设公司第二工厂，实施主体为全资子公司欣芯材料。本项目将依托公司现有技术及生产经验积累，有效扩充公司 12 英寸硅片产能规模，设计产能为 50 万片/月，进一步提升公司的产品竞争力和市场占有率。

项目建设地点位于西安高新区西沣南路以西，拟建设办公、生产及仓储等场地建筑面积为 174,217.85m²，计划总投资额 1,254,400.00 万元，建设周期为 18 个月。

2、项目可行性及与发行人主要业务、核心技术之间的关系

首先，公司具有良好的客户基础。截至本招股说明书签署日，公司已通过验证的客户累计 144 家，已通过验证的测试片超过 390 款，量产正片超过 90 款，抛光片和外延片产品已实现国内主要晶圆代工厂和存储 IDM 客户绝大多数主流量产工艺平台批量供应，极大提升了 12 英寸硅片的国产化率，弥补市场短板和缺口，已成为目前中国大陆 12 英寸硅片产能及月均出货量第一。同时，公司放眼需求量更大的国际市场，截至本招股说明书签署日，公司已拥有 30 家国际客户，覆盖海外全部主流晶圆厂客户，海外客户正片已量产近 10 款。

其次，公司具有成熟的技术基础。公司基于自主研发，在拉晶、成型、抛光、清洗和外延五大工艺环节均形成了核心技术，相应硅片产品的晶体缺陷控制水平、低翘曲度、超平坦度、清洁度和外延膜厚及电阻率均匀性等核心指标已与国际友

商处于同一水平。公司产品已量产用于 **2YY** 层 **NAND** 芯片、先进际代 **DRAM** 芯片和先进制程逻辑芯片，更先进制程产品正在进一步客户验证导入。公司产品技术已经匹配国内存储和逻辑领域最先进制程，同时正在不断导入海外客户先进制程。

第三，产能建设和后续运营具有供应链保障。一方面，基于第一工厂建设和产线运营，公司已经与国际主要材料、耗材和设备供应商形成战略合作关系；另一方面，公司持续培育和孵化国内供应商。目前无论从上游原材料(包括耗材)，还是工艺设备，公司通过合作开发不断提升本土化供应商的量产供应的比例，特别是晶体生长、硅片抛、量测等部分核心设备、超导磁场和热场等部分关键设备的核心零部件也已实现本土供应商配套。随着公司上市融资，第二工厂将进一步推动本土化设备和材料的突破全面提升国内电子级硅片产业链的竞争力。

最后，第二工厂 50 万片/月产能是对公司目前产品的升级和核心技术的延伸。第二工厂将以先进际代存储芯片用抛光片和更先进制程用外延片为主要产品，并且在细分领域，开发应用于功率器件的 **N** 型轻掺和重掺硅片特色产品，进一步提升国内 12 英寸硅片的国产比例，并满足全球晶圆厂对先进制程硅片日益增长的需求。

3、项目审批及用地情况

本项目已获得行业主管部门的同意意见，均已履行相应备案、审批及环评程序，项目建设用地均已取得权属证书，具体情况如下：

项目名称	项目备案	环评批复	项目用地
西安奕斯伟硅产业基地二期项目	陕西省企业投资项目备案确认书(项目代码: 2304-610161-04-01-141699)	高新环评批复(2023)024号	陕(2024)西安市不动产权第0365410号

4、项目投资估算

本项目计划投资总额为 1,254,400.00 万元，具体构成情况如下：

单位：万元

名称	金额	投资比例	募集资金拟投资金额
----	----	------	-----------

建筑工程费	94,590.29	7.54%	-
设备购置及安装费	1,042,692.80	83.12%	490,000.00
生产辅助设备	10,500.00	0.84%	-
固定资产其他费用	15,778.39	1.26%	-
无形资产	13,210.00	1.05%	-
递延资产	2,364.00	0.19%	-
预备费	20,171.53	1.61%	-
铺底流动资金及建设期贷款利息	55,093.00	4.39%	-
项目总投资	1,254,400.00	100.00%	490,000.00

5、项目实施进度安排

内容	月份进度									
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	
可行性研究报告编制、评审、备案	■									
环境影响报告书、节能报告书编制、审批	■	■								
设计招标及工程设计		■	■							
建安工程施工			■	■	■					
动力设备验收、启运、到货、安装调试				■	■	■				
生产工人招募及技术培训					■	■	■			
工艺设备验收、启运、到货、安装测试						■	■	■		
生产线点亮						■	■	■	■	

三、未来发展规划

(一) 战略规划

公司坚持“以客户为中心、以技术为基石、以品质为生命、以成果为导向、以奋斗者为本、以自省促卓越”的核心价值观，秉持“成为半导体硅材料领域受人尊敬的伟大企业”的企业愿景，始终将提升产品品质、提高技术能力、丰富产品结构和股东价值最大化作为推动企业发展的重要策略。

公司已制定 2020-2035 年的 15 年长期战略规划，通过挑战者、赶超者等 5 个阶段的努力，到 2035 年打造 2-3 个核心制造基地，若干座现代化的智能制造工厂，实现更优经济规模，聚焦技术力、品质力和管理力，成为半导体硅材料领域全球头部企业，服务全球客户。

(二) 报告期内的措施及实施效果、未来规划措施

截至本招股说明书签署日，公司产能和出货量均实现国内第一，产品已经覆盖国内晶圆厂客户主流最先进工艺制程，2023 年“挑战者”目标阶段性实现。公司将采用如下措施，保障第二阶段“赶超者”战略目标的达成。

1、客户导向、市场开拓

首先，与国内晶圆厂战略级客户继续深化合作，持续推动海外战略级客户导入；其次，通过商务关系维护、加强客户服务、提升产品品质，不断切入客户新品研发，增强境内外战略级客户粘性；最后，不断提升国内战略级客户采购份额，继续推进海外战略级客户的正片认证和销售，实现境内外战略级客户的先进制程产品的全覆盖，对细分领域客户（如功率器件客户）确保工艺平台全覆盖。

2、技术前瞻、产品先行

产品方面：加快缩短与全球顶尖硅片友商的先进制程产品差距，持续完成更先进制程 NAND FLASH 存储芯片、更先进际代 DRAM 芯片以及更先进制程逻辑芯片的技术储备和研发。

材料方面：继续深挖材料特性，掌握材料全面属性，优化材料评估标准和评估手段，并与国内外供应商合作不断提升晶体品质，对拉晶段及硅片段中新技术、新工艺进行储备。

平台方面：持续完善数据一体化，缩短研发周期，基于现有积累持续完善统一的硅材料特性基础研究平台、工艺研发平台和评价及测试平台。

专利方面，基于公司已有的专利战略，定期检讨，持续建设完善专利攻防体系，2028 年实现累计 2,000 件专利申请。

3、磨练内功、优质交付

实施精益管理。紧盯库存控制、产能利用率、良率和产出效率等核心指标，持续加强品质管控和流程标准化建设。

提升产品品质。持续提升质量管理体系，定期梳理总结产品品质异常原因，强化来料管理和建设国际一流产品品控实验室，持续提升客户满意度。

实施工艺精进战略。持续提升自动化控制能力、产品异常发现能力，确保机台稳定运行，持续优化机台标准管理。

降本增效。通过技术提升、国产化导入和供应商议价，不断降低 BOM 成本和制造费用。

保障供应链体系。通过国产化导入，与部分国内外供应商战略合作，提升供应链的稳定性和自身议价能力。

4、组织建设及其他

首先，持续优化多工厂运营下的组织架构，强化人才配置，建设人才孵化平台，推进管理者多职能、前后台发展路径；其次，持续优化风控机制、法规合规体系和内控流程；第三，确保环保及职业健康、消费和安全管理有效运行，打造绿色工厂；第四，根据上市公司运行要求，持续完善公司治理、信息披露等相应体系建设。

第八节 公司治理与独立性

一、公司治理制度的建立健全及运行情况说明

公司设立以来,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的要求,逐步建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等制度,制定并完善了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《总经理(总裁)工作细则》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》等公司治理的相关制度,形成了规范的公司治理结构。此外,公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名薪酬与考核委员会三个专门委员会,为董事会重大决策提供咨询、建议,保证董事会议事、决策的专业化、高效化。

上述人员和机构能够按照国家法律法规和公司章程的规定,行使权利并履行义务。公司重大生产经营决策、关联交易决策、投资决策和财务决策均能严格按照公司章程规定的程序和规则进行,能够切实保护中小股东的利益,未出现重大违法违规行为。

(一) 股东大会制度的建立健全及运行情况

股份公司自设立以来,股东大会审议并通过了《公司章程》和《股东大会议事规则》,对股东大会的职权、召开方式、表决方式等做出明确规定。

自股份公司成立至本招股说明书签署日,公司已累计召开**7**次股东大会,会议的表决、决议内容合法合规、真实有效。

(二) 董事会制度的建立健全及运行情况

1、董事会的运作情况

股份公司自设立以来,股东大会审议并通过了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》,对董事会的构成、职权、召开方式和表决方式等做出明确规定。

自股份公司成立至本招股说明书签署日,公司已累计召开**10**次董事会,会议的表决、决议内容合法合规、真实有效。

2、专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名薪酬与考核委员会三个专门委员会，专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名薪酬与考核委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。

截至本招股说明书签署日，公司董事会各专门委员会的组成及运行情况如下：

委员会	主任委员	委员	报告期内会议次数
战略与投资委员会	王东升	王东升、杨新元、方向明、王辉、郑丽丽、商文江、陈磊	9
审计委员会	陈磊	陈磊、商文江、郑丽丽、王辉、杨卓	8
提名薪酬与考核委员会	商文江	商文江、郑丽丽、陈磊、郭辉、王辉	4

(三) 监事会制度的建立健全及运行情况

股份公司自设立以来，股东大会审议并通过了《监事会议事规则》，对监事会的构成、职权、召开方式和表决方式等做出明确规定。

自股份公司成立至本招股说明书签署日，公司监事会已召开 7 次会议，会议的召开、表决、决议内容合法合规、真实有效。

(四) 独立董事制度的运行情况

公司现有独立董事 3 名，其中包括 1 名会计专业人士。

独立董事自聘任以来，依据《公司章程》《独立董事工作制度》等要求积极参与公司决策，在战略规划、审计、提名、薪酬与考核方面积极发挥作用。独立董事的履职维护了全体股东权益，完善了公司治理结构。

(五) 董事会秘书制度的运行情况

公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。2023 年 3 月 1 日，公司第一届董事会第一次

会议审议通过《董事会秘书工作细则》，相关制度内容符合监管机构发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

自公司董事会聘请董事会秘书以来，董事会秘书严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定，严格履行相关职责，配合董事会的工作，对公司董事会的规范运作起到了重要作用。

二、发行人内部控制制度情况

(一) 公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见

公司现有内控制度能够适应公司管理要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司认为：根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司内部控制于**2024年12月31日**在所有重大方面是有效的。

(二) 注册会计师对发行人内部控制制度的审计意见

毕马威会计师已出具《内部控制审计报告》（毕马威华振审字第**2507533**号），审计意见为：发行人于**2024年12月31日**按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(三) 报告期内公司的内控规范情况

报告期内，公司厂房存在未批先建的情况，后续公司已完善了相关建设的审批手续，并已取得了西安高新区住房和城乡建设局出具的合规证明，报告期内公司不存在受到有关住房和建设相关行政处罚的情况。

综上，相关未批先建事项对于公司的持续经营不会产生重大不利影响，公司不存在重大内控缺陷。

三、报告期内发行人的违法违规情况

报告期内，发行人不存在因违法违规而被行政处罚的情形，也不存在其他尚未了结的或可预见的行政处罚情况。

四、报告期内资金占用及对外关联担保情况

报告期内，发行人不存在资金被直接和间接控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

五、发行人独立运行情况

公司具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

（一）资产独立

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。

截至**2024年末**，发行人及其子公司在中国境内未拥有自有注册商标。根据奕斯伟集团与发行人于**2024年1月18日**签订的《商标使用许可协议》（以下简称“协议”）和**2024年9月19日**签订的《商标使用权协议》之补充协议，发行人存在获授许可使用控股股东奕斯伟集团商标的情况，具体详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“五、（二）、3、商标”。

报告期内，发行人存在向控股股东奕斯伟集团的下属子公司租赁房产的情形，具体情况参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“五、（一）、2、（2）租赁房屋及建筑物情况”和“第十二节 附件”之“附件三、2、租赁房屋及建筑物情况”。

截至**2024年末**，发行人存在与历史控股子公司奕斯伟设备共有专利的情形，具体情况参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“五、（二）、4、专利”和“第十二节 附件”之“附件五”。

上述事项对发行人资产独立性和生产经营不构成重大不利影响。

(二) 人员独立

截至本招股说明书签署日,公司高级管理人员不存在直接和间接控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务,不在控股股东奕斯伟集团、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员不在控股股东奕斯伟集团、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

(三) 财务独立

公司已建立独立的财务核算体系、能够独立做出财务决策;具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;公司未与直接和间接控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

(四) 机构独立

公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权,与直接和间接控股股东和实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

(五) 业务独立

公司的业务独立于直接和间接控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争,以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

(六) 其他

公司主营业务、控制权、管理团队稳定,最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化;控股股东、实际控制人所持发行人的直接和间接的股份权属清晰,最近两年实际控制人没有发生变更,截至本招股说明书签署日不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

截至本招股说明书签署日,公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷,重大偿债风险,重大担保、诉讼、仲裁等或有事项,不存在因经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

六、同业竞争

(一) 发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在构成重大不利影响的同业竞争

1、直接和间接控股股东控制和投资的其他企业不涉及发行人业务

截至本招股说明书签署日,除发行人和与发行人控股股东构成一致行动关系的宁波奕芯、重庆奕芯和奕斯欣盛、奕斯欣合、奕斯欣诚三家员工持股平台及其上层持股平台外,间接控股股东奕明科技和直接控股股东奕斯伟集团控制的一级企业共有 24 家,具体如下:

板块划分	控制的一级企业名称	奕斯伟集团控制比例	企业主营业务
智能化系统级解决方案	奕斯伟计算	奕斯伟集团与一致行动的员工持股平台合计控制 31.66%	一家智能化系统级解决方案提供商,聚焦智能终端和具身智能两大应用场景,为全球客户提供软硬一体化系统级解决方案,旗下控股包括北京奕斯伟信息技术有限公司等 18 家子公司
	北京奕想科技合伙企业(有限合伙)、北京奕理科技合伙企业(有限合伙)等 14 家有限合伙企业	奕斯伟集团作为普通合伙人和执行事务合伙人	奕斯伟计算员工持股平台,相应平台仅直接或间接持有奕斯伟计算股份
半导体生态链项目孵化投资及其他	西安奕斯伟产业公司	100.00%	科技园区规划建设和运营管理服务
	海宁奕联科技有限公司	100.00%	专项投资平台,参股投资某传感器企业
	重庆原石装备	85.00%	碳化硅设备研发、制造
	合肥奕斯伟投资	75.00%	专项投资平台,间接参股合肥硕中科技股份有限公司(688352.SH,从事显示驱动芯片封测业务)和合肥硕材科技有限公司(显示驱动封测所需材料制造)
	重庆奕能科技	58.50%	碳化硅器件的研发、制造
	重庆奕欣科技	75.00%	原规划为碳化硅材料,鉴于目前国内碳化硅材料领域已有多家优秀企业,竞争激烈,未来拟与重庆奕能科技进行合并从事第三代半导体器件相关业务,不涉及碳化硅衬底材料的生产制造
	珠海奕源科技	57.14%	合成石英部件、碳化硅功率器件模组载板的研发、制造,控制珠海奕

			源材料技术有限公司
	宁波梅山保税港区奕斯众享企业管理合伙企业(有限合伙)	76.29%	目前无实际业务
	浙江欣晖科技有限公司	66.67%	项目工程管理和物业服务

截至本招股说明书签署日,间接控股股东奕明科技无参股企业,直接控股股东奕斯伟集团参股比例在5%以上的一级企业共9家,具体如下:

一级企业名称	奕斯伟集团直接持股比例	企业主营业务
重庆欣晖材料	28.63%	设备用硅及碳化硅部件业务
北京远森医工科技有限公司	45.00%	医工投资平台
宁波梅山保税港区奕斯众合企业管理合伙企业(有限合伙)	33.86%	目前无实际业务
成都奕成科技股份有限公司	25.51%	板级系统封测业务
北京梵霖未来科技有限公司	24.00%	人工智能终端及解决方案业务
武汉元石智算科技有限公司	24.00%	智能计算、RISC-V服务器与解决方案业务
北京奕行私募基金管理有限公司	19.50%	备案私募基金管理人,投资管理
芯晖装备	8.57%	产品涉及电子级硅片研磨及抛光设备、晶圆前道量测、后道自动化测试设备等。受让奕斯伟设备控股权后,产品品类新增电子级硅片拉晶设备,同时为发行人参股子公司
浙江埃纳微电子材料有限公司	7.00%	电子级抛光液制造业务

2、实际控制人控制的主要下属企业不涉及发行人业务

截至本招股说明书签署日,除奕明科技、奕斯伟集团及其控制的企业外,公司共同实际控制人王东升、米鹏、杨新元、刘还平四人不存在其他控制或参股投资的企业。

截至本招股说明书签署日,公司直接和间接控股股东和实际控制人控制和投资的其他企业均不涉及电子级硅片业务,均不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争。

(二) 避免同业竞争承诺

发行人直接控股股东奕斯伟集团、间接控股股东奕明科技、共同实际控制人王东升及与其保持一致行动的米鹏、杨新元、刘还平均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件一、(十)关于避免同业竞争的承诺”。

七、关联方及关联交易

(一) 关联方及关联关系

截至本招股说明书签署日，根据《公司法》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》《上市规则》等相关规定，公司关联方及关联关系具体情况如下：

1、控股股东、实际控制人及其控制或施加重大影响的其他企业

1) 公司直接控股股东为奕斯伟集团，间接控股股东为奕明科技，实际控制人为王东升及与其保持一致行动的米鹏、杨新元和刘还平。

2) 控股股东、实际控制人及其直接或间接控制、施加重大影响的其他主要企业具体情况详见本节之“六、(一)发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在构成重大不利影响的同业竞争”，前述企业的控股子公司亦为公司关联方，报告期内与公司发生交易的企业如下：

序号	关联方	与公司的关联关系
1	西安奕斯伟产业公司	奕斯伟集团控股子公司
2	芯晖装备	奕斯伟集团施加重大影响的企业
3	奕斯伟设备	奕斯伟集团施加重大影响的芯晖装备的控股子公司。其中奕斯伟设备自 2023 年 6 月 30 日不纳入发行人合并范围，2023 年 6 月 30 日后方成为关联方
4	西安芯晖检测技术有限公司	
5	浙江埃纳检测技术有限公司	
6	浙江埃纳微电子材料有限公司	奕斯伟集团施加重大影响的企业
7	成都奕成集成电路有限公司	奕斯伟集团施加重大影响的成都奕成科技股份有限公司的控股子公司
8	合肥颀中科技股份有限公司	奕斯伟集团通过控制的合肥奕斯伟投资可施加重大影响的合肥颀中科技控股有限公司控股子公司

9	颀中科技(苏州)有限公司	合肥颀中科技股份有限公司的控股子公司
10	重庆欣晖材料	奕斯伟集团施加重大影响的企业

此外,报告期内上述关联方认定范围内的奕斯伟集团、奕斯伟计算、合肥颀中科技控股有限公司、成都奕成科技股份有限公司存在报告期外关联交易在报告期内款项结算的情况。

2、实际控制人担任董事、高级管理人员的其他企业

实际控制人王东升、杨新元和刘还平担任董事、高级管理人员的其他企业具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十四、(二)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员兼职情况”。

实际控制人米鹏担任董事、高级管理人员的其他企业情况如下:

姓名	性质	兼职单位	兼任职务
米鹏	实际控制人之一	奕斯伟集团	董事
		奕斯伟计算	董事、总经理
		北京奕斯伟信息技术有限公司	董事长
		奕斯伟科技(香港)有限公司	董事
		芯创智(北京)微电子有限公司	董事
		广州全盛威信息技术有限公司	董事长
		武汉计算生态技术有限公司	董事

3、直接或间接持股 5%以上股份或直接控制 5%以上股份的其他自然人、法人或其他组织及其一致行动人

序号	关联方	与公司的关联关系
1	宁波奕芯	直接持有发行人 10.00%股份,为控股股东的一致行动人
2	陕西集成电路基金	直接持有发行人 5%以上股份
3	二期基金	直接持有发行人 5%以上股份
4	奕斯欣盛	公司的员工持股平台,直接持有发行人 0.88%股份,为控股股东的一致行动人
5	奕斯欣合	公司的员工持股平台,直接持有发行人 0.66%股份,为

		控股股东的一致行动人
6	奕斯欣诚	公司的员工持股平台, 直接持有发行人 0.66% 股份, 为控股股东的一致行动人
7	国华人寿保险股份有限公司	间接持有发行人 5% 以上股份
8	天茂实业集团股份有限公司	间接持有发行人 5% 以上股份
9	西安高新硬科技产业投资控股集团有限公司	间接持有发行人 5% 以上股份
10	西安高新金融控股集团有限公司	间接持有发行人 5% 以上股份
11	西安高新技术产业开发区管理委员会	间接持有发行人 5% 以上股份
12	西安高新技术产业风险投资有限责任公司	西安高新技术产业风险投资有限责任公司为陕西集成电路基金的执行事务合伙人, 可控制发行人 5% 以上股份
13	重庆奕芯	直接持有发行人 0.75% 股份, 为控股股东的一致行动人

4、公司的董事、监事及高级管理人员

公司现任董事、监事及高级管理人员构成公司关联方, 具体情况请详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”。

5、公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员任董事、高级管理人员的其他企业，或者公司董事、监事及高级管理人员直接或间接控制、施加重大影响的其他企业

1) 公司现任董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员任董事、高级管理人员的其他企业为公司的关联方, 该等企业的具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十四、（二）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员兼职情况”。

2) 公司董事、监事及高级管理人员直接或间接控制、施加重大影响的企业为公司关联方, 相应关联方均已在前述范围中披露或认定。

6、直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或其他主要负责人及其控制或担任董事、高级管理人员的其他企业

1) 公司直接控股股东奕斯伟集团的董事、监事、高级管理人员或其他主要负责人和间接控股股东奕明科技主要负责人的情况如下:

序号	关联方姓名	与公司的关联关系
1	王东升	奕斯伟集团董事长, 奕明科技执行事务合伙人, 公司共同实际控制人之一
2	方向明	奕斯伟集团董事, 发行人董事
3	米鹏	奕斯伟集团董事, 公司共同实际控制人之一
4	王辉	奕斯伟集团总经理
4	吴茜	奕斯伟集团监事
6	代明明	奕斯伟集团财务负责人

2) 公司控股股东奕斯伟集团的董事、监事、高级管理人员或其他主要负责人和奕明科技主要负责人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业亦是公司关联方, 相应关联方均已在前述范围中披露或认定。

7、公司的控股子公司及参股公司

截至 2024 年 12 月末, 公司共有 5 家全资子公司、1 家控制的合伙企业和 1 家参股子公司, 均为公司关联方。

报告期内, 公司转让 1 家控股子公司, 仍为公司关联方, 注销 1 家控股子公司, 为公司曾经的关联方。

具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、发行人子公司、分公司及参股公司情况”。

8、其他关联方

除上述已披露的关联方外, 报告期内及报告期前 12 个月内具有下列情形之一的主体为发行人的关联方:

(1) 发行人实际控制人、控股股东、直接或间接持有发行人 5% 股份以上的自然人、董事、监事或高级管理人员关系密切的家庭成员及其直接或间接控制、施加重大影响, 或由前述自然人(独立董事关系密切的家庭成员除外)担任董事、高级管理人员的其他企业;

(2) 公司的合营企业及其子公司或联营企业及其子公司, 公司所属企业集团的其他共同成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业及其子公司或联营企业及其子公司。

(3) 根据实质重于形式原则认定的其他与发行人有特殊关系, 可能导致发行人利益对其倾斜的, 认定为发行人的关联方进行披露:

1) 根据《公司章程》及公司董事人选委派提名情况, 中建材新材料基金和奕斯伟集团共同确定一名董事候选人, 并由奕斯伟集团向公司提名该名董事, 本招股说明书中, 中建材新材料基金及其控制的企业认定为发行人的关联方。

2) 公司董事杨卓担任北方华创科技集团股份有限公司和拓荆科技股份有限公司之董事, 北方华创科技集团股份有限公司和拓荆科技股份有限公司自杨卓担任发行人董事(2023年7月)前12个月开始构成发行人关联方, 北京北方华创微电子装备有限公司系北方华创科技集团股份有限公司的全资子公司, 拓荆科技(上海)有限公司和拓荆创益(沈阳)半导体设备有限公司系拓荆科技股份有限公司的全资子公司, 认定北京北方华创微电子装备有限公司、拓荆科技(上海)有限公司和拓荆创益(沈阳)半导体设备有限公司为公司其他关联方。

9、其他

发行人实际控制人之一米鹏曾与北京欣奕华科技有限公司的实际控制人存在共同投资情况, 并且发行人与北京欣奕华科技有限公司控制的合肥欣奕华智能机器股份有限公司、京东贝(北京)光电科技有限公司和重大影响的浙江欣奕华智能科技有限公司存在业务往来, 基于上述情况并根据实质重于形式原则, 前述四家企业参考发行人的关联方进行披露。

(二) 报告期内曾经存在的关联方

1、报告期内及报告期前12个月内, 曾经具有本节“七、关联方及关联交易”之“(一) 关联方及关联关系”所示情形的主体, 均构成发行人报告期内曾经的关联方, 除前述已经披露的关联方外, 其中王家恒、孙达飞、方浩报告期曾经担任发行人董事, YOUNG RAK HONG、MUN YOUNG HEE、张淑军报告期内曾经担任发行人高级管理人员, 具体详见本招股说明书之“第四节 发行人基

本情况”之“十四、(七)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员近两年变动情况”。

2、上述人员及其关系密切的家庭成员均为发行人报告期内曾经的关联自然人，在相关人员任职期间及**2021**年以来任董事、高级管理人员的其他企业，或者直接或间接控制、施加重大影响的其他企业均为发行人报告期内曾经的关联方，在关联方期间发生的交易按关联交易披露。

基于上述原则，公司历史董事王家恒在**2022**年**11**月卸任后的**12**个月内，担任成都瑞波科光电有限公司董事长至今。成都瑞波科光电有限公司及其全资子公司成都瑞波科材料科技有限公司在王家恒卸任发行人董事前后**12**个月成为发行人关联方，**2022**年至**2023**年期间与发行人发生的交易作为关联交易披露。

3、除上述情况和已经披露和认定的关联方外，报告期内曾经的关联方如下表所示。下表中仅有西安硅产业基金报告期内与发行人有关联交易。

关联方名称	与公司曾经的关联关系
成都奕斯伟芯片设计有限公司	成都奕斯伟集成电路有限公司持有其 65% 股权，奕斯伟计算持有其 35% 股权，米鹏担任其执行董事， 2024 年 10 月注销
重庆原石企业管理合伙企业(有限合伙)	王辉曾持有其 50% 财产份额，并担任执行事务合伙人，于 2024 年 8 月退出，不再持有任何财产份额
珠海奕源咨询管理合伙企业(有限合伙)	
北京奕能咨询管理合伙企业(有限合伙)	
北京奕欣一号咨询管理合伙企业(有限合伙)	
北京奕行私募基金管理有限公司	王辉报告期内曾担任其董事长
重庆欣晖科技合伙企业(有限合伙)	奕斯伟集团曾持有其财产份额，并担任执行事务合伙人， 2024 年 8 月退出，不再持有其任何财产份额
北京元石智算科技有限公司	奕斯伟集团曾持有其 48% 股权， 2023 年 12 月注销
新理益集团	报告期内曾通过奕斯伟集团、宁波奕芯等股东间接持有发行人 5% 以上股份，目前已不再间接持有发行人 5% 以上股份

北京智能科创技术开发有限公司	王东升报告期内曾担任其董事，2024年3月注销
北京磐易科技有限公司	米鹏报告期内曾担任其董事，2023年5月注销
北京致知投资管理有限公司	米鹏曾任其经理及执行董事，并曾持有其70%股权，2021年1月退出，不再持有其任何股权
西安硅产业基金	发行人控制的西安奕斯伟投资曾为西安硅产业基金的有限合伙人之一，为奕斯伟硅片的原股东，2024年8月注销
海宁欣元信息咨询有限公司	浙江欣晖科技有限公司曾持有其100%股权，2023年3月退出，不再持有其任何股权
成都奕斯众创科技合伙企业（有限合伙）	
成都奕斯芯创科技合伙企业（有限合伙）	奕斯伟集团曾持有其财产份额并担任其执行事务合伙人，2023年3月退出，不再持有任何财产份额
成都奕斯智创科技合伙企业（有限合伙）	
奕斯伟系统技术	奕斯伟集团曾持有其64.41%股权，2022年8月注销
奕斯伟封测技术	奕斯伟集团曾持有该公司100%股权，2021年8月注销
北京奕斯伟集成电路技术有限公司	奕斯伟计算曾持有该公司100%股权，2021年12月注销
淮安众力创业投资合伙企业（有限合伙）	
南京崑隆创业投资合伙企业（有限合伙）	奕斯伟集团曾持有其财产份额，为企业执行事务合伙人，2021年9月退出，不再持有其任何财产份额
南京盈志创业投资合伙企业（有限合伙）	
西安埃纳科技合伙企业（有限合伙）	奕斯伟集团曾持有其90.00%财产份额，2023年11月退出，不再持有任何财产份额，于2024年10月注销
海宁欣晖投资合伙企业（有限合伙）	奕斯伟集团曾持有其82.2222%财产份额，浙江欣晖科技有限公司曾持有其17.7778%财产份额并担任执行事务合伙人，于2023年12月注销
安徽华晟新能源科技股份有限公司	郭辉报告期内曾担任其董事
江苏艾森半导体材料股份有限公司	俞信华自2023年1月至2024年8月曾担任其董事

爱奇投资顾问(上海)有限公司	俞信华报告期内曾担任其董事兼总经理
京东方华灿光电股份有限公司	俞信华报告期内曾担任其副董事长、董事
京东方华灿光电(苏州)有限公司	俞信华报告期前 12 个月内曾担任其执行董事
北京昆兰新能源技术有限公司	俞信华报告期内曾担任其副董事长
云南蓝晶科技有限公司	俞信华报告期内曾担任其董事
浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司	俞信华报告期内曾担任其董事
上海爱旭新能源股份有限公司	俞信华报告期内曾担任其董事
Square Limited	俞信华报告期内担任其董事
上海秀派电子科技股份有限公司	俞信华报告期前 12 个月内曾担任其董事, 工商变更登记尚未变更完成
时空电动汽车股份有限公司	俞信华报告期前 12 个月内曾担任其董事
西安瑞联新材料股份有限公司	俞信华报告期前 12 个月内曾担任其董事
天津格盛科技有限公司	俞信华曾担任其执行董事、经理, 2022 年 11 月注销
天津环汇精创管理咨询有限公司	俞信华曾担任其执行董事、经理, 2022 年 4 月注销
光华(天津)投资管理有限公司	俞信华曾担任其执行董事、经理, 2022 年 7 月注销
西藏祺达创业投资管理有限公司	俞信华曾担任其执行董事、经理, 2021 年 3 月注销
珠海博芯管理咨询有限公司	俞信华担任其执行董事、总经理, 2024 年 11 月注销
西安高新区创业中小企业服务有限公司	董铁牛报告期内曾担任董事
宝村合作咨询发展(北京)有限公司	方向明曾持有其 94.00% 股权, 并担任其执行董事、经理, 2022 年 6 月注销
北京跃麟企业管理咨询有限公司	方向明持有其 50% 的股权并担任总经理, 2022 年 4 月注销
北京菲零图文设计有限公司	北京跃麟企业管理咨询有限公司曾持有该公司 80% 股权, 2022 年 4 月注销

(三) 报告期内关联交易情况

1、关联交易的总体情况及重大关联交易的判断标准和依据

根据《公司章程》规定，公司与关联法人发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值的 1%以上的交易，且超过 3,000.00 万元的关联交易事项，应提交股东大会审议批准。发行人将满足前述标准的关联交易定为重大关联交易。

报告期内，公司关联交易的总体情况汇总如下：

交易类型	关联方	关联交易主要内容	是否属于重大关联交易
经常性关联交易	奕斯伟设备	奕斯伟设备不纳入合并范围后，公司向其采购拉晶设备和辅助工具等	是
	芯晖装备	采购最终抛光机、双面精磨机及设备所需备品备件，并向其销售少量 12 英寸硅片	否
	西安芯晖检测技术有限公司	采购检测设备	否
	成都瑞波科材料科技有限公司	采购射频识别标签	否
	成都瑞波科光电有限公司	采购射频识别标签	否
	浙江埃纳微电子材料有限公司	销售废片、12 英寸硅片和抛光液，其向公司提供免费样品	否
	颀中科技（苏州）有限公司	销售 12 英寸硅片；公司提供免费样品，确认发行人销售费用	否
	合肥颀中科技股份有限公司	销售 12 英寸硅片	否
	浙江埃纳检测技术有限公司	销售 12 英寸硅片	否
	成都奕成集成电路有限公司	销售 12 英寸硅片；公司提供免费样品，确认发行人销售费用	否
	拓荆科技股份有限公司	提供免费样品，确认发行人销售费用	否
	北京北方华创微电子装备有限公司	销售 12 英寸硅片、采购高温炉等	否
	合肥欣奕华智能机器股份有限公司	采购 AMHS 系统等	否
	浙江欣奕华智能科技有限公司	采购移动机器人作为主要载体的搬运集成系统等	否

	重庆欣晖材料	销售电子级多晶硅材料	否
	拓荆科技(上海)有限公司	销售 12 英寸硅片	否
	拓荆创益(沈阳)半导体设备有限公司	销售 12 英寸硅片; 公司提供免费样品, 确认发行人销售费用	否
	西安奕斯伟产业公司	奕斯伟材料、奕斯伟硅片、欣芯材料租用其部分房屋用于宿舍、临时仓库等	否
	京东贝(北京)光电科技有限公司	租用其部分房屋用于北京分公司办公	否
	奕斯伟集团	奕斯伟集团将其拥有的商标免费授权许可公司使用	否
偶发性关联交易	陕西集成电路基金	奕斯伟材料有限吸收合并控股子公司奕斯伟材料技术	是
	西安硅产业基金	发行人收购其持有的奕斯伟硅片少数股权	是
	芯晖装备	发行人以所持有的奕斯伟设备全部股权认购芯晖装备参股权	是
	西安硅产业基金	公司子公司作为其合伙人, 收取股权投资收益	否
	奕斯伟集团	为公司员工代缴社保公积金	否

注: 关联交易未包含关联方对发行人的增资情况, 相关情况详见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“三、报告期内公司股本和股东变化情况”

2、重大经常性关联交易

报告期内, 发行人重大经常性关联交易情况如下:

单位: 万元

交易性质	关联方	主要交易内容	定价方式	2024 年	2023 年
向关联方采购	奕斯伟设备	拉晶设备	结合市场价格协商定价	17,440.00	1,635.05

2023 年和 2024 年, 发行人重大经常性关联采购金额分别为 1,635.05 万元和 17,440.00 万元, 占各期营业成本的比例分别为 1.31%和 8.47%, 公司上述重大经常性关联交易占同期同类型(五大工艺设备采购)交易比例分别为 1.11%和 18.28%。

奕斯伟设备自 2023 年 6 月后换股重组后出表, 上表列示的为其出表后与发

行人的交易金额。若不考虑 2023 年 6 月前奕斯伟设备在发行人并表内合并抵消的因素,报告期内,发行人向奕斯伟设备分别采购 10,904.66 万元、7,060.05 万元和 17,440.00 万元,鉴于奕斯伟设备目前主要客户为发行人,相关交易规模波动情况与发行人第一工厂和第二工厂建设、投产进度一致,双方之间的关联交易具有合理性。

出表后发行人向奕斯伟设备采购的拉晶炉单价与出表前采购单价基本一致。此外,报告期内,发行人向其他国内拉晶炉生产商询价,较奕斯伟设备供应的拉晶炉贵约 10%左右,综合比较产品性能、价格因素后,发行人确定向奕斯伟设备采购,相关交易价格公允。

3、重大偶发性关联交易

(1) 奕斯伟材料有限吸收合并控股子公司奕斯伟材料技术

具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、(二)2022 年 7 月,奕斯伟材料有限吸收合并控股子公司奕斯伟材料技术”。

(2) 发行人收购控股子公司奕斯伟硅片少数股权

具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、(三)2023 年 6 月,发行人收购控股子公司奕斯伟硅片少数股权”。

(3) 发行人以所持奕斯伟设备 75%股权认购芯晖装备股权

具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、(四)2023 年 6 月,发行人以所持奕斯伟设备 75%股权认购芯晖装备股权”。

4、一般经常性关联交易

单位:万元

交易性质	关联方	定价方式	2024 年	2023 年	2022 年
向关联方 采购	北京北方华创 微电子装备有 限公司	结合市场价格 协商定价	-	2,080.73	-
	芯晖装备		1,298.31	39.24	3,986.16
	西安芯晖检测 技术有限公司		497.80	886.00	-

	成都瑞波科材料科技有限公司		-	487.59	-
	成都瑞波光电有限公司		-	-	283.50
	浙江埃纳微电子材料有限公司	免费送样	0.00	0.00	-
	合肥欣奕华智能机器股份有限公司	AMHS 系统为招投标, 其他采购结合市场价格协商定价	1,120.80	10,922.82	9.50
	浙江欣奕华智能科技有限公司	结合市场价格协商定价	-	-	891.07
	合计		2,916.91	14,416.37	5,170.23
向关联方销售	浙江埃纳微电子材料有限公司	结合市场价格协商定价	4.71	3.96	-
	硕中科技(苏州)有限公司		23.85	8.94 (注1)	-
	合肥硕中科技股份有限公司		17.23	-	-
	芯晖装备		-	12.00	-
	浙江埃纳检测技术有限公司		2.25	-	-
	成都奕成集成电路有限公司		26.00	8.00 (注1)	-
	北京北方华创微电子装备有限公司		481.36	-	-
	重庆欣晖材料		43.49	-	-
	拓荆创益(沈阳)半导体设备有限公司		270.45 (注1)	-	-
	拓荆科技(上海)有限公司		586.46	-	-
	拓荆科技股份有限公司	免费送样	-	0.00 (注1)	-
	合计		1,455.80	32.90	-

关联租赁	西安奕斯伟产业公司	结合市场价格 协商定价	1,804.38	758.75	-
	京东贝(北京)光电科技有限公司		83.64	83.22	-
	合计		1,888.01	841.97	
商标授权	奕斯伟集团	无偿授权 (注2)	0.00	0.00	0.00

注1: 2023年, 发行人对顾中科技(苏州)有限公司、成都奕成集成电路有限公司、拓荆科技股份有限公司存在免费送样, 发行人确认的销售费用合计14.69万元。2024年, 发行人对拓荆创益(沈阳)半导体设备有限公司存在免费送样, 确认销售费用4.82万元。免费送样上表中关联交易金额均为0.00万元。

注2: 发行人与奕斯伟科技集团于2024年1月18日签订了《商标使用许可协议》, 自协议签署生效之日起五年内奕斯伟科技集团将其拥有的多项注册商标免费授权许可给发行人使用, 发行人承担因奕斯伟科技集团注册和维护许可商标产生的部分维护费用, 具体以商标维护费结算通知单为准。发行人与奕斯伟集团于2024年9月19日签订《<商标使用许可协议>之补充协议》, 约定《商标使用许可协议》到期后自动续期五年。

报告期内, 公司报告期内累计金额超过1,000.00万元的经常性关联交易主要情况如下:

1) 北京北方华创微电子装备有限公司为国内半导体设备厂商龙头, 因其母公司北方华创科技集团股份有限公司董事杨卓成为发行人董事而被动成为发行人关联方。发行人向其采购高温炉进行氧化或退火, 用于提高单晶硅材料的电学性能和结构性能。自北京北方华创微电子装备有限公司成为关联方后, 发行人2023年主要向北京北方华创微电子装备有限公司采购3台高温炉, 其中两台与北京北方华创微电子装备有限公司成为关联方前的采购单价一致, 另外一台具有功能差异所以价格略高, 3台高温炉价格较发行人前期采购境外同类型设备低10%左右, 发行人向北京北方华创微电子装备有限公司采购高温炉具有商业合理性, 且价格公允。

2) 芯晖装备及其控股子公司西安芯晖检测技术有限公司为奕斯伟集团施加重大影响的关联方, 主要提供半导体设备和解决方案, 产品涉及电子级硅片研磨及抛光设备、晶圆前道量测、后道自动化测试等设备。

发行人主要向芯晖装备采购最终抛光机和双面精磨机用于12英寸硅片生产, 具有商业合理性。报告期内, 发行人向芯晖装备采购2台最终抛光机和3台双面精磨机, 其中最终抛光机价格较发行人前期采购同类型最终抛光机价格低约15%左右, 双面精磨机虽然价格高于境外厂商竞品约30%左右, 但其设计产能

高于境外厂商竞品约 80%左右，价格差异具有合理性。

报告期内，发行人向西安芯晖检测技术有限公司采购 3 台外观检测设备，因其功能差异，性能不及境外厂商竞品，相比价格低 30%左右，价格差异具有合理性。

3) 合肥欣奕华智能机器股份有限公司是中国领先的泛半导体高端装备提供商，主营泛半导体移栽设备、工艺及检测设备、工业软件及大数据等产品的研发、生产、销售及技术服务。报告期内，发行人向合肥欣奕华智能机器股份有限公司采购 AMHS 系统用于发行人第二工厂，该项目由发行人委托中电商务（北京）有限公司已履行招投标程序；此外，发行人也向合肥欣奕华智能机器股份有限公司采购部分立体仓用于智能存储货物，相应交易通过询比价确定，合肥欣奕华智能机器股份有限公司价格较其他境内供应商低约 5%至 15%左右。相应交易具有商业合理性，价格公允。

4) 浙江欣奕华智能科技有限公司为行业客户提供全场景移动机器人解决方案。发行人向浙江欣奕华智能科技有限公司采购搬运集成系统用于工厂自动化运输，具有商业合理性。系统中主要的载体为移动机器人，其较发行人前期采购的境内供应商产品价格低约 10%以内，价格公允。

5) 2023 年和 2024 年，发行人向关联方西安奕斯伟产业公司租赁房屋用于宿舍和临时仓库等，同时向京东贝（北京）光电科技有限公司租赁房屋用于北京分公司办公。就上述事项，公司确认使用权资产及租赁负债，具体详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“九、（一）2、（3）使用权资产”。公司租赁价格参考当地市场租金水平协商确定，具有公允性。

5、一般偶发性关联交易

1) 2023 年，发行人收购控股子公司奕斯伟硅片少数股权具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、（三）2023 年 6 月，发行人收购控股子公司奕斯伟硅片少数股权”。西安硅产业基金获得回购款后，按《合伙协议》约定，向合伙人按实缴出资比例分配。发行人全资子公司西安奕斯伟投资作为合伙人收取 331.52 万元投资收益。2024 年，发行人全资子公司西安奕斯伟投资作为合伙人收取 1,226.59 元投资收益。

2) 报告期内, 公司部分核心员工具有异地缴纳社保公积金的需求, 由奕斯伟集团先代为缴纳, 公司再与奕斯伟集团结算, 2022 年发生额为 179.86 万元。2022 年 10 月起, 前述情况已终止。

6、关键管理人员薪酬

报告期各期, 公司关键管理人员(含核心技术人员)在公司领取的薪酬分别为 3,779.41 万元、4,854.91 万元和 2,611.71 万元。

7、关联方往来款项余额

报告期各期末, 公司与关联方的往来款项余额情况具体如下:

(1) 应收关联方款项

单位: 万元

项目	关联方	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	款项性质
应收账款	芯晖装备	-	6.78	-	12 英寸硅片销售
	颀中科技(苏州)有限公司	5.99	10.10	-	
	成都奕成集成电路有限公司	4.52	9.04	-	
	北京北方华创微电子装备有限公司	287.98	-	-	
	拓荆创益(沈阳)半导体设备有限公司	44.24	-	-	
	拓荆科技(上海)有限公司	125.50	-	-	
合计		468.23	25.92	-	-

(2) 应付关联方款项

单位: 万元

项目	关联方	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	主要款项性质
应付账款	芯晖装备	-	24.69	93.59	
	成都瑞波科光电有	-	-	106.79	

	限公司				原材料或 辅助耗材 采购形成
	合肥欣奕华智能机器股份有限公司	-	4.35	-	
其他应付款	芯晖装备	3,644.25	4,062.35	7,392.05	设备或工程采购形成
	奕斯伟设备	9,420.91 (注1)	1,650.54	-	
	西安芯晖检测技术有限公司	618.00	771.52	28.14	
	合肥欣奕华智能机器股份有限公司	1,360.44	8,066.96	-	
	浙江欣奕华智能科技有限公司	117.23	402.37	1,005.92	
	北京北方华创微电子装备有限公司	158.20	1,428.32	76.84 (注2)	
	奕斯伟计算	-	-	0.09	关联方代缴社保公积金结算 (注3)
	成都奕成科技股份有限公司	-	-	-	
	奕斯伟集团	-	-	-	
	西安奕斯伟产业公司	1,758.19	452.03	-	租赁形成 (注4)
京东贝(北京)光电科技有限公司	8.88	1.68	-		
合计	17,086.10	16,864.80	8,703.42	-	

注1: 奕斯伟设备出表前, 发行人牵头承担的陕西省科技重大专项课题于2021年获得政府补助, 其中部分分子课题由奕斯伟设备承担, 实施主体奕斯伟设备应收奕斯伟材料100万元政府补助。随着奕斯伟设备出表, 2023年末, 发行人对奕斯伟设备的其他应付中包含前述100万元政府补助; 项目达到验收标准后, 发行人于2024年内完成前述对奕斯伟设备的政府补助支付。

注2: 北京北方华创微电子装备有限公司因其母公司北方华创科技集团股份有限公司董事杨卓于2023年7月成为发行人董事被动成为发行人关联方。发行人自2022年7月起将北京北方华创微电子装备有限公司认定为关联方, 2022年末余额系发行人向北京北方华创微电子装备有限公司于其成为发行人关联方前采购一台高温炉产生。

注3: 奕斯伟计算为公司员工代缴社保公积金均发生在报告期外, 报告期内完成结算, 相应科目已无余额, 后续不再发生。

注4: 租赁形成的其他应付包含所有应支付的租金及相关费用。

(四) 报告期内关联交易程序履行情况及独立董事对关联交易的意见

公司已建立了完善的公司治理制度, 在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》等制度中, 规定了有关关联交易的回避表决制度、决策权限、决策程序等, 以保证公司关联交易的公允性, 确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。

公司于 2023 年 5 月 8 日召开第一届董事会第三次会议,于 2023 年 5 月 28 日召开 2022 年度股东大会,审议通过《关于第一工厂股权回购的议案》《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的报告》;于 2023 年 12 月 13 日召开第一届董事会第五次会议,审议通过《关于审议新增 2023 年度日常关联交易的议案》;公司于 2024 年 5 月 28 日分别召开第一届董事会第六次会议、第一届监事会第四次会议,于 2024 年 6 月 17 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过《关于审议确认公司三年一期关联交易的议案》,对发行人报告期内应提交董事会或股东大会审议的关联交易进行了确认,关联董事、关联股东已回避表决;于 2024 年 11 月 8 日分别召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第五次会议,于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会,审议通过《关于审议确认公司三年一期关联交易的议案》,对发行人报告期内根据《公司章程》应提交董事会或股东大会审议的关联交易进行了确认,关联董事、关联股东已回避表决;于 2025 年 2 月 24 日分别召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议,于 2025 年 3 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会,审议通过《关于审议确认公司 2024 年度关联交易的议案》,对发行人 2024 年度根据《公司章程》应提交董事会或股东大会审议的关联交易进行了确认,关联董事、关联股东已回避表决。

发行人独立董事对上述关联交易议案发表了肯定意见,认为上述关联交易属于公司的正常经营行为,符合公司的生产经营及业务发展需要,交易条件公平、合理,定价政策、定价依据及交易价格以市场价格为基础,合理、公允,不影响公司独立性,也不存在损害公司及股东特别是非关联股东及中小股东利益的情形。

综上,公司报告期内根据《公司章程》应提交董事会或股东大会审议的关联交易事项已履行了必要的审议程序,符合法律、法规和《公司章程》的规定,关联交易价格合法公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情况;发行人独立董事在审议相关关联交易事项时发表了肯定意见。

(五) 规范和减少关联交易的措施

1、制定并完善相关制度

公司以维护股东利益为原则,尽量减少关联交易。对于不可避免的关联交易,

发行人在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等制度中对关联交易的审议、披露、回避制度等内容进行了规定，并在实际工作中充分发挥独立董事的作用，以确保关联交易决策合法合规和公平公正。

2、减少关联交易的承诺

为规范和减少关联交易，发行人实际控制人王东升、米鹏、杨新元和刘还平，控股股东奕斯伟集团，间接控股股东奕明科技，发行人董事、监事、高级管理人员，其余持股 5%以上的股东均出具了《关于规范及减少关联交易的承诺函》，承诺内容详见本招股说明书“附件一：本次发行相关承诺”之“（十一）关于规范并减少关联交易的承诺”。

第九节 投资者保护

一、公司投资者权益保护的情况

(一) 信息披露制度和流程

为规范公司信息披露行为,确保信息披露真实、准确、完整、及时,根据《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定,2023年7月11日,公司第一届董事会第四次会议审议通过了《信息披露管理办法》。该制度明确了重大信息报告、审批、披露程序,明确了公司管理人员在信息披露中的责任和义务。该制度有助于加强公司与投资者之间的信息沟通,提升规范运作和公司治理水平,切实保护投资者的合法权益。

(二) 投资者沟通渠道的建立情况

为进一步规范和加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通,促进投资者对公司了解和认识,强化公司与投资者之间的良性互动关系,提升公司形象,完善公司治理结构,形成良好的回报投资者的企业文化,切实保护投资者的利益,2023年7月11日,公司第一届董事会第四次会议审议通过了《投资者关系管理办法》。

公司由董事会秘书担任投资者关系管理的直接负责人;董秘办是公司负责投资者关系管理的常设机构,由董事会秘书领导,作为公司信息汇集和对外披露的部门,负责投资者关系管理的具体工作。

二、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序

根据公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市前滚存利润分配和未弥补亏损承担方案的议案》,本次发行上市前的滚存利润由发行后新老股东按照本次发行后的股份比例共同享有,累计未弥补亏损由发行后的新老股东按照发行后的持股比例相应承担。

三、股利分配政策及长期回报规划

(一) 本次发行完成后本公司的股利分配政策

公司 2023 年第三次临时股东大会以及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》，对本次发行上市后的股利分配政策作出了相应规定，公司的股利分配政策如下：

1、利润分配原则

公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司董事会应遵守有关法律、法规及公司章程的规定，在制订利润分配方案尤其是现金分红方案时应当听取各方的意见，尤其是应当充分听取独立董事和中小股东的意见。在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持以现金分红为主的基本原则。

2、制定股利分配政策考虑的因素

公司将着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分听取独立董事和中小股东的要求和意愿，并结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学、积极的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

3、利润分配方案的制订

公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划制订合理的利润分配方案并经董事会审议通过后提请股东大会审议，独立董事及监事会应对提请股东大会审议的利润分配方案进行审核并出具书面意见。董事会在审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确的独立意见；监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数表决同意。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

股东大会对利润分配具体方案进行审议前,公司应当通过电话、传真、邮件或者投资者交流平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。公司在将利润分配方案提交股东大会审议时,应当为投资者提供网络投票便利条件。公司董事会、独立董事、符合相关规定条件的股东可在审议利润分配方案的股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权,其中,独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、进行调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征求中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划的情况以及是否履行相应决策程序和信息披露情况进行监督。

公司应当严格执行有关法律、法规、规范性文件及公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。

4、利润分配政策的调整

如遇到战争、自然灾害等不可抗力事件,或者公司外部经营环境变化并已经或即将对公司生产经营造成重大影响,或者公司自身经营状况发生较大变化时,公司经详细论证后可以对既定利润分配政策作出调整。

公司对既定利润分配政策(尤其是现金分红政策)作出调整时,应详细论证调整利润分配政策的必要性、可行性,充分听取独立董事意见,并通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。调整后的利润分配政策应符合有关法律、法规的规定,经董事会审议通过后需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司在有关法律、法规、规范性文件允许或公司章程规定的特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见,公司当年的利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、利润分配形式及时间间隔

公司将采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利，但应优先采用现金分红的利润分配方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

在具备利润分配的情况下，公司每年度进行一次利润分配。经董事会和股东大会审议决定，公司可以进行中期利润分配。

6、现金分红的具体条件

公司进行现金分红应同时具备以下条件：

(1) 公司在该年度盈利且实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后利润）为正值；

(2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等特殊状况发生。其中，重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

7、发放股票股利的条件

根据公司可持续发展的实际情况，董事会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。公司采取股票方式分配股利的条件为：

(1) 公司经营情况良好；

(2) 因公司具有成长性、股本规模和经营规模不相适应、有重大投资计划或重大现金支出等真实合理因素，以股票方式分配股利有利于公司和股东整体利益；

(3) 不违反公司的现金分红政策。

8、上市后三年的股东回报规划

公司上市后三年,综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、重大资金支出安排以及预计上市时间等因素,公司在上市后三年仍将处于成长期且有重大资金支出安排,在上述期间进行利润分配时,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

9、股东分红回报规划制定周期

公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划,在符合公司章程的前提下,根据独立董事、监事会和中小股东的意见,由公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及资金需求,对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改,确定该时段的股东分红回报规划。

10、差异化的现金分红政策

在保证正常经营业务发展的前提下,公司坚持以现金分红为主、多种方式结合的利润分配政策。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形提出差异化的现金分红政策:

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

(4) 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照第 3 项规定处理。

(5) 现金分红在利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

11、利润分配监督机制

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合法、合规和透明等。

(二) 发行前后股利分配政策的差异

本次发行前后股利分配政策的差异主要在于进一步完善了发行后的利润分配政策,对分配顺序、现金分红的条件和比例、利润分配方案的决策程序和机制、利润分配政策的披露等进行了明确。

四、股东投票机制建立情况

根据《公司章程》规定,公司股东投票机制如下:

股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

中小投资者单独计票机制:股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

网络投票方式召开股东大会进行审议表决:公司召开股东大会的地点为公司住所地或者股东大会召集人会议通知中确定的其他地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开为原则。公司还将提供网络或其他投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

征集投票权的相关安排:公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

五、承诺事项

发行人、发行人股东、发行人实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员以及本次发行相关中介机构中信证券、竞天公诚、毕马威会计师、天健兴业均已经按照法律、法规、中国证监会、上交所的规范性文件要求作出了相应的符合该等要求的承诺，承诺内容详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件一：本次发行相关承诺”。

提请投资者特别关注，报告期内公司尚未盈利，截至**2024年末**公司存在累计未弥补亏损，前述承诺涉及保护投资者合法权益的特殊安排。

第十节 其他重要事项

一、重大合同

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及控股子公司已履行和正在履行的合同中，对公司的生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下：

(一) 采购合同

1、原材料采购合同

报告期内，公司已履行、正在履行和将要履行的金额（与同一交易主体在一个会计年度内连续发生的相同内容或性质的合同累计计算）在 5,000.00 万元以上的采购合同或者年度交易金额在 5,000.00 万元以上的采购框架协议如下：

序号	交易对方	签订时间	采购内容	合同类型或金额 (含税)	合同履行状态
1	供应商 O	2022 年	电子级多晶硅、化学试剂、切磨抛耗材、包装材料	9,929.18 万元	履行完毕
		2024 年	化学试剂、切磨抛耗材、包装材料	框架协议	履行中
2	供应商 A	2021 年	电子级多晶硅	框架协议及补充协议	履行中
3	鑫华半导体	2022 年	电子级多晶硅	框架协议	履行中
4	供应商 N	2023 年	包装材料	框架协议	履行中
5	供应商 D	2022 年及 2023 年	石英制品	框架协议及补充协议	履行中
6	赛米芯技术	2023 年	切磨抛耗材	框架协议及补充协议	履行中

2、设备采购合同

报告期内，公司已履行、正在履行和将要履行的金额（与同一交易主体在一个会计年度内连续发生的相同内容或性质的合同累计计算）在 20,000.00 万元以上的采购合同如下：

序号	交易对方	签订时间	采购内容	合同金额(含税)	合同履行状态
1	供应商 Q	2022 年	表面颗粒度检测仪、线上扫描电镜、平坦度检测仪	15,240.00 万美元	履行中

(二) 销售合同

报告期内,公司已履行、正在履行和将要履行的金额(与同一交易主体在一个会计年度内连续发生的相同内容或性质的合同累计计算)在 5,000.00 万元以上的销售合同或者年度交易金额在 5,000.00 万元以上的销售框架协议如下:

序号	交易对方	签订时间	合同内容	合同类型或金额(含税)	合同履行状态
1	华虹集团	2021 年	抛光片、外延片、测试片	框架协议	履行中
2	客户 A	2021 年	抛光片、测试片	框架协议及补充协议	履行中
3	客户 B1	2021 年	抛光片、测试片	框架协议及补充协议	履行中
4	客户 B2	2021 年	抛光片、外延片、测试片	框架协议	履行中
5	客户 C	2021 年	抛光片、外延片、测试片	框架协议	履行完毕
		2023 年	抛光片、外延片、测试片	框架协议	履行中
6	华立股份	2022 年	抛光片、外延片、测试片	框架协议	履行中
7	客户 D	2021 年	外延片、测试片	框架协议	履行中
8	晶合集成	2021 年	抛光片、外延片、测试片	框架协议	履行完毕
		2024 年	抛光片、外延片、测试片	1,409.43 万美元	履行中
9	SVM	2022 年	抛光片、测试片	框架协议	履行完毕

		2023年	抛光片、测试片	框架协议	履行中	
10	客户 E	2024年	外延片、测试片	9,875.47 万元	履行中	
11	客户 F	2024年	外延片、测试片	3,875.90 万元	履行中	
			客户 F1	测试片	1,201.13 万元	履行中
			客户 F2	外延片	2,556.83 万元	履行中
12	客户 M	2024年	测试片	5,468.75 万元	履行中	

(三) 借款及授信合同

报告期内,公司金额超过 10,000 万元重大借款及授信合同的具体情况如下:

序号	合同名称及编号	借款人/受信人	贷款人/授信人	金额(万元)	贷款/授信期限
1	《并购贷款合同》(129HT2023380013)、《并购贷款合同之补充协议》(129HT2023380013-001)、《并购贷款合同之补充协议二》(129HT2023380013-002)	奕斯伟材料	招商银行股份有限公司西安分行	不超过 90,000	2023年11月16日至2030年11月14日
2	《流动资金借款合同》(2022年陕中银咸奕斯伟材料科技借字 001号)	奕斯伟材料	中国银行股份有限公司西安咸宁路支行	60,000	2022年11月23日至2025年10月20日
3	《借款合同(并购)》(平银(西安)并贷字政金三第 20240325001号)	奕斯伟材料	平安银行股份有限公司西安分行	不超过 60,000	2024年3月29日至2031年3月28日
4	《并购借款合同》(兴银陕曲江并购借字(2024)第 052101号)、《并购贷款合同》补充协议(兴银陕	奕斯伟材料	兴业银行股份有限公司西安分行	不超过 90,000	2024年5月23日至2031年5月22日

	曲江并购借补字(2024)第 080201 号)				
5	《固定资产贷款合同》(2022 信银西电固贷字第 001 号)、《补充协议》(无编号)、《补充协议》(2022 信银西电补字第 003 号)、《补充协议》(2022 信银西电补字第 006 号)	奕斯伟硅片	中信银行股份有限公司西安分行	150,000	2022 年 2 月 21 日至 2032 年 2 月 21 日
6	《固定资产贷款合同》(2023 信银西电固贷字第 001 号)、《补充协议》(2023 信银西电补字第 001 号)	奕斯伟硅片	中信银行股份有限公司西安分行	150,000	2023 年 2 月 24 日至 2033 年 2 月 21 日
7	《授信额度协议》(2021 年陕中银咸奕斯伟授额字 001 号)	奕斯伟硅片	中国银行股份有限公司西安咸宁路支行	50,000	2021 年 6 月 1 日至 2022 年 5 月 9 日
8	《授信额度协议》(2022 年陕中银咸奕斯伟授额字 001 号)	奕斯伟硅片	中国银行股份有限公司西安咸宁路支行	53,000	2022 年 5 月 23 日至 2023 年 4 月 26 日
9	《授信协议》(129XY2022043145)	奕斯伟硅片	招商银行股份有限公司西安分行	30,000	2022 年 12 月 13 日至 2023 年 12 月 12 日
10	《授信额度协议》(2023 年陕中银咸奕斯伟授额字 001 号)	奕斯伟硅片	中国银行股份有限公司西安咸宁路支行	60,000	2023 年 6 月 19 日至 2024 年 6 月 6 日
11	《流动资金借款合同》(2022 年陕中银咸奕斯伟借字第 001 号)、《流动资金借款合同补充协议》(2022 年陕中银咸奕斯伟借补字第 001 号)	奕斯伟硅片	中国银行股份有限公司西安咸宁路支行	17,000	2022 年 5 月 26 日至 2023 年 6 月 26 日

12	《授信协议》 (129XY2024014912)	奕斯伟硅片	招商银行股份有限公司 西安分行	30,000	2024年4月30日至2027年4月29日
13	《固定资产贷款合同》 (HTU610860000FBWB2023N000H)、《固定资产贷款合同》补充协议 (HTU610860000FBWB2023N000H-补充001号)	欣芯材料	中国建设银行股份有限公司西安南大街支行	90,000	2023年8月31日至2026年8月30日
14	《项目前期借款合同》 (2023年陕中银咸欣芯材料借字001号)	欣芯材料	中国银行股份有限公司西安咸宁路支行	50,000	2023年9月1日至2026年9月1日
15	《固定资产借款合同》 (0370000020-2024年(高科)字01134号)、《固定资产借款合同补充协议》 (0370000020-2024年(高科)字01134号-(补充)001)	欣芯材料	中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	100,000	2024年6月26日至2027年6月25日

注：《并购贷款合同之补充协议》(129HT2023380013-001)、《并购贷款合同之补充协议二》(129HT2023380013-002)的签订日期分别为2024年4月10日、2024年5月24日，补充协议将借款金额调整为不超过9亿元。

(四) 其他重大合同

报告期内，公司已履行完毕或正在履行的其他重大合同情况如下：

序号	合同类型	合同签署对方	主要内容	合同履行情况
1	商标许可协议	奕斯伟集团	奕斯伟集团授权公司使用商标，使用期限为5年	履行中
2	《商标使用许可协议》之补充协议	奕斯伟集团	延长奕斯伟集团授权公司使用商标期限，到期后自动续期5年	履行中

二、发行人对外担保有关情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在对外担保的情形。

三、对发行人产生重大影响的诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日,公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼或仲裁事项。

四、发行人控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项

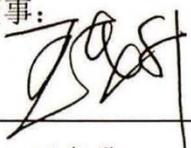
截至本招股说明书签署日,本公司控股股东及实际控制人、控股子公司和董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在尚未了结的重大诉讼或仲裁事项。

第十一节 声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：


王东升


杨新元

王 辉

方向明

杨 卓

郭 辉

郑丽丽

商文江

陈 磊



西安奕斯伟材料科技股份有限公司

2025年 3月 24日

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：

_____	_____	_____
王东升	杨新元	王 辉
_____	_____	_____
方向明	杨 卓	郭 辉
_____	_____	_____
郑丽丽	商文江	陈 磊

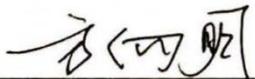
西安奕斯伟材料科技股份有限公司

2025年3月24日

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：

王东升 	杨新元	王 辉
方向明	杨 卓	郭 辉
郑丽丽	商文江	陈 磊

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

2025年3月24日



一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：

王东升	杨新元	王 辉
方向明	 杨 卓	郭 辉
郑丽丽	商文江	陈 磊



西安奕斯伟材料科技股份有限公司

2025年3月24日

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：

_____	_____	_____
王东升	杨新元	王辉
_____	_____	_____
方向明	杨卓	郭辉
_____	_____	_____
郑丽丽	商文江	陈磊

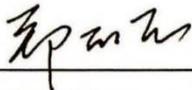
西安奕斯伟材料科技股份有限公司

2025年3月24日

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：

_____ 王东升	_____ 杨新元	_____ 王 辉
_____ 方向明	_____ 杨 卓	_____ 郭 辉
_____  郑丽丽	_____ 商文江	_____ 陈 磊

西安奕斯伟材料科技股份有限公司



一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：

_____ 王东升	_____ 杨新元	_____ 王 辉
_____ 方向明	_____ 杨 卓 	_____ 郭 辉
_____ 郑丽丽	_____ 商文江	_____ 陈 磊

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

2025年3月24日



一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：

王东升	杨新元	王 辉
方向明	杨 卓	郭 辉 陈磊
郑丽丽	商文江	陈 磊

西安奕斯伟材料科技股份有限公司



一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体监事：

董铁牛

董铁牛

俞信华

苗嘉

宋胜宏

张鹏

西安奕斯伟材料科技股份有限公司
2025年3月24日



一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体监事：

_____		_____
董铁牛	俞信华	苗嘉
_____	_____	
宋胜宏	张鹏	

西安奕斯伟材料科技股份有限公司



2025年3月24日

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体监事：

董铁牛

俞信华

苗嘉

宋胜宏

张鹏

西安奕斯伟材料科技股份有限公司
2025年3月24日

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体监事：

董铁牛

俞信华

苗嘉

宋胜宏

张鹏

宋胜宏

张鹏



西安奕斯伟材料科技股份有限公司

2025年 7月24日

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

除董事、监事之外的全体高级管理人员：



刘还平



兰 洵



王 琛



杨春雷



西安奕斯伟材料科技股份有限公司

2025年3月24日

二、发行人控股股东声明

本公司承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

北京奕斯伟科技集团有限公司



法定代表人/授权代表(签字):

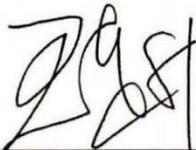
王辉

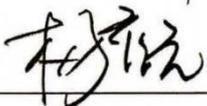
2025年3月24日

三、发行人实际控制人声明

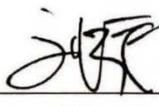
本人承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,按照诚信原则履行承诺,并承担相应的法律责任。

实际控制人:


王东升


杨新元


米鹏


刘还平



西安奕斯伟材料科技股份有限公司

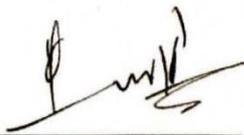
2025年3月24日

三、发行人实际控制人声明

本人承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

实际控制人：

王东升



米 鹏

杨新元

刘还平

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

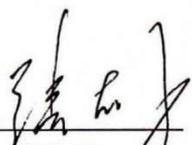
2025年3月24日



保荐人(主承销商)声明

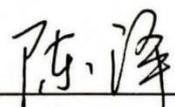
本公司已对招股说明书进行核查,确认招股说明书的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

法定代表人:


张佑君

保荐代表人:


张 欢


陈 泽

项目协办人:

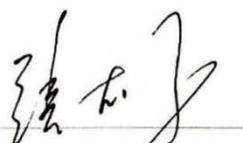

赵 悠

中信证券股份有限公司
2025年3月24日

保荐人管理层声明

本人已认真阅读西安奕斯伟材料科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长：

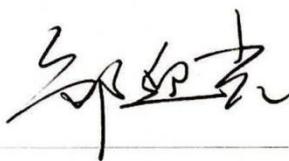

张佑君



保荐人管理层声明

本人已认真阅读西安奕斯伟材料科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理：



邹迎光



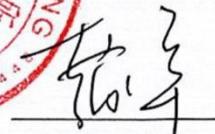
发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

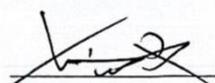
北京市竞天公诚律师事务所(盖章)



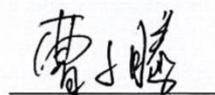
律师事务所负责人(签字):


赵洋

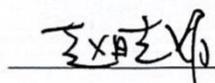
经办律师(签字):


范瑞林

经办律师(签字):


曹子腾

经办律师(签字):


赵晓娟

2025年3月24日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《西安奕斯伟材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(“招股说明书”),确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

签字注册会计师签名:张欢



刘婧媛



会计师事务所负责人签名:邹俊



毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)

2025年3月24日

资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书, 确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议, 确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任。

签字资产评估师:

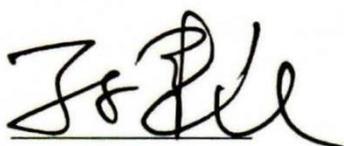

吴振玲



(已离职)

杨冰

资产评估机构负责人:


孙建民

北京天健兴业资产评估有限公司



2025 年 3 月 24 日

关于签字资产评估师离职的说明

本机构作为西安奕斯伟材料科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的资产评估机构，于2023年2月出具了《西安奕斯伟材料科技股份有限公司拟改制为股份有限公司涉及的西安奕斯伟材料科技股份有限公司净资产资产评估报告》(天兴评报字[2023]第0153号)，签字资产评估师为吴振玲、杨冰，现将资产评估相关情况说明如下：

截至本说明书出具之日，杨冰因个人原因已于2023年4月从本公司离职，故西安奕斯伟材料科技股份有限公司本次发行声明文件中资产评估机构声明无签字资产评估师杨冰的签名，杨冰的离职不影响本机构出具的上述资产评估报告的法律效力。

特此说明。

资产评估机构负责人签名：



孙建民

北京天健兴业资产评估有限公司

2025年3月24日



承担验资业务的机构的声明

本所及签字注册会计师已阅读《西安奕斯伟材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(“招股说明书”),确认招股说明书与本所出具的验资报告(报告号为毕马威华振验字第 2300565 号、毕马威华振验字第 2400477 号、毕马威华振验字第 2400478 号、毕马威华振验字第 2400479 号、毕马威华振验字第 2400480 号、毕马威华振验字第 2400482 号)无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

签字注册会计师签名:张欢

张欢



刘婧媛

刘婧媛



会计师事务所负责人签名:邹俊

邹俊

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)

2025年3月24日

第十二节 附件

一、备查文件

- (一) 发行保荐书;
- (二) 上市保荐书;
- (三) 法律意见书;
- (四) 财务报告及审计报告;
- (五) 公司章程(草案);
- (六) 与投资者保护相关的承诺;
- (七) **内部控制审计报告**;
- (八) 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表;
- (九) 其他与本次发行有关的重要文件。

二、文件查阅时间

工作日上午 9:00~11:30; 下午 13:30~17:00。

三、文件查阅地点

(一) 发行人: 西安奕斯伟材料科技股份有限公司

地址: 陕西省西安市高新区西沣南路 1888 号 1-3-029 室

电话: 029-6827 8899 (分机号: 6927)

联系人: 杨春雷

(二) 保荐机构: 中信证券股份有限公司

地址: 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层

电话: 010-6083 6812

联系人: 赵凡

附件一：本次发行相关承诺

(一) 关于股份锁定、持有及减持意向的承诺

1、控股股东的相关承诺

直接控股股东奕斯伟集团和间接控股股东奕明科技分别承诺：

“一、股份锁定承诺及约束措施

1、自奕斯伟材料股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理本公司/企业直接和间接持有的奕斯伟材料首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由奕斯伟材料回购该部分股份。

2、奕斯伟材料上市时未盈利的，在奕斯伟材料实现盈利前，本公司/企业自奕斯伟材料股票上市之日起3个完整会计年度内，不得减持首发前股份；自奕斯伟材料股票上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内，每年减持的首发前股份不得超过奕斯伟材料股份总数的2%（在计算减持比例时，本公司/企业及一致行动人所持公司股份合并计算，下同），并应当符合相关法律法规规定。奕斯伟材料实现盈利后，可以自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份，但本公司/企业亦同时遵循其他限售安排和自愿锁定承诺及相关法律法规的规定。

3、奕斯伟材料上市后6个月内如奕斯伟材料股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行A股股票的发行价格，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行A股股票的发行价格，本公司/企业持有奕斯伟材料股票的锁定期限自动延长6个月；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价格作相应调整。

4、奕斯伟材料上市当年较上市前一年净利润下滑50%以上的，延长本公司/企业届时所持股份锁定期限6个月；奕斯伟材料上市第二年较上市前一年净利润下滑50%以上的，在前项基础上延长本公司/企业届时所持股份锁定期限6个月；奕斯伟材料上市第三年较上市前一年净利润下滑50%以上的，在前两项基础上延长本公司/企业届时所持股份锁定期限6个月。

5、本公司/企业将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员

减持股份》等相关法律法规及证券交易所规则的要求。

6、如本公司/企业违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归奕斯伟材料。本公司/企业在接到奕斯伟材料董事会发出的本公司/企业违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起20日内将有关收益交给奕斯伟材料。

二、持股意向、减持意向承诺及约束措施

1、本公司/企业将严格根据证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本公司/企业就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项；在证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本公司/企业股份锁定承诺规定的限售期内，本公司/企业不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。奕斯伟材料上市后如出现《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》中规定的最近3个已披露经审计的年度报告的会计年度未实施现金分红或者累计现金分红金额低于同期年均归属于奕斯伟材料股东净利润的30%的、最近20个交易日中任一日股票收盘价（向后复权）低于最近一个会计年度或者最近一期财务报告期末每股归属于奕斯伟材料股东的净资产的，本公司/企业不得通过集中竞价交易、大宗交易方式减持其直接或间接持有的奕斯伟材料股份；最近20个交易日中任一日股票收盘价（向后复权）低于首次公开发行时的股票发行价格的，本公司/企业及本公司/企业一致行动人不得通过集中竞价交易、大宗交易方式减持其直接或间接持有的奕斯伟材料股份。

2、在本公司/企业股份锁定期满后，若本公司/企业因故需转让本公司/企业持有的奕斯伟材料股份，本公司/企业就减持奕斯伟材料股份事宜承诺如下：

（1）减持条件

A、法律法规及规范性文件规定的本公司/企业所持奕斯伟材料股份锁定期届满；

B、本公司/企业承诺的所持奕斯伟材料股份锁定期届满；

C、本公司/企业不存在法律法规及规范性文件规定的不得转让股份的情形。

(2) 减持数量

本公司/企业将根据相关法律法规及证券交易所规则进行减持,采取集中竞价交易方式减持奕斯伟材料股份的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过奕斯伟材料股份总数的1%;采取大宗交易方式减持奕斯伟材料股份的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过奕斯伟材料股份总数的2%;采取协议转让方式减持的,单个受让方的受让比例不低于奕斯伟材料股份总数的5%。

(3) 减持方式

本公司/企业减持所持有的奕斯伟材料股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定,减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(4) 减持价格

若本公司/企业在所持奕斯伟材料股份锁定期届满后二十四个月内减持的,减持价格的预期为不低于首次公开发行上市的发行价(若奕斯伟材料股票发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,发行价应相应作除权、除息调整)。

(5) 信息披露

如本公司/企业确定依法减持奕斯伟材料股份的,通过上海证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式首次减持的在减持前15个交易日予以公告,通过其他方式减持的在减持前3个交易日予以公告,并按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行信息披露义务。

3、本公司/企业减持奕斯伟材料股份的,将促使受让方遵守相关法律法规及证券交易所规则关于股份减持的相关规定。

4、如果本公司/企业违反了有关承诺减持而获得的任何收益将归奕斯伟材料,本公司/企业在接到奕斯伟材料董事会发出的本公司/企业违反了关于股份减持承诺的通知之日起20日内将有关收益交给奕斯伟材料。

5、本承诺函出具日后,如果相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时,相应部分自行终止。如果监管规则对股份锁定或减持有新的规定,则本公司/企业在锁定或减持奕斯伟材料股份时将适用并执行届时最新的监管规则。”

2、实际控制人的相关承诺

实际控制人王东升及与其保持一致行动的米鹏、杨新元、刘还平承诺:

“一、股份锁定承诺及约束措施

1、自奕斯伟材料股票上市之日起三十六个月之内,承诺人及其亲属(依据《民法典》相关规定认定)不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的奕斯伟材料首次公开发行A股股票前已发行的股份,也不由奕斯伟材料回购该部分股份。

2、奕斯伟材料上市后6个月内如奕斯伟材料股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行A股股票的发行价格,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行A股股票的发行价格,承诺人持有奕斯伟材料股票的锁定期限自动延长6个月;如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价格作相应调整。

3、在前述限售期满后,在承诺人担任奕斯伟材料董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的股份不超过承诺人所持有奕斯伟材料股份总数的25%,如承诺人在任期届满前离职的,在承诺人就任时确定的期限内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不超过承诺人持有奕斯伟材料股份总数的25%,并且在卖出后六个月内不再买入奕斯伟材料的股份,买入后六个月内不再卖出奕斯伟材料股份;离职后六个月内,不转让承诺人所持奕斯伟材料股份。

4、奕斯伟材料上市时未盈利的,在奕斯伟材料实现盈利前,承诺人自奕斯伟材料股票上市之日起3个完整会计年度内,不得减持首发前股份,若在前述期间内离职的,承诺人将继续遵守;自奕斯伟材料股票上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内,每年减持的首发前股份不得超过奕斯伟材料股份总数的2%(在计算减持比例时,承诺人及一致行动人所持公司股份合并计算,下同),并应当符合相关法律法规规定。奕斯伟材料实现盈利后,可以自当年年

度报告披露后次日起减持首发前股份，但承诺人亦同时遵循其他限售安排和自愿锁定承诺及相关法律法规的规定。

5、奕斯伟材料上市当年较上市前一年净利润下滑50%以上的，延长承诺人届时所持股份锁定期限6个月；奕斯伟材料上市第二年较上市前一年净利润下滑50%以上的，在前项基础上延长承诺人届时所持股份锁定期限6个月；奕斯伟材料上市第三年较上市前一年净利润下滑50%以上的，在前两项基础上延长承诺人届时所持股份锁定期限6个月。

6、承诺人将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及证券交易所规则的要求。

7、如承诺人或其亲属违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归奕斯伟材料。承诺人或其亲属在接到奕斯伟材料董事会发出的承诺人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起20日内将有关收益交给奕斯伟材料。

二、持股意向、减持意向承诺及约束措施

1、承诺人将严格根据证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及承诺人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项；在证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及承诺人股份锁定承诺规定的限售期内，承诺人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。奕斯伟材料上市后如出现《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》中规定的最近3个已披露经审计的年度报告的会计年度未实施现金分红或者累计现金分红金额低于同期年均归属于奕斯伟材料股东净利润的30%的、最近20个交易日中任一日股票收盘价（向后复权）低于最近一个会计年度或者最近一期财务报告期末每股归属于奕斯伟材料股东的净资产的，承诺人不得通过集中竞价交易、大宗交易方式减持其直接或间接持有的奕斯伟材料股份；最近20个交易日中任一日股票收盘价（向后复权）低于首次公开发行股票发行价格的，承诺人及其一致行动人不得通过集中竞价交易、大宗交易方式减持其直接或间接持有的奕斯伟材料股份。

2、股份锁定期满后，承诺人届时将综合考虑承诺人的资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持奕斯伟材料股份。

如承诺人确定依法减持奕斯伟材料股份的，将严格按照证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的届时有效的减持规则进行减持，并履行相应的信息披露义务。承诺人减持奕斯伟材料股份的，将促使受让方遵守相关法律法规及证券交易所规则关于股份减持的相关规定。

3、在股份锁定期满后二十四个月内，如承诺人确定依法减持奕斯伟材料股份的，将以不低于奕斯伟材料首次公开发行A股股票的发行价格进行减持。如自首次公开发行A股股票至披露减持公告期间奕斯伟材料发生过派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，承诺人的减持价格应相应调整。

4、承诺人将在公告的减持期限内以证券监管机构、证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集中竞价等合规方式进行减持。如承诺人确定依法减持奕斯伟材料股份的，承诺人将严格按照证券监管机构、证券交易所颁布的届时有效的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应的减持操作，并及时履行有关信息披露义务。

5、如果承诺人违反了有关承诺减持而获得的任何收益将归奕斯伟材料，承诺人在接到奕斯伟材料董事会发出的承诺人违反了关于股份减持承诺的通知之日起20日内将有关收益交给奕斯伟材料。”

3、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的相关承诺

1) 持有公司股份的董事、高级管理人员的承诺：

“一、本人承诺以下情形下，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

(一) 自公司股票上市交易之日起一年内；

(二) 本人离职后半年内；

(三) 公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的；

(四) 本人因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查

或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的；

(五) 本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳罚没款的除外；

(六) 本人因涉及与公司有关的违法违规，被证券交易所公开谴责未满三个月的；

(七) 公司可能触及重大违法强制退市情形，在证券交易所规定的限制转让期限内的；

(八) 法律、法规、中国证监会和证券交易所规则以及公司章程规定的其他情形。

二、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行A股股票的发行价格，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行A股股票的发行价格，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价格作相应调整。

三、在前述限售期满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%，如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的期限内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。

本人计划通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式转让股份，将按照相关规定及时、准确地履行向证券交易所报告和信息披露义务。本人所持公司股份被人民法院通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式强制执行的，本人将按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。

本人因离婚导致其所持公司股份减少的，将促使股份的过出方和过入方持续共同遵守相关法律法规及证券交易所规则关于股份减持的有关规定。

四、在股份锁定期满后两年内，如本人确定依法减持公司股份的，将以不低于公司首次公开发行A股股票的发行价格进行减持。如自首次公开发行A股股票至披露减持公告期间公司发生过派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，本人的减持价格应相应调整。

五、公司上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本人自公司股票上市之日起3个完整会计年度内，不得减持首次公开发行股票前已发行股份；在前述期间内离职的，应当继续遵守本承诺。公司实现盈利后，本人可以自当年年度报告披露后次日起减持首次公开发行股票前已发行股份，但本人亦同时遵循其他限售安排和自愿锁定承诺及相关法律法规的规定。

六、公司上市后，本人在下列期间不得买卖公司股票：（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；（3）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；（4）证券交易所规定的其他期间。

七、如果本人违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司。本人在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起20日内将有关收益交给公司。

八、本人不因职务变更、离职等原因而放弃上述承诺。

本承诺函出具日后，如果相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对股份锁定或减持等有新的规定，则本人在锁定或减持公司股份时将适用并执行届时最新的监管规则。”

2) 持有公司股份的监事的承诺:

“一、本人承诺以下情形下，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份:

(一) 自公司股票上市交易之日起一年内;

(二) 本人离职后半年内;

(三) 公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机

关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的；

(四) 本人因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的；

(五) 本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳罚没款的除外；

(六) 本人因涉及与公司有关的违法违规，被证券交易所公开谴责未满三个月的；

(七) 公司可能触及重大违法强制退市情形，在证券交易所规定的限制转让期限内的；

(八) 法律、法规、中国证监会和证券交易所规则以及公司章程规定的其他情形。

二、在前述限售期满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的**25%**，如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的期限内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的**25%**，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。

本人计划通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式转让股份，将按照相关规定及时、准确地履行向证券交易所报告和信息披露义务。本人所持公司股份被人民法院通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式强制执行的，本人将按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。

本人因离婚导致其所持公司股份减少的，将促使股份的过出方和过入方持续共同遵守相关法律法规及证券交易所规则关于股份减持的有关规定。

三、公司上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本人自公司股票上市之日起**3**个完整会计年度内，不得减持首次公开发行股票前已发行股份；在前述期间内离职的，应当继续遵守本承诺。公司实现盈利后，本人可以自当年年度报告披露后次日起减持首次公开发行股票前已发行股份，但本人亦同时遵循其他限售安排

和自愿锁定承诺及相关法律法规的规定。

四、公司上市后，本人在下列期间不得买卖公司股票：（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；（3）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；（4）证券交易所规定的其他期间。

五、如果本人违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司。本人在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起20日内将有关收益交给公司。

本承诺函出具日后，如果相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对股份锁定或减持等有新的规定，则本人在锁定或减持公司股份时将适用并执行届时最新的监管规则。”

3) 持有公司股份的核心技术人员的承诺：

“1、自公司股票上市之日起十二个月内和本人离职后六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

在上述股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不超过公司上市时本人所持公司首次公开发行A股股票前已发行的股份总数的25%，减持比例可以累积使用。

公司上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本人自公司股票上市之日起3个完整会计年度内，不得减持首次公开发行股票前已发行股份；在前述期间内离职的，应当继续遵守本承诺。公司实现盈利后，本人可以自当年年度报告披露后次日起减持首次公开发行股票前已发行股份，但本人亦同时遵循其他限售安排和自愿锁定承诺及相关法律法规的规定。

若法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所相关业务规则对于核心技术人员股份转让有其他规定的，本人承诺遵守该等规定。

2、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。如果本人违反了

关于股份锁定期承诺的相关内容,则由此所得的收益归公司。本人在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给公司。”

4、员工持股平台及宁波奕芯、重庆奕芯的相关承诺

三家员工持股平台奕斯欣盛、奕斯欣诚、奕斯欣合及宁波奕芯承诺如下,重庆奕芯下述承诺正在签署中:

“一、股份锁定承诺及约束措施

1、自公司股票上市之日起三十六个月之内,不转让或者委托他人管理本单位持有的公司首次公开发行A股股票前已发行的股份(下称“首发前股份”),也不由公司回购该部分股份。

2、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行A股股票的发行价格,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行A股股票的发行价格,本单位持有公司股票的锁定期限自动延长6个月;如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价格作相应调整。

3、公司上市时未盈利的,在公司实现盈利前,本单位自公司股票上市之日起3个完整会计年度内,不得减持首发前股份;自公司股票上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内,每年减持的首发前股份不得超过公司股份总数的2%(在计算减持比例时,本单位及一致行动人所持公司股份合并计算,下同),并应当符合相关法律法规规定。公司实现盈利后,可以自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份,但本单位亦同时遵循其他限售安排和自愿锁定承诺及相关法律法规的规定。

4、公司上市当年较上市前一年净利润下滑50%以上的,延长本单位届时所持股份锁定期限6个月;公司上市第二年较上市前一年净利润下滑50%以上的,在前项基础上延长本单位届时所持股份锁定期限6个月;公司上市第三年较上市前一年净利润下滑50%以上的,在前两项基础上延长本单位届时所持股份锁定期限6个月。

5、本单位将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及证券交易所规则的要求。

6、如本单位违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司。本单位在接到公司董事会发出的本单位违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起20日内将有关收益交给公司。

二、持股意向、减持意向承诺及约束措施

1、本单位将严格根据证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本单位就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项；在证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本单位股份锁定承诺规定的限售期内，本单位不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。公司上市后如出现《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》中规定的最近3个已披露经审计的年度报告的会计年度未实施现金分红或者累计现金分红金额低于同期年均归属于公司股东净利润的30%的、最近20个交易日中任一日股票收盘价（向后复权）低于最近一个会计年度或者最近一期财务报告期末每股归属于公司股东的净资产的，本单位不得通过集中竞价交易、大宗交易方式减持其持有的公司股份；最近20个交易日中任一日股票收盘价（向后复权）低于首次公开发行时的股票发行价格的，本单位及本单位一致行动人不得通过集中竞价交易、大宗交易方式减持其持有的公司股份。

2、在本单位股份锁定承诺规定的限售期满后，若本单位因故需转让本单位持有的公司股份，本单位就减持公司股份事宜承诺如下：

（1）减持条件

- A、法律法规及规范性文件规定的本单位所持公司股份锁定期届满；
- B、本单位承诺的所持公司股份锁定期届满；
- C、本单位不存在法律法规及规范性文件规定的不得转让股份的情形。

（2）减持数量

本单位将根据相关法律法规及证券交易所规则进行减持,采取集中竞价交易方式减持公司股份的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式减持公司股份的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%;采取协议转让方式减持的,单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。

(3) 减持方式

本单位减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定,减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(4) 减持价格

若本单位在所持公司股份锁定期届满后二十四个月内减持的,减持价格的预期为不低于首次公开发行上市的发行价(若公司股票发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,发行价应相应作除权、除息调整)。

(5) 信息披露

如本单位确定依法减持公司股份的,通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式首次减持的在减持前15个交易日予以公告,通过其他方式减持的在减持前3个交易日予以公告,并按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行信息披露义务。

3、本单位减持公司股份的,将促使受让方遵守相关法律法规及证券交易所规则关于股份减持的相关规定。

4、如果本单位违反了有关承诺减持而获得的任何收益将归公司,本单位在接到公司董事会发出的本单位违反了关于股份减持承诺的通知之日起20日内将有关收益交给公司。

5、本承诺函出具日后,如果相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时,相应部分自行终止。如果监管规则对股份锁定或减持有新的规定,则本单位在锁定或减持公司股份时将适用并执行届时最新的监管规则。”

5、其余股东的相关承诺

股东名称	承诺内容
------	------

二期基金	<p>一、股份锁定承诺及约束措施</p> <p>1、自公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的公司首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、本单位将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及证券交易所规则的要求。</p> <p>3、如本单位违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，本单位愿意依法承担相应责任。</p> <p>二、持股意向、减持意向承诺及约束措施</p> <p>1、本单位将严格根据证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本单位就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项；在证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本单位股份锁定承诺规定的限售期内，本单位不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。</p> <p>2、在本单位股份锁定承诺规定的限售期满后，若本单位因故需转让本单位持有的公司股份，本单位就减持公司股份事宜承诺如下：</p> <p>(1) 减持条件</p> <p>A、法律法规及规范性文件规定的本单位所持公司股份锁定期届满；</p> <p>B、本单位承诺的所持公司股份锁定期届满；</p> <p>C、本单位不存在法律法规及规范性文件规定的不得转让股份的情形。</p> <p>(2) 减持数量</p> <p>本单位将根据相关法律法规及证券交易所规则进行减持，采取集中竞价交易方式减持公司股份的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；采取协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。</p> <p>(3) 减持方式</p> <p>本单位减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>(4) 减持价格</p> <p>若本单位在所持公司股份锁定期届满后二十四个月内减持的，按照法律法规、中国证监会、证券交易所关于上市公司股东减持的相关规定进行股份减持。</p> <p>(5) 信息披露</p> <p>在本单位持有公司5%以上股份期间，如本单位确定依法减持公司股份的，通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式首次减持的在减持前15个交易日予以公告，通过其他方式减持的在减持前3个交易日予以公告，并按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行信息披露义务。</p> <p>3、本单位减持公司股份的，将促使受让方遵守相关法律法规及证券交易所规则关于股份减持的相关规定。</p> <p>4、如果本单位违反了有关承诺，则由此所得按相关法律法规规定处置。</p> <p>5、本承诺函出具日后，如果相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对股份锁定或减持有新的规定，则本单位在锁定或减持公司股份时将适用并执行届时最新的监管规则。</p>
陕西集成电路基金	<p>一、股份锁定承诺及约束措施</p> <p>1、自公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的公司首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、本单位将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人</p>

	<p>员减持股份》等相关法律法规及证券交易所规则的要求。</p> <p>3、如本单位违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司。本单位在接到公司董事会发出的本单位违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起20日内将有关收益交给公司。</p> <p>二、持股意向、减持意向承诺及约束措施</p> <p>1、本单位将严格根据证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本单位就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项；在证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本单位股份锁定承诺规定的限售期内，本单位不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。</p> <p>2、在本单位股份锁定承诺规定的限售期满后，若本单位因故需转让本单位持有的公司股份，本单位就减持公司股份事宜承诺如下：</p> <p>(1) 减持条件</p> <p>A、法律法规及规范性文件规定的本单位所持公司股份锁定期届满；</p> <p>B、本单位承诺的所持公司股份锁定期届满；</p> <p>C、本单位不存在法律法规及规范性文件规定的不得转让股份的情形。</p> <p>(2) 减持数量</p> <p>本单位将根据相关法律法规及证券交易所规则进行减持，采取集中竞价交易方式减持公司股份的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；采取协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。</p> <p>(3) 减持方式</p> <p>本单位减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>(4) 减持价格</p> <p>若本单位在所持公司股份锁定期届满后二十四个月内减持的，减持价格的预期为不低于首次公开发行上市的发行价（若公司股票发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，发行价应相应作除权、除息调整）。</p> <p>(5) 信息披露</p> <p>在本单位持有公司5%以上股份期间，如本单位确定依法减持公司股份的，通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式首次减持的在减持前15个交易日予以公告，通过其他方式减持的在减持前3个交易日予以公告，并按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行信息披露义务。</p> <p>3、本单位减持公司股份的，将促使受让方遵守相关法律法规及证券交易所规则关于股份减持的相关规定。</p> <p>4、如果本单位违反了有关承诺减持而获得的任何收益将归公司，本单位在接到公司董事会发出的本单位违反了关于股份减持承诺的通知之日起20日内将有关收益交给公司。</p> <p>5、本承诺函出具日后，如果相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对股份锁定或减持有新的规定，则本单位在锁定或减持公司股份时将适用并执行届时最新的监管规则。</p>
创合材丰	<p>一、股份锁定承诺及约束措施</p> <p>1、自奕斯伟材料股票上市之日起12个月之内，不转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的奕斯伟材料首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由奕斯伟材料回购该部分股份。</p> <p>2、如果本单位违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，本单位愿意依法承担相应责任。</p> <p>二、减持承诺及约束措施</p>

	<p>1、本单位将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本单位就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项；在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本单位股份锁定承诺规定的限售期内，本单位不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。</p> <p>2、股份锁定期满后，如本单位确定依法减持奕斯伟材料股份的，将严格按照证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的届时有效的减持规则进行减持，并履行相应的信息披露义务。</p> <p>3、本单位将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集中竞价等合规方式进行减持。如本单位未来依法发生任何增持或减持奕斯伟材料股份情形的，本单位将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。</p> <p>4、如果本单位违反了有关承诺减持，本单位在愿意依法承担相应责任。</p>
嘉兴顺嘉	<p>一、股份锁定承诺及约束措施</p> <p>1、自奕斯伟材料股票上市之日起12个月之内，不转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的奕斯伟材料首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由奕斯伟材料回购该部分股份。</p> <p>2、本单位所持有的于奕斯伟材料提交本次发行上市申请前十二个月内所取得的奕斯伟材料注册资本所对应的奕斯伟材料股份，自该等股份取得之日起三十六个月内不得转让，也不提议由奕斯伟材料回购该部分股份。</p> <p>3、如果本单位违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，本单位愿意依法承担相应责任。</p> <p>二、减持承诺及约束措施</p> <p>1、本单位将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本单位就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项；在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本单位股份锁定承诺规定的限售期内，本单位不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。</p> <p>2、股份锁定期满后，如本单位确定依法减持奕斯伟材料股份的，将严格按照证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的届时有效的减持规则进行减持，并履行相应的信息披露义务（如需）。</p> <p>3、本单位将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集中竞价等合规方式进行减持。如本单位未来依法发生任何增持或减持奕斯伟材料股份情形的，本单位将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。</p> <p>4、如果本单位违反了关于股份减持承诺的相关内容，本单位愿意依法承担相应责任。</p>
中建材新材料基金	<p>一、股份锁定承诺及约束措施</p> <p>1、自奕斯伟材料股票上市之日起12个月之内，不转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的奕斯伟材料首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由奕斯伟材料回购该部分股份。</p> <p>2、如果本单位违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，本单位愿意依法承担相应责任。</p> <p>二、减持承诺及约束措施</p> <p>1、本单位将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本单位就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项；在证券监管机构、自律机构及证券交易所</p>

	<p>所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本单位股份锁定承诺规定的限售期内, 本单位不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。</p> <p>2、股份锁定期满后, 如本单位确定依法减持奕斯伟材料股份的, 将严格按照证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的届时有效的减持规则进行减持, 并履行相应的信息披露义务(如需)。</p> <p>3、本单位将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集中竞价等合规方式进行减持。如本单位未来依法发生任何增持或减持奕斯伟材料股份情形的, 本单位将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作, 并及时履行有关信息披露义务(如需)。</p> <p>4、如果本单位违反了关于股份减持承诺的相关内容, 本单位愿意依法承担相应责任。</p>
<p>西安汇奕、中芯熙诚、宏兆天实、嘉兴隽望、国寿建泉、宁波庄宣、陕西民营基金、三行资本、烟台中冀、中证投资、众励投资</p>	<p>一、股份锁定承诺及约束措施</p> <p>1、自奕斯伟材料股票上市之日起12个月之内, 不转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的奕斯伟材料首次公开发行A股股票前已发行的股份, 也不由奕斯伟材料回购该部分股份。</p> <p>2、如果本单位违反了关于股份锁定期承诺的相关内容, 则由此所得的收益归奕斯伟材料。本单位在接到奕斯伟材料董事会发出的本单位违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起20日内将有关收益交给奕斯伟材料。</p> <p>二、减持承诺及约束措施</p> <p>1、本单位将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定, 以及本单位就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项; 在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本单位股份锁定承诺规定的限售期内, 本单位不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。</p> <p>2、股份锁定期满后, 如本单位确定依法减持奕斯伟材料股份的, 将严格按照证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的届时有效的减持规则进行减持, 并履行相应的信息披露义务。</p> <p>3、本单位将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集中竞价等合规方式进行减持。如本单位未来依法发生任何增持或减持奕斯伟材料股份情形的, 本单位将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定进行相应增持或减持操作, 并及时履行有关信息披露义务。</p> <p>4、如果本单位违反了有关承诺减持而获得的任何收益将归奕斯伟材料, 本单位在接到奕斯伟材料董事会发出的本单位违反了关于股份减持承诺的通知之日起20日内将有关收益交给奕斯伟材料。</p>
<p>渝富芯材</p>	<p>一、股份锁定承诺及约束措施</p> <p>1、自奕斯伟材料股票上市之日起12个月之内, 不转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的奕斯伟材料首次公开发行A股股票前已发行的股份, 也不由奕斯伟材料回购该部分股份。</p> <p>2、如果本单位违反了关于股份锁定期承诺的相关内容, 本单位愿意依法承担相应责任。</p> <p>二、减持承诺及约束措施</p> <p>1、本单位将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定, 以及本单位就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项; 在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本单位股份锁定承诺规定的限售期内, 本单位不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。</p>

	<p>2、股份锁定期满后，如本单位确定依法减持奕斯伟材料股份的，将严格按照证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的届时有效的减持规则进行减持，并履行相应的信息披露义务。</p> <p>3、本单位将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集中竞价等合规方式进行减持。如本单位未来依法发生任何增持或减持奕斯伟材料股份情形的，本单位将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。</p> <p>4、如果本单位违反了有关承诺减持而获得的任何收益将归奕斯伟材料，本单位愿意依法承担相应责任。</p>
天津博思	<p>一、股份锁定承诺及约束措施</p> <p>1、自奕斯伟材料股票上市之日起12个月之内，不转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的奕斯伟材料首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由奕斯伟材料回购该部分股份。</p> <p>2、若本单位违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本单位将依法承担相应的责任。</p> <p>二、减持承诺及约束措施</p> <p>1、本单位将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本单位就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项；在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本单位股份锁定承诺规定的限售期内，本单位不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。</p> <p>2、股份锁定期满后，如本单位确定依法减持奕斯伟材料股份的，将严格按照证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的届时有效的减持规则进行减持，并履行相应的信息披露义务。</p> <p>3、本单位将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集中竞价等合规方式进行减持。如本单位未来依法发生任何增持或减持奕斯伟材料股份情形的，本单位将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。</p> <p>4、若本单位违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本单位将依法承担相应的责任。</p>
长峡金石	<p>一、股份锁定承诺及约束措施</p> <p>1、自奕斯伟材料股票上市之日起12个月之内，不转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的奕斯伟材料首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由奕斯伟材料回购该部分股份。</p> <p>2、如果本单位违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，本单位将依法承担相应法律责任。</p> <p>二、减持承诺及约束措施</p> <p>1、本单位将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本单位就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项；在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本单位股份锁定承诺规定的限售期内，本单位不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。</p> <p>2、股份锁定期满后，如本单位确定依法减持奕斯伟材料股份的，将严格按照证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的届时有效的减持规则进行减持，并履行相应的信息披露义务。</p> <p>3、本单位将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集中竞价等合规方式进行减持。如本单位未来</p>

	<p>依法发生任何增持或减持奕斯伟材料股份情形的，本单位将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。</p> <p>4、如果本单位违反了有关承诺减持，本单位将依法承担相应法律责任。</p>
中网投	<p>一、股份锁定承诺及约束措施</p> <p>1、自奕斯伟材料股票上市之日起12个月之内，不转让或者委托他人管理本单位持有的奕斯伟材料首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不提议由奕斯伟材料回购该部分股份。</p> <p>2、如果本单位违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，本单位依法承担相应责任。</p> <p>二、减持承诺及约束措施</p> <p>1、股份锁定期满后，如本单位确定依法减持奕斯伟材料股份的，将严格按照证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的届时有效的减持规则进行减持，并履行相应的信息披露义务（如需）。</p> <p>2、如果本单位违反了有关减持承诺的相关内容，本单位依法承担相应责任。</p>
华泰紫金	<p>1、自奕斯伟材料股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的奕斯伟材料首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由奕斯伟材料回购该部分股份。</p> <p>2、若本单位所持有的奕斯伟材料股份系于奕斯伟材料提交本次发行上市申请前十二个月内取得，则自该等股份取得之日起三十六个月内不得转让，也不提议由奕斯伟材料回购。</p> <p>3、如果本单位违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，将依法承担相应责任。</p>
国合新力	<p>1、自奕斯伟材料股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的奕斯伟材料首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由奕斯伟材料回购该部分股份。</p> <p>2、本单位所持有的于奕斯伟材料提交本次发行上市申请前十二个月内所取得的奕斯伟材料注册资本所对应的奕斯伟材料股份，自该等股份取得之日起三十六个月内不得转让，也不提议由奕斯伟材料回购该部分股份。</p> <p>3、如果本单位违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归奕斯伟材料。本单位保证在接到奕斯伟材料董事会发出的本单位违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起20日内将有关收益交给奕斯伟材料。</p>
长安汇通、钛信九期、睿势六期、佰仕德	<p>1、自奕斯伟材料股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的奕斯伟材料首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由奕斯伟材料回购该部分股份。</p> <p>2、若本单位所持有的奕斯伟材料股份系于奕斯伟材料提交本次发行上市申请前十二个月内取得，则自该等股份取得之日起三十六个月内不得转让，也不提议由奕斯伟材料回购。</p> <p>3、如果本单位违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归奕斯伟材料。本单位保证在接到奕斯伟材料董事会发出的本单位违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起20日内将有关收益交给奕斯伟材料。</p>
普耀芯业、东方电气基金、广东星耀、越秀智创、嘉兴翊榛、建银国际、建泉绿色基金、中小企	<p>1、自奕斯伟材料股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的奕斯伟材料首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由奕斯伟材料回购该部分股份。</p> <p>2、如果本单位违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归奕斯伟材料。本单位保证在接到奕斯伟材料董事会发出的本单位违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起20日内将有关收益交给奕斯伟材料。</p>

业基金、江阴毅达、宁波卓煌、青岛远润、上海澜翎、天堂硅谷领新、天堂硅谷恒新、博达奕行、烟台伯和、北京硅新、国开科创、道禾源信、上海综改基金、泓生嘉启	
川投金石	<p>1、自奕斯伟材料股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的奕斯伟材料首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由奕斯伟材料回购该部分股份。</p> <p>2、如果本单位违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，本单位将依法承担相应责任。</p>
苏州芯动能、建投投资、无锡源轩	<p>1、自奕斯伟材料股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的奕斯伟材料首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由奕斯伟材料回购该部分股份。</p> <p>2、如果本单位违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，本单位愿意依法承担相应责任。</p>
盛剑科技、光子强链、鑫华半导体、海南瑞麟	<p>1、本单位所持有的于奕斯伟材料提交本次发行上市申请前十二个月内所取得的奕斯伟材料注册资本所对应的奕斯伟材料股份，自该等股份取得之日起三十六个月内不得转让，也不提议由奕斯伟材料回购该部分股份。</p> <p>2、如果本单位违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归奕斯伟材料。本单位保证在接到奕斯伟材料董事会发出的本单位违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起20日内将有关收益交给奕斯伟材料。</p>
王建成	<p>1、本人所持有的于奕斯伟材料提交本次发行上市申请前十二个月内所取得的奕斯伟材料注册资本所对应的奕斯伟材料股份，自该等股份取得之日起三十六个月内不得转让，也不提议由奕斯伟材料回购该部分股份。</p> <p>2、如果本人违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归奕斯伟材料。本人保证在接到奕斯伟材料董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起20日内将有关收益交给奕斯伟材料。</p>

(二) 关于首次公开发行上市后稳定股价的承诺

1、关于股份发行上市后稳定公司股价的预案

“一、稳定公司股价的原则

公司将确保正常经营和可持续发展，为全体股东带来合理回报。为兼顾全体股东的即期利益和长远利益，有利于公司健康发展和市场稳定，当公司股价出现启动股价稳定措施的具体条件时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会颁布的规范性文件的相关规定，并根据公司实际情况，

公司和有关方将启动有关稳定股价的措施,以维护市场公平,切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

二、启动稳定股价措施的具体条件

公司自上市之日起三年内,若出现公司股票连续 20 个交易日(第 20 个交易日称为“触发稳定股价措施日”)。如在该 20 个交易日期间公司披露了新的最近一期经审计的净资产,则该等 20 个交易日的期限需自公司披露了新的最近一期经审计的净资产之日起重新开始计算,下同)的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产情况的,则为启动稳定股价措施的具体条件,公司和有关方将采取有关股价稳定措施。

当公司或有关方正式公告将采取的稳定股价措施之前,或当公司和有关方采取稳定股价措施后,公司股票若连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产,则可终止启动或实施稳定股价措施。

以上所称“每股净资产”是指经审计的公司最近一期合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数除以该期审计基准日时公司的股份总数。如该期审计基准日后至触发稳定股价措施日期间,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息事项导致公司净资产或股份总数出现变化的,上述每股净资产将相应进行调整。

三、可采取的具体措施

在遵守所适用的法律、法规、规范性文件的前提下,公司、公司控股股东、公司的董事(仅指负有增持义务的董事,即独立董事、未在公司领取薪酬或未直接或间接持有公司股份的董事以外的其他董事)和高级管理人员(仅指负有增持义务的高级管理人员,即直接或间接持有公司股份的高级管理人员)将采取以下措施稳定公司股价:

(一) 公司回购股份

1、启动回购股份的程序

在满足启动稳定股价措施的具体条件之日起 10 个交易日内,公司制订回购公司股票方案并提交董事会审议,回购方案应包括回购的价格区间、数量范围、

回购期限等。董事会综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素,决定是否回购公司股份。独立董事应对公司回购方案发表独立意见,监事会应对公司回购方案提出审核意见。

若届时有效的《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》规定或公司股东大会就回购股份事项对董事会实施了授权,即公司回购股份经三分之二以上董事出席的董事会会议决议即可生效实施的,公司回购股份方案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意、并经三分之二以上董事出席的董事会审议通过后公告实施。若届时有效的《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》未予规定且公司股东大会亦未授权董事会实施股份回购的,则公司回购股份方案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意、经董事会审议通过后予以公告并提请股东大会审议,于股东大会审议通过后予以实施。

公司回购股份应符合届时有效的法律、法规规定及中国证监会、证券交易所颁布的相关规范性文件的规定,并按照该等规定的要求履行有关回购股份的具体程序,并及时进行信息披露。

2、回购股份的其他条件

在满足本预案规定的启动稳定股价措施的具体条件,且满足如下条件时,公司负有启动回购公司股份程序以稳定公司股价的义务:

(1) 公司股票上市已满一年、公司回购股份不会导致其股权分布不符合上市条件;

(2) 回购股份符合相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所的相关规定。

如公司在本预案规定的实施期限内回购公司股份将导致违反前款任何一项条件的,则公司在本预案规定的实施期限内不负有启动回购公司股份程序的义务。

3、回购股份的方式

回购股份的方式为通过证券交易所证券交易系统允许的方式进行,包括但不限于集中竞价交易方式、要约方式及中国证监会认可的其他方式。

4、回购股份的价格

回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。

5、回购股份的资金总额

公司为稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要求之外,还应符合下列各项:(1)公司单轮用于回购的资金总额原则上不少于公司上一会计年度经审计的归属于母公司普通股股东净利润的5%;(2)公司单一会计年度回购股份比例不超过公司上一年度末总股本的2%;(3)公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额。超过上述标准的,公司有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。

6、回购股份的终止

回购期限自回购股份方案生效实施之日起3个月内。在回购期限内,如公司股票连续5个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产,或者公司继续回购股份将导致公司不满足法定上市条件的,公司可以终止回购股份。

7、回购股份的用途

回购的股份将被注销,从而减少公司的注册资本。

(二) 控股股东增持股份

1、启动增持股份的程序

(1) 公司未能实施回购股份方案

在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下,并且在公司无法实施回购股份或回购股份的议案未能获得公司董事会/股东大会批准,公司控股股东将在触发稳定股价措施日或公司董事会/股东大会做出不实施回购股份方案的决议之日起10个交易日内向公司提交增持公司股份的方案,并由公司进行公告。

(2) 公司已实施回购股份方案

公司虽已实施回购股份方案,但仍未满足公司股票连续5个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产之条件,公司控股股东将在公司回购股份方案实施完毕或终止之日起10个交易日内向公司提交增持公司股份的方案,并由公司进行公告。

2、增持股份的计划

除非出现下列情形，公司控股股东将在公司公告增持方案之日起 3 个月内依照方案中规定的价格区间、数量范围、完成期限等实施增持：

(1) 增持股份的时间不符合相关法律法规、规范性文件及证券交易所的监管规则的规定；

(2) 继续增持股份将导致公司的股权分布不符合上市条件；

(3) 继续增持将触发控股股东的要约收购义务且控股股东未计划实施要约收购；

(4) 增持股份不符合相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所的其他相关规定。

公司控股股东可以直接执行有关增持事宜，也可以通过其一致行动人执行有关增持事宜。

3、增持股份的方式

增持方式为通过证券监管机构、证券交易所等有权部门允许的方式进行，包括但不限于集中竞价交易方式和大宗交易方式等。

4、增持股份的价格

增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。

5、增持股份的资金总额

控股股东单轮用于增持的资金总额不少于其最近一次或最近一年（以孰高为准）从公司取得的现金分红（税后）的 20%；单一会计年度内用以稳定股价的增持资金合计不超过其最近一次或最近一年（以孰高为准）从公司取得的现金分红（税后）的 50%。超过上述标准的，控股股东有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。

6、增持股份的终止

在控股股东实施增持公司股票方案过程中，若公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，或者继续增持将导致公司不满

足法定上市条件的，控股股东可以终止执行该次增持股份方案。

(三) 董事、高级管理人员增持股份

1、启动增持股份的程序

在公司控股股东增持公司股份方案实施完毕后，仍未满足公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产之条件，则负有增持义务的董事、高级管理人员应在控股股东增持公司股份方案实施完毕后 10 个交易日内向公司提交增持公司股份的方案，并由公司进行公告。

本预案中负有增持义务的董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职的负有增持义务的董事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任职的负有增持义务的董事、高级管理人员。对于公司拟聘任的董事、高级管理人员，符合负有增持义务条件的，应在获得提名前书面同意履行前述义务。

2、董事、高级管理人员增持股份的计划

除非出现下列情形，公司董事、高级管理人员将在公告增持方案之日起 3 个月内依照方案中规定的价格区间、数量范围、完成期限等实施增持：

(1) 增持股份的时间不符合相关法律法规、规范性文件及证券交易所的监管规则的规定；

(2) 继续增持股份将导致公司的股权分布不符合上市条件；

(3) 继续增持将触发董事、高级管理人员的要约收购义务且董事、高级管理人员未计划实施要约收购；

(4) 增持股份不符合相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所的其他相关规定。

公司董事、高级管理人员可以直接执行有关增持事宜，也可以通过其一致行动人执行有关增持事宜。

3、增持股份的方式

增持方式为通过证券监管机构、证券交易所等有权部门允许的方式进行，包括但不限于集中竞价交易方式和大宗交易方式等。

4、增持股份的价格

增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。

5、增持股份的资金总额

公司董事、高级管理人员各自单轮用于增持的资金总额不低于上一年度各自从公司取得的税后薪酬的 20%；单一会计年度内用以稳定股价的增持资金合计不超过其上一会计年度各自从公司取得的税后薪酬的 50%。超过上述标准的，董事和高级管理人员有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。

6、增持股份的终止

在董事、高级管理人员实施增持公司股票方案过程中，若公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，或者继续增持将导致公司不满足法定上市条件的，董事、高级管理人员可以终止执行该次增持股份方案。

四、稳定股价措施的再次启动

在采取上述稳定股价措施且在执行完毕后，再次出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产的，则公司、控股股东、董事和高级管理人员应在该情形出现之日起 10 个交易日内按照本预案的规定重新确定启动新一轮的稳定股价措施。

五、稳定股价预案的约束措施

1、对公司的约束措施

如在满足本预案规定的启动稳定股价措施的具体条件和公司回购股份的其他条件的情况下，公司未及时制订回购股份方案并提请董事会审议，或者董事会没有正当充分的理由而否决回购股份方案，则公司及对回购股份方案投否决票的董事应在指定的信息披露媒体上说明情况和原因。公司应继续履行尽快制订股份回购方案的义务，公司董事应督促公司履行前述义务。

2、对负有增持义务的控股股东、董事和高级管理人员的约束措施

如负有增持义务的控股股东未按照本预案规定履行增持义务，则公司自该年度起有权扣留相等于控股股东应承担的用于履行增持义务的资金总额的分红款，

控股股东放弃对该部分分红款的所有权，由公司用于回购股份或其他用途。

如负有增持义务的董事和高级管理人员未按照本预案规定履行其增持义务的，则公司自该年度起有权扣留董事、高级管理人员应承担的用于履行增持义务的资金总额的税后薪酬，被扣留薪酬的董事或高级管理人员放弃对该部分薪酬的所有权，由公司用于回购股份或其他用途。”

2、发行人的相关承诺

“1、公司将依照《关于股份发行上市后稳定公司股价的预案》规定的条件、时间、期限、价格、方式等履行稳定公司股价的义务。

2、如公司未能依照上述承诺履行义务的，公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。”

3、控股股东的相关承诺

控股股东奕斯伟集团和间接控股股东奕明科技分别承诺：

“1、本公司/企业将依照《关于股份发行上市后稳定公司股价的预案》规定的条件、时间、期限、价格、方式等履行稳定奕斯伟材料股价的义务。

2、如本公司/企业未能依照上述承诺履行义务的，本公司/企业将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。”

4、发行人董事、高级管理人员的相关承诺

负有增持义务的发行人董事、高级管理人员承诺：

“1、本人将依照《关于股份发行上市后稳定公司股价的预案》规定的条件、时间、期限、价格、方式等履行稳定公司股价的义务。

2、如本人未能依照上述承诺履行义务的，本人将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。”

(三) 关于股份回购的承诺

详见本节之“附件一、(二)关于首次公开发行上市后稳定股价的承诺”和“附件一、(四)关于欺诈发行上市的股份购回承诺”。

(四) 关于欺诈发行上市的股份购回承诺

1) 奕斯伟材料承诺:

“1、公司保证本次公开发行并在科创板上市不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,不存在欺诈发行的情形。

2、若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或有权机构认定公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,或公司存在欺诈发行的情形,导致对判断公司是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将在该等有权部门作出前述认定后五个工作日内启动股份购回程序,依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格不低于公司股票发行价,并根据相关法律、法规及公司章程规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的,从其规定。若公司在本次发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对前述发行价进行除权除息调整。”

2) 实际控制人王东升及与其保持一致行动的米鹏、杨新元、刘还平承诺:

“1、本人保证本次发行上市不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,不存在欺诈发行的情形。

2、若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或有权机构认定奕斯伟材料本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,或奕斯伟材料存在欺诈发行的情形,导致对判断奕斯伟材料是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将在该等有权部门作出前述认定后五个工作日内启动股份购回程序,依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格不低于奕斯伟材料股票发行价,并根据相关法律、法规及公司章程规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的,从其规定。若奕斯伟材料在本次发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对前述发行价进行除权除息调整。

3、若因奕斯伟材料首次公开发行股票并上市存在欺诈发行情形的,招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者实际损失。在该等违法事实被中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或司法机关等有权机关认定后,本人将本着简化程

序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的实际损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。”

4) 控股股东奕斯伟集团和间接控股股东奕明科技分别承诺:

“1、本公司/企业保证奕斯伟材料本次公开发行并在科创板上市不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在欺诈发行的情形。

2、若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或有权机构认定奕斯伟材料本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或奕斯伟材料存在欺诈发行的情形，导致对判断奕斯伟材料是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司/企业将在该等有权部门作出前述认定后五个工作日内启动股份购回程序，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于奕斯伟材料股票发行价，并根据相关法律、法规及奕斯伟材料章程规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的，从其规定。若奕斯伟材料在本次发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对前述发行价进行除权除息调整。

3、若因奕斯伟材料首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/企业将依法赔偿投资者实际损失。在该等违法事实被中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本公司/企业将本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额，通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的实际损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。”

5) 发行人董事、监事、高级管理人员承诺:

“1、本人保证公司本次公开发行并在科创板上市不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在欺诈发行的情形。

2、若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或有权机构认定公司本次

发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或公司存在欺诈发行的情形，导致对判断公司是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司在该等有权部门作出前述认定后五个工作日内启动股份购回程序，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于公司股票发行价，并根据相关法律、法规及公司章程规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的，从其规定。若公司在本次发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对前述发行价进行除权除息调整。”

(五) 关于填补被摊薄即期回报的承诺

1、控股股东及实际控制人的相关承诺

1) 控股股东奕斯伟集团和间接控股股东奕明科技分别承诺:

“一、不越权干预奕斯伟材料经营管理活动，不侵占奕斯伟材料利益；

二、切实履行奕斯伟材料制定的有关填补被摊薄即期回报的有关措施以及本承诺函；

三、本承诺函经出具后即具有法律效力。本公司/企业将严格履行本承诺函中的各项承诺。本公司/企业自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺本公司/企业将依法承担相应责任；

四、本承诺函出具日后至奕斯伟材料本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所该等规定时，本公司/企业承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。”

2) 实际控制人王东升及与其保持一致行动的米鹏、杨新元、刘还平承诺:

“一、不越权干预奕斯伟材料经营管理活动，不侵占奕斯伟材料利益；

二、切实履行奕斯伟材料制定的有关填补被摊薄回报的有关措施以及本承诺函；

三、本承诺函经出具后即具有法律效力。本人将严格履行本承诺函中的各项承诺。本人自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺本人将依法

承担相应补充责任；

四、本承诺函出具日后至奕斯伟材料本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定、且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。”

2、董事、高级管理人员的相关承诺

“一、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

二、对本人的职务消费行为进行约束；

三、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

四、由董事会或提名薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；

五、若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；

六、本承诺函经本人出具后即具有法律效力。本人将严格履行本承诺函中的各项承诺。本人自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任；

七、本承诺函出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。”

3、发行人的相关承诺

“鉴于本次发行可能导致公司的每股收益等财务指标有所下降，公司将采取多项措施以防范业务风险，提高日常运营效率，降低运营成本，提升公司经营业绩。

1、加强主营业务开拓，提升公司竞争力

公司将继续坚持技术创新，提高公司的产品技术及服务水平，进一步提升公司的核心竞争力。

2、加快募投项目投资进度，尽早实现预期效益

本次募投项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向，具有良好的经济效益和社会效益。本次发行募集资金到位后，公司将抓紧进行本次募投项目的实施工作，积极调配资源，统筹合理安排项目的投资建设进度，力争缩短项目建设期，争取募投项目早日完工并实现预期效益，避免即期回报被摊薄，或使公司被摊薄的即期回报尽快得到填补。

3、加强募集资金管理，保证募集资金合理、规范使用

为规范募集资金的管理和使用，确保本次募集资金专项用于募集资金投资项目，公司已根据相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了公司上市后适用的《募集资金使用管理办法》，对公司上市后募集资金的专户存储、使用、用途变更等行为进行严格规范，以便于募集资金的管理和监督。

本次发行募集资金到位后，公司将根据相关法规和《募集资金使用管理办法》的要求，严格管理募集资金的使用，保证募集资金按照既定用途合理、规范使用，充分有效地发挥作用。

4、加强经营管理和内部控制，提升经营效率

公司将在现有公司治理水平上不断完善、加强内控体系建设，合理控制资金成本，提高资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管理风险。公司将采取的主要措施包括：进一步加强对公司及各子公司(如有)在业务发展、资源整合、要素共享等方面的统筹，发挥战略协同优势；加强降本增效工作，强化基础计量和规范成本核算工作；加强服务质量管理，进一步完善服务质量管理体系，提升公司整体的经营效率、资源配置效率和盈利能力。

5、完善利润分配制度，强化投资者回报机制

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，公司已在上市后适用的《公司章程》中规定了利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序、机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。同时，公司制定了《上市后三年股东分红回报规划》，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报。本次发行后，公司将依据相关法律法规规定，严格执行《公司章程》并落实现金分红的相关制度，保障投资者的利益。

综上，为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险，公司将提高经营效率、降低经营成本、进一步提高经营水平。通过强化募集资金管理、合理安排募集资金的使用、加快募投项目投资进度、提高募集资金使用效率等方式，提高募投项目管理水平、促进主营业务发展、增强持续创利能力，以填补被摊薄即期回报。”

(六) 关于利润分配的承诺

奕斯伟材料承诺：

“公司在上市后将严格依照《公司法》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》及《上市后三年股东分红回报规划》等法律、法规、监管机构的规定及公司治理制度的规定执行利润分配政策。如遇相关法律、法规及规范性文件修订的，公司将及时根据该等修订调整公司利润分配政策并严格执行。

如公司未能依照本承诺严格执行利润分配政策的，公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。”

(七) 关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

1、发行人的相关承诺

奕斯伟材料承诺：

“一、关于招股说明书的声明

本公司承诺本次发行上市的招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责

任。

二、回购首次公开发行的全部新股

如果本公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购本公司首次公开发行的全部新股，具体如下：

(一) 回购程序的启动

本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构或者司法机关认定有关违法事实之日起五个交易日内制订回购股份方案，按照有关法律法规和本公司章程的规定提交董事会审议，审议通过后及时公告回购股份方案；同时，在根据届时有有效的《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》等的规定需提交股东大会批准时发出股东大会会议通知，将回购公司股份的方案提交股东大会批准。

(二) 回购价格和回购数量

回购股份的价格按照二级市场价格进行，且不低于首次公开发行人民币普通股股票时的发行价格。回购数量为本公司首次公开发行的全部新股。

自本公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市之日起至本公司发布回购股份方案之日，本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则回购价格及回购数量将相应进行调整。

三、赔偿投资者损失

如果本公司本次发行上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将根据证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件，以及《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》（法释[2022]2号），依法及时赔偿投资者实际损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。

四、约束措施

本公司将积极采取合法措施履行上述承诺,自愿接受监管机构、社会公众及投资者的监督。若本公司未能完全履行上述承诺事项中的义务或责任,本公司将及时披露未履行承诺的情况和原因,并自愿接受有关法律、法规及有关监管机构要求的其他约束措施。”

2、控股股东及实际控制人的相关承诺

1) 直接控股股东奕斯伟集团和间接控股股东奕明科技分别承诺:

“一、关于招股说明书的声明

本公司/企业承诺奕斯伟材料本次发行上市的招股说明书的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,按照诚信原则履行承诺,并承担相应的法律责任。

二、赔偿投资者损失

如果奕斯伟材料本次发行上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司/企业将根据证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件,以及《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》(法释[2022]2号),依法及时赔偿投资者实际损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,以最终确定的赔偿方案为准。

三、回购

如果奕斯伟材料本次发行上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断奕斯伟材料是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司/企业将在该等有权部门作出前述认定后五个工作日内启动股份回购程序,依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格不低于奕斯伟材料股票发行价,并根据相关法律、法规及公司章程规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的,从其规定。若奕斯伟材料在本次发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对前述发行价进行除权除息调整。

四、约束措施

本公司/企业将积极采取合法措施履行上述承诺,自愿接受监管机构、社会公众及投资者的监督。若本公司/企业未能完全履行上述承诺事项中的义务或责任,本公司/企业将提请奕斯伟材料及时披露未履行承诺的情况和原因,并自愿接受有关法律、法规及有关监管机构要求的其他约束措施。”

2) 实际控制人王东升及与其保持一致行动的米鹏、杨新元、刘还平承诺:

“一、关于招股说明书的声明

本人承诺奕斯伟材料本次发行上市的招股说明书的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,按照诚信原则履行承诺,并承担相应的法律责任。

二、赔偿投资者损失

如果奕斯伟材料本发行上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将根据证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件,以及《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》(法释[2022]2号),依法及时赔偿投资者实际损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等详细内容待上述情形实际发生时,以最终确定的赔偿方案为准。

三、回购

如果奕斯伟材料发行上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断奕斯伟材料是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将在该等有权部门作出前述认定后五个工作日内启动股份购回程序,依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格不低于奕斯伟材料股票发行价,并根据相关法律、法规及公司章程规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的,从其规定。若奕斯伟材料在本次发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对前述发行价进行除权除息调整。

四、约束措施

本人将积极采取合法措施履行上述承诺,自愿接受监管机构、社会公众及投资者的监督。若本人未能完全履行上述承诺事项中的义务或责任,本人将提请奕

斯伟材料及时披露未履行承诺的情况和原因,并自愿接受有关法律、法规及有关监管机构要求的其他约束措施。”

3、董事、监事、高级管理人员的相关承诺

发行人董事(独立董事以及不在公司领取薪酬的董事除外)、监事、高级管理人员承诺:

“一、关于招股说明书的声明

本人确认,公司本次发行上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

二、赔偿投资者损失

如果公司本次发行上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将根据证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件,以及《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》(法释[2022]2号),依法及时赔偿投资者实际损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等详细内容待上述情形实际发生时,以最终确定的赔偿方案为准。

三、约束措施

本人将积极采取合法措施履行上述承诺,自愿接受监管机构、社会公众及投资者的监督。若本人未能完全履行上述承诺事项中的义务或责任,本人将提请公司及时披露未履行承诺的情况和原因,并自愿接受有关法律、法规及有关监管机构要求的其他约束措施。”

(八) 关于未履行承诺的约束措施的承诺

1、发行人的相关承诺

奕斯伟材料承诺:

“一、公司保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

二、如公司非因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客

观原因导致未能履行公开承诺事项的，公司承诺：

1、及时、充分披露公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司投资者的权益；

3、如违反相关承诺给投资者造成损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，公司将依法赔偿投资者的损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，公司将继续履行该等承诺。

三、如公司因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等导致未能履行公开承诺事项的，公司承诺：

1、及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司投资者的权益。”

2、控股股东的相关承诺

直接控股股东奕斯伟集团和间接控股股东奕明科技分别承诺：

“一、本公司/企业保证将严格履行在奕斯伟材料上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

二、如本公司/企业非因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的，本公司/企业承诺：

1、及时、充分披露本公司/企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、向奕斯伟材料投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护奕斯伟材料投资者的合法权益；

3、如违反相关承诺给投资者造成损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，将依法赔偿投资者的损失。如该等已违反的承诺仍可继续

履行，本公司/企业将继续履行该等承诺。

三、如本公司/企业因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等导致未能履行公开承诺事项的，本公司/企业承诺：

1、及时、充分披露本公司/企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、向奕斯伟材料投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护奕斯伟材料投资者的合法权益。”

3、实际控制人的相关承诺

实际控制人王东升及与其保持一致行动的米鹏、杨新元、刘还平承诺：

“一、本人保证将严格履行在奕斯伟材料上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

二、如本人非因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的，本人承诺：

1、及时、充分披露本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、向奕斯伟材料投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护奕斯伟材料投资者的合法权益；

3、如违反相关承诺给投资者造成损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，将依法赔偿投资者的损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等承诺。

三、如本人因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等导致未能履行公开承诺事项的，本人承诺：

1、及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、向奕斯伟材料投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护奕斯伟材料投资者的合法权益。”

4、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的相关承诺

发行人董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员承诺：

“一、本人保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

二、如本人非因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的，本人承诺：

1、及时、充分披露本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司投资者的权益；

3、如违反相关承诺给投资者造成损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，将依法赔偿投资者的损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等承诺。

三、如本人因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等导致未能履行公开承诺事项的，本人承诺：

1、及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司投资者的权益。”

5、持股 5%以上的股东的相关承诺

持股 5%以上的股东的承诺：

“一、本单位保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

二、如本单位非因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的，本单位承诺：

1、及时、充分披露本单位承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体

原因:

2、向公司投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司投资者的合法权益;

3、如违反相关承诺给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者的损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行,本单位将继续履行该等承诺。

三、如本单位因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等导致未能履行公开承诺事项的,本单位承诺:

1、及时、充分披露本单位承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;

2、向公司投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司投资者的合法权益。”

(九) 关于股东信息的专项承诺

1、发行人关于股东信息披露的专项承诺

奕斯伟材料承诺:

“1、公司现有直接或间接持有发行人股份数量高于 10 万股的股东(以下简称“直接或间接股东”)均具备持有公司股份的主体资格,不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形,不存在证监会系统离职人员入股公司的情形;

2、除本次发行的保荐机构中信证券通过其全资子公司中证投资以及关联方长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、四川川投金石康健股权投资基金合伙企业(有限合伙)间间接持有公司 4.2463%股份,中信证券全资子公司中证投资以及中证投资参股企业中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)共持有公司 5.6955%股份,以及本次发行的发行人律师北京市竞天公诚律师事务所合伙人李柳杰律师(非律师事务所的负责人,本次发行的项目经办律师)通过咸宁三行智赢资产管理中心(有限合伙)的有限合伙人苏州众汇寄托创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司约 0.0005%股份外,本次发行

的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有公司股份的情形；

3、公司直接或间接股东不存在以公司股份进行不当利益输送的情形；

4、公司直接或间接股东均真实持有公司股份。公司直接或间接股东所持公司股份权属清晰，不存在委托、受托、信托持股或其他类似持股安排的情形，不存在抵押、质押、司法冻结或其他权利受到限制的情形，不存在法律争议或者潜在纠纷，也不存在影响公司股权结构清晰、控制权稳定的其他任何形式的协议、约定、承诺、安排；

5、公司及公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务；

6、若公司违反上述承诺，将依法承担相应责任。”

(十) 关于避免同业竞争的承诺

1、直接控股股东奕斯伟集团和间接控股股东奕明科技分别承诺

“一、避免同业竞争

1、截至本承诺函出具之日，本公司/企业及本公司/企业控制的公司、企业或其他经营实体（奕斯伟材料及其控制的公司除外，下同）均未直接或间接从事任何与奕斯伟材料主营业务构成实质性竞争的相同或类似业务；本公司/企业及本公司/企业控制的公司、企业或其他经营实体与奕斯伟材料不存在同业竞争。

2、本公司/企业作为奕斯伟材料控股股东期间，本公司/企业将促使本公司/企业控制的公司、企业或其他经营实体不会直接或间接进行任何与奕斯伟材料主营业务构成实质性同业竞争的业务或活动。

3、本公司/企业作为奕斯伟材料控股股东期间，本公司/企业及本公司/企业控制的公司、企业或其他经营实体从任何第三者获得的任何商业机会与奕斯伟材料主营业务构成或可能构成实质性同业竞争的，本公司/企业将立即通知奕斯伟材料，并尽力将该等商业机会让与奕斯伟材料。

4、本公司/企业及本公司/企业控制的公司、企业或其他经营实体承诺将不向

其业务与奕斯伟材料主营业务构成实质性同业竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

5、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本公司/企业将向奕斯伟材料赔偿一切直接损失。

二、约束措施

1、若本公司/企业违反了上述关于避免同业竞争承诺的相关内容，产生了与奕斯伟材料同业竞争情形的，由此所得的收益归奕斯伟材料。如奕斯伟材料因同业竞争情形遭受损失的，则本公司/企业将向奕斯伟材料赔偿直接损失。

2、本公司/企业保证在接到奕斯伟材料董事会发出的本公司/企业违反关于避免同业竞争承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给奕斯伟材料，收益需厘定确认的，则在厘定确认后交给奕斯伟材料。如奕斯伟材料因同业竞争情形遭受损失的，在有关损失金额厘定确认后，本公司/企业将赔偿奕斯伟材料直接损失。

3、如已产生与奕斯伟材料同业竞争情形的，本公司/企业承诺根据有关规定以及证券监督管理部门的要求及时转让、终止业务或其他方式稳妥解决同业竞争问题，或尽最大努力促使本公司/企业实际控制的企业转让、终止业务或其他方式稳妥解决同业竞争问题。”

2、共同实际控制人王东升、米鹏、杨新元、刘还平四人承诺

“一、避免同业竞争

1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体（奕斯伟材料及其控制的公司除外，下同）均未直接或间接从事任何与奕斯伟材料主营业务构成实质性竞争的相同或类似业务；本公司及本公司控制的公司、企业或其他经营实体与奕斯伟材料不存在同业竞争。

2、本人作为奕斯伟材料实际控制人期间，本人将促使本人控制的公司、企业或其他经营实体不会直接或间接进行任何与奕斯伟材料主营业务构成实质性同业竞争的业务或活动。

3、本人作为奕斯伟材料实际控制人期间，本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体从任何第三者获得的任何商业机会与奕斯伟材料主营业务构成或

可能构成实质性同业竞争的,本人将立即通知奕斯伟材料,并尽力将该等商业机会让与奕斯伟材料。

4、本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体承诺将不向其业务与奕斯伟材料主营业务构成实质性同业竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

5、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守,本人将向奕斯伟材料补充赔偿直接损失。

二、约束措施

1、若本人违反了上述关于避免同业竞争承诺的相关内容,产生了与奕斯伟材料同业竞争情形的,由此所得的收益归奕斯伟材料。如奕斯伟材料因同业竞争情形遭受损失的,则本人将向奕斯伟材料补充赔偿直接损失。

2、本人保证在接到奕斯伟材料董事会发出的本人违反关于避免同业竞争承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给奕斯伟材料,收益需厘定确认的,则在厘定确认后交给奕斯伟材料。如奕斯伟材料因同业竞争情形遭受损失的,在有关损失金额厘定确认后,本人将补充赔偿奕斯伟材料直接损失。

3、如已产生与奕斯伟材料同业竞争情形的,本人承诺根据有关规定以及证券监督管理部门的要求及时转让、终止业务或其他方式稳妥解决同业竞争问题,或尽最大努力促使本人实际控制的企业转让、终止业务或其他方式稳妥解决同业竞争问题。”

(十一) 关于规范并减少关联交易的承诺

1、发行人的相关承诺

奕斯伟材料承诺:

“1、严格执行相关法律、法规、规章等规范性文件和《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》《西安奕斯伟材料科技股份有限公司股东大会议事规则》《西安奕斯伟材料科技股份有限公司关联交易管理办法》等有关关联交易管理制度中关于关联交易的规定;

2、严格履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序,及时详细进行信息

披露:

3、确保关联交易价格的公允性、批准程序的合规性，最大程度的保护股东利益;

4、尽量减少与关联方的关联交易，在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作;

5、在实际工作中充分发挥独立董事的作用，确保关联交易价格的公允性、批准程序的合法、合规性，最大程度地保护公司股东(尤其是中小股东)的利益。”

2、控股股东的相关承诺

直接控股股东奕斯伟集团和间接控股股东奕明科技分别承诺:

“一、规范和减少关联交易

1、不利用自身作为奕斯伟材料控股股东之地位及控制性谋求奕斯伟材料在业务合作等方面给予本公司/企业及本公司/企业控制的公司、企业或其他经营实体优于市场第三方的权利;

2、不利用自身作为奕斯伟材料控股股东之地位及控制性影响谋求与奕斯伟材料达成交易的优先权利;

3、不以与市场价格相比显失公允的条件与奕斯伟材料进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害奕斯伟材料利益的行为;

4、尽量减少与奕斯伟材料的关联交易，在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件和《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》《西安奕斯伟材料科技股份有限公司关联交易管理办法》等有关关联交易管理制度的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害奕斯伟材料及其他股东的合法权益。

同时，本公司/企业保证，在本公司/企业作为奕斯伟材料控股股东期间，奕斯伟材料在对待将来可能产生的与本公司/企业及本公司/企业控制的公司、企业或其他经营实体的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易:

1、严格遵守《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》《西安奕斯伟材料

科技股份有限公司股东大会会议事规则》《西安奕斯伟材料科技股份有限公司关联交易管理办法》及奕斯伟材料关联交易管理制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；

2、依照市场经济原则、采取市场定价方式确定交易价格。

二、约束措施

1、如果本公司/企业违反了上述关于规范和减少关联交易承诺的相关内容，由此所得的收益归奕斯伟材料。如奕斯伟材料因该等关联交易情形遭受损失的，则本公司/企业将向奕斯伟材料赔偿直接损失。

2、本公司/企业在接到奕斯伟材料董事会发出的本公司/企业违反了关于规范和减少关联交易承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给奕斯伟材料，收益需厘定确认的，则在厘定确认后交给奕斯伟材料。如奕斯伟材料因关联交易情形遭受损失的，在有关损失金额厘定确认后，本公司/企业将根据奕斯伟材料董事会的通知或损失确认文件并在通知的时限内赔偿奕斯伟材料直接损失。

3、如已产生违反上述承诺的关联交易情形的，本公司/企业在接到奕斯伟材料董事会通知之日起 20 日内启动有关消除或规范关联交易的相关措施，包括但不限于重新履行关联交易的程序、终止关联交易、回归至市场公允价格等。”

3、实际控制人的相关承诺

实际控制人王东升及与其保持一致行动的米鹏、杨新元、刘还平承诺：

“一、规范和减少关联交易

1、不利用自身作为奕斯伟材料实际控制人之地位及控制性谋求奕斯伟材料在业务合作等方面给予本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体优于市场第三方的权利；

2、不利用自身作为奕斯伟材料实际控制人之地位及控制性影响谋求与奕斯伟材料达成交易的优先权利；

3、不以与市场价格相比显失公允的条件与奕斯伟材料进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害奕斯伟材料利益的行为；

4、尽量减少与奕斯伟材料的关联交易，在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件和《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》《西安奕斯伟材料科技股份有限公司关联交易管理办法》等有关关联交易管理制度的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害奕斯伟材料及其他股东的合法权益。

同时，本人保证，在本人作为奕斯伟材料实际控制人期间，奕斯伟材料在对待将来可能产生的与本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：

1、严格遵守《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》《西安奕斯伟材料科技股份有限公司股东大会议事规则》《西安奕斯伟材料科技股份有限公司关联交易管理办法》及奕斯伟材料关联交易管理制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；

2、依照市场经济原则、采取市场定价方式确定交易价格。

二、约束措施

1、如果本人违反了上述关于规范和减少关联交易承诺的相关内容，由此所得的收益归奕斯伟材料。如奕斯伟材料因该等关联交易情形遭受损失的，则本人将向奕斯伟材料赔偿一切直接损失。

2、本人在接到奕斯伟材料董事会发出的本人违反了关于规范和减少关联交易承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给奕斯伟材料，收益需厘定确定的，则在厘定确认后交给奕斯伟材料。如奕斯伟材料因关联交易情形遭受损失的，在有关损失金额厘定确认后，本人将根据奕斯伟材料董事会的通知或损失确认文件并在通知的时限内赔偿奕斯伟材料一切直接损失。

3、如已产生违反上述承诺的关联交易情形的，本人在接到奕斯伟材料董事会通知之日起 20 日内启动有关消除或规范关联交易的相关措施，包括但不限于重新履行关联交易的程序、终止关联交易、回归至市场公允价格等。”

4、董事、监事、高级管理人员的相关承诺

发行人董事、监事、高级管理人员承诺：

“一、规范和减少关联交易

1、不利用自身作为公司董事、监事、高级管理人员之地位及影响谋求公司在业务合作等方面给予本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体优于市场第三方的权利；

2、不利用自身作为公司董事、监事、高级管理人员之地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利；

3、不以与市场价格相比显失公允的条件与公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；

4、尽量减少与公司的关联交易，在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》《西安奕斯伟材料科技股份有限公司关联交易管理办法》等有关关联交易决策制度的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

同时，本人保证，在本人作为公司董事、监事、高级管理人员期间，公司在对待将来可能产生的与本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：

1、严格遵守《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》《西安奕斯伟材料科技股份有限公司股东大会议事规则》《西安奕斯伟材料科技股份有限公司关联交易管理办法》及其他关联交易管理制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；

2、依照市场经济原则、采取市场定价方式确定交易价格。

二、约束措施

1、如果本人违反了上述关于规范和减少关联交易承诺的相关内容，由此所得的收益归公司。如公司因该等关联交易情形遭受损失的，则本人将向公司赔偿一切直接损失。

2、本人在接到公司董事会发出的本人违反了关于规范和减少关联交易承诺

的通知之日起 20 日内将有关收益交给公司，收益需厘定确定的，则在厘定确认后交给公司。如公司因关联交易情形遭受损失的，在有关损失金额厘定确认后，本人将根据公司董事会的通知或损失确认文件并在通知的时限内赔偿公司一切直接损失。

3、如已产生违反上述承诺的关联交易情形的，本人在接到公司董事会通知之日起 20 日内启动有关消除或规范关联交易的相关措施，包括但不限于重新履行关联交易的程序、终止关联交易、回归至市场公允价格等。”

5、其余持股 5%以上的股东的相关承诺

股东名称	承诺内容
二期基金	<p>一、规范和减少关联交易</p> <p>1、尽量减少与公司的关联交易，在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件和《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》《西安奕斯伟材料科技股份有限公司关联交易管理办法》等有关关联交易决策制度的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>同时，本单位保证，在本单位作为公司持股5%以上的股东期间，公司在对待将来可能产生的与本单位及本单位控制的公司、企业或其他经营实体的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：</p> <p>1、严格遵守《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》《西安奕斯伟材料科技股份有限公司股东大会会议事规则》《西安奕斯伟材料科技股份有限公司关联交易管理办法》及其他关联交易管理制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；</p> <p>2、依照市场经济原则、采取市场定价方式确定交易价格。</p> <p>二、约束措施</p> <p>如果本单位违反了上述关于规范和减少关联交易承诺的相关内容，本单位愿意承担相应的法律责任。</p>
陕西集成电路基金	<p>一、规范和减少关联交易</p> <p>1、不利用自身作为公司持股5%以上的股东之地位及影响谋求公司在业务合作等方面给予本单位及本单位控制的公司、企业或其他经营实体优于市场第三方的权利；</p> <p>2、不利用自身作为公司持股5%以上的股东之地位及影响谋求与公司达</p>

	<p>成交易的优先权利；</p> <p>3、不以与市场价格相比显失公允的条件与公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；</p> <p>4、尽量减少与公司的关联交易，在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件和《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》《西安奕斯伟材料科技股份有限公司关联交易管理办法》等有关关联交易决策制度的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>同时，本单位保证，在本单位作为公司持股5%以上的股东期间，公司在对待将来可能产生的与本单位及本单位控制的公司、企业或其他经营实体的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：</p> <p>1、严格遵守《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》《西安奕斯伟材料科技股份有限公司股东大会会议事规则》《西安奕斯伟材料科技股份有限公司关联交易管理办法》及其他关联交易管理制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；</p> <p>2、依照市场经济原则、采取市场定价方式确定交易价格。</p> <p>二、约束措施</p> <p>1、如果本单位违反了上述关于规范和减少关联交易承诺的相关内容，由此所得的收益归公司。如公司因该等关联交易情形遭受损失的，则本单位将向公司赔偿一切直接损失。</p> <p>2、本单位在接到公司董事会发出的本单位违反了关于规范和减少关联交易承诺的通知之日起20日内将有关收益交给公司，收益需厘定确认的，则在厘定确认后交给公司。如公司因关联交易情形遭受损失的，在有关损失金额厘定确认后，本单位将根据公司董事会的通知或损失确认文件并在通知的时限内赔偿公司一切直接损失。</p> <p>3、如已产生违反上述承诺的关联交易情形的，本单位在接到公司董事会通知之日起20日内启动有关消除或规范关联交易的相关措施，包括但不限于重新履行关联交易的程序、终止关联交易、回归至市场公允价格等。</p>
宁波奕芯	<p>一、规范和减少关联交易</p> <p>1、不利用自身作为公司持股5%以上的股东之地位及影响谋求公司在业务合作等方面给予本单位及本单位控制的公司、企业或其他经营实体优于市场第三方的权利；</p> <p>2、不利用自身作为公司持股5%以上的股东之地位及影响谋求与公司达</p>

成交易的优先权利;

3、不以与市场价格相比显失公允的条件与公司进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为;

4、尽量减少与公司的关联交易,在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件和《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》《西安奕斯伟材料科技股份有限公司关联交易管理办法》等有关关联交易决策制度的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务,保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

同时,本单位保证,在本单位作为公司持股5%以上的股东期间,公司在对待将来可能产生的与本单位及本单位控制的公司、企业或其他经营实体的关联交易方面,将采取如下措施规范可能发生的关联交易:

1、严格遵守《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》《西安奕斯伟材料科技股份有限公司股东大会会议事规则》《西安奕斯伟材料科技股份有限公司关联交易管理办法》及其他关联交易管理制度等规定,履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序,及时详细进行信息披露;

2、依照市场经济原则、采取市场定价方式确定交易价格。

二、约束措施

1、如果本单位违反了上述关于规范和减少关联交易承诺的相关内容,由此所得的收益归公司。如公司因该等关联交易情形遭受损失的,则本单位将向公司赔偿一切直接损失。

2、本单位在接到公司董事会发出的本单位违反了关于规范和减少关联交易承诺的通知之日起20日内将有关收益交给公司,收益需厘定确认的,则在厘定确认后交给公司。如公司因关联交易情形遭受损失的,在有关损失金额厘定确认后,本单位将根据公司董事会的通知或损失确认文件并在通知的时限内赔偿公司一切直接损失。

3、如已产生违反上述承诺的关联交易情形的,本单位在接到公司董事会通知之日起20日内启动有关消除或规范关联交易的相关措施,包括但不限于重新履行关联交易的程序、终止关联交易、回归至市场公允价格等。

(十二) 延长股份锁定期的承诺

发行人的实际控制人王东升、米鹏、杨新元和刘还平、间接控股股东奕明科技以及控股股东奕斯伟集团及其一致行动人宁波奕芯、**重庆奕芯**、奕斯欣盛、奕斯欣合、奕斯欣诚承诺如下:

奕斯伟材料上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的, 延长承诺人届时所持股份锁定期限 6 个月; 奕斯伟材料上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的, 在前项基础上延长承诺人届时所持股份锁定期限 6 个月; 奕斯伟材料上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的, 在前两项基础上延长承诺人届时所持股份锁定期限 6 个月。

(十三) 在审期间不进行现金分红的承诺

发行人就在审期间不进行分红事项承诺如下:

“ (一) 本公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有;

(二) 自本公司申请首次公开发行股票并在科创板上市至完成上市前即在审期间, 本公司承诺不进行现金分红;

(三) 上述承诺为本公司的真实意思表示, 本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督, 如本公司违反承诺给投资者造成损失的, 本公司将向投资者依法承担责任。”

(十四) 关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺

1、控股股东的相关承诺

直接控股股东奕斯伟集团和间接控股股东奕明科技分别承诺:

“本公司/企业承诺奕斯伟材料本次发行上市的招股说明书的内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 本公司/企业将按照诚信原则履行承诺, 并承担相应的法律责任。”

2、实际控制人的相关承诺

实际控制人王东升及与其保持一致行动的米鹏、杨新元、刘还平承诺:

“本人承诺本次发行上市的招股说明书的内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 本人将按照诚信原则履行承诺, 并承担相应的法律责任。”

3、发行人及董事、监事、高级管理人员的相关承诺

1) 发行人承诺:

“公司承诺招股说明书的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,按照诚信原则履行承诺,并承担相应的法律责任。”

2) 发行人董事、监事、高级管理人员承诺:

“西安奕斯伟材料科技股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺对本公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市全套申请文件进行了核查和审阅,承诺招股说明书等申请文件的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,按照诚信原则履行承诺,并承担相应的法律责任。”

4、中介机构的相关承诺**1) 中信证券股份有限公司承诺:**

“本公司为奕斯伟材料首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形;若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。”

2) 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:

“本所为西安奕斯伟材料科技股份有限公司首次公开发行股票出具的报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。”

“本所为西安奕斯伟材料科技股份有限公司首次公开发行股票出具的验资报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。”

3) 北京市竞天公诚律师事务所承诺:

“如证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门认定本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且给投资者造成损失的,本所将根据中国证券监督管理委员会等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定,就本所负有责任的部分承担赔偿责任,但有证据证明本

所无过错的除外。”

4) 北京天健兴业资产评估有限公司:

“本公司为奕斯伟材料首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形;若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。”

附件二：申报前十二个月新增股东基本信息

(一) 光子强链（持股比例 0.21%）

名称	陕西光子强链创新创业投资合伙企业（有限合伙）		
执行事务合伙人\普通合伙人\基金管理人	陕西科迈投资管理合伙企业（有限合伙）		
合伙人构成	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例
	陕西科迈投资管理合伙企业（有限合伙）	1,000.00	0.50%
	长安汇通资产管理有限公司	64,500.00	32.25%
	西安市创新投资基金合伙企业（有限合伙）	40,000.00	20.00%
	西安中科光机投资控股有限公司	29,500.00	14.75%
	西安高新新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	25,000.00	12.50%
	中科硬科技产业发展（北京）有限公司	19,000.00	9.50%
	陕西省政府投资引导基金合伙企业（有限合伙）	15,000.00	7.50%
	西安高新区芯石投资合伙企业（有限合伙）	5,000.00	2.50%
	长安汇通私募基金管理有限公司	500.00	0.25%
	西安财金资本管理有限公司	500.00	0.25%
	合计	200,000.00	100.00%

光子强链的执行事务合伙人基本信息如下：

名称	陕西科迈投资管理合伙企业（有限合伙）		
执行事务合伙人\普通合伙人	中科创星科技投资有限公司		
实际控制人	米磊		
合伙人构成	合伙人名称	出资额	出资比例

		(万元)	
	中科创星科技投资有限公司	823.30	82.33%
	陕西光电子先导院科技有限公司	126.70	12.67%
	西安高新技术产业风险投资有限责任公司	50.00	5.00%
	合计	1,000.00	100.00%

(二) 鑫华半导体 (持股比例 0.21%)

股东名称	江苏鑫华半导体科技股份有限公司		
控股股东及实际控制人	第一大股东为江苏中能硅业科技发展有限公司，无实际控制人		
股东情况	股东名称	股数(万股)	出资比例
	江苏中能硅业科技发展有限公司	36,467.43	24.55%
	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	30,629.34	20.62%
	厦门鼎峰启融创业投资合伙企业(有限合伙)	8,387.10	5.65%
	国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	8,387.10	5.65%
	其他持股 5%以下股东合计	64,700.46	43.55%
	合计	148,571.43	100.00%

(三) 王建成 (持股比例 0.08%)

王建成，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 4414251980*****39，住所为上海市长宁区威宁路。

(四) 盛剑科技 (持股比例 0.06%)

股东名称	上海盛剑科技股份有限公司 (603324.SH)		
控股股东及实际控制人	控股股东为张伟明，实际控制人为张伟明、汪哲		
股东情况	股东名称	股数(万股)	出资比例
	张伟明	8,937.30	59.80%

	其他持股 5%以下股东合计	6,008.95	40.20%
	合计	14,946.25	100.00%

(五) 海南瑞麟 (持股比例 0.06%)

名称	海南瑞麟贰号投资合伙企业(有限合伙)		
执行事务合伙人 \\ 普通合伙人	李红燕		
实际控制人	李红燕		
合伙人构成	合伙人名称	出资额(万元)	出资比例
	李红燕	80.00	80.00%
	王书豪	20.00	20.00%
	合计	100.00	100.00%

附件三：发行人及其子公司拥有或使用的房屋及建筑物清单

（一）自有房屋及建筑物

序号	权利人	证书号码	坐落	具体用途	终止日期	房屋建筑面积（m ² ）	他项权利
1	奕斯伟硅片	陕（2023）西安市不动产权第0463484号	西安高新区西沣南路1888号1幢10000室	工业用地/工业	2068.10.14	89,231.69	抵押
2	奕斯伟硅片	陕（2023）西安市不动产权第0463485号	西安高新区西沣南路1888号2幢10101室	工业用地/工业	2068.10.14	41,723.08	抵押
3	奕斯伟硅片	陕（2023）西安市不动产权第0463486号	西安高新区西沣南路1888号3幢10101室	工业用地/工业	2068.10.14	22,600.56	抵押
4	奕斯伟硅片	陕（2023）西安市不动产权第0463497号	西安高新区西沣南路1888号19幢10101室	工业用地/其他	2068.10.14	9,811.70	抵押
5	奕斯伟硅片	陕（2023）西安市不动产权第0463498号	西安高新区西沣南路1888号20幢10101室	工业用地/其他	2068.10.14	8,582.12	抵押
6	奕斯伟硅片	陕（2023）西安市不动产权第0463487号	西安高新区西沣南路1888号4幢10000室	工业用地/工业	2068.10.14	7,813.28	抵押
7	奕斯伟硅片	陕（2023）西安市不动产权第0463495号	西安高新区西沣南路1888号17幢10000室	工业用地/其他	2068.10.14	5,126.65	抵押
8	奕斯伟硅片	陕（2023）西安市不动产权第0463496号	西安高新区西沣南路1888号18幢10000室	工业用地/其他	2068.10.14	5,126.65	抵押

9	奕斯伟硅片	陕（2023）西安市不动产权第 0463490 号	西安高新区西沔南路 1888 号 7 幢 10000 室	工业用地/工业	2068.10.14	783.10	抵押
10	奕斯伟硅片	陕（2023）西安市不动产权第 0463491 号	西安高新区西沔南路 1888 号 8 幢 10000 室	工业用地/工业	2068.10.14	777.98	抵押
11	奕斯伟硅片	陕（2023）西安市不动产权第 0463488 号	西安高新区西沔南路 1888 号 5 幢 10000 室	工业用地/工业	2068.10.14	502.00	抵押
12	奕斯伟硅片	陕（2023）西安市不动产权第 0463489 号	西安高新区西沔南路 1888 号 6 幢 10000 室	工业用地/工业	2068.10.14	502.00	抵押
13	奕斯伟硅片	陕（2023）西安市不动产权第 0463492 号	西安高新区西沔南路 1888 号 10 幢 10000 室	工业用地/配套建筑	2068.10.14	133.61	-
14	奕斯伟硅片	陕（2023）西安市不动产权第 0463499 号	西安高新区西沔南路 1888 号 21 幢 10000 室	工业用地/配套建筑	2068.10.14	31.50	-
15	奕斯伟硅片	陕（2023）西安市不动产权第 0463493 号	西安高新区西沔南路 1888 号 11 幢 10000 室	工业用地/配套建筑	2068.10.14	31.16	-
16	奕斯伟硅片	陕（2023）西安市不动产权第 0463494 号	西安高新区西沔南路 1888 号 16 幢 10000 室	工业用地/配套建筑	2068.10.14	18.11	-
17	欣芯材料	陕（2025）西安市不动产权第 0028747 号	西安高新区盛丰路 111 号 1 幢 10000 室	工业用地/工业	2068.10.14	82,223.43	-
18	欣芯材料	陕（2025）西安市不动产权第 0028748 号	西安高新区盛丰路 111 号 2 幢 10000 室	工业用地/工业	2068.10.14	44,530.52	-

19	欣芯材料	陕（2025）西安市不动产权第 0028749 号	西安高新区盛丰路 111 号 3 幢 10000 室	工业用地/工业	2068.10.14	27,051.51	-
20	欣芯材料	陕（2025）西安市不动产权第 0028750 号	西安高新区盛丰路 111 号 6 幢 10000 室	工业用地/工业	2068.10.14	9,603.53	-
21	欣芯材料	陕（2025）西安市不动产权第 0028751 号	西安高新区盛丰路 111 号 8 幢 10000 室	工业用地/配套建筑	2068.10.14	127.60	-
22	欣芯材料	陕（2025）西安市不动产权第 0067479 号	西安高新区盛丰路 111 号 7 幢 10000 室	工业用地/工业	2068.10.14	932.74	-
23	欣芯材料	陕（2025）西安市不动产权第 0067485 号	西安高新区盛丰路 111 号 10 幢 10000 室	工业用地/工业	2068.10.14	423.54	-
24	奕斯伟硅片	陕（2025）西安市不动产权第 0104137 号	西安高新区西沔南路 1888 号 22 幢 10000 室	工业用地/工业	2068.10.14	354.32	-
25	奕斯伟硅片	陕（2025）西安市不动产权第 0104138 号	西安高新区西沔南路 1888 号 23 幢 10000 室	工业用地/工业	2068.10.14	457.36	-
26	奕斯伟硅片	陕（2025）西安市不动产权第 0104139 号	西安高新区西沔路 1888 号 24 幢 10000 室	工业用地/工业	2068.10.14	459.20	-
27	奕斯伟硅片	陕（2025）西安市不动产权第 0104140 号	西安高新区西沔路 1888 号 25 幢 10000 室	工业用地/工业	2068.10.14	206.40	-
28	奕斯伟硅片	陕（2025）西安市不动产权第 0104141 号	西安高新区西沔路 1888 号 26 幢 10000 室	工业用地/配套建筑	2068.10.14	120.23	-

注：以上涉及的房产抵押，所担保的债权均为发行人及其下属子公司的银行贷款债权；截至本招股说明书签署日，以上第 17-28 项已取得权属证书

（二）租赁房屋及建筑物情况

序号	承租方	出租方	租赁地点	主要租赁用途	租赁期限	租赁面积(m ²)	租赁备案
1	奕斯伟硅片	西安奕斯伟科技产业发展有限公司	西安市高新区翠北路 219 号西安奕斯伟集成电路产业园 D0	仓库	2023.05.31-2043.05.30	21,086.83	是
2	奕斯伟硅片	西安奕斯伟科技产业发展有限公司	西安市高新区翠北路 219 号西安奕斯伟集成电路产业园 D4、D5	宿舍	2023.01.01-2042.12.31	14,871.20	是
3	奕斯伟材料	西安奕斯伟科技产业发展有限公司	西安市高新区翠北路 219 号西安奕斯伟集成电路产业园 D6	宿舍	2023.01.01-2042.12.31	7,417.37	是
4	奕斯伟材料	西安奕斯伟科技产业发展有限公司	西安市高新区翠北路 219 号西安奕斯伟集成电路产业园 D1	宿舍	2023.05.31-2043.05.30	7,335.18	是
5	奕斯伟材料	京东贝（北京）光电科技有限公司	中国北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院京东贝科技园 1 号楼三层西侧、南侧区域	办公	2023.01.01-2030.06.30	1,071.35	是
6	奕斯伟材料	上海龙枢物业管理有限公司	上海市闵行区号文路 111 号 503B 室	办公	2023.03.01- 2027.02.28	151.53	否
7	奕斯伟材料	魏**	西安市长安区西长安街 989 号国色天香小区	宿舍	2024.07.01-2025.06.30	148.19	是
8	奕斯伟材料	时*	西安市长安区学府大道与居安路十字东南角万科城润园小区	宿舍	2024.08.16-2025.08.15	147.63	是

9	奕斯伟材料	崔**	西安市长安区学府大道与居安路十字东南角 万科城润园小区	宿舍	2024.12.06-2025.12.05	128.49	是
10	奕斯伟材料	何**	西安市高新区龙城铭园二期小区	宿舍	2024.07.23-2025.07.23	117.68	是
11	奕斯伟材料	刘*	西安市长安区西长安街 989 号国色天香小区	宿舍	2024.05.15-2025.05.14	98.90	是
12	奕斯伟材料韩国	MKCOMMS Co.,Ltd.	京畿道城南市盆唐区三坪洞	办公	2023.06.15-2025.06.14	128.24	-
13	奕斯伟材料日本	株式会社 One-stop Business Centre	东京都港区高轮四丁目	注册地址	2024.08.08-2025.04.09	-（注）	-
14	奕斯伟材料	Servcorp Tokyo K.K.	东京都港区海岸一丁目	办公	2024.07.16-2025.07.15	18.00	-
15	奕斯伟材料	Justco（Singapore）Pte. Ltd.	新加坡淡滨尼大道 9 号	办公	2024.05.06-2025.05.05	6 个工位	-

注：该虚拟办公地址仅用作注册目标公司，无面积

附件四：发行人及其子公司拥有或使用的商标清单

序号	所有权人	许可国家/地区	商标名称	注册商标	商标号	类别	申请日	注册日	许可使用方式
1	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	22746728	37	2017.01.26	2018.02.21	普通许可
2	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	22746722	7	2017.01.26	2018.02.21	普通许可
3	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	22746720	37	2017.01.26	2018.02.21	普通许可
4	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	22746719	42	2017.01.26	2018.02.21	普通许可
5	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	22746730A	7	2017.01.26	2018.03.07	普通许可
6	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	22746727A	42	2017.01.26	2018.03.07	普通许可
7	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	22746729 A	9	2017.01.26	2018.03.21	普通许可
8	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	22746721A	9	2017.01.26	2018.03.21	普通许可

9	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	38056482	35	2019.05.08	2019.12.28	普通许可
10	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	22746729	9	2017.01.26	2020.01.14	普通许可
11	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	38036779	35	2019.05.08	2020.03.14	普通许可
12	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	45657614	9	2020.04.22	2020.12.21	普通许可
13	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69471466	17	2023.02.09	2023.07.28	普通许可
14	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69467077	22	2023.02.09	2023.07.28	普通许可
15	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69483039	34	2023.02.09	2023.07.28	普通许可
16	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69468298	36	2023.02.09	2023.07.28	普通许可
17	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69485013	37	2023.02.09	2023.07.28	普通许可
18	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69469418	40	2023.02.09	2023.07.28	普通许可

19	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69467557	31	2023.02.09	2023.07.28	普通许可
20	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69478070	32	2023.02.09	2023.07.28	普通许可
21	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69485948	33	2023.02.09	2023.07.28	普通许可
22	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69478093	34	2023.02.09	2023.07.28	普通许可
23	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69475532	35	2023.02.09	2023.07.28	普通许可
24	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69466051	36	2023.02.09	2023.07.28	普通许可
25	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69483081	1	2023.02.09	2023.07.28	普通许可
26	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69479419	10	2023.02.09	2023.07.28	普通许可
27	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69479422	11	2023.02.09	2023.07.28	普通许可
28	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69467138	12	2023.02.09	2023.07.28	普通许可

29	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69481413	13	2023.02.09	2023.07.28	普通许可
30	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69479440	15	2023.02.09	2023.07.28	普通许可
31	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69474769	18	2023.02.09	2023.07.28	普通许可
32	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69465269	2	2023.02.09	2023.07.28	普通许可
33	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69487508	20	2023.02.09	2023.07.28	普通许可
34	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69465636	22	2023.02.09	2023.07.28	普通许可
35	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69480569	23	2023.02.09	2023.07.28	普通许可
36	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69483272	24	2023.02.09	2023.07.28	普通许可
37	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69477717	25	2023.02.09	2023.07.28	普通许可
38	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69465663	26	2023.02.09	2023.07.28	普通许可

39	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69480597	27	2023.02.09	2023.07.28	普通许可
40	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69465682	28	2023.02.09	2023.07.28	普通许可
41	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69485053	3	2023.02.09	2023.07.28	普通许可
42	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69480622	30	2023.02.09	2023.07.28	普通许可
43	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69485838	4	2023.02.09	2023.07.28	普通许可
44	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69467095	6	2023.02.09	2023.07.28	普通许可
45	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69473272	8	2023.02.09	2023.07.28	普通许可
46	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69474744	14	2023.02.09	2023.08.07	普通许可
47	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69465629	21	2023.02.09	2023.08.07	普通许可
48	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69469080	40	2023.02.09	2023.08.14	普通许可

49	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69464950	44	2023.02.09	2023.08.14	普通许可
50	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69482080	45	2023.02.09	2023.08.14	普通许可
51	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69476594A	42	2023.02.09	2023.09.07	普通许可
52	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69473203A	35	2023.02.09	2023.09.07	普通许可
53	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69487251	6	2023.02.09	2023.09.14	普通许可
54	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69473128	14	2023.02.09	2023.09.28	普通许可
55	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69478986	18	2023.02.09	2023.09.28	普通许可
56	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69476544	24	2023.02.09	2023.09.28	普通许可
57	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69483027	29	2023.02.09	2023.09.28	普通许可
58	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69476567	30	2023.02.09	2023.09.28	普通许可

59	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69474936	8	2023.02.09	2023.09.28	普通许可
60	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69469045	20	2023.02.09	2023.09.28	普通许可
61	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69473175	25	2023.02.09	2023.09.28	普通许可
62	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69480088	16	2023.02.09	2023.10.21	普通许可
63	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69469398	31	2023.02.09	2023.10.07	普通许可
64	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69466448	39	2023.02.09	2023.10.07	普通许可
65	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69468309	41	2023.02.09	2023.10.07	普通许可
66	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69469423	43	2023.02.09	2023.10.07	普通许可
67	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69468218	45	2023.02.09	2023.10.07	普通许可
68	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69485981	43	2023.02.09	2023.10.07	普通许可

69	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69474956	10	2023.02.09	2023.10.07	普通许可
70	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69484993	28	2023.02.09	2023.10.07	普通许可
71	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69466459	44	2023.02.09	2023.10.14	普通许可
72	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69487613	39	2023.02.09	2023.10.21	普通许可
73	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69479055	41	2023.02.09	2023.10.14	普通许可
74	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69485144	19	2023.02.09	2023.10.14	普通许可
75	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69485662	12	2023.02.09	2023.10.14	普通许可
76	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69466738	11	2023.02.09	2023.10.21	普通许可
77	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69464933	42	2023.02.09	2023.10.21	普通许可
78	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69466829	16	2023.02.09	2023.10.21	普通许可

79	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69471908	17	2023.02.09	2023.10.21	普通许可
80	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69479382	5	2023.02.09	2023.10.21	普通许可
81	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69467540	29	2023.02.09	2023.10.28	普通许可
82	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69482193	21	2023.02.09	2023.11.07	普通许可
83	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69479656	5	2023.02.09	2023.11.14	普通许可
84	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69471823A	9	2023.02.09	2023.11.28	普通许可
85	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69471823	9	2023.02.09	2024.09.07	普通许可
86	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69480835	3	2023.02.09	2023.12.07	普通许可
87	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69484941	19	2023.02.09	2023.12.07	普通许可
88	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	71828939	35	2023.05.26	2023.12.14	普通许可

89	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69477013	1	2023.02.09	2023.12.21	普通许可
90	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69479406	9	2023.02.09	2023.12.28	普通许可
91	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69473997	37	2023.02.09	2024.01.07	普通许可
92	奕斯伟集团	中国大陆	奕斯伟	奕斯伟	69474707	7	2023.02.09	2024.01.21	普通许可
93	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69473203	35	2023.02.09	2024.02.28	普通许可
94	奕斯伟集团	中国大陆	ESWIN	ESWIN	69476594	42	2023.02.09	2024.02.28	普通许可
95	奕斯伟集团	韩国	ESWIN	ESWIN	40147280900 00	7/9/37/4 2	2018.05.15	2019.04.25	普通许可
96	奕斯伟集团	美国、欧盟、英国	ESWIN	ESWIN	美国： 5963932（马德里商标分配注册号）； 欧盟、英国： 1447466（马德里注册号）	7/9/37/4 2	2018.05.15	2018.10.31	普通许可

97	奕斯伟集团	欧盟	ESWIN	ESWIN	018838447	7/9/35/3 7/42	2023.02.20	2023.02.20	普通许可
98	奕斯伟集团	日本	ESWIN	ESWIN	6165552	7/9/37/4 2	2018.05.15	2019.07.26	普通许可
99	奕斯伟集团	新加坡、英国、巴西、美国	ESWIN	ESWIN	美国： 7546807 （马德里商标 分配注册号） 新加坡、英 国、巴西： 1746214（马 德里注册号）	7/9/35/3 7/42	2023.03.07	2023.03.07	普通许可
100	奕斯伟集团	中国台湾	ESWIN	ESWIN	01975381	7	2018.05.15	2019.03.16	普通许可
101	奕斯伟集团	中国台湾	ESWIN	ESWIN	01976660	37	2018.05.15	2019.03.16	普通许可
102	奕斯伟集团	中国台湾	ESWIN	ESWIN	01987871	42	2018.05.15	2019.05.16	普通许可
103	奕斯伟集团	中国台湾	ESWIN	ESWIN	01992247	9	2018.05.15	2019.06.16	普通许可

104	奕斯伟集团	中国台湾	奕斯伟	奕斯伟	02322426	35	2023.02.24	2023.09.16	普通许可
105	奕斯伟集团	中国台湾	ESWIN	ESWIN	02331301	7	2023.02.24	2023.11.01	普通许可
106	奕斯伟集团	中国台湾	ESWIN	ESWIN	02322427	35	2023.02.24	2023.09.16	普通许可
107	奕斯伟集团	中国台湾	奕斯伟	奕斯伟	02331300	7	2023.02.24	2023.11.01	普通许可
108	奕斯伟集团	中国台湾	奕斯伟	奕斯伟	02332876	37	2023.02.24	2023.11.01	普通许可
109	奕斯伟集团	中国台湾	ESWIN	ESWIN	02332877	37	2023.02.24	2023.11.01	普通许可
110	奕斯伟集团	中国台湾	ESWIN	ESWIN	02347179	9	2023.02.24	2024.01.01	普通许可
111	奕斯伟集团	中国台湾	ESWIN	ESWIN	02349454	42	2023.02.24	2024.01.01	普通许可
112	奕斯伟集团	中国台湾	奕斯伟	奕斯伟	02347178	9	2023.02.24	2024.01.01	普通许可
113	奕斯伟集团	中国台湾	奕斯伟	奕斯伟	02349453	42	2023.02.24	2024.01.01	普通许可

114	奕斯伟集团	中国香港	ESWIN	ESWIN	304531428	7/9/37/4 2	2018.05.15	2018.05.17	普通许可
115	奕斯伟集团	中国香港	ESWIN	ESWIN	306174559	7/9/35/3 7/42	2023.02.22	2023.02.22	普通许可
116	奕斯伟集团	中国香港	奕斯伟	奕斯伟	306174568	7/9/35/3 7/42	2023.02.22	2023.02.22	普通许可

注：发行人被许可使用的第 85 项境内注册商标（商标号：69471823），奕斯伟集团持有有效的权利证书，但尚未办理该商标的商标使用许可备案，上述未备案的情形不影响商标许可合同的效力，发行人可以依法使用该等注册商标

附件五：发行人及其子公司拥有的专利权清单

（一）已获授权的境内发明专利

序号	专利权人	专利名称	专利号	授权日	取得方式	他项权利
1	发行人	硅晶圆及其检测方法	ZL202410877273.8	2024.12.27	原始取得	无
2	发行人、欣芯材料	一种通讯连接方法、装置、设备、介质及产品	ZL202310172157.1	2024.12.27	原始取得	无
3	发行人、奕斯伟硅片	检测单晶炉同轴度的方法、装置、设备及计算机存储介质	ZL202111530487.0	2024.12.27	原始取得	无
4	发行人、奕斯伟硅片	掺杂剂及其制备方法、掺杂的硅片及其制造方法	ZL202211153844.0	2024.12.24	原始取得	无
5	发行人、奕斯伟硅片	一种硅熔液液面位置的检测装置及单晶炉	ZL202010818550.X	2024.12.13	原始取得	无
6	发行人	抛光头和抛光设备	ZL202211713309.6	2024.11.22	原始取得	无
7	发行人、奕斯伟硅片	外延生长设备重启方法	ZL202211562148.5	2024.11.22	原始取得	无
8	发行人、奕斯伟硅片	一种单晶炉及单晶硅的制备方法	ZL202010393429.7	2024.11.08	原始取得	无
9	发行人、奕斯伟硅片	清洁装置、设备及方法	ZL202211657789.9	2024.10.29	原始取得	无
10	发行人	单晶炉装置	ZL202211562146.6	2024.10.25	原始取得	无
11	发行人	晶圆及其表面纳米形貌的预测方法、装置、设备及介质	ZL202410895811.6	2024.10.22	原始取得	无
12	发行人	测量装置和测量方法	ZL202210546950.9	2024.10.22	原始取得	无
13	发行人	用于硅片脱胶的装置及设备	ZL202211567623.8	2024.10.22	原始取得	无

14	发行人、奕斯伟硅片	研磨清洗设备	ZL202211626121.8	2024.10.15	原始取得	无
15	发行人	研磨轮、研磨装置、研磨方法及硅片	ZL202211230927.5	2024.10.01	原始取得	无
16	发行人、奕斯伟硅片	一种硅片插片装置	ZL202011307980.1	2024.10.01	原始取得	无
17	发行人、奕斯伟硅片	硅片清洗方法及硅片清洗设备	ZL202011327637.3	2024.09.24	原始取得	无
18	发行人、奕斯伟硅片	一种机械手及机械手夹取状态检测方法	ZL202211523248.7	2024.09.20	原始取得	无
19	发行人、奕斯伟硅片	用于硅片边缘抛光的设备及方法	ZL202211612654.0	2024.09.13	原始取得	无
20	发行人、奕斯伟硅片	一种用于硅片的干燥系统	ZL202211714553.4	2024.08.30	原始取得	无
21	发行人、奕斯伟硅片	一种晶硅熔炉用熔硅液面测距组件及晶硅熔炉	ZL202010384718.0	2024.08.27	原始取得	无
22	发行人、奕斯伟硅片	硅片钝化系统及硅片钝化系统的工作方法	ZL202211675920.4	2024.08.23	原始取得	无
23	发行人、奕斯伟硅片	一种单晶炉的组合套筒及单晶炉	ZL202010909017.4	2024.08.16	原始取得	无
24	发行人	硅片双面抛光装置的承载件及硅片双面抛光装置	ZL202211718374.8	2024.08.16	原始取得	无
25	发行人	角度磨抛装置和角度磨抛方法	ZL202410575180.X	2024.07.30	原始取得	无
26	发行人、奕斯伟硅片	一种监测熔体液面位置的方法、系统及计算机存储介质	ZL202110129542.9	2024.07.12	原始取得	无
27	发行人、奕斯伟硅片	用于调准硅片的清洗设备中的氮气吹送管路的装置及方法	ZL202110832947.9	2024.07.05	原始取得	无
28	发行人、奕斯伟硅片	硅片处理方法及装置	ZL202211597468.4	2024.06.25	原始取得	无
29	发行人、奕斯伟硅片	一种硅片的清洗装置以及清洗方法	ZL202110686731.6	2024.06.18	原始取得	无
30	发行人、奕斯伟硅片	一种测试硅片少子寿命的方法和设备	ZL202110121154.6	2024.06.14	原始取得	无

31	发行人	石英坩埚、坩埚组件和单晶炉	ZL202211151168.3	2024.06.04	原始取得	无
32	发行人	多线切割装置和多线切割方法	ZL202111136623.8	2024.06.04	原始取得	无
33	发行人	研磨装置、研磨方法及硅片	ZL202211160607.7	2024.05.31	原始取得	无
34	发行人	用于监控研磨装置的加工状态的系统、方法及双面研磨装置	ZL202211098362.X	2024.05.28	原始取得	无
35	发行人、奕斯伟硅片	一种用于切割硅棒的装置	ZL202111640959.8	2024.05.28	原始取得	无
36	发行人	用于对硅片进行背封的方法和设备	ZL202211555360.9	2024.05.28	原始取得	无
37	发行人、奕斯伟硅片	抛光装置及其工作方法	ZL202211687043.2	2024.05.03	原始取得	无
38	发行人、奕斯伟设备	晶体直径检测方法、系统及计算机程序产品	ZL202111637395.2	2024.04.30	原始取得	无
39	发行人、奕斯伟硅片	一种用于校准外延炉的温度计的方法	ZL202210107312.7	2024.04.19	原始取得	无
40	发行人	一种晶圆清洗干燥装置及晶圆清洗干燥方法	ZL202111085207.X	2024.04.19	原始取得	无
41	发行人、奕斯伟硅片	清洗硅片的周缘的装置、方法及清洗硅片的设备	ZL202211396011.7	2024.04.16	原始取得	无
42	发行人、奕斯伟硅片	一种用于降低双面抛光设备碎片风险的检测装置和方法	ZL202211713649.9	2024.04.16	原始取得	无
43	发行人、奕斯伟硅片	边缘抛光装置和边缘抛光方法	ZL202211607168.X	2024.04.12	原始取得	无
44	发行人、奕斯伟硅片	一种用于研磨硅片的研磨盘及研磨设备	ZL202211575108.4	2024.04.12	原始取得	无
45	发行人	静压垫、研磨设备及硅片	ZL202310340170.3	2024.04.12	原始取得	无
46	发行人、奕斯伟硅片	一种用于生产硅片的系统、方法及单晶硅棒	ZL202111591417.6	2024.04.09	原始取得	无
47	发行人、奕斯伟硅片	一种取样装置	ZL202011471588.0	2024.03.26	原始取得	无

48	发行人、奕斯伟硅片	一种晶圆传送叶片	ZL201911206763.0	2024.03.26	原始取得	无
49	发行人、奕斯伟硅片	一种外延生长方法及外延晶圆	ZL202211019953.3	2024.03.26	原始取得	无
50	发行人	单晶硅拉晶控制方法及装置、单晶硅拉晶炉	ZL202210749785.7	2024.03.22	原始取得	无
51	发行人	一种加热器和单晶炉	ZL202210588892.6	2024.03.19	原始取得	无
52	发行人、奕斯伟硅片	一种硅片加热装置	ZL202010756126.7	2024.03.15	原始取得	无
53	发行人、奕斯伟硅片	预热环及晶圆外延生长设备	ZL202110102200.8	2024.02.27	原始取得	无
54	发行人	加热器组件和单晶炉	ZL202210705520.7	2024.02.27	原始取得	无
55	发行人、奕斯伟硅片	一种硅片边缘剥离方法及硅片	ZL202010392779.1	2024.02.23	原始取得	无
56	发行人	单面减薄方法和单面减薄设备	ZL202210603660.3	2024.02.23	原始取得	无
57	发行人、奕斯伟硅片	一种二流体喷嘴及清洗装置	ZL202111623580.6	2024.02.13	原始取得	无
58	发行人	一种用于生产单晶硅棒的石英坩埚、坩埚组件及拉晶炉	ZL202210594928.1	2024.02.13	原始取得	无
59	发行人	一种加热器及其工作方法	ZL202210588592.8	2024.02.09	原始取得	无
60	发行人、奕斯伟硅片	炉管清洁方法及清洁设备	ZL202011073112.1	2024.01.26	原始取得	无
61	发行人、奕斯伟硅片	一种晶圆载体的处理方法和晶圆载体	ZL202011337895.X	2024.01.26	原始取得	无
62	发行人、奕斯伟硅片	硅片处理设备	ZL202011536953.1	2024.01.26	原始取得	无
63	发行人、奕斯伟硅片	滑片检测装置和抛光系统	ZL202110932998.9	2024.01.26	原始取得	无
64	发行人、奕斯伟硅片	硅片边缘粗糙度检测治具及检测方法	ZL202110974373.9	2024.01.26	原始取得	无

65	发行人、奕斯伟硅片	一种硅片检测方法	ZL202111269607.6	2024.01.26	原始取得	无
66	发行人	单晶体直径控制方法及装置、单晶硅拉晶炉	ZL202210751316.9	2024.01.26	原始取得	无
67	发行人	拉晶炉	ZL202210825183.5	2024.01.26	原始取得	无
68	发行人	一种硅片双面研磨装置的静压板及硅片双面研磨装置	ZL202210542408.6	2023.11.17	原始取得	无
69	发行人、奕斯伟硅片	研磨装置和研磨方法	ZL202210770838.3	2023.11.17	原始取得	无
70	发行人、奕斯伟硅片	一种用于对硅片进行抛光的抛光垫和抛光设备	ZL202210771464.7	2023.11.14	原始取得	无
71	发行人、奕斯伟硅片	单晶硅棒电阻率的测量方法及装置	ZL202110180928.2	2023.11.10	原始取得	无
72	发行人、奕斯伟硅片	一种硅片样片的制作方法和硅片样片	ZL202011410162.4	2023.11.03	原始取得	无
73	发行人	一种用于背封硅片的设备和方法	ZL202211479416.7	2023.11.03	原始取得	无
74	发行人、奕斯伟硅片	一种晶圆的清洗辅助装置及清洗装置	ZL202010339252.2	2023.10.10	原始取得	无
75	发行人、奕斯伟硅片	外延晶圆的缺陷检测方法、装置、系统及其制造方法	ZL202310405559.1	2023.09.29	原始取得	无
76	发行人	双面研磨装置和双面研磨方法	ZL202210663292.1	2023.09.29	原始取得	无
77	发行人	改善氮掺杂晶圆翘曲度的加工方法和系统	ZL202111155414.8	2023.08.22	原始取得	无
78	发行人	一种用于控制单晶硅棒的拉晶炉、方法及单晶硅棒	ZL202210007056.4	2023.08.22	原始取得	无
79	发行人	双面研磨装置和双面研磨方法	ZL202210687857.X	2023.08.22	原始取得	无
80	发行人	静压支撑件、双面研磨装置和双面研磨方法	ZL202310412015.8	2023.08.22	原始取得	无
81	发行人、奕斯伟硅片	一种多晶硅清洗装置及方法	ZL202010356974.9	2023.08.18	原始取得	无

82	发行人、奕斯伟硅片	一种硅料处理装置、硅棒生产设备和硅料处理方法	ZL202111622589.5	2023.07.28	原始取得	无
83	发行人、奕斯伟硅片	测量单晶硅中元素含量的方法及装置	ZL202010776364.4	2023.07.25	原始取得	无
84	发行人、奕斯伟硅片	为切割硅棒的多条切割线供应砂浆的装置及硅棒切割设备	ZL202110908833.8	2023.06.23	原始取得	无
85	发行人、奕斯伟硅片	水平度调整装置、抛光设备及水平度调整方法	ZL202111635560.0	2023.06.23	原始取得	无
86	发行人、奕斯伟硅片	晶棒线切割装置和晶棒线切割方法	ZL202110891837.X	2023.06.16	原始取得	无
87	发行人、奕斯伟硅片	一种用于硅片的真空包装设备及方法	ZL202110712996.9	2023.06.09	原始取得	无
88	发行人、奕斯伟硅片	基座支撑结构和外延生长装置	ZL202111587730.2	2023.06.06	原始取得	无
89	发行人、奕斯伟设备	拉晶炉软轴清理装置、拉晶炉及其软轴清理方法	ZL202111622581.9	2023.05.26	原始取得	无
90	发行人	一种用于制造单晶硅棒的拉晶炉、方法及单晶硅棒	ZL202111165968.6	2023.05.16	原始取得	无
91	发行人、奕斯伟硅片	一种用于调节晶圆位置的装置和方法	ZL202210767535.6	2023.05.12	原始取得	无
92	发行人	一种氮掺杂单晶硅棒的制备方法	ZL202111165312.4	2023.05.05	原始取得	无
93	发行人、奕斯伟硅片	一种用于抛光垫的裁剪装置	ZL202110725468.7	2023.05.05	原始取得	无
94	发行人、奕斯伟硅片	一种用于硅片的外延生长的基座支撑架、装置及方法	ZL202110912704.6	2023.04.18	原始取得	无
95	发行人	一种单晶硅棒的拉制方法及单晶硅棒	ZL202111411291.X	2023.03.28	原始取得	无
96	发行人、奕斯伟硅片	热屏蔽组件、拉晶炉系统及其工作方法	ZL201910280398.1	2023.03.21	原始取得	无
97	发行人、奕斯伟硅片	绕线装置及绕线方法	ZL202110178335.2	2023.03.21	原始取得	无
98	发行人、奕斯伟硅片	一种用于将原材料加工成为成品的装置	ZL202110786188.7	2023.03.21	原始取得	无

99	发行人、奕斯伟硅片	硅片清洗装置及其控制方法	ZL202010355099.2	2023.03.14	原始取得	无
100	发行人、奕斯伟硅片	双面研磨装置和双面研磨方法	ZL202111597504.2	2023.03.14	原始取得	无
101	发行人	研磨轮、研磨设备及硅片	ZL202211301302.3	2023.02.28	原始取得	无
102	发行人、奕斯伟硅片	一种硅片缺陷的分析方法及装置	ZL201910649557.0	2023.02.21	原始取得	无
103	发行人、奕斯伟硅片	单晶硅棒间隙氧含量的测量方法及装置	ZL202110226443.2	2023.02.21	原始取得	无
104	发行人、奕斯伟硅片	一种晶棒的开槽方法及晶棒开槽装置	ZL202011480406.6	2023.02.03	原始取得	无
105	发行人、奕斯伟硅片	一种单晶炉热场加热器组件及单晶炉	ZL202011102898.5	2023.02.03	原始取得	无
106	发行人、奕斯伟硅片	单晶棒直径测量装置、单晶棒生长系统及方法	ZL202110019643.0	2023.01.24	原始取得	无
107	发行人、奕斯伟硅片	晶圆清洗装置及晶圆清洗方法	ZL201911336436.7	2023.01.13	原始取得	无
108	发行人、奕斯伟硅片	用于获得籽晶缆相对于线鼓的偏斜量的装置和提拉设备	ZL202111539973.9	2023.01.10	原始取得	无
109	发行人、奕斯伟硅片	一种取样装置及方法	ZL201910811479.X	2023.01.06	原始取得	无
110	发行人、奕斯伟硅片	对硅片位置进行调准的系统、方法及外延设备	ZL202111639869.7	2023.01.06	原始取得	无
111	发行人、奕斯伟硅片	一种翘曲度的控制方法及装置	ZL201910763955.5	2022.12.20	原始取得	无
112	发行人、奕斯伟硅片	单晶炉热场加热器及单晶炉	ZL202011053337.0	2022.12.13	原始取得	无
113	发行人、奕斯伟硅片	抛光液供给装置	ZL202011489844.9	2022.12.13	原始取得	无
114	发行人、奕斯伟硅片	抛光液供给装置	ZL202011490914.2	2022.12.09	原始取得	无
115	发行人、奕斯伟硅片	多线切割晶棒的方法和装置	ZL202110136709.4	2022.11.22	原始取得	无

116	发行人、奕斯伟硅片	一种研磨装置	ZL201910887203.X	2022.11.18	原始取得	无
117	发行人、奕斯伟硅片	一种气流控制装置和晶圆处理装置	ZL201910870206.2	2022.11.08	原始取得	无
118	发行人、奕斯伟硅片	一种晶棒的加工方法及晶片	ZL202011478313.X	2022.11.04	原始取得	无
119	发行人、奕斯伟硅片	一种单晶硅缺陷分布区域的检测方法	ZL202010596309.7	2022.10.21	原始取得	无
120	发行人、奕斯伟硅片	一种用于清洗硅片的装置	ZL202010927248.8	2022.10.14	原始取得	无
121	发行人	精准调整 ADC 相机的方法、装置、设备及计算机存储介质	ZL202111124306.4	2022.09.30	原始取得	无
122	发行人、奕斯伟硅片	一种用于常压外延反应腔室的清洁方法及外延硅片	ZL202111654778.0	2022.09.30	原始取得	无
123	发行人、奕斯伟硅片	对机械手相对于承载空间取放硅片进行示教的系统及方法	ZL202210756238.1	2022.09.30	原始取得	无
124	发行人、奕斯伟硅片	清洗装置和清洗方法	ZL202110881455.9	2022.09.27	原始取得	无
125	发行人、奕斯伟硅片	晶体缺陷的检测方法与检测装置	ZL202210131296.5	2022.09.27	原始取得	无
126	发行人	一种用于承载和清洁硅片的装置	ZL202210544196.5	2022.09.09	原始取得	无
127	发行人、奕斯伟硅片	一种用于硅片边缘刻蚀的装置和方法	ZL202210620140.3	2022.09.09	原始取得	无
128	发行人、奕斯伟硅片	一种气相沉积反应腔体的清洗装置、清洗系统及清洗方法	ZL201911347026.2	2022.09.02	原始取得	无
129	发行人、奕斯伟硅片	一种单晶硅棒的拉制方法	ZL202110768942.4	2022.08.30	原始取得	无
130	发行人	石英坩埚及拉晶炉	ZL202111162512.4	2022.08.26	原始取得	无
131	发行人、奕斯伟硅片	一种单晶硅棒的拉制方法	ZL202110767665.5	2022.08.23	原始取得	无
132	发行人、奕斯伟硅片	一种导流筒和拉晶炉	ZL202110686468.0	2022.08.02	原始取得	无

133	发行人、奕斯伟硅片	晶体生长直径的控制方法、装置、设备及计算机存储介质	ZL202110949748.6	2022.08.02	原始取得	无
134	发行人、奕斯伟硅片	一种化学钝化塑封系统	ZL201911294364.4	2022.07.29	原始取得	无
135	发行人、奕斯伟硅片	单面抛光装置及方法	ZL202011309493.9	2022.07.29	原始取得	无
136	发行人、奕斯伟硅片	多晶硅二次加料装置、多晶硅铸锭设备	ZL202011073109.X	2022.07.12	原始取得	无
137	发行人、奕斯伟硅片	多晶硅熔化参数的检测方法、多晶硅、单晶硅及其制造方法	ZL201910473292.3	2022.07.01	原始取得	无
138	发行人、奕斯伟硅片	一种硅片清洗装置及方法	ZL201911063219.5	2022.06.28	原始取得	无
139	发行人、奕斯伟硅片	一种晶圆研磨设备	ZL202110805056.4	2022.06.24	原始取得	无
140	发行人、奕斯伟硅片	研磨机吸附台表面的清洁方法	ZL202010443516.9	2022.06.10	原始取得	无
141	发行人、奕斯伟硅片	一种用于角抛光硅片样品的装置、设备及方法	ZL202010944806.1	2022.06.10	原始取得	无
142	发行人、奕斯伟硅片	一种手持式晶圆吸附装置	ZL202111235833.2	2022.06.10	原始取得	无
143	发行人	一种用于制造掺氮单晶硅的设备与方法	ZL202111162445.6	2022.06.10	原始取得	无
144	发行人、奕斯伟硅片	一种导流筒装置和拉晶炉	ZL201911367146.9	2022.06.07	原始取得	无
145	发行人、奕斯伟硅片	研磨装置、研磨机及研磨方法	ZL202011231876.9	2022.06.07	原始取得	无
146	发行人、奕斯伟硅片	一种研磨载台、研磨装置、研磨方法及硅片	ZL202210188211.7	2022.06.07	原始取得	无
147	发行人、奕斯伟硅片	一种晶棒切割装置及晶棒切割方法	ZL202010869343.7	2022.05.31	原始取得	无
148	发行人、奕斯伟硅片	防止工件掉落保护装置、工件切割系统及切割方法	ZL201911121040.0	2022.05.27	原始取得	无
149	发行人、奕斯伟硅片	一种气相沉积反应腔体的承载装置及清洗系统	ZL201911347019.2	2022.05.27	原始取得	无

150	发行人、奕斯伟硅片	一种用于化学钝化的系统	ZL201911357714.7	2022.05.24	原始取得	无
151	发行人、奕斯伟硅片	一种清洗装置	ZL201911301459.4	2022.05.20	原始取得	无
152	发行人、奕斯伟硅片	研磨头及晶圆研磨装置	ZL201911369943.0	2022.05.13	原始取得	无
153	发行人、奕斯伟硅片	晶棒粘接方法及晶棒粘接装置	ZL202010299611.6	2022.05.03	原始取得	无
154	发行人、奕斯伟硅片	边缘抛光装置和抛光方法	ZL202010800000.5	2022.04.29	原始取得	无
155	发行人、奕斯伟硅片	多晶硅选择方法、多晶硅及其在直拉法中的应用	ZL201910414330.8	2022.04.26	原始取得	无
156	发行人、奕斯伟硅片	一种晶圆表面损伤层深度测量方法及系统	ZL202011237065.X	2022.04.22	原始取得	无
157	发行人、奕斯伟硅片	一种硅片处理设备	ZL202011478667.4	2022.04.19	原始取得	无
158	发行人、奕斯伟硅片	一种硅片处理装置和处理方法	ZL201910795184.8	2022.04.15	原始取得	无
159	发行人、奕斯伟硅片	用于清洗硅块的容器、装置及清洗方法	ZL201910324164.2	2022.04.15	原始取得	无
160	发行人、奕斯伟硅片	一种导流筒装置和拉晶炉	ZL201911357718.5	2022.04.15	原始取得	无
161	发行人、奕斯伟硅片	流量可控的侧排气装置及具有该装置的拉晶炉	ZL201911076441.9	2022.04.08	原始取得	无
162	发行人、奕斯伟硅片	研磨头及研磨设备	ZL202010382859.9	2022.04.08	原始取得	无
163	发行人、奕斯伟硅片	一种水平对中校准夹具、拉晶炉及水平对中校准方法	ZL201911311540.0	2022.04.08	原始取得	无
164	发行人、奕斯伟硅片	一种多线切割装置	ZL202010468660.8	2022.04.08	原始取得	无
165	发行人、奕斯伟硅片	一种清洗装置及清洗方法	ZL201811634866.2	2022.04.05	原始取得	无
166	奕斯伟硅片	用于电荷钝化测试单晶硅片少子寿命的前处理系统和方法	ZL202110330098.7	2022.04.05	原始取得	无

167	发行人、奕斯伟硅片	一种晶圆处理装置和上下料方法	ZL201911000372.3	2022.04.01	原始取得	无
168	发行人、奕斯伟硅片	一种晶圆检测工具	ZL201911044068.9	2022.04.01	原始取得	无
169	发行人、奕斯伟硅片	一种研磨砂轮	ZL201911075573.X	2022.04.01	原始取得	无
170	发行人、奕斯伟硅片	一种超疏油有机涂层及其制备方法	ZL202010926078.1	2022.03.29	原始取得	无
171	发行人、奕斯伟硅片	一种切割装置	ZL202010774028.6	2022.03.25	原始取得	无
172	发行人、奕斯伟硅片	一种硅片的处理方法、检测方法及处理装置	ZL201910477898.4	2022.03.25	原始取得	无
173	发行人、奕斯伟硅片	一种晶圆处理装置和上下料方法	ZL201911001569.9	2022.03.22	原始取得	无
174	发行人、奕斯伟硅片	应用于双面抛光设备的物料管理方法、系统及存储介质	ZL202011344635.5	2022.03.22	原始取得	无
175	发行人、奕斯伟硅片	应用于双面抛光设备的物料管理方法、系统及存储介质	ZL202011350935.4	2022.03.22	原始取得	无
176	奕斯伟硅片	一种晶圆表面金属离子采集装置及方法	ZL202111123683.6	2022.03.22	原始取得	无
177	发行人、奕斯伟硅片	一种硅片清洗装置及硅片清洗方法	ZL201910604084.2	2022.03.18	原始取得	无
178	发行人、奕斯伟硅片	一种改善外延晶圆平坦度的方法以及外延晶圆	ZL202111428677.1	2022.03.11	原始取得	无
179	发行人、奕斯伟硅片	硅片方位调准装置及硅片缺陷检测设备	ZL202111355514.5	2022.03.08	原始取得	无
180	发行人、奕斯伟硅片	一种硅片样品的制备装置及制备方法	ZL201910880970.8	2022.03.01	原始取得	无
181	发行人、奕斯伟硅片	一种将抛光垫的初始状态转变为亲水性的方法和装置	ZL202011256546.5	2022.02.25	原始取得	无
182	发行人、奕斯伟硅片	一种片盒清洗装置及方法	ZL201910605488.3	2022.02.22	原始取得	无
183	发行人、奕斯伟硅片	冷却装置以及冷却系统	ZL201911364861.7	2022.02.22	原始取得	无

184	发行人	用于检测晶圆表面金属的方法	ZL202111329658.3	2022.02.18	原始取得	无
185	发行人、奕斯伟硅片	硅片少子寿命的测试方法及装置	ZL202010191560.5	2022.02.15	原始取得	无
186	发行人、奕斯伟硅片	一种外延生长基座	ZL201910718301.0	2022.02.08	原始取得	无
187	发行人、奕斯伟硅片	一种拉晶炉及单晶硅棒的制备方法	ZL201911219643.4	2022.02.08	原始取得	无
188	发行人、奕斯伟硅片	晶圆预处理装置及晶圆缺陷检测方法	ZL202111285466.7	2022.02.08	原始取得	无
189	发行人、奕斯伟硅片	一种抛光垫的修整装置及修整方法	ZL201910865033.5	2022.02.01	原始取得	无
190	发行人、奕斯伟硅片	硅蚀刻方法、硅块、直拉单晶的提拉方法及单晶	ZL201910092226.1	2022.02.01	原始取得	无
191	发行人	一种用于背封硅片的方法和设备	ZL202111281508.X	2022.01.25	原始取得	无
192	发行人、奕斯伟硅片	晶圆 V 型缺口中心的定位方法、系统及计算机存储介质	ZL202111228898.4	2022.01.21	原始取得	无
193	发行人、奕斯伟硅片	一种校准工具	ZL201910707570.7	2022.01.14	原始取得	无
194	发行人、奕斯伟硅片	一种切割装置和晶棒的切割方法	ZL201910340131.7	2021.12.24	原始取得	无
195	发行人、奕斯伟硅片	一种研磨设备和研磨设备的清洁方法	ZL201910560878.3	2021.12.24	原始取得	无
196	奕斯伟硅片	一种硅片的最终抛光方法、系统以及硅片	ZL202111137980.6	2021.12.21	原始取得	无
197	发行人、奕斯伟硅片	一种晶棒的加工方法及晶片	ZL201911121037.9	2021.12.17	原始取得	无
198	奕斯伟硅片	硅片承载装置和分离设备	ZL202111180208.2	2021.12.07	原始取得	无
199	发行人、奕斯伟硅片	一种倒角研磨设备	ZL201911141593.2	2021.12.03	原始取得	无
200	发行人、奕斯伟硅片	一种加料装置、拉晶炉及加料方法	ZL202010280241.1	2021.11.30	原始取得	无

201	发行人、奕斯伟硅片	一种抛光垫的修整器及修整方法	ZL201911002359.1	2021.11.26	原始取得	无
202	发行人、奕斯伟硅片	一种晶棒直径测量装置及方法	ZL202010304544.2	2021.11.23	原始取得	无
203	发行人、奕斯伟硅片	多线切割装置及多线切割方法	ZL202010332487.9	2021.11.23	原始取得	无
204	发行人、奕斯伟硅片	一种单晶炉热场加热器组件及单晶炉	ZL202010419341.8	2021.11.23	原始取得	无
205	发行人、奕斯伟硅片	抛光垫及其制备方法、化学机械研磨设备	ZL201911006629.6	2021.11.19	原始取得	无
206	发行人、奕斯伟硅片	一种拉晶炉	ZL201910933783.1	2021.11.16	原始取得	无
207	发行人、奕斯伟硅片	研磨载具清洗装置及研磨载具清洗方法	ZL202010268464.6	2021.11.12	原始取得	无
208	发行人、奕斯伟设备	低信噪比下的硅单晶生长图像的自适应随机共振去噪方法	ZL201810199562.1	2021.11.09	继受取得	无
209	发行人、奕斯伟硅片	一种砂浆罐、切割装置及晶棒的切割方法	ZL201911259537.9	2021.11.02	原始取得	无
210	发行人、奕斯伟硅片	外延层厚度测试装置和方法	ZL201911107836.0	2021.11.02	原始取得	无
211	发行人、奕斯伟硅片	线切割清洁装置及线切割系统	ZL201911192832.7	2021.11.02	原始取得	无
212	发行人、奕斯伟硅片	一种边缘研磨装置及方法	ZL201910664989.9	2021.10.29	原始取得	无
213	奕斯伟硅片	一种侦测晶圆异常的方法、装置、设备及计算机存储介质	ZL202110723876.9	2021.10.29	原始取得	无
214	发行人、奕斯伟硅片	一种硅片夹持装置	ZL201910649553.2	2021.10.22	原始取得	无
215	奕斯伟硅片	晶圆处理装置及晶圆缺陷评价方法	ZL202110317141.6	2021.10.22	原始取得	无
216	发行人、奕斯伟硅片	一种上抛光盘水冷却系统	ZL201911260499.9	2021.10.01	原始取得	无
217	奕斯伟硅片	一种晶棒防护组件、晶棒取出装置及晶棒取出方法	ZL201911294767.9	2021.09.17	原始取得	无

218	奕斯伟硅片	一种研磨设备和研磨台的调节方法	ZL201910372442.1	2021.09.14	原始取得	无
219	奕斯伟硅片	一种抛光机	ZL201911377700.1	2021.09.14	原始取得	无
220	奕斯伟硅片	一种抛光盘冷却结构、抛光盘以及抛光机	ZL202010185005.1	2021.09.14	原始取得	无
221	奕斯伟硅片	一种研磨垫的定位结构、研磨设备及定位方法	ZL201910666441.8	2021.09.10	原始取得	无
222	奕斯伟硅片	一种用于硅片的外延生长的基座、装置及方法	ZL202010867628.7	2021.09.07	原始取得	无
223	奕斯伟硅片	一种研磨盘平行度调节装置及方法	ZL201911273746.9	2021.09.03	原始取得	无
224	奕斯伟硅片	抛光液供给系统、方法及抛光系统	ZL201811614382.1	2021.08.31	原始取得	无
225	奕斯伟硅片	抛光垫及化学机械抛光设备	ZL201911100422.5	2021.08.24	原始取得	无
226	奕斯伟硅片	一种研磨设备	ZL201910978694.9	2021.08.24	原始取得	无
227	奕斯伟硅片	一种研磨装置、研磨方法及晶圆	ZL201910567467.7	2021.08.17	原始取得	无
228	奕斯伟硅片	一种晶棒取出防护组件、晶棒取出装置及晶棒取出方法	ZL201911300087.3	2021.07.27	原始取得	无
229	奕斯伟硅片	挡板装置及具有其的导流筒、挡辐射装置及拉晶装置	ZL201911365076.3	2021.07.27	原始取得	无
230	奕斯伟硅片	一种晶棒转移下降防护组件、晶棒取出装置及晶棒取出方法	ZL201911293642.4	2021.07.23	原始取得	无
231	奕斯伟硅片	一种单晶炉及单晶硅棒的制备方法	ZL201911347998.1	2021.07.23	原始取得	无
232	奕斯伟硅片	一种用于卡夹硅片的卡盘销及用于保持硅片的装置	ZL202011382851.9	2021.07.16	原始取得	无
233	奕斯伟硅片	硅片中金属含量的测量方法	ZL202110330104.9	2021.06.25	原始取得	无
234	奕斯伟硅片	一种抛光设备及方法	ZL201910717529.8	2021.06.22	原始取得	无

235	奕斯伟硅片	一种晶圆热处理方法和晶圆	ZL201910072442.X	2021.05.28	原始取得	无
236	奕斯伟硅片	一种晶棒切割装置及方法	ZL201910973668.7	2021.05.28	原始取得	无
237	奕斯伟硅片	单晶炉及单晶硅的制备方法	ZL201910862546.0	2021.05.25	原始取得	无
238	奕斯伟硅片	一种夹持晶圆的部件及机构	ZL202110133255.5	2021.05.25	原始取得	无
239	奕斯伟硅片	一种边缘研磨装置及方法	ZL201910664996.9	2021.05.18	原始取得	无
240	奕斯伟硅片	一种支撑结构和具有其的热处理装置	ZL201910531379.1	2021.05.07	原始取得	无
241	奕斯伟硅片	一种硅晶体的破碎方法及热处理装置	ZL201910411874.9	2021.04.23	原始取得	无
242	奕斯伟硅片	清洗装置及清洗方法	ZL201811553821.2	2021.04.20	原始取得	无
243	奕斯伟硅片	一种晶圆分选设备及晶圆分选方法	ZL202011557684.7	2021.04.13	原始取得	无
244	奕斯伟硅片	一种晶圆研磨装置	ZL201910863379.1	2021.04.09	原始取得	无
245	奕斯伟硅片	一种获取晶圆接触点的方法及系统	ZL202110044533.X	2021.04.02	原始取得	无
246	奕斯伟硅片	稳流装置及拉晶炉	ZL201910561753.2	2021.04.02	原始取得	无
247	奕斯伟硅片	一种晶圆翻转设备	ZL202011542248.2	2021.04.02	原始取得	无
248	奕斯伟硅片	夹取储存在硅片盒中的硅片的装置、方法及硅片传送设备	ZL202011347533.9	2021.03.05	原始取得	无
249	奕斯伟硅片	角度抛光装置、晶圆表面损伤深度测量方法	ZL202011251075.9	2021.03.02	原始取得	无
250	奕斯伟硅片	能够保持 FOUP 的盖部的洁净度的装载端口及设备前端模块	ZL202011506727.9	2021.03.02	原始取得	无
251	奕斯伟硅片	一种晶圆盒装载装置和晶圆盒装载方法	ZL202011285956.2	2021.03.02	原始取得	无

252	奕斯伟硅片	一种晶圆外延设备	ZL201910925692.3	2021.03.02	原始取得	无
253	奕斯伟硅片	一种用于在硅片目视检测过程中夹持硅片的装置	ZL202011321225.9	2021.02.12	原始取得	无
254	奕斯伟硅片	蚀刻装置及蚀刻装置的工作方法	ZL201910476381.3	2020.11.17	原始取得	无
255	奕斯伟硅片	一种用于晶片的外延生长的基座、装置及方法	ZL202010728747.4	2020.10.30	原始取得	无
256	奕斯伟硅片	减少硅块表面有机物的方法及单晶硅的制备方法	ZL201910475513.0	2020.10.30	原始取得	无
257	奕斯伟硅片	一种晶圆保护机构、装置及方法	ZL202010700098.7	2020.10.23	原始取得	无
258	发行人、奕斯伟设备	一种热场温度-硅单晶直径非线性时滞系统智能辨识方法	ZL201710615951.3	2020.09.15	继受取得	无
259	奕斯伟硅片	红外干燥装置	ZL201911002392.4	2020.08.28	原始取得	无
260	奕斯伟硅片	一种硅晶圆的加工方法、控制装置及外延反应设备	ZL201811612257.7	2020.08.28	原始取得	无
261	奕斯伟硅片	一种硅片背封层的边缘去除装置及边缘去除方法	ZL202010428566.X	2020.08.25	原始取得	无
262	奕斯伟硅片	抛光垫的修整方法、修整装置、抛光垫及双面抛光装置	ZL201811609439.9	2020.07.28	原始取得	无
263	奕斯伟硅片	喷头、喷淋组件、冷却剂的供应方法及晶圆的研磨方法	ZL201910562635.3	2020.06.23	原始取得	无
264	发行人、奕斯伟设备	一种基于恒拉速控制结构的硅单晶直径控制方法	ZL201710772913.9	2020.05.22	继受取得	无
265	奕斯伟硅片	晶圆研磨方法及其研磨系统	ZL201811623632.8	2020.05.19	原始取得	无
266	发行人、奕斯伟设备	MCZ 硅单晶炉用超导磁体励磁高频开关电源的控制方法	ZL201810075447.3	2020.04.24	继受取得	无
267	发行人、奕斯伟设备	一种直拉硅单晶生长工艺优化固液界面氧分布调节方法	ZL201710811360.3	2020.03.31	继受取得	无

268	发行人、奕斯伟设备	一种基于自由液面温度测量值和特征函数插值的硅熔体温度场重构方法	ZL201710439593.5	2020.03.27	继受取得	无
269	发行人、奕斯伟设备	一种直拉硅单晶生长过程工艺参数优化方法	ZL201810994948.1	2019.09.27	继受取得	无
270	发行人、奕斯伟设备	一种可抑制波动的直拉硅单晶炉液位检测方法	ZL201510697587.0	2017.09.22	继受取得	无
271	发行人、奕斯伟设备	基于支持向量机回归的晶体直径测量方法	ZL201210391462.1	2015.12.02	继受取得	无
272	发行人、奕斯伟设备	采用激光曲面镜反射进行熔硅液位检测的装置及检测方法	ZL201010246742.4	2012.04.18	继受取得	无
273	发行人、奕斯伟设备	用于 MCZ 单晶炉的非对称勾形磁场的三维优化设计方法	ZL201010257476.5	2012.04.04	继受取得	无
274	发行人、奕斯伟设备	用于 MCZ 单晶炉的勾形磁场的优化设计方法	ZL201010105658.0	2012.02.08	继受取得	无
275	发行人、奕斯伟设备	基于数字信号处理器的双相机直拉单晶直径测量方法	ZL200810017263.8	2011.08.10	继受取得	无
276	发行人、奕斯伟设备	基于霍夫变换的直拉单晶硅棒直径的测量方法	ZL200610105331.7	2008.11.26	继受取得	无
277	发行人、奕斯伟设备	直拉法单晶硅生长过程中的熔体液面位置检测方法	ZL200610105332.1	2008.11.26	继受取得	无

（二）已获授权的境内实用新型专利

序号	专利权人	专利名称	专利号	授权日	取得方式	他项权利
1	发行人、奕斯伟硅片	晶舟	ZL202323326053.6	2024.12.6	原始取得	无
2	发行人、欣芯材料	槽体间连接结构和刻蚀设备	ZL202420867758.4	2024.12.10	原始取得	无
3	发行人、奕斯伟硅片	一种树脂基砂轮整形装置	ZL202323601189.3	2024.11.12	原始取得	无
4	发行人、奕斯伟硅片	一种硅片刻蚀装置	ZL202323389754.4	2024.10.8	原始取得	无

5	发行人、奕斯伟硅片	硅片抛光设备	ZL202322575499.6	2024.10.22	原始取得	无
6	发行人、奕斯伟硅片	一种销环结构、装置及双面抛光设备	ZL202322570352.8	2024.08.20	原始取得	无
7	发行人、欣芯材料	重锤结构和拉晶设备	ZL202322927543.5	2024.08.02	原始取得	无
8	发行人、奕斯伟硅片	一种晶棒截断机的支撑装置及晶棒截断机	ZL202322940539.2	2024.07.30	原始取得	无
9	发行人、奕斯伟硅片	硅片研磨去除量测量装置	ZL202323246790.5	2024.07.12	原始取得	无
10	发行人、奕斯伟硅片	一种用于清洁晶圆研磨垫的装置及晶圆研磨设备	ZL202323252853.8	2024.07.05	原始取得	无
11	发行人、欣芯材料	清洗设备	ZL202322833090.X	2024.07.02	原始取得	无
12	发行人、奕斯伟硅片	定位片安装装置	ZL202323225900.X	2024.06.28	原始取得	无
13	发行人、奕斯伟硅片	砂浆温度自动控制装置和多线切割系统	ZL202323369606.6	2024.06.18	原始取得	无
14	发行人、奕斯伟硅片	研磨盘清洁装置	ZL202322593773.2	2024.04.19	原始取得	无
15	发行人、奕斯伟硅片	一种拉晶炉及单晶硅棒	ZL202322596083.2	2024.04.16	原始取得	无
16	发行人、奕斯伟硅片	识别码识别装置	ZL202322560132.7	2024.04.12	原始取得	无
17	发行人、奕斯伟硅片	一种晶圆钝化装置	ZL202322263140.5	2024.03.26	原始取得	无
18	发行人、奕斯伟硅片	水处理系统	ZL202322039769.1	2024.02.09	原始取得	无
19	发行人、奕斯伟硅片	金属收集系统	ZL202321950557.2	2024.01.26	原始取得	无
20	发行人、奕斯伟硅片	一种液体采样装置	ZL202322036110.0	2024.01.26	原始取得	无
21	发行人、奕斯伟硅片	硅片承载结构	ZL202321680019.6	2024.01.26	原始取得	无

22	发行人、奕斯伟硅片	硅片刻蚀装置	ZL202322010182.8	2024.01.12	原始取得	无
23	发行人、奕斯伟硅片	一种用于取放晶圆的机械手臂	ZL202321506637.9	2023.12.22	原始取得	无
24	发行人、奕斯伟硅片	一种磨轮法兰防护罩、磨轮组件和研磨设备	ZL202321501767.3	2023.11.28	原始取得	无
25	发行人、奕斯伟硅片	一种边缘研磨设备	ZL202321504396.4	2023.11.24	原始取得	无
26	发行人、奕斯伟硅片	一种晶圆承载装置、抛光设备及处理系统	ZL202321461953.9	2023.11.21	原始取得	无
27	发行人、奕斯伟硅片	用于清洁硅片清洗设备的系统及硅片清洗设备	ZL202321197153.0	2023.11.03	原始取得	无
28	发行人、奕斯伟硅片	边缘抛光检测装置及边缘抛光设备	ZL202321003304.4	2023.10.27	原始取得	无
29	发行人、奕斯伟硅片	晶圆盒识别装置及晶圆盒装载台	ZL202321497397.0	2023.10.27	原始取得	无
30	发行人、奕斯伟硅片	一种用于切割晶棒的切割线及切割机	ZL202321355256.5	2023.10.20	原始取得	无
31	发行人、奕斯伟硅片	晶圆检测装置及晶圆搬送设备	ZL202321154792.9	2023.10.20	原始取得	无
32	发行人、奕斯伟硅片	一种转运装置	ZL202321218064.X	2023.10.13	原始取得	无
33	发行人、奕斯伟硅片	用于对硅片进行倒角的 T 型的磨轮组件及研磨装置	ZL202321000869.7	2023.10.10	原始取得	无
34	发行人、奕斯伟硅片	硅片清洗设备的清洗液获取系统及硅片清洗设备	ZL202321198533.6	2023.09.29	原始取得	无
35	发行人、奕斯伟硅片	一种用于对晶圆进行热处理的设备	ZL202320699130.3	2023.07.04	原始取得	无
36	发行人	单晶转运系统	ZL202223129501.9	2023.04.25	原始取得	无
37	发行人	电极保护结构和单晶炉	ZL202222807433.0	2023.04.07	原始取得	无
38	发行人、奕斯伟硅片	一种用于存放晶棒的装置及用于转运晶棒的设备	ZL202223002203.3	2023.03.24	原始取得	无

39	发行人、奕斯伟硅片	一种磨损监测系统、提升机构及拉晶炉	ZL202223282264.X	2023.03.21	原始取得	无
40	发行人	石墨坩埚	ZL202221457151.6	2023.02.21	原始取得	无
41	发行人、奕斯伟硅片	一种单晶炉	ZL202222854926.X	2022.12.27	原始取得	无
42	发行人、奕斯伟硅片	一种晶棒切割装置	ZL202221516375.X	2022.12.09	原始取得	无
43	发行人、奕斯伟硅片	研磨轮固定组件和研磨设备	ZL202221379003.7	2022.12.06	原始取得	无
44	发行人	坩埚装置及单晶炉	ZL202221302614.1	2022.11.08	原始取得	无
45	发行人、奕斯伟硅片	抛光头吸附垫检测装置及抛光机设备	ZL202221589543.8	2022.11.08	原始取得	无
46	发行人、奕斯伟硅片	一种硅片研磨装置	ZL202220684076.0	2022.11.04	原始取得	无
47	发行人	双面研磨装置	ZL202221347618.1	2022.11.04	原始取得	无
48	发行人、奕斯伟硅片	抛光机	ZL202221447658.3	2022.10.21	原始取得	无
49	发行人	一种单晶炉	ZL202221372340.3	2022.10.21	原始取得	无
50	发行人、奕斯伟硅片	一种用于粘接晶棒的装置	ZL202221521345.8	2022.10.18	原始取得	无
51	发行人、奕斯伟硅片	一种用于将晶棒粘接至粘接板的装置	ZL202221536120.X	2022.10.18	原始取得	无
52	发行人	一种晶锭固定装置	ZL202221665215.1	2022.10.18	原始取得	无
53	发行人、奕斯伟硅片	切割装置	ZL202221682645.4	2022.10.18	原始取得	无
54	发行人	一种用于修整磨轮的装置	ZL202221837931.3	2022.10.18	原始取得	无
55	发行人、奕斯伟硅片	晶圆夹持机械手臂及晶圆清洗装置	ZL202221293160.6	2022.10.14	原始取得	无

56	发行人、奕斯伟硅片	承载槽清洗装置	ZL202221690438.3	2022.09.20	原始取得	无
57	发行人	籽晶夹持装置和单晶炉	ZL202221681013.6	2022.09.20	原始取得	无
58	发行人	一种用于拉晶炉的隔离阀及拉晶炉	ZL202221161349.X	2022.09.16	原始取得	无
59	发行人	一种双螺旋切割线	ZL202221129486.5	2022.09.16	原始取得	无
60	发行人、奕斯伟硅片	半导体加工设备	ZL202221680463.3	2022.09.16	原始取得	无
61	发行人、奕斯伟硅片	一种硅片表面自动加标装置	ZL202123362314.0	2022.09.09	原始取得	无
62	发行人	砂浆供给系统	ZL202221314885.9	2022.09.06	原始取得	无
63	发行人、奕斯伟硅片	一种研磨轮、双面研磨装置及硅片	ZL202221008117.0	2022.09.06	原始取得	无
64	发行人、奕斯伟硅片	一种防止硅片边缘损伤的预处理装置	ZL202221236780.6	2022.09.02	原始取得	无
65	发行人	一种用于双面研磨装置的静压板和双面研磨装置	ZL202221161089.6	2022.09.02	原始取得	无
66	发行人	一种用于清洁抛光盘的装置	ZL202221334139.6	2022.08.30	原始取得	无
67	发行人、奕斯伟硅片	一种石墨坩埚、坩埚组件及拉晶炉	ZL202123304483.9	2022.08.26	原始取得	无
68	发行人、奕斯伟硅片	一种外延片氧化层清洗设备	ZL202220249082.3	2022.08.26	原始取得	无
69	发行人、奕斯伟硅片	一种片盒清洗机	ZL202220045819.X	2022.08.16	原始取得	无
70	发行人	一种单晶炉的组合套筒及单晶炉	ZL202123016165.2	2022.08.09	原始取得	无
71	发行人、奕斯伟硅片	磨轮修正装置	ZL202123313123.5	2022.08.02	原始取得	无
72	发行人、奕斯伟硅片	用于承载硅片的装置及研磨设备	ZL202221595288.8	2022.07.29	原始取得	无

73	发行人	一种单晶炉的提拉装置和单晶炉	ZL202123041288.1	2022.07.08	原始取得	无
74	发行人、奕斯伟硅片	一种清洗抛光垫的装置	ZL202123335737.3	2022.07.05	原始取得	无
75	发行人、奕斯伟硅片	一种导流筒和拉晶炉	ZL202123301915.0	2022.07.01	原始取得	无
76	发行人	线切割装置	ZL202123319625.9	2022.06.28	原始取得	无
77	发行人、奕斯伟硅片	一种硅片研磨液前处理装置和硅片研磨设备	ZL202123365614.4	2022.06.21	原始取得	无
78	发行人、奕斯伟设备	拉晶炉	ZL202220227611.X	2022.06.07	原始取得	无
79	发行人、奕斯伟设备	导流筒提升组件和单晶炉	ZL202220252868.0	2022.06.07	原始取得	无
80	发行人、奕斯伟硅片	一种颗粒物去除装置及外延设备	ZL202220246298.4	2022.06.07	原始取得	无
81	发行人、奕斯伟硅片	一种臭氧水制备装置	ZL202123158259.3	2022.06.07	原始取得	无
82	发行人、奕斯伟设备	一种坩埚升降装置和单晶炉	ZL202220216498.5	2022.06.07	原始取得	无
83	发行人、奕斯伟硅片	一种吸附垫贴附装置	ZL202220245422.5	2022.06.03	原始取得	无
84	发行人、奕斯伟设备	一种清洁工具及二次加料器清洁装置	ZL202220246299.9	2022.06.03	原始取得	无
85	发行人、奕斯伟硅片	一种硅片边缘抛光装置	ZL202123355342.X	2022.05.17	原始取得	无
86	发行人	一种双面研磨装置	ZL202123366531.7	2022.05.17	原始取得	无
87	发行人、奕斯伟硅片	一种用于清洗载盘的清洗槽	ZL202123385940.1	2022.05.13	原始取得	无
88	发行人、奕斯伟硅片	一种测量熔硅液面位置的定位销及晶硅熔炉	ZL202120221631.1	2022.05.10	原始取得	无
89	发行人、奕斯伟硅片	一种开放式晶圆匣	ZL202123365822.4	2022.05.10	原始取得	无

90	发行人、奕斯伟硅片	一种石墨坩埚、坩埚组件及拉晶炉	ZL202123366727.6	2022.05.10	原始取得	无
91	发行人、奕斯伟硅片	一种硅料二次加料装置及单晶炉	ZL202123366229.1	2022.05.06	原始取得	无
92	发行人、奕斯伟硅片	一种硅棒破碎装置	ZL202123358875.3	2022.05.06	原始取得	无
93	发行人	一种用于切割单晶硅棒的装置	ZL202123091731.6	2022.04.29	原始取得	无
94	发行人、奕斯伟硅片	一种用于获取拉晶炉的炉体内的污染信息的装置	ZL202123237214.5	2022.04.29	原始取得	无
95	发行人	一种用于对双面研磨设备的对置磨轮同时进行修整的装置	ZL202123301596.3	2022.04.29	原始取得	无
96	发行人	一种用于控制硅片研磨装置的变形的系统	ZL202123295963.3	2022.04.29	原始取得	无
97	发行人、奕斯伟硅片	一种硅片边缘检测系统	ZL202220705660.X	2022.04.29	原始取得	无
98	发行人	一种用于更换磨轮的装置	ZL202123153508.X	2022.04.19	原始取得	无
99	发行人、奕斯伟硅片	样品瓶清洗装置	ZL202023014486.4	2022.04.15	原始取得	无
100	发行人、奕斯伟硅片	监控单晶炉中硅熔液的液面的状态及坩埚的状态的系统	ZL202123091409.3	2022.04.15	原始取得	无
101	发行人、奕斯伟硅片	用于调准成对的石墨块对带锯的夹紧力的系统及带锯机	ZL202122922405.9	2022.04.15	原始取得	无
102	发行人、奕斯伟硅片	一种硅片厚度测量装置	ZL202220296760.1	2022.03.11	原始取得	无
103	发行人、奕斯伟硅片	一种用于对硅片盒中的硅片进行夹取的机械手及系统	ZL202123066329.2	2022.01.21	原始取得	无
104	发行人、奕斯伟硅片	熔液间距控制结构和单晶棒生长装置	ZL202120553828.5	2022.01.11	原始取得	无
105	发行人、奕斯伟硅片	机械手臂和硅片传输系统	ZL202123026948.9	2022.01.04	原始取得	无
106	发行人、奕斯伟硅片	一种倒角研磨装置	ZL202121823752.X	2021.12.31	原始取得	无

107	发行人、奕斯伟硅片	一种单晶炉	ZL202121906928.8	2021.12.31	原始取得	无
108	发行人、奕斯伟设备	单晶炉	ZL202120379054.9	2021.12.28	原始取得	无
109	发行人、奕斯伟设备	旋转装置	ZL202120089106.9	2021.12.17	原始取得	无
110	发行人、奕斯伟硅片	一种单晶炉套筒装置和单晶炉	ZL202120166296.X	2021.12.14	原始取得	无
111	发行人、奕斯伟硅片	测量拉晶炉熔硅液面高度的结构及拉晶炉	ZL202120884689.4	2021.12.03	原始取得	无
112	发行人、奕斯伟硅片	一种带锯夹持装置及带锯机	ZL202120354571.0	2021.12.03	原始取得	无
113	发行人、奕斯伟硅片	一种用于硅片的预清洗设备	ZL202120613202.9	2021.12.03	原始取得	无
114	发行人、奕斯伟硅片	一种硅片抛光设备中使用的中转装置及硅片抛光设备	ZL202121497763.3	2021.11.30	原始取得	无
115	发行人、奕斯伟硅片	一种晶圆制样装置	ZL202121485727.5	2021.11.26	原始取得	无
116	发行人、奕斯伟设备	吸盘装置	ZL202120295146.9	2021.11.23	原始取得	无
117	发行人、奕斯伟硅片	一种抛光载盘清洗存储设备	ZL202120402414.2	2021.11.23	原始取得	无
118	发行人、奕斯伟硅片	一种检测装置	ZL202022788604.0	2021.11.23	原始取得	无
119	发行人、奕斯伟硅片	预热环及外延生长设备	ZL202023138293.X	2021.11.09	原始取得	无
120	发行人、奕斯伟设备	多关节运动机构的位置检测装置及多关节运动设备	ZL202120491977.3	2021.11.02	原始取得	无
121	发行人、奕斯伟硅片	一种晶棒吊装工具	ZL202120243265.X	2021.10.22	原始取得	无
122	发行人、奕斯伟硅片	清洗抛光机的外周挡罩的组件及抛光机的清洗系统	ZL202120295832.6	2021.10.15	原始取得	无
123	发行人、奕斯伟硅片	一种研磨装置	ZL202022851580.9	2021.10.08	原始取得	无

124	发行人、奕斯伟硅片	拉晶炉排气管道及拉晶炉	ZL202120343231.8	2021.09.28	原始取得	无
125	发行人、奕斯伟设备	一种单晶炉主室吊装定位装置	ZL202120197380.8	2021.09.24	原始取得	无
126	发行人、奕斯伟硅片	一种组装装置	ZL202120039041.7	2021.09.24	原始取得	无
127	发行人、奕斯伟硅片	一种最终抛光设备	ZL202022835880.8	2021.09.17	原始取得	无
128	发行人、奕斯伟设备	重锤装置和用于晶棒生长的提拉机构	ZL202120079282.4	2021.09.14	原始取得	无
129	发行人、奕斯伟设备	一种籽晶提拉装置	ZL202120114208.1	2021.09.14	原始取得	无
130	发行人、奕斯伟硅片	一种适用于 FPD 缺陷刻蚀的料篮	ZL202120245500.7	2021.09.14	原始取得	无
131	发行人、奕斯伟硅片	一种用于拉制单晶硅棒的拉晶炉	ZL202120042335.5	2021.09.07	原始取得	无
132	发行人、奕斯伟硅片	一种拉晶炉	ZL202023046389.3	2021.09.03	原始取得	无
133	奕斯伟硅片	一种可控温的刻蚀设备	ZL202023140061.8	2021.08.24	原始取得	无
134	发行人、奕斯伟硅片	一种晶圆热处理装置	ZL202023034108.2	2021.08.17	原始取得	无
135	奕斯伟硅片	能够保持装载盒内部晶圆洁净度的装载端口及前端模块	ZL202121542538.7	2021.08.10	原始取得	无
136	奕斯伟硅片	一种用于暂存以及运输硅片的水槽以及硅片的上料系统	ZL202121537184.7	2021.08.10	原始取得	无
137	发行人、奕斯伟硅片	一种用于拉制单晶硅棒的拉晶炉	ZL202022897671.6	2021.07.30	原始取得	无
138	发行人、奕斯伟硅片	一种用于为硅片的研磨设备供应研磨液的系统	ZL202023037193.8	2021.07.27	原始取得	无
139	发行人、奕斯伟硅片	取样装置	ZL202022691238.7	2021.07.23	原始取得	无
140	发行人、奕斯伟硅片	一种半导体晶圆的最终抛光设备	ZL202022442951.8	2021.07.20	原始取得	无

141	奕斯伟硅片	晶圆制样装置	ZL202121153051.X	2021.07.06	原始取得	无
142	发行人、奕斯伟硅片	晶圆表面金属离子采集装置	ZL202023059989.3	2021.06.25	原始取得	无
143	奕斯伟硅片	一种单晶炉	ZL202020673343.5	2021.06.18	原始取得	无
144	发行人、奕斯伟硅片	用于制备抑菌抛光液的装置及用于双面抛光硅片的系统	ZL202022573638.8	2021.06.15	原始取得	无
145	发行人、奕斯伟硅片	研磨盘平坦度测量装置及测量系统	ZL202022751915.X	2021.06.08	原始取得	无
146	发行人、奕斯伟硅片	一种用于角抛光硅片样品的设备	ZL202022321034.4	2021.05.25	原始取得	无
147	发行人、奕斯伟硅片	一种刻蚀装置	ZL202022724211.3	2021.05.25	原始取得	无
148	奕斯伟硅片	一种修整结构	ZL202021402710.4	2021.05.11	原始取得	无
149	奕斯伟硅片	晶圆固定台、贴膜机及划片机	ZL202120624923.X	2021.04.30	原始取得	无
150	发行人、奕斯伟硅片	一种晶舟	ZL202022505172.8	2021.04.20	原始取得	无
151	奕斯伟硅片	一种用于接合支撑销和基座的机构及相关的组件和装置	ZL202021952195.7	2021.04.20	原始取得	无
152	奕斯伟硅片	一种晶圆裂片夹具	ZL202021512206.X	2021.03.30	原始取得	无
153	奕斯伟硅片	硅片运输装置	ZL202120415829.3	2021.03.26	原始取得	无
154	奕斯伟硅片	一种抛光结构	ZL202021809881.9	2021.03.23	原始取得	无
155	奕斯伟硅片	一种抛光结构	ZL202021808324.5	2021.03.23	原始取得	无
156	奕斯伟硅片	一种晶棒夹持定位装置及研磨设备	ZL202020982480.7	2021.03.23	原始取得	无
157	发行人、奕斯伟硅片	一种用于硅片样品的刻蚀的夹具及组件	ZL202022274550.6	2021.03.19	原始取得	无

158	奕斯伟硅片	一种硅片承载装置及硅片缺陷检测装置	ZL202021002784.9	2021.03.12	原始取得	无
159	奕斯伟硅片	一种夹取结构	ZL202021403945.5	2021.03.02	原始取得	无
160	奕斯伟硅片	测量晶圆直径的装置	ZL202022013645.2	2021.03.02	原始取得	无
161	奕斯伟硅片	硅片倒角冷却装置以及硅片倒角机	ZL202021005659.3	2021.02.26	原始取得	无
162	奕斯伟硅片	冷却装置及拉晶系统	ZL201920485343.X	2021.02.12	原始取得	无
163	奕斯伟硅片	一种半导体刻蚀夹具	ZL202021756224.2	2021.02.09	原始取得	无
164	奕斯伟硅片	硅片清洗干燥装置和硅片处理设备	ZL202120092309.3	2021.02.09	原始取得	无
165	奕斯伟硅片	边缘研磨设备	ZL202021234437.9	2021.02.05	原始取得	无
166	奕斯伟硅片	一种缺陷定位装置和缺陷定位系统	ZL202021372134.3	2021.02.02	原始取得	无
167	奕斯伟硅片	晶圆切割裂片装置	ZL202020498218.5	2021.01.29	原始取得	无
168	奕斯伟硅片	样品采集装置	ZL202021212730.5	2021.01.26	原始取得	无
169	奕斯伟硅片	一种单晶炉	ZL202020766292.0	2021.01.08	原始取得	无
170	奕斯伟硅片	一种开孔装置	ZL202020980182.4	2021.01.05	原始取得	无
171	奕斯伟硅片	晶圆承载装置	ZL202021570855.5	2021.01.01	原始取得	无
172	奕斯伟硅片	研磨盘的清洁装置和研磨设备	ZL202020892125.0	2020.12.29	原始取得	无
173	奕斯伟硅片	一种双面研磨装置	ZL202020286917.3	2020.12.29	原始取得	无
174	奕斯伟硅片	副炉室清洁装置及副炉室清洁系统	ZL202020754127.3	2020.12.18	原始取得	无

175	奕斯伟硅片	样品承载装置	ZL202020977956.8	2020.12.18	原始取得	无
176	奕斯伟硅片	一种用于硅片钝化的设备	ZL202022465491.0	2020.12.11	原始取得	无
177	奕斯伟硅片	一种修磨装置	ZL202020625102.3	2020.12.08	原始取得	无
178	奕斯伟硅片	硅片分选机	ZL202020700876.8	2020.12.08	原始取得	无
179	奕斯伟硅片	一种夹具	ZL202020721935.X	2020.12.08	原始取得	无
180	奕斯伟硅片	一种拉晶炉	ZL202020839889.3	2020.12.08	原始取得	无
181	奕斯伟硅片	一种研磨设备	ZL202020662129.X	2020.11.24	原始取得	无
182	奕斯伟硅片	硅片刻蚀承载结构、硅片刻蚀装置、DOSD 测试设备	ZL202022317668.2	2020.11.17	原始取得	无
183	奕斯伟硅片	硅片承载结构即分离装置	ZL202020988709.8	2020.11.06	原始取得	无
184	奕斯伟硅片	一种取样装置	ZL202020564569.1	2020.11.03	原始取得	无
185	奕斯伟硅片	测量晶圆直径的装置	ZL202022025454.8	2020.10.27	原始取得	无
186	奕斯伟硅片	一种真空吸笔	ZL202020756815.3	2020.09.29	原始取得	无
187	奕斯伟硅片	真空吸盘及倒角机	ZL202020837378.8	2020.09.29	原始取得	无
188	奕斯伟硅片	一种晶棒移取车	ZL201922347758.3	2020.09.25	原始取得	无
189	奕斯伟硅片	一种晶棒称重装置	ZL202020575696.1	2020.09.11	原始取得	无
190	奕斯伟硅片	一种石英坩埚检测装置	ZL201922092213.2	2020.08.18	原始取得	无
191	奕斯伟硅片	一种半导体切割装置	ZL201922103837.X	2020.08.14	原始取得	无

192	奕斯伟硅片	一种双面抛光装置	ZL201922309282.4	2020.08.11	原始取得	无
193	奕斯伟硅片	一种硅片制样装置	ZL201922120360.6	2020.08.07	原始取得	无
194	奕斯伟硅片	一种研磨装置	ZL201922201356.2	2020.07.28	原始取得	无
195	奕斯伟硅片	砂轮修复工具	ZL201922208028.5	2020.07.24	原始取得	无
196	奕斯伟硅片	一种研磨液供给系统	ZL201921910666.5	2020.07.24	原始取得	无
197	奕斯伟硅片	一种承载结构	ZL202021067393.5	2020.07.17	原始取得	无
198	奕斯伟硅片	一种晶圆的定位寻边装置	ZL202021040932.6	2020.07.14	原始取得	无
199	奕斯伟硅片	一种真空管道清洁装置	ZL201922012496.5	2020.07.10	原始取得	无
200	奕斯伟硅片	硅片夹取机械手臂和硅片清洗装置	ZL202020992477.3	2020.07.07	原始取得	无
201	奕斯伟硅片	一种热屏升降装置及晶体生长炉	ZL201921979005.8	2020.07.07	原始取得	无
202	奕斯伟硅片	一种硅源气体的检测装置	ZL201921935246.2	2020.07.07	原始取得	无
203	奕斯伟硅片	一种边缘检测设备	ZL202020883588.0	2020.06.30	原始取得	无
204	奕斯伟硅片	真空吸附装置	ZL201921634520.2	2020.06.02	原始取得	无
205	奕斯伟硅片	一种用于单晶硅片缺陷检测的夹具及加热设备	ZL201920590857.1	2019.10.18	原始取得	无
206	发行人、奕斯伟设备	一种基于 PLC 控制器的液位控制系统	ZL201720707239.1	2018.02.23	继受取得	无
207	发行人、奕斯伟设备	一种专用电信号的放大滤波电路	ZL201620176992.8	2016.08.24	继受取得	无

（三）已获授权的中国台湾及境外专利

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请国家/地区	授权日	取得方式	权利限制
1	发行人、奕斯伟硅片	Method and system for positioning center of V-type notch of wafer, and computer storage medium (中文名称: 晶圆 V 型缺口中心的定位方法、系统及计算机存储介质)	发明专利	US18/568629	美国	2024.12.31	原始取得	无
2	发行人	一种硅片缺陷测量方法及装置	发明专利	TW112150481	中国台湾	2024.12.11	原始取得	无
3	发行人	晶种、拉晶方法及拉晶装置	发明专利	TW111139195	中国台湾	2024.12.11	原始取得	无
4	发行人	硅片双面抛光装置的承载件及硅片双面抛光装置	发明专利	TW112105937	中国台湾	2024.12.11	原始取得	无
5	发行人	一种加热器和单晶炉	发明专利	TW111134426	中国台湾	2024.12.11	原始取得	无
6	发行人	用于线切割硅棒的装置、设备、硅片及硅片制造方法	发明专利	TW112106084	中国台湾	2024.12.11	原始取得	无
7	发行人	抛光液提供装置、抛光设备和抛光方法	发明专利	TW112106621	中国台湾	2024.12.11	原始取得	无
8	发行人、奕斯伟硅片	硅片清洗方法及设备	发明专利	TW111150307	中国台湾	2024.12.11	原始取得	无
9	发行人、奕斯伟硅片	一种晶圆生产物料的调度方法、系统及介质	发明专利	TW112105133	中国台湾	2024.12.11	原始取得	无
10	发行人、奕斯伟硅片	打标位置评估方法、装置及可读存储介质	发明专利	TW112105723	中国台湾	2024.12.11	原始取得	无
11	发行人、奕斯伟硅片	硅料处理方法及其装置	发明专利	TW112104925	中国台湾	2024.12.11	原始取得	无

12	发行人、奕斯伟硅片	用于硅片边缘抛光的设备及方法	发明专利	TW112106089	中国台湾	2024.12.11	原始取得	无
13	发行人、奕斯伟硅片	一种抛光液存储及混合装置	发明专利	TW111136679	中国台湾	2024.12.11	原始取得	无
14	发行人、奕斯伟硅片	硅片装载系统及半导体加工设备	发明专利	TW112105081	中国台湾	2024.12.11	原始取得	无
15	发行人、奕斯伟硅片	晶圆载具管理系统及方法	发明专利	TW111150523	中国台湾	2024.12.11	原始取得	无
16	发行人、奕斯伟硅片	用于硅片的磊晶生长的基座及装置	发明专利	TW112105073	中国台湾	2024.12.11	原始取得	无
17	发行人、奕斯伟硅片	磊晶生长方法及磊晶硅片	发明专利	TW112105933	中国台湾	2024.12.11	原始取得	无
18	发行人、奕斯伟硅片	磊晶生长方法及磊晶晶圆	发明专利	TW112105372	中国台湾	2024.12.11	原始取得	无
19	发行人、奕斯伟硅片	水平检测装置及水平检测方法	发明专利	TW112104094	中国台湾	2024.12.11	原始取得	无
20	发行人、奕斯伟硅片	边缘抛光装置和边缘抛光方法	发明专利	TW112105286	中国台湾	2024.12.11	原始取得	无
21	发行人、奕斯伟硅片	晶体生长装置和确定引晶柄位的方法	发明专利	TW112104922	中国台湾	2024.12.11	原始取得	无
22	发行人、奕斯伟硅片	晶棒制造管理方法和晶棒制造管理系统	发明专利	TW111138168	中国台湾	2024.12.11	原始取得	无
23	发行人、奕斯伟硅片	硅片磊晶生长支撑装置及硅片磊晶生长设备	发明专利	TW112105547	中国台湾	2024.12.11	原始取得	无

24	发行人	硅片双面抛光装置的承载件及硅片双面抛光装置	发明专利	TW112105940	中国台湾	2024.11.21	原始取得	无
25	发行人、奕斯伟硅片	基座支撑结构和外延生长装置	发明专利	TW112104920	中国台湾	2024.11.21	原始取得	无
26	发行人、奕斯伟硅片	硅片磊晶生长基座支撑架及装置	发明专利	TW111148926	中国台湾	2024.11.21	原始取得	无
27	发行人、奕斯伟硅片	磊晶生长方法	发明专利	TW112105544	中国台湾	2024.11.21	原始取得	无
28	发行人、奕斯伟硅片	抛光垫检测方法	发明专利	TW112105083	中国台湾	2024.11.21	原始取得	无
29	发行人、奕斯伟硅片	单晶炉和晶体生长方法	发明专利	TW112104921	中国台湾	2024.11.21	原始取得	无
30	发行人	単結晶シリコンロッドの引張方法及び単結晶シリコンロッド（中文名称：单晶硅棒的拉制方法及单晶硅棒）	发明专利	JP2023569755	日本	2024.11.19	原始取得	无
31	（发行人、奕斯伟硅片）	Polishing device（中文名称：研磨装置）	发明专利	US16/918617	美国	2024.11.12	继受取得	无
32	发行人、奕斯伟硅片	单晶硅棒中缺陷的检测方法及系统	发明专利	TW112106112	中国台湾	2024.11.11	原始取得	无
33	发行人、奕斯伟硅片	一种用于降低双面抛光设备碎片风险的检测装置和方法	发明专利	TW112105718	中国台湾	2024.11.11	原始取得	无
34	发行人	一种用于硅片的背封装置及背封方法	发明专利	TW112104283	中国台湾	2024.10.21	原始取得	无

35	发行人、奕斯伟硅片	Cylinder assembly for improving region of defect-free growth of crystal ingot for single crystal pulling apparatus and single crystal pulling apparatus (中文名称: 用于提高单晶控制装置用晶锭无缺陷生长区域的缸体组件及单晶控制装置)	发明专利	US17/786794	美国	2024.10.15	原始取得	无
36	发行人	单晶硅片处理方法及装置	发明专利	TW112105137	中国台湾	2024.10.11	原始取得	无
37	发行人、奕斯伟硅片	用于清洗硅晶片的装置、设备及方法	发明专利	TW111149647	中国台湾	2024.10.11	原始取得	无
38	发行人	単結晶シリコンインゴットを製造するための結晶引上げ炉、方法及び単結晶シリコンインゴット(中文名称: 一种用于制造单晶硅棒的拉晶炉、方法及单晶硅棒)	发明专利	JP2023515716	日本	2024.09.27	原始取得	无
39	发行人、奕斯伟硅片	単結晶炉のホットゾーン構造、単結晶炉及び結晶棒(中文名称: 一种单晶炉热场结构、单晶炉及晶棒)	发明专利	JP2022542035	日本	2024.09.17	原始取得	无
40	发行人	双面研磨装置和双面研磨方法	发明专利	TW111137959	中国台湾	2024.09.11	原始取得	无
41	发行人	测量晶圆表面损伤层深度的方法和系统	发明专利	TW111141022	中国台湾	2024.09.11	原始取得	无
42	发行人	一种用于监测晶线的生长的监测系统和监测方法	发明专利	TW111149932	中国台湾	2024.09.11	原始取得	无
43	发行人	用于测量晶圆边缘损伤层深度的方法和装置	发明专利	TW112105378	中国台湾	2024.09.11	原始取得	无
44	发行人	抛光头和抛光设备	发明专利	TW112105939	中国台湾	2024.09.11	原始取得	无
45	发行人	一种用于检测硅片的周缘损伤层的深度的系统及方法	发明专利	TW112105982	中国台湾	2024.09.11	原始取得	无
46	发行人	定盘、抛光设备和抛光方法	发明专利	TW112105936	中国台湾	2024.09.11	原始取得	无
47	发行人、奕斯伟硅片	一种双面研磨中下定盘沟槽的清洁系统以及方法	发明专利	TW111126432	中国台湾	2024.09.11	原始取得	无

48	发行人、奕斯伟硅片	槽式清洗装置	发明专利	TW111134444	中国台湾	2024.09.11	原始取得	无
49	发行人、奕斯伟硅片	半导体边缘研磨设备和半导体的边缘研磨方法	发明专利	TW111138745	中国台湾	2024.09.11	原始取得	无
50	发行人、奕斯伟硅片	一种监测晶圆位置的装置以及最终抛光设备	发明专利	TW112105135	中国台湾	2024.09.11	原始取得	无
51	发行人、奕斯伟硅片	清洗系统及方法	发明专利	TW112105538	中国台湾	2024.09.11	原始取得	无
52	发行人、奕斯伟硅片	半导体生产设备和拉晶炉的冷却控制方法及装置	发明专利	TW112105730	中国台湾	2024.09.11	原始取得	无
53	发行人、奕斯伟硅片	抛光装置及抛光垫去除方法	发明专利	TW112105935	中国台湾	2024.09.11	原始取得	无
54	发行人、奕斯伟硅片	一种用于研磨硅片的设备和方法	发明专利	TW112106086	中国台湾	2024.09.11	原始取得	无
55	发行人、奕斯伟硅片	실리콘재 처리 장치, 실리콘 잉곳 생산 기기 및 실리콘재 처리 방법 (中文名称: 一种硅料处理装置、硅棒生产设备和硅料处理方法)	发明专利	KR1020237042508	韩国	2024.09.10	原始取得	无
56	发行人	질소가 도핑된 단결정 실리콘 제조 기기 및 방법(中文名称: 氮掺杂单晶硅的制造装置及方法)	发明专利	KR1020237042507	韩国	2024.08.26	原始取得	无
57	发行人、奕斯伟硅片	一种单晶炉及二次加料方法	发明专利	TW112105971	中国台湾	2024.08.21	原始取得	无
58	发行人、奕斯伟硅片	用于修复切割线的装置、线切割设备及方法	发明专利	TW112106078	中国台湾	2024.08.21	原始取得	无
59	发行人	对多线切割机之转轴的线槽进行清洗的装置及多线切割机	发明专利	TW112100708	中国台湾	2024.08.11	原始取得	无

60	发行人	坩埚传动轴、坩埚传动元件和坩埚传动元件的应用方法	发明专利	TW112101388	中国台湾	2024.08.11	原始取得	无
61	发行人	坩埚装置、单晶炉装置及其工作方法	发明专利	TW112105369	中国台湾	2024.08.11	原始取得	无
62	发行人	用于改善硅片表面平坦度的方法及系统	发明专利	TW112105375	中国台湾	2024.08.11	原始取得	无
63	发行人	单晶炉装置	发明专利	TW112105791	中国台湾	2024.08.11	原始取得	无
64	发行人、奕斯伟硅片	硅片加工方法及硅片	发明专利	TW111137848	中国台湾	2024.08.11	原始取得	无
65	发行人、奕斯伟硅片	跑货控制方法及装置	发明专利	TW111150140	中国台湾	2024.08.11	原始取得	无
66	发行人、奕斯伟硅片	清洗硅片的周缘的装置、方法及清洗硅片的设备	发明专利	TW112101969	中国台湾	2024.08.11	原始取得	无
67	发行人、奕斯伟硅片	二次加料系统和二次加料方法	发明专利	TW112105314	中国台湾	2024.08.11	原始取得	无
68	发行人、奕斯伟硅片	晶圆的磊晶生长方法及设备	发明专利	TW112105379	中国台湾	2024.08.11	原始取得	无
69	发行人、奕斯伟硅片	磊晶生长装置及设备	发明专利	TW112105247	中国台湾	2024.08.11	原始取得	无
70	发行人、奕斯伟硅片	晶棒分离装置、系统及方法	发明专利	TW112105249	中国台湾	2024.08.11	原始取得	无
71	发行人、奕斯伟硅片	颗粒物去除装置、磊晶设备及其工作方法	发明专利	TW112105370	中国台湾	2024.08.11	原始取得	无
72	发行人、奕斯伟硅片	退火炉温度计校准方法及装置	发明专利	TW112105720	中国台湾	2024.08.11	原始取得	无

73	发行人	线切割设备和线切割方法	发明专利	TW112104092	中国台湾	2024.08.01	原始取得	无
74	发行人	用于对硅片进行背封的方法和设备	发明专利	TW112105139	中国台湾	2024.08.01	原始取得	无
75	发行人、奕斯伟硅片	单晶炉副室清洁装置及方法	发明专利	TW112104919	中国台湾	2024.08.01	原始取得	无
76	发行人	窒素ドーピングウエハの反り度を改善する加工方法及びシステム（中文名称：改善氮掺杂晶圆翘曲程度的加工方法及系统）	发明专利	JP2023576119	日本	2024.07.29	原始取得	无
77	发行人、奕斯伟硅片	シリコン材料処理装置、シリコン棒生産設備及びシリコン材料処理方法（中文名称：硅材料加工设备、硅棒生产设备以及硅材料加工方法）	发明专利	JP2023577406	日本	2024.07.29	原始取得	无
78	发行人	用于单晶炉的加料装置	发明专利	TW111140810	中国台湾	2024.07.21	原始取得	无
79	发行人	用于背封晶圆的设备和方法	发明专利	TW112104287	中国台湾	2024.07.21	原始取得	无
80	发行人	用于线切割硅棒的装置、设备、硅片及其制造方法	发明专利	TW112105722	中国台湾	2024.07.21	原始取得	无
81	发行人、奕斯伟硅片	清洁装置、设备及方法	发明专利	TW112105725	中国台湾	2024.07.21	原始取得	无
82	发行人、奕斯伟硅片	硅晶圆处理方法及装置	发明专利	TW112105540	中国台湾	2024.07.21	原始取得	无
83	发行人、奕斯伟硅片	抛光装置及其工作方法	发明专利	TW112105728	中国台湾	2024.07.21	原始取得	无
84	发行人、奕斯伟硅片	用于线切割硅棒的方法、设备及硅片	发明专利	TW112105974	中国台湾	2024.07.21	原始取得	无
85	发行人	用于修整研磨轮的装置和方法	发明专利	TW111150365	中国台湾	2024.07.11	原始取得	无

86	发行人	用于对硅片进行背封的设备	发明专利	TW112100964	中国台湾	2024.07.11	原始取得	无
87	发行人、奕斯伟硅片	用于硅片的干燥系统	发明专利	TW112105938	中国台湾	2024.07.11	原始取得	无
88	发行人	单晶转运测量方法及系统	发明专利	TW111150620	中国台湾	2024.07.01	原始取得	无
89	发行人、奕斯伟硅片	抛光设备和抛光方法	发明专利	TW111131113	中国台湾	2024.07.01	原始取得	无
90	发行人、奕斯伟硅片	清洗装置	发明专利	TW111150621	中国台湾	2024.07.01	原始取得	无
91	发行人、奕斯伟硅片	晶圆用的检测系统	发明专利	TW112103801	中国台湾	2024.07.01	原始取得	无
92	发行人、奕斯伟硅片	装载晶圆用的载具位置的检测方法、装置及介质	发明专利	TW112105543	中国台湾	2024.07.01	原始取得	无
93	发行人、奕斯伟硅片	硅片钝化系统及硅片钝化系统的工作方法	发明专利	TW112105721	中国台湾	2024.07.01	原始取得	无
94	发行人、奕斯伟硅片	检测晶圆缺口位置的装置、方法及电脑存储介质	发明专利	TW112105724	中国台湾	2024.07.01	原始取得	无
95	发行人、奕斯伟硅片	一种用于硅片边缘的清洗方法和装置	发明专利	TW112106083	中国台湾	2024.07.01	原始取得	无
96	发行人	水冷套和单晶炉	发明专利	TW111134440	中国台湾	2024.06.21	原始取得	无
97	发行人	用于检测硅片表面损伤层深度的方法和系统	发明专利	TW112106090	中国台湾	2024.06.21	原始取得	无
98	发行人、奕斯伟硅片	一种用于外延反应炉的灯座及辅助拆装工具	发明专利	TW111140804	中国台湾	2024.06.21	原始取得	无

99	发行人、奕斯伟硅片	一种用于研磨硅片的研磨盘及研磨设备	发明专利	TW112105377	中国台湾	2024.06.21	原始取得	无
100	发行人、奕斯伟硅片	磊晶晶圆生产设备、磊晶晶圆生产方法和装置	发明专利	TW112105932	中国台湾	2024.06.21	原始取得	无
101	发行人、奕斯伟硅片	一种晶圆位置的检测方法、装置及介质	发明专利	TW112106079	中国台湾	2024.06.21	原始取得	无
102	发行人	直拉法拉制单晶硅棒的方法、单晶硅棒、硅片及外延硅片	发明专利	TW111140349	中国台湾	2024.06.11	原始取得	无
103	发行人	硅片处理方法	发明专利	TW112105136	中国台湾	2024.06.11	原始取得	无
104	发行人	砂浆供给系统和线切割设备	发明专利	TW112103799	中国台湾	2024.06.01	原始取得	无
105	发行人	用于改善硅片表面平坦度的方法及系统	发明专利	TW112105373	中国台湾	2024.06.01	原始取得	无
106	发行人、奕斯伟硅片	水平度调整装置、抛光设备及水平度调整方法	发明专利	TW111129668	中国台湾	2024.06.01	原始取得	无
107	发行人、奕斯伟硅片	借助少数载子寿命表征矽片捕获金属杂质效率的装置和方法	发明专利	TW111131482	中国台湾	2024.06.01	原始取得	无
108	发行人、奕斯伟硅片	用于监测半导体制程块体金属的方法	发明专利	TW112101930	中国台湾	2024.06.01	原始取得	无
109	发行人、奕斯伟硅片	抛光系统	发明专利	TW112104923	中国台湾	2024.06.01	原始取得	无
110	发行人、奕斯伟硅片	磊晶生长设备重启方法	发明专利	TW112105368	中国台湾	2024.06.01	原始取得	无
111	发行人	多线切割方法及装置	发明专利	TW111138789	中国台湾	2024.05.21	原始取得	无
112	发行人	石英坩埚、坩埚元件和单晶炉	发明专利	TW111140575	中国台湾	2024.05.21	原始取得	无

113	发行人、奕斯伟硅片	一种用于校准外延炉的温度计的方法	发明专利	TW111138569	中国台湾	2024.05.21	原始取得	无
114	发行人、奕斯伟硅片	掺杂剂及其制备方法、掺杂的矽片及其制造方法	发明专利	TW111141016	中国台湾	2024.05.21	原始取得	无
115	发行人、奕斯伟硅片	硅晶片夹持装置及硅晶片清洗设备	发明专利	TW111150261	中国台湾	2024.05.21	原始取得	无
116	发行人	双面研磨装置和双面研磨方法	发明专利	TW111136471	中国台湾	2024.05.11	原始取得	无
117	发行人	用于副炉室的清洁装置	发明专利	TW111141012	中国台湾	2024.05.11	原始取得	无
118	发行人、奕斯伟硅片	用于获得籽晶缆相对于线鼓的偏斜量的装置和提拉设备	发明专利	TW111130151	中国台湾	2024.05.11	原始取得	无
119	发行人、奕斯伟硅片	一种用于硅片表面金属离子的采集装置	发明专利	TW111150612	中国台湾	2024.05.11	原始取得	无
120	发行人、奕斯伟硅片	晶圆隐裂检测装置及晶圆隐裂检测方法	发明专利	TW112105934	中国台湾	2024.05.11	原始取得	无
121	发行人	一种用于制造单晶硅棒的拉晶炉、方法及单晶硅棒	发明专利	TW111129968	中国台湾	2024.05.01	原始取得	无
122	发行人、奕斯伟硅片	用于调准硅片的清洗设备中的氮气吹送管路的装置及方法	发明专利	TW111126617	中国台湾	2024.05.01	原始取得	无
123	发行人	用于晶圆表面微损伤的检测方法和检测系统	发明专利	TW111140587	中国台湾	2024.04.21	原始取得	无
124	发行人	用于单晶炉的坩埚支承组件和单晶炉	发明专利	TW111140582	中国台湾	2024.04.21	原始取得	无
125	发行人	定盘、抛光设备和抛光方法	发明专利	TW112105941	中国台湾	2024.04.21	原始取得	无
126	发行人、奕斯伟硅片	一种单晶硅棒的控制方法	发明专利	TW111125082	中国台湾	2024.04.21	原始取得	无

127	发行人、奕斯伟硅片	一种硅片金属含量测试方法和设备	发明专利	TW111137828	中国台湾	2024.04.21	原始取得	无
128	发行人、奕斯伟硅片	一种磊晶生长方法及磊晶晶圆	发明专利	TW111140605	中国台湾	2024.04.21	原始取得	无
129	发行人、奕斯伟硅片	研磨清洗设备	发明专利	TW112104914	中国台湾	2024.04.21	原始取得	无
130	发行人、奕斯伟硅片	用于晶圆表面金属离子检测样品的制备装置及方法	发明专利	TW112105972	中国台湾	2024.04.21	原始取得	无
131	发行人	硅片双面抛光用的载具、双面抛光装置及硅片	发明专利	TW112105931	中国台湾	2024.04.11	原始取得	无
132	发行人、奕斯伟硅片	硅片磊晶步骤中引导气体流通的元件及磊晶生长装置	发明专利	TW111131125	中国台湾	2024.04.11	原始取得	无
133	发行人、奕斯伟硅片	用于常压外延反应腔室的清洁方法及外延硅片	发明专利	TW111131069	中国台湾	2024.04.11	原始取得	无
134	发行人、奕斯伟硅片	装卸装置、方法及硅片双面抛光设备	发明专利	TW112105930	中国台湾	2024.04.11	原始取得	无
135	发行人、奕斯伟硅片	基座支撑结构和外延生长装置	发明专利	TW111129457	中国台湾	2024.04.01	原始取得	无
136	发行人、奕斯伟硅片	二流体喷嘴及清洗装置	发明专利	TW111129698	中国台湾	2024.04.01	原始取得	无
137	发行人、奕斯伟硅片	一种用于硅片清洗的承载装置、设备及硅片	发明专利	TW111133490	中国台湾	2024.04.01	原始取得	无
138	发行人、奕斯伟硅片	一种用于对硅片进行抛光的抛光垫和抛光设备	发明专利	TW111136671	中国台湾	2024.04.01	原始取得	无

139	发行人	질소 도핑된 웨이퍼의 휘어짐을 개선시키는 가공 방법 및 시스템（中文名称：改善氮掺杂晶圆翘曲的加工方法及系统）	发明专利	KR1020237042512	韩国	2024.03.29	原始取得	无
140	发行人	硅片双面研磨装置的静压板及硅片双面研磨装置	发明专利	TW111137844	中国台湾	2024.03.21	原始取得	无
141	发行人、奕斯伟硅片	机械手及机械手夹取状态检测方法	发明专利	TW111150619	中国台湾	2024.03.21	原始取得	无
142	发行人、奕斯伟硅片	硅片检测工具及硅片检测方法	发明专利	TW112105367	中国台湾	2024.03.21	原始取得	无
143	发行人、奕斯伟硅片	用于清洗抛光设备的装置及抛光设备	发明专利	TW112105732	中国台湾	2024.03.21	原始取得	无
144	发行人、奕斯伟硅片	节流阀	发明专利	TW112106113	中国台湾	2024.03.21	原始取得	无
145	发行人、奕斯伟硅片	硅片直径的测量方法、装置及电脑存储介质	发明专利	TW112106088	中国台湾	2024.03.21	原始取得	无
146	发行人、奕斯伟硅片	Assembly sleeve of single crystal pulling apparatus, and single crystal pulling apparatus（中文名称：单晶拉制装置组装套筒及单晶拉制装置）	发明专利	US17/627717	美国	2024.03.19	原始取得	无
147	发行人	一种用于拉晶炉的热场控制装置及拉晶炉	发明专利	TW111137852	中国台湾	2024.03.11	原始取得	无
148	发行人	一种加热器及其工作方法	发明专利	TW111137964	中国台湾	2024.03.11	原始取得	无
149	发行人	研磨装置、研磨方法及硅片	发明专利	TW111140603	中国台湾	2024.03.11	原始取得	无
150	发行人	用于导引切割线的装置、线切割设备及硅片	发明专利	TW111150616	中国台湾	2024.03.11	原始取得	无
151	发行人	线切割单元、设备、硅片及其制造方法	发明专利	TW111150613	中国台湾	2024.03.11	原始取得	无

152	发行人、奕斯伟硅片	一种单晶硅棒的拉制方法及单晶硅棒	发明专利	TW111125083	中国台湾	2024.03.11	原始取得	无
153	发行人、奕斯伟硅片	一种用于晶圆磊晶生长的晶圆支撑杆装置、设备及方法	发明专利	TW111131121	中国台湾	2024.03.11	原始取得	无
154	发行人、奕斯伟硅片	用于清洁石英晶舟的方法及装置	发明专利	TW111138057	中国台湾	2024.03.11	原始取得	无
155	发行人、奕斯伟硅片	热场元件、单晶炉、漏液检测装置及其方法	发明专利	TW112105539	中国台湾	2024.03.11	原始取得	无
156	发行人、奕斯伟硅片	测量硅片径向电阻均匀性的装置及方法	发明专利	TW112106087	中国台湾	2024.03.11	原始取得	无
157	发行人	研磨轮、研磨设备及硅片	发明专利	TW111150615	中国台湾	2024.03.1	原始取得	无
158	发行人、奕斯伟硅片	一种晶圆上下料系统及上下料方法	发明专利	TW111131099	中国台湾	2024.03.01	原始取得	无
159	发行人、奕斯伟硅片	一种改善外延片平坦度的硅片基板传送方法	发明专利	TW111136469	中国台湾	2024.03.01	原始取得	无
160	发行人、奕斯伟硅片	晶圆片盒检测方法及装置、片盒清洗机	发明专利	TW111139207	中国台湾	2024.03.01	原始取得	无
161	发行人、奕斯伟硅片	単結晶炉の組立スリーブ及び単結晶炉（中文名称：单晶炉组件套管及单晶炉）	发明专利	JP2022542058	日本	2024.02.22	原始取得	无
162	发行人	单面减薄方法和单面减薄设备	发明专利	TW111138775	中国台湾	2024.02.11	原始取得	无
163	发行人	研磨装置、研磨方法及硅片	发明专利	TW111140604	中国台湾	2024.02.11	原始取得	无
164	发行人	一种线切割机的晶棒固定装置	发明专利	TW111140808	中国台湾	2024.02.11	原始取得	无

165	发行人	研磨轮、研磨装置、研磨方法及硅片	发明专利	TW112104089	中国台湾	2024.02.11	原始取得	无
166	发行人、奕斯伟硅片	一种用于生产硅片的系统、方法及单晶硅棒	发明专利	TW111131262	中国台湾	2024.02.11	原始取得	无
167	发行人、奕斯伟硅片	一种用于单晶生长的热场调节装置和方法	发明专利	TW111131490	中国台湾	2024.02.11	原始取得	无
168	发行人、奕斯伟硅片	晶圆清洗方法及设备	发明专利	TW111150139	中国台湾	2024.02.11	原始取得	无
169	发行人、奕斯伟硅片	单結晶炉の組立スリーブ及び単結晶炉（中文名称：单晶炉组装套筒及单晶炉）	发明专利	JP2022538788	日本	2024.02.07	原始取得	无
170	发行人、奕斯伟硅片	一种研磨装置的清洗方法及系统	发明专利	TW111126043	中国台湾	2024.01.21	原始取得	无
171	发行人	一种用于定位待被线切割的晶棒的定位装置和线切割机	发明专利	TW111138171	中国台湾	2024.01.11	原始取得	无
172	发行人	用于硅片脱胶的装置及设备	发明专利	TW112106091	中国台湾	2024.01.11	原始取得	无
173	发行人、奕斯伟硅片	外延反应腔室的恢复方法、外延生长装置及外延晶圆	发明专利	TW111130894	中国台湾	2024.01.11	原始取得	无
174	发行人、奕斯伟硅片	一种抛光垫刷洗装置及操作方法、最终抛光设备	发明专利	TW111131273	中国台湾	2024.01.11	原始取得	无
175	发行人、奕斯伟硅片	抛光头和抛光设备	发明专利	TW111131443	中国台湾	2024.01.11	原始取得	无
176	发行人、奕斯伟硅片	存储装置	发明专利	TW112104924	中国台湾	2024.01.11	原始取得	无
177	发行人、奕斯伟硅片	物料的处理方法和处理系统	发明专利	TW112105942	中国台湾	2024.01.11	原始取得	无

178	发行人、奕斯伟硅片	一种晶圆分选设备和晶圆分选方法	发明专利	TW111137829	中国台湾	2024.01.01	原始取得	无
179	发行人	一种用于分选硅片的系统	发明专利	TW111129814	中国台湾	2023.12.21	原始取得	无
180	发行人	氮掺杂剂加料装置、方法及氮掺杂单晶硅棒的制造系统	发明专利	TW111132605	中国台湾	2023.12.21	原始取得	无
181	发行人	水冷套装置和单晶炉	发明专利	TW111134427	中国台湾	2023.12.21	原始取得	无
182	发行人、奕斯伟硅片	一种硅片中转装置和硅片中转方法	发明专利	TW111129244	中国台湾	2023.12.21	原始取得	无
183	发行人、奕斯伟硅片	一种外延设备冷却系统和方法	发明专利	TW111137955	中国台湾	2023.12.21	原始取得	无
184	发行人、奕斯伟硅片	단결정 노의 컴바인더 콘 튜브(Combined Cone Tube) 및 단결정 노 (中文名称: 组合式单晶炉锥管及单晶炉)	发明专利	KR1020217037495	韩国	2023.12.13	原始取得	无
185	发行人、奕斯伟硅片	단결정 폴러의 컴바인 콘 튜브 및 단결정 폴러(中文名称: 组合单晶拉晶机锥管与单晶拉晶机)	发明专利	KR1020217037381	韩国	2023.12.13	原始取得	无
186	发行人、奕斯伟硅片	Polishing pad, method for preparing the same, and chemical and mechanical polishing equipment (中文名称: 抛光垫及其制备方法以及化学和机械抛光设备)	发明专利	US16/918041	美国	2023.12.12	继受取得	无
187	发行人	用于检测抛光液中的金属杂质的方法	发明专利	TW111126974	中国台湾	2023.12.11	原始取得	无
188	发行人	氮掺杂 P 型单晶硅制造方法	发明专利	TW111132604	中国台湾	2023.12.11	原始取得	无
189	发行人	监控研磨装置的加工状态的系统、方法及双面研磨装置	发明专利	TW111141168	中国台湾	2023.12.11	原始取得	无
190	发行人、奕斯伟硅片	用于补液的补液装置及系统	发明专利	TW111130856	中国台湾	2023.12.11	原始取得	无

191	发行人、奕斯伟硅片	一种用于硅片边缘刻蚀的装置和方法	发明专利	TW111138785	中国台湾	2023.12.11	原始取得	无
192	发行人	一种用于承载和清洁硅片的装置	发明专利	TW111137850	中国台湾	2023.12.01	原始取得	无
193	发行人、奕斯伟硅片	修整盘及其制备方法、化学机械抛光设备	发明专利	TW111129694	中国台湾	2023.12.01	原始取得	无
194	发行人、奕斯伟硅片	对机械手相对于承载空间取放硅片进行示教的系统及方法	发明专利	TW111139031	中国台湾	2023.12.01	原始取得	无
195	发行人、奕斯伟硅片	片盒内部离子采集装置及方法	发明专利	TW112105074	中国台湾	2023.12.01	原始取得	无
196	发行人	一种晶圆清洗干燥装置及晶圆清洗干燥方法	发明专利	TW111129092	中国台湾	2023.11.21	原始取得	无
197	发行人、奕斯伟硅片	硅片边缘粗糙度检测治具及检测方法	发明专利	TW111128933	中国台湾	2023.11.21	原始取得	无
198	发行人、奕斯伟硅片	双面研磨装置和双面研磨方法	发明专利	TW111129696	中国台湾	2023.11.21	原始取得	无
199	发行人、奕斯伟硅片	对硅片位置进行调准的系统、方法及外延设备	发明专利	TW111131068	中国台湾	2023.11.21	原始取得	无
200	发行人、奕斯伟硅片	一种用于切割硅棒的装置	发明专利	TW111131267	中国台湾	2023.11.21	原始取得	无
201	发行人、奕斯伟硅片	晶圆清洗装置和晶圆清洗方法	发明专利	TW111139196	中国台湾	2023.11.21	原始取得	无
202	发行人、奕斯伟硅片	晶圆评估方法、装置及可读存储介质	发明专利	TW112105000	中国台湾	2023.11.21	原始取得	无

203	发行人、奕斯伟硅片	磊晶硅片检测方法及装置	发明专利	TW112105537	中国台湾	2023.11.21	原始取得	无
204	发行人、奕斯伟硅片	信号发送方法及装置	发明专利	TW112105792	中国台湾	2023.11.21	原始取得	无
205	发行人、奕斯伟硅片	一种检测晶圆边缘形貌的方法及系统	发明专利	TW112106111	中国台湾	2023.11.21	原始取得	无
206	发行人	一种氮掺杂单晶硅棒的制备方法及氮掺杂单晶硅棒	发明专利	TW111129967	中国台湾	2023.11.01	原始取得	无
207	发行人	改善氮掺杂晶圆翘曲度的加工方法和系统	发明专利	TW111130892	中国台湾	2023.11.01	原始取得	无
208	发行人	硅片定位方法及装置	发明专利	TW111139034	中国台湾	2023.10.21	原始取得	无
209	发行人	氮掺杂硅熔体获取设备、方法及氮掺杂单晶硅制造系统	发明专利	TW111129098	中国台湾	2023.10.11	原始取得	无
210	发行人、奕斯伟硅片	单晶炉	发明专利	TW111129665	中国台湾	2023.10.11	原始取得	无
211	发行人、奕斯伟硅片	获取直拉法拉制硅棒的即时长度的装置、方法及拉晶炉	发明专利	TW111130896	中国台湾	2023.10.11	原始取得	无
212	发行人、奕斯伟硅片	一种用于检测硅片的缺陷的方法	发明专利	TW111129308	中国台湾	2023.10.01	原始取得	无
213	发行人、奕斯伟硅片	用于调节晶圆位置的装置和方法	发明专利	TW111140347	中国台湾	2023.10.01	原始取得	无
214	发行人	一种晶圆表面损伤深度测量方法及系统	发明专利	TW111130727	中国台湾	2023.09.21	原始取得	无
215	发行人、奕斯伟硅片	一种研磨载台、研磨装置、研磨方法及硅片	发明专利	TW111134254	中国台湾	2023.09.21	原始取得	无

216	发行人、奕斯伟硅片	用于测量晶棒直径的装置和方法	发明专利	TW111136711	中国台湾	2023.09.21	原始取得	无
217	发行人	精准调整直径自动控制（A D C）相机的方法、装置、设备及电脑存储介质	发明专利	TW111129101	中国台湾	2023.09.11	原始取得	无
218	发行人	多线切割装置和多线切割方法	发明专利	TW111129245	中国台湾	2023.09.11	原始取得	无
219	发行人	一种用于生产单晶硅棒的石英坩埚、坩埚元件及拉晶炉	发明专利	TW111137961	中国台湾	2023.09.11	原始取得	无
220	发行人	对转轴的线槽中的污染颗粒进行检查的系统和方法	发明专利	TW112101959	中国台湾	2023.09.11	原始取得	无
221	发行人	测量晶圆表面损伤层深度的方法及系统	发明专利	TW112104091	中国台湾	2023.09.11	原始取得	无
222	发行人、奕斯伟硅片	晶体生长直径的控制方法、装置、设备及电脑存储介质	发明专利	TW111128931	中国台湾	2023.09.11	原始取得	无
223	发行人、奕斯伟硅片	一种硅料处理装置、硅棒生产设备和硅料处理方法	发明专利	TW111129280	中国台湾	2023.09.11	原始取得	无
224	发行人、奕斯伟硅片	检测单晶炉同轴度的方法、装置、设备及电脑存储介质	发明专利	TW111130150	中国台湾	2023.09.11	原始取得	无
225	发行人、奕斯伟硅片	一种用于检测硅片的系统	发明专利	TW111136473	中国台湾	2023.09.11	原始取得	无
226	发行人、奕斯伟硅片	硅晶圆边缘金属离子的采集装置及方法	发明专利	TW111140800	中国台湾	2023.09.11	原始取得	无
227	发行人	石英坩埚及拉晶炉	发明专利	TW111130552	中国台湾	2023.08.21	原始取得	无
228	发行人、奕斯伟硅片	研磨装置和研磨方法	发明专利	TW111138744	中国台湾	2023.08.21	原始取得	无
229	发行人	一种单晶硅棒的控制方法及单晶硅棒	发明专利	TW111130730	中国台湾	2023.08.11	原始取得	无

230	发行人	加热器元件和单晶炉	发明专利	TW111139209	中国台湾	2023.08.11	原始取得	无
231	发行人	坩埚和单晶炉	发明专利	TW111139210	中国台湾	2023.08.11	原始取得	无
232	发行人	单晶体直径控制方法及装置、单晶硅拉晶炉	发明专利	TW111139420	中国台湾	2023.08.11	原始取得	无
233	发行人	单晶硅拉晶控制方法及装置、单晶硅拉晶炉	发明专利	TW111139421	中国台湾	2023.08.11	原始取得	无
234	发行人	测量装置和测量方法	发明专利	TW111139986	中国台湾	2023.08.11	原始取得	无
235	发行人	拉晶炉	发明专利	TW111139988	中国台湾	2023.08.11	原始取得	无
236	发行人、奕斯伟硅片	一种用于硅片的外延生长的基座支撑架、装置及方法	发明专利	TW111128930	中国台湾	2023.08.11	原始取得	无
237	发行人、奕斯伟硅片	一种硅片检测方法	发明专利	TW111129270	中国台湾	2023.08.11	原始取得	无
238	发行人、奕斯伟硅片	一种用于对硅片进行抛光的抛光垫和抛光设备	发明专利	TW111133496	中国台湾	2023.08.11	原始取得	无
239	发行人	坩埚元件、拉晶炉及拉制单晶硅棒的方法	发明专利	TW111133820	中国台湾	2023.07.11	原始取得	无
240	发行人、奕斯伟硅片	一种单晶炉热场结构、单晶炉及晶棒	发明专利	TW110118757	中国台湾	2023.07.11	继受取得	无
241	发行人	水冷套装置和单晶炉	发明专利	TW111138788	中国台湾	2023.06.11	原始取得	无
242	发行人、奕斯伟硅片	一种观察窗及单晶炉	发明专利	TW111129667	中国台湾	2023.06.11	原始取得	无
243	发行人、奕斯伟硅片	单晶炉热场加热器及单晶炉	发明专利	TW110135943	中国台湾	2023.05.21	原始取得	无

244	发行人、奕斯伟硅片	硅片方位调准装置及硅片缺陷检测设备	发明专利	TW111130874	中国台湾	2023.05.21	原始取得	无
245	发行人、奕斯伟硅片	为切割硅棒的多条切割线供应沙浆的装置及硅棒切割设备	发明专利	TW111127758	中国台湾	2023.05.11	原始取得	无
246	发行人、奕斯伟硅片	一种用于将原材料加工成为成品的装置	发明专利	TW111125468	中国台湾	2023.05.01	原始取得	无
247	发行人、奕斯伟硅片	一种晶圆研磨设备	发明专利	TW111125441	中国台湾	2023.05.01	原始取得	无
248	发行人、奕斯伟硅片	一种改善磊晶晶圆平坦度的方法以及磊晶晶圆	发明专利	TW111130873	中国台湾	2023.05.01	原始取得	无
249	发行人	一种用于背封硅片的方法和设备	发明专利	TW111133334	中国台湾	2023.04.21	原始取得	无
250	发行人、奕斯伟硅片	晶棒线切割装置和晶棒线切割方法	发明专利	TW111125632	中国台湾	2023.04.21	原始取得	无
251	发行人、奕斯伟硅片	Method for regulating inert gas flow, method for preparing monocrystalline silicon, and monocrystalline silicon（中文名称：惰性气体流量的调节方法、单晶硅的制备方法及单晶硅）	发明专利	US16/912885	美国	2023.04.18	继受取得	无
252	发行人	用于检测晶圆表面金属的方法	发明专利	TW111129313	中国台湾	2023.04.11	原始取得	无
253	发行人、奕斯伟硅片	一种手持式晶圆吸附装置	发明专利	TW111133326	中国台湾	2023.04.11	原始取得	无
254	发行人、奕斯伟硅片	晶圆 V 型缺口中心的定位方法、系统及电脑存储介质	发明专利	TW111133325	中国台湾	2023.04.11	原始取得	无
255	发行人、奕斯伟硅片	晶体缺陷的检测方法与检测装置	发明专利	TW111138575	中国台湾	2023.04.11	原始取得	无

256	发行人	一种用于制造掺氮单晶硅的设备与方法	发明专利	TW111133852	中国台湾	2023.01.01	原始取得	无
257	发行人、奕斯伟硅片	清洗装置和清洗方法	发明专利	TW111127756	中国台湾	2023.01.01	原始取得	无
258	发行人、奕斯伟硅片	晶圆预处理装置及晶圆缺陷检测方法	发明专利	TW111129243	中国台湾	2023.01.01	原始取得	无
259	发行人、奕斯伟硅片	单晶炉的组合套筒及单晶炉	发明专利	TW110127622	中国台湾	2022.08.01	原始取得	无
260	发行人、奕斯伟硅片	单晶炉的组合套筒及单晶炉	发明专利	TW110123261	中国台湾	2021.12.11	继受取得	无
261	发行人、奕斯伟设备	Device and method for detecting liquid level of molten silicon using laser reflected from curved mirror（中文名称：利用曲面镜反射激光检测熔融硅液位的装置及方法）	发明专利	US12/951578	美国	2014.07.22	继受取得	无
262	发行人、奕斯伟设备	Method of three-dimensional optimization design for asymmetric cusp magnetic field in MCZ single crystal furnace（中文名称：MCZ 单晶炉不对称尖端磁场三维优化设计方法）	发明专利	US12/951481	美国	2013.06.18	继受取得	无

附件六：发行人及其子公司拥有的软件著作权清单

序号	著作权人	著作权名称	登记号	开发完成日期	首次发表日期	取得方式	他项权利
1	奕斯伟硅片	信息管理系统 V1.0	2019SR1454738	2018.11.20	2019.04.18	原始取得	无
2	奕斯伟硅片	生产执行系统 V1.0	2019SR1449720	2019.09.30	2019.09.30	原始取得	无
3	奕斯伟硅片	请款管理程序系统 V1.0	2019SR1454644	2019.12.03	2019.12.03	原始取得	无
4	奕斯伟硅片	发票校验与开票通知打印审核程序系统 V1.0	2019SR1456455	2019.12.13	2019.12.13	原始取得	无

附件七：发行人及其子公司拥有的业务许可或资质清单

（一）进出口经营权

序号	公司	资质名称	海关备案编码	备案平台	备案日期	报关有效期
1	奕斯伟材料	进出口货物收发货人备案	6101360A0R	中国海关企业进出口信用信息公示平台	2021.03.23	长期有效
2	奕斯伟硅片	进出口货物收发货人备案	61013609E2	中国海关企业进出口信用信息公示平台	2018.06.05	长期有效
3	欣芯材料	进出口货物收发货人备案	6101360AG7	中国海关企业进出口信用信息公示平台	2022.10.31	长期有效

（二）固定污染源排污登记回执及排污许可

序号	公司	资质名称	证书编号	发证机构/登记平台	发证时间	到期日期
1	奕斯伟硅片	固定污染源排污登记回执	91610131MA6UQQ3U2A001Y	全国排污许可证管理信息平台	2021.08.23	2025.01.14
2	奕斯伟硅片	排污许可证	91610131MA6UQQ3U2A001Y	西安市生态环境局	2023.04.13	2028.04.12
3	欣芯材料	固定污染源排污登记回执	91610131MAB124LG4N001W	全国排污许可证管理信息平台	2023.7.12	2028.7.11

（三）第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明

序号	公司	资质名称	证书编号	发证机构	发证时间	到期日期
1	奕斯伟硅片、欣芯材料	第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明	-	西安市公安局高新分局	-	-

注：发行人在研发、生产过程中需要用到第二类、第三类易制毒化学品盐酸和硫酸，发行人在购买前述易制毒化学品之前均已取得主管公安部门出具的《第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明》，相关证明注明购买物品、数量、有效次数及有效期限。

（四）放射性同位素与射线装置豁免备案表

序号	公司	资质名称	证书编号	发证机构	发证时间	到期日期
1	奕斯伟硅片	放射性同位素与射线装置豁免备案表	陕辐豁免[2020]5号	陕西省核安全局	2020.06.01	-
2	奕斯伟硅片	放射性同位素与射线装置豁免备案表	陕辐豁免[2021]3021号	陕西省生态环境厅	2021.11.16	-
3	奕斯伟硅片	放射性同位素与射线装置豁免备案表	陕辐豁免[2022]9号	陕西省核安全局	2022.09.08	-
4	奕斯伟硅片	放射性同位素与射线装置豁免备案表	陕辐豁免[2023]A030号	西安市生态环境局	2023.12.15	-
5	欣芯材料	放射性同位素与射线装置豁免备案表	陕辐豁免[2024]A011号	西安市生态环境局	2024.04.09	-

（五）企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

序号	公司	资质名称	证书编号	发证机构	发证时间	到期日期
1	奕斯伟硅片	生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表	QT61010320191127007	西安高新技术产业开发区应急管理局	2019.11.27	-

2	奕斯伟硅片	企业事业单位突发环境事件应急预案备案表	GXHB-2022-027-L	西安高新技术产业开发区行政审批服务局	2022.06.09	-
3	奕斯伟硅片	企业事业单位突发环境事件应急预案备案表	GXHB-2023-082-M	西安高新技术产业开发区行政审批服务局	2023.11.03	-
4	欣芯材料	企业事业单位突发环境事件应急预案备案表	GXHB-2023-072-M	西安高新技术产业开发区行政审批服务局	2023.09.28	-

（六）排水许可证

序号	公司	资质名称	证书编号	发证机构	发证时间	到期日期
1	奕斯伟硅片	城镇污水排入排水管网许可证	西高新排许字第 2022018 号	西安高新技术产业开发区城市管理和综合执法局	2022.06.02	2027.06.02
2	欣芯材料	城镇污水排入排水管网许可证	西高新排许字第 2024011 号	西安高新技术产业开发区农业农村和水务局	2024.10.14	2029.10.13